

苏州晶方半导体科技股份有限公司

China Wafer Level CSP Co., Ltd.

(苏州工业园区汀兰巷 29 号)



首次公开发行股票招股说明书

(申 报 稿)

声明：本公司的发行申请尚未得到证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

发行概况

发行股票类型：人民币普通股	每股面值：1.00 元
发行股数：6,317 万股	每股发行价格：【】 元
发行后总股本：25,267 万股	预计发行日期：【】 年 【】 月 【】 日
拟上市证券交易所：上海证券交易所	
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：	公司第一大股东 EIPAT 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司第二大股东中新创投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，自公司股票上市之日起六十个月后，每年转让直接持有的发行人股份不超过其所直接持有发行人股份总数的百分之二十五。 公司股东厚睿咨询、豪正咨询、晶磊有限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东 OmniH、英菲中新、泓融投资、德睿亨风、Gillad Galor 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员王蔚、陆健、黄福龙、段佳国、俞国庆、王文龙、刘宏钧、钱小洁、王卓伟承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
保荐人（主承销商）：	国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期：	2012 年 6 月 11 日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、本公司股东及董事、监事和高管人员直接或间接持股自愿锁定的承诺

本次发行前公司总股本 18,950 万股，本次拟发行 6,317 万股，发行后公司所有股份均为流通股。

公司第一大股东 EIPAT 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司第二大股东中新创投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，自公司股票上市之日起六十个月后，每年转让直接持有的发行人股份不超过其所直接持有发行人股份总数的百分之二十五。

公司股东厚睿咨询、豪正咨询、晶磊有限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东 OmniH、英菲中新、泓融投资、德睿亨风、Gillad Galor 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员王蔚、陆健、黄福龙、段佳国、俞国庆、王文龙、刘宏钧、钱小洁、王卓伟承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。

根据江苏省国有资产监督管理委员会 2011 年 3 月 10 日出具的苏国资复【2011】28 号《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》，中新创投所持发行人股份为国有股。2011 年 3 月 14 日，中新创投已按《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问

题的通知》取得了【2011】31号《财政部关于豁免中新苏州工业园区创业投资有限公司国有股转持义务有关问题的批复》。

二、本次发行完成前未分配利润的分配安排

2012年4月5日，经公司2011年度股东大会决议通过，截至2011年12月31日的可供分配利润为13,130.26万元，分配现金股利3,000万元，本次股利分配完成后产生的可供分配利润将由本次发行上市后的新老股东共享。

三、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定

（一）公司实行连续、稳定的利润分配原则，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）公司利润分配政策为：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会根据实际盈利状况和公司发展需要，以经审计后净利润的一定比例向全体股东进行分配，在每次定期报告中对利润分配方案进行详细披露，经股东大会批准后实施。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会未作出现金分配预案的，应当于定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（三）发行上市后三年内（含发行当年），公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策。”

四、发行人特别提醒投资者关注下列风险

（一）行业波动风险

本公司属于集成电路封装测试行业，主要业务是向集成电路设计与制造企业提供封装与测试服务，位于集成电路生产与应用的中间环节，与集成电路生产及应用环节紧密相连。如果集成电路应用行业或集成电路设计与制造行业的发展出现较大波动，将对集成电路封装与测试行业带来重大影响，因此本公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，全球半导体行业具有技术呈周期性发展、市场呈周期性波动的特点。2002 年到 2004 年，全球半导体行业处于高速增长阶段，2005 年出现了周期性回落，增长速度从 2004 年的 38% 下降到 6.8%，之后 2006 年和 2007 年增速一直保持较低的水平，2008 年和 2009 年受金融危机的影响，甚至出现了负增长，2010 年随着国家拉动内需政策的迅速制定与深入实施，以及国际市场环境的逐步好转，国内集成电路产业又步入高速发展阶段。虽然中国目前是新兴经济体，整体经济正处于快速发展阶段，宏观经济景气度远好于国际上大多数国家特别是发达国家，我国半导体行业目前还处在吸收和追赶国外先进技术阶段，发展速度较快，发展空间较大，但国内半导体行业也会受到全球半导体行业的周期性影响，从而会给公司的经营业绩带来一定负面影响。

（二）行业竞争加剧的风险

公司是中国大陆首家、全球第二大能用 WLCSP 量产技术封装影像传感芯片的专业封装测试服务商，但由于晶圆级封装测试产业市场前景广阔，可能会吸引众多投资者从事晶圆级封装测试业务。虽然本行业技术门槛很高，量产难度很大，但如果国内外某些企业成功突破了本行业技术门槛，能够运用 WLCSP 量产技术从事封装测试服务，导致本行业业务规模扩张过快，可能会加剧行业竞争，降低行业利润率。

上述风险都直接或间接影响公司的经营业绩，请投资者仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”及其他章节的相关资料，并特别关注上述风险的描述。

目 录

发行概况	2
发行人声明	3
重大事项提示	4
目 录	7
第一节 释 义	12
第二节 概 览	16
一、发行人概况	16
二、发行人控股股东与实际控制人简介	19
三、本次发行情况	19
四、募集资金主要用途	20
第三节 本次发行概况	21
一、发行人基本情况	21
二、本次发行的基本情况	21
三、本次发行有关当事人	22
四、发行人与本次发行有关中介机构的关系	23
五、与本次发行上市有关的重要日期	23
第四节 风险因素	24
一、行业波动和竞争风险	24
二、经营性风险	25
三、财务风险	25
四、募集资金投资项目风险	26
五、公司股权分散风险	27
六、股价波动风险	27
第五节 发行人基本情况	29
一、发行人的基本资料	29
二、发行人改制重组情况	31
三、发行人独立经营情况	33
四、发行人设立以来的股本形成情况	34

五、发行人历次验资情况	47
六、发行人的组织结构	50
七、发行人子公司及分公司情况	52
八、发起人、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	53
九、发行人股本情况	79
十、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或 股东数量超过二百人的情况	81
十一、发行人员工及其社会保障情况	81
十二、持有发行人 5% 以上股份的股东及作为股东的董事、监事及高管人员的 重要承诺	83
第六节 业务与技术	84
一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况	84
二、行业基本情况	84
三、公司在行业中的竞争地位	106
四、发行人主营业务情况	112
五、固定资产及无形资产	126
六、公司特许经营权	136
七、公司的生产技术	136
八、公司主要产品的质量控制情况	139
九、冠名“科技”的依据	140
第七节 同业竞争与关联交易	141
一、同业竞争	141
二、关联方与关联关系	146
三、关联交易	149
四、规范关联交易的制度安排	150
五、公司独立董事对关联交易事项的意见	154
第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员	155
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	155
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况	159

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况	160
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况	160
五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的关系及兼职情况	161
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、所作承诺及其履行情况	165
七、董事、监事与高级管理人员的任职资格	165
八、报告期内董事、监事与高级管理人员变动情况	165
第九节 公司治理结构	168
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况	168
二、董事会专门委员会的设置情况	172
三、报告期内违法违规行情况	173
四、报告期内对外担保和资金占用的情况	173
五、公司内部控制制度的情况	174
第十节 财务会计信息	176
一、最近三年经审计的财务报表	176
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	179
三、主要会计政策和会计估计	179
四、非经常性损益明细表	190
五、最近一期末主要固定资产及对外投资情况	191
六、最近一期末无形资产情况	192
七、最近一期末主要债项	192
八、股东权益变动情况	193
九、现金流量情况	193
十、财务报表附注中的或有事项、期后事项和其他重要事项	193
十一、最近三年的主要财务指标	194
十二、发行人历次资产评估情况	196
十三、发行人历次验资情况	197
第十一节 管理层讨论与分析	198

一、财务状况分析	198
二、盈利能力分析	207
三、现金流量分析	218
四、资本性支出	220
五、重大或有事项和期后事项	221
六、公司主要财务优势、财务困难以及盈利前景分析	221
七、股东未来分红回报分析	222
第十二节 业务发展目标	225
一、公司当前及未来两年目标发展计划	225
二、本公司拟定上述计划所依据的假设条件	227
三、本公司实施上述计划将面临的主要困难	228
四、本公司制订业务目标与现有业务的关系	228
五、本次募集资金对实现上述业务目标的作用	228
第十三节 募集资金运用	230
一、募集资金运用项目情况	230
二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系	231
三、募集资金投资项目的市场前景分析	232
四、募集资金投资项目的相关情况	236
五、募集资金运用对生产经营及财务状况的影响	239
第十四节 股利分配政策	241
一、发行前的股利分配政策	241
二、发行后的股利分配政策	242
三、公司成立以来实际股利分配情况	242
四、本次发行完成前未分配利润的分配政策	243
第十五节 其他重要事项	244
一、信息披露制度和投资者服务计划	244
二、报告期末正在履行的重要合同	244
第十六节 有关声明	245
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	245

二、保荐人（主承销商）声明	246
三、发行人律师声明	247
四、会计师事务所声明	248
五、资产评估机构声明	249
六、验资机构声明	251
第十七节 备查文件	255
一、备查文件内容	256
二、查阅地点和时间	256

第一节 释 义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

一、常用词语解释

晶方科技、股份公司、本公司、公司、发行人	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司
晶方有限、有限公司	指	晶方半导体科技（苏州）有限公司
公司章程	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
晶方北美	指	晶方半导体科技（北美）有限公司(OptiZ,Inc)，公司全资子公司
Shellcase	指	Shellcase Ltd. (后更名：Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.)
EIPAT	指	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.，公司目前第一大股东
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司，公司目前第二大股东
OmniH	指	OmniVision Holding (Hong Kong) Company Limited，豪威控股（香港）有限公司，公司目前第三大股东
OmniInternational	指	OmniVision International holding Ltd.，豪威国际控股有限公司，公司目前第三大股东 OmniH 的控股股东
OmniVision	指	OmniVision Technologies, Inc，豪威科技股份有限公司，美国上市公司，全球最大的影像传感器供应商，OmniInternational 的控股股东
OmniT	指	OmniVision Trading (Hong Kong) Company Limited，豪威贸易（香港）有限公司，公司目前第三大股东的兄弟公司
Omnitech	指	OmniVision Technologies (Hong Kong) Company Limited，豪威科技（香港）有限公司，公司目前第三大股东的兄弟公司
英菲中新	指	英菲尼迪-中新创业投资企业，公司目前第四大股东
厚睿咨询	指	苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司，员工持股公司，公司目前第五大股东
Gillad Galor	指	美籍自然人，公司目前第六大股东
豪正咨询	指	苏州豪正企业管理咨询有限公司，员工持股公司，公司目前第七大股东
泓融投资	指	苏州泓融投资有限公司，公司目前第八大股东
晶磊有限	指	晶磊有限公司，员工持股公司，公司目前第九大股东
德睿亨风	指	苏州德睿亨风创业投资有限公司，公司目前第十大股东
Tessera	指	Tessera Technologies, Inc.，美国上市公司，电子行业小型化技术供应商，2005 年 10 月取得 Shellcase 的 ShellOP、ShellOC 等晶圆级芯片尺寸封装技术的所有权。
精材科技	指	精材科技股份有限公司，台积电控股子公司，全球最大

		的 WLCSP 影像传感芯片封测服务商
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司，全球领先的集成电路制造服务公司
Galaxycore	指	格科微电子(香港)有限公司，公司目前第一大客户
BYD	指	BYD(HK)CO Ltd.，公司目前第三大客户，其母公司为上市公司比亚迪股份有限公司
Hynix	指	海力士半导体公司，韩国上市公司，全球十大半导体销量巨头之一，公司目前第二大客户
CNNIC	指	中国互联网络信息中心
园区国资	指	苏州工业园区国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上交所	指	上海证券交易所
本次发行	指	发行人本次发行 6,317 万股 A 股的行为
A 股	指	每股面值 1.00 元人民币之普通股
元、万元	指	人民币元、万元
新谢克尔	指	以色列货币单位
近三年、报告期	指	2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
保荐人（主承销商）	指	国信证券股份有限公司
华普天健	指	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
发行人律师、国浩律所	指	国浩律师（上海）事务所
江苏华星会计师事务所	指	江苏华星会计师事务所有限公司
江苏仁合评估	指	江苏仁合资产评估有限公司
江苏公证	指	江苏公证天业会计师事务所有限公司
园区国控	指	苏州工业园区国有资产控股发展有限公司
苏创集团	指	苏州创业投资集团有限公司
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
CSSD	指	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
中新置地	指	中新苏州工业园区置地有限公司
华亿创投	指	华亿创业投资管理（苏州）有限公司
园区经发	指	苏州工业园区经济发展有限公司
IDB	指	与以色列国家贴现银行

二、专业术语解释

封装	指	将通过测试的晶圆加工得到独立芯片的过程，保护电路芯片免受周围环境的影响（包括物理、化学的影响），起着保护芯片、增强导热（散热）性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以沟通芯片内部与外部电路的作用。
芯片	指	用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路。
晶圆	指	多指单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的半导体材料，按其直径分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸等规格，近来发展出 12 英寸甚至更大规格，目前以 8 英寸为主流。
IDM	指	集芯片设计、芯片制造、封装测试及产品销售于一体的集成器件制造商。
CMOS	指	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 的简写，由金属氧化物器件构成。

CCD	指	charge-coupled device 的简写，由光电耦合器件构成，用于光学成像。
微机电系统、MEMS	指	以微电子、微机械及材料科学为基础，研究、设计、制造具有特定功能的微型装置，常见的有压力传感器、加速度计、微陀螺仪。
LED	指	发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。
PVC	指	聚氯乙烯
WLCSP	指	Wafer level Chip size package 的缩写，晶圆级芯片尺寸封装。
WLP	指	Wafer level package 的缩写，晶圆级封装。
CSP	指	Chip size package 的缩写，芯片尺寸封装。
BGA	指	Ball grid array 的缩写，球栅阵列封装。
SiP	指	System-in-Package 的缩写，系统级封装。
DIP	指	Dual in-line package 的缩写，双列直插式封装。
PGA	指	Pin Grid Array 的缩写，阵列引脚封装。
SOP	指	Small Outline Package 的缩写，小外形封装。
PoP	指	Package-on-package 的缩写，层叠封装
PLCC	指	Plastic Leaded Chip Carrier 的缩写，带引线的塑料芯片载体（封装）。
PQFP	指	Plastic Quad Flat Package 的缩写，塑料四边引线扁平封装。
CLCC	指	Leadless Ceramic Chip Carrier 的缩写，无引线陶瓷芯片载体。
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的缩写，在集成电路界被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。
PQFN	指	Plastic Quad Flat Non-leaded package 的缩写，无引线四边扁平封装。
MCM	指	Multi-chip Module 的缩写，多芯片组件。
3D	指	三维立体封装
CCID	指	中国电子信息产业发展研究院
ShellOP	指	光学型晶圆级芯片尺寸封装技术
ShellOC	指	光学空腔型晶圆级芯片尺寸封装技术
ThinPac	指	超薄晶圆级芯片尺寸封装技术
TSV	指	硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术
PDA	指	掌上电脑
HUD	指	平视显示器
DLP	指	投影仪
RF 开关	指	射频开关
RFID	指	射频识别芯片

SEMI	指	国际半导体设备材料产业协会，创立于 1970 年，会员为从事半导体、平面显示、太阳能光伏、纳米科技、微电子机械系统等领域开发、生产和技术支持的公司。
iSuppli	指	全球领先的针对电子制造领域的市场研究公司，拥有庞大的数据库及专业分析师实时更新电子产业的相关信息。
Yole Développement	指	法国权威市场调研机构，专注于影像传感器、MEMS 等领域。

第二节 概 览

声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人概况

（一）发行人简要情况

本公司前身为晶方半导体科技（苏州）有限公司，成立于 2005 年 6 月 10 日。2010 年 7 月 6 日，晶方有限整体变更为股份公司，目前注册资本为人民币 18,950 万元。经营范围为：研发、生产、制造、封装和测试集成电路产品，销售本公司所生产的产品并提供相关的服务。

（二）发行人的主营业务

本公司主营业务为集成电路的封装测试业务，主要为影像传感芯片、环境光感应芯片、微机电系统（MEMS）、发光电子器件（LED）等提供晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）及测试服务。

公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封测服务商。公司拥有多样化的 WLCSP 量产技术，包括超薄晶圆级芯片尺寸封装技术（ThinPac）、光学型晶圆级芯片尺寸封装技术（ShellOP）、空腔型晶圆级芯片尺寸封装技术（ShellOC）、晶圆级凸点封装技术（RDL Wafer Bumping）、硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术（TSV），以及应用于微机电系统（MEMS）、发光电子器件（LED）的晶圆级芯片尺寸封装技术。

公司目前封装产品主要有影像传感芯片、环境光感应芯片、医疗电子器件、微机电系统（MEMS）、射频识别芯片（RFID）等，该些产品被广泛应用在消费电子（手机、电脑、照相机等）、医学电子、电子标签身份识别、安防设备等诸多领域。

公司在技术创新和产品开发上取得了较多成果，公司及其子公司已成功申请并获得国家知识产权局授权的专利共 19 项，另有 5 项美国发明专利， 并且还有 19 项发明专利正在受理中。

公司先后承担多项国家及省级科研项目，其中：“晶圆级封装关键技术研究”被科技部列入国际科技合作与交流专项基金；“晶圆级芯片尺寸封装技术在影像传感芯片中的开发和应用”被科技部列入国家火炬计划项目；“晶圆级芯片尺寸封装技术在影像传感芯片及 MEMS 中的开发和应用”被列入江苏省重大科技成果转化专项。

公司近年来因产品和技术获得了国家级以及重要单位评定的诸多荣誉，具体情况如下：

时间	荣誉名称	颁发单位
公司获得的国家级以及重要单位评定的荣誉		
2007 年 2 月	2006 年度苏州工业园区十佳科技创新小巨人	中共苏州工业园区工作委员会 苏州工业园区管理委员会
2007 年 3 月	2006 年度园区知识产权工作先进单位	苏州工业园区科技发展局 苏州工业园区知识产权局
2007 年 8 月	第一批国家鼓励的集成电路企业	国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局
2008 年 2 月	2007 年度中国最具成长性封装测试企业	中国半导体行业协会 中国电子信息产业发展研究院
2008 年 3 月	2007 年度苏州市技术进步一等奖	苏州市人民政府
2008 年 7 月	江苏省百家优秀科技成长型企业	江苏省科技企业孵化器协会
2008 年 9 月	高新技术企业	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、 江苏省国家税务局、江苏省地方税务局
2009 年 1 月	2008 年度江苏省科学技术进步三等奖	江苏省人民政府
2009 年 3 月	江苏省创新型企业	江苏省科学技术厅、江苏省国资委、 江苏省总工会、江苏省工商业联合会
2009 年 9 月	省级企业技术中心	江苏省经济和信息化委员会
2010 年 1 月	苏州市科学技术奖二等奖	苏州市人民政府
2010 年 1 月	第三批苏州市科技创新示范企业	苏州市人民政府
2010 年 4 月	2009 年度苏州工业园区 A 级劳动保障信用等级单位、苏州市劳动关系和谐企业	苏州工业园区劳动和社会保障局（苏州工业园区公积金管理局）
2010 年 10 月	苏州工业园区科技企业“双百工程”认定	苏州工业园区管理委员会
2010 年 12 月	江苏省晶圆级芯片封装测试工程技术研究中心	江苏省科学技术厅
2011 年 1 月	江苏省晶圆级芯片封装测试工程技术中心	江苏省科学技术厅
2011 年 4 月	2011 年江苏省重点工业投资项目	江苏省经济和信息化委员会
2011 年 5 月	“十一五”江苏省十大自主创新	江苏省科学技术厅
2011 年 6 月	江苏省创新成果奖	江苏省人民政府
2011 年 9 月	高新技术企业复审	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、 江苏省国家税务局、江苏省地方税务局
2011 年 12 月	2011 年苏州市创新先锋企业	苏州市人民政府
公司产品或技术所获得的国家级以及重要单位评定的荣誉		
2006 年 12 月	高新技术产品	江苏省科学技术厅
2007 年 12 月	国家重点新产品	中华人民共和国科学技术部

2008年2月	2007年中国半导体创新产品和技术	中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社
2009年6月	江苏省第四批自主创新产品	江苏省科学技术厅
2011年1月	第五届（2010年度）中国半导体创新产品和技术	中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报
2011年12月	江苏省重点技术创新项目	苏州市经济和信息化委员会

（三）发行人的主要财务数据

根据经华普天健审计的财务报告，本公司主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动资产	30,308.54	27,623.46	20,653.08
资产总计	59,797.66	48,625.58	40,152.41
流动负债	7,879.93	5,173.84	6,422.77
负债合计	7,879.93	5,173.84	7,422.77
归属于母公司股东权益	51,917.73	43,451.74	32,729.63
股东权益合计	51,917.73	43,451.74	32,729.63
负债及股东权益总计	59,797.66	48,625.58	40,152.41

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	30,611.99	27,068.00	13,884.88
营业利润	12,625.34	9,392.41	4,384.66
利润总额	12,971.38	10,043.11	5,606.51
净利润	11,468.35	9,074.24	5,090.72
归属于母公司股东的净利润	11,468.35	9,074.24	5,090.72
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	11,163.83	8,495.12	3,987.31

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	14,433.46	12,141.86	7,693.38
投资活动产生的现金流量净额	-9,818.65	-5,334.22	-1,432.96
筹资活动产生的现金流量净额	-4,044.86	-2,483.17	-155.27
现金及现金等价物净增加额	17.16	4,224.13	6,062.66
期末现金及现金等价物余额	21,948.05	21,930.89	17,706.76

4、主要财务指标

主要财务指标	2011 年度	2010 年度	2009 年度
流动比率	3.85	5.34	3.22
速动比率	3.65	5.01	3.12
资产负债率（母公司）（%）	13.10	10.60	18.49
应收账款周转率（次/年）	12.99	12.97	6.72
存货周转率（次/年）	8.39	11.48	11.34
息税折旧摊销前利润（万元）	15,879.14	12,901.07	8,373.55
归属于发行人股东的净利润（万元）	11,468.35	9,074.24	5,090.72
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	11,163.83	8,495.12	3,987.31
利息保障倍数	204.19	77.22	37.11
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.76	0.64	0.41
每股净现金流量（元/股）	0.0009	0.22	0.32
加权平均净资产收益率（%）	22.52	24.23	16.15
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益）（%）	21.92	22.68	12.65
基本每股收益（元/股）	0.61	0.50	-
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.50	-
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.74	2.29	1.84
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	-	-	-

二、发行人控股股东与实际控制人简介

发行人无实际控制人，主要股东为 EIPAT 和中新创投。截至本招股说明书签署日，EIPAT 和中新创投分别直接持有公司 35.27%和 29.05%的股份。有关两家公司的简要情况详见本招股书“第五节 发行人基本情况”之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。

三、本次发行情况

（一）本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00 元
发行股数	6,317 万股，占发行后总股本的 25.00%
每股发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
发行前每股净资产	2.74 元（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的归属母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）
发行方式	采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	主承销商余额包销
预计募集资金	约【 】亿元（扣除发行费用后）

（二）本次发行前后的股本结构

公司本次拟发行人民币普通股 6,317.00 万股，发行前后的股本结构如下：

项 目	发行前		发行后	
	股数（万股）	股份比例（%）	股数（万股）	股份比例（%）
有限售条件的股份	18,950.00	100.00	18,950.00	75.00
本次发行的股份	-	-	6,317.00	25.00
合 计	18,950.00	100.00	25,267.00	100.00

四、募集资金主要用途

本次募集资金拟投资“先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目”，募集资金投入总额为 66,735.96 万元。募集资金总额与项目募集资金拟投入额之间的资金缺口由公司自筹解决。募集资金超过项目募集资金拟投入额时，可补充流动资金需求。募集资金到位之前，公司可先自筹适当资金投入项目。

第三节 本次发行概况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称：苏州晶方半导体科技股份有限公司
- 2、英文名称：China Wafer Level CSP Co.,Ltd.
- 3、注册资本：人民币 189,500,000 元
- 4、实收资本：人民币 189,500,000 元
- 5、法定代表人：王蔚
- 6、成立日期：2005 年 6 月 10 日（有限公司）
2010 年 7 月 6 日（整体变更为股份公司）
- 7、公司住所：苏州工业园区汀兰巷 29 号
- 8、邮政编码：215026
- 9、联系电话：0512-67730001
- 10、传真号码：0512-67730808
- 11、互联网地址：<http://www.wlcsp.com>
- 12、电子信箱：frend@wlcsp.com
- 13、负责信息披露和投资关系的部门：董事会办公室
该部门负责人：段佳国
联系电话：0512-67730001

二、本次发行的基本情况

1、股票种类	人民币普通股（A 股）
2、每股面值	1.00 元
3、发行股数	6,317 万股，占发行后总股本的 25.00%
4、每股发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
5、市盈率	【 】倍（每股收益按照 2011 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6、发行前每股净资产	2.74 元（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的归属母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）
7、发行后每股净资产	【 】元（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的归属母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
8、市净率	【 】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
9、发行方式	采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

10、发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）	
11、承销方式	主承销商余额包销	
12、预计募集资金总额	约【 】亿元	
13、预计募集资金净额	约【 】亿元	
14、发行费用概算	承销保荐费用：	【 】万元
	律师费用：	【 】万元
	审计费用：	【 】万元
	发行手续费：	【 】万元

三、本次发行有关当事人

（一）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层

电话：0755—82130833

传真：0755—82130620

保荐代表人：杨鑫强 吴卫钢

项目协办人：薛兰婷

其他项目组成员：徐伟 刘凌云 葛体武 唐昕

（二）律师事务所：国浩律师（上海）事务所

法定代表人：倪俊骥

住所：上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 楼

电话：021—52341668

传真：021—52341670

经办律师：李辰 陈洋

（三）会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

法定代表人：肖厚发

住所：北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号

电话：0551-3475878

传真：0551-2652879

经办注册会计师：张全心 郑磊

（四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路 166 号

电话：021-38874800

传真：021-58754185

（五）保荐人（主承销商）收款银行：中国工商银行股份有限公司深圳市深港支行

户名：国信证券股份有限公司

账号：4000029119200021817

四、发行人与本次发行有关中介机构的关系

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人（主承销商）、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

五、与本次发行上市有关的重要日期

- 1、发行公告的刊登日期：【 】年【 】月【 】日
- 2、询价推介时间：【 】年【 】月【 】日～【 】年【 】月【 】日
- 3、定价公告的刊登日期：【 】年【 】月【 】日
- 4、申购日期和缴款日期：【 】年【 】月【 】日
- 5、股票上市日期：【 】年【 】月【 】

第四节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、行业波动和竞争风险

（一）行业波动风险

本公司属于集成电路封装测试行业，主要业务是向集成电路设计与制造企业提供封装与测试服务，位于集成电路生产与应用的中间环节，与集成电路生产及应用环节紧密相连。如果集成电路应用行业或集成电路设计与制造行业的发展出现较大波动，将对集成电路封装与测试行业带来重大影响，因此本公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，全球半导体行业具有技术呈周期性发展、市场呈周期性波动的特点。2002 年到 2004 年，全球半导体行业处于高速增长阶段，2005 年出现了周期性回落，增长速度从 2004 年的 38% 下降到 6.8%，之后 2006 年和 2007 年增速一直保持较低的水平，2008 年和 2009 年受金融危机的影响，甚至出现了负增长，2010 年随着国家拉动内需政策的迅速制定与深入实施，以及国际市场环境的逐步好转，国内集成电路产业又步入高速发展阶段。虽然中国目前是新兴经济体，整体经济正处于快速发展阶段，宏观经济景气度远好于国际上大多数国家特别是发达国家，我国半导体行业目前还处在吸收和追赶国外先进技术阶段，发展速度较快，发展空间较大，但国内半导体行业也会受到全球半导体行业的周期性影响，从而会给公司的经营业绩带来一定负面影响。

（二）行业竞争加剧的风险

公司是中国大陆首家、全球第二大能用 WLCSP 量产技术封装影像传感芯片的专业封装测试服务商，但由于晶圆级封装测试产业市场前景广阔，可能会吸引众多投资者从事晶圆级封装测试业务。虽然本行业技术门槛很高，量产难度很大，但如果国内外某些企业成功突破了本行业技术门槛，能够运用 WLCSP 量产技术从事封装测试服务，导致本行业业务规模扩张过快，可能会加剧行业竞争，降低行业利润率。

二、经营性风险

（一）客户集中的风险

报告期内，公司对前五大客户的销售收入金额分别为 13,379.51 万元、26,855.41 万元和 30,407.71 万元，占公司各期营业收入的比例分别为 96.36%、99.21%和 99.33%。虽然公司为大陆首家能使用 WLCSP 技术进行量产的公司，在细分行业内具有一定的议价能力和主导权，但由于公司客户集中度较高，如果公司与主要客户的合作发生摩擦，致使主要客户减少或终止与公司的合作，或主要客户自身经营发生困难，则将对公司的销售造成一定的不利影响。

（二）核心技术人员流失的风险

集成电路封装测试行业技术进步快、产品更新率高，研发技术人员的实力对公司的持续发展至关重要。经过多年的探索和积累，公司培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 94 名研发技术人员（占公司总员工 19.42%），该些技术人员掌握着本公司的核心技术。本公司已与这些技术人员签订了保密协议，并且实施了各项激励政策（如股权激励）以保持技术人员的稳定性，防止核心技术外流。但公司无法完全确保核心技术及研发技术人员的稳定性，从而会给公司的可持续发展带来风险。

（三）技术开发和更新不及时风险

发行人主要从事晶圆级芯片尺寸封装业务，晶圆级芯片尺寸封装是一种新兴的封装形式。晶圆级芯片尺寸封装的主要特点为“先封后切，封装后芯片与裸芯片尺寸基本一致”。与传统封装技术相比，晶圆级芯片尺寸封装具有尺寸小、重量轻、信息传输速度快等显著的外表优势和性能优势，是未来封装行业的发展趋势。集成电路封装行业技术发展较快，如果发行人不能掌握新的晶圆级芯片尺寸封装技术，开发出新产品满足客户需要，将无法进一步开拓市场，发行人将面临高盈利能力具有不可持续性的风险。

三、财务风险

（一）净资产收益率下降的风险

本次募集资金到位后，公司的净资产规模将在短时间内大幅增长，但是募集

资金投资项目需要一定的建设期，项目达产也需要一定的时间，预计本次发行后公司的净资产收益率与以前年度相比将会出现一定下滑。因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

（二）企业税收优惠政策变动风险

本公司 2008 年 9 月 24 日被认定为高新技术企业，有效期三年，所得税税率执行 15% 的税率。根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，本公司享受外商投资企业“两免三减半”的所得税优惠政策，本公司 2007 年至 2008 年免征缴纳所得税，2009 年至 2011 年减半缴纳所得税。按照《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》要求，2009 年执行 20% 减半即 10% 税率、2010 年执行 22% 减半即 11% 税率、2011 年执行 24% 减半即 12% 税率。

2011 年 9 月，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示 2011 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2011]13 号），本公司高新技术企业通过复审，认定有效期为 3 年（2011 年-2013 年），并经苏州工业园区国税局批准，本公司 2012 年、2013 年企业所得税执行 15% 税率。

如果 2014 年公司高新技术企业资格三年有效期满后未能通过重新认定，或国家税收法律、法规中相关规定发生不利于本公司的变化，发行人将面临无法继续享受相关企业所得税税率优惠的风险。

（三）汇率波动风险

公司产品绝大部分直接出口国外，主要以美元作为结算货币；原材料也大部分从国外采购，主要以美元和欧元作为结算货币。自 2005 年 7 月 21 日起我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币总体呈升值趋势，给出口型公司经营业绩带来一定影响。虽然发行人产品毛利率一直保持较高水平且有一定的议价能力，汇率的小幅波动对发行人业绩影响较小，但如果人民币汇率变动幅度较大，还是会对发行人业绩产生不利影响。

四、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金拟投资于“先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目”，公司为本次募投项目在技术工艺、市场开拓、人员安排等方面已经做了充分的准备，但是该投资项目是根据晶圆级芯片尺寸封装测试服务行业市场需求较大、公司现有业务发展态势良好以及技术储备充分的基础上拟定的，存在项目投产后市场情况变化达不到预期效果、发行人市场开拓不力等不确定性因素，从而使得本次募集资金投资项目实际经营成果与预测性财务信息可能存在一定差异。

（二）固定资产折旧大量增加影响未来业绩的风险

由于本次募集资金主要投向机器设备等固定资产，在募集资金投资项目建成后，公司将会每年增加大量固定资产折旧，如果募集资金投资项目不能产生预期收益，这将对公司未来效益造成一定压力。

五、公司股权分散风险

发行人前两大股东的持股比例分别为 35.27%、29.05%，无任何单一股东单独持股比例高于 50%；单一股东在公司董事会所占席位均未过半，无任何单一股东对董事会有实质影响；前两大股东在公司股东大会上的表决权均不超过 50%，无任何单一股东可以对公司决策形成实质性影响，公司股权比较分散，无实际控制人。

公司股权分散和无实际控制人可能会导致公司存在以下两个方面的风险：

第一，控制权发生变动的风险。公司全体股东均对其所持公司股份的锁定期限作出了承诺，保证了公司股权结构发行前以及上市后三十六个月内保持稳定，但不排除故意收购者通过恶意收购控制公司股权或其他原因而引致公司控制权发生变动的风险。

第二，内部人控制风险。公司股权结构分散，单一股东无法对公司经营决策进行控制，主要股东也不直接参与生产经营，公司如果缺乏健全的内部管理制度和内部控制制度，可能会导致直接参与企业战略决策以及从事具体生产经营决策的内部管理成员掌握企业的实际控制权，造成内部人控制风险。

六、股价波动风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，因此即使在本公司

经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

第五节 发行人基本情况

一、发行人的基本资料

（一）公司概况

- 1、注册中文名称：苏州晶方半导体科技股份有限公司
公司英文名称：China Wafer Level CSP Co.,Ltd.
- 2、注册资本：18,950 万元
- 3、法定代表人：王蔚
- 4、成立日期：2005 年 6 月 10 日（有限公司）
2010 年 7 月 6 日（股份公司）
- 5、公司住所：苏州工业园区汀兰巷 29 号
- 6、邮政编码：215026
- 7、电话号码：0512-67730001
- 8、传真号码：0512-67730808
- 9、互联网网址：<http://www.wlcsp.com>
- 10、电子信箱：frend@wlcsp.com

（二）主要荣誉

1、本公司获得的国家级以及重要单位评定的荣誉

2007 年 2 月，本公司被中共苏州工业园区工作委员会、苏州工业园区管理委员会联合评为“2006 年度苏州工业园区十佳科技创新小巨人”。

2007 年 3 月，本公司被苏州工业园区科技发展局、苏州工业园区知识产权局联合评为“2006 年度园区知识产权工作先进单位”。

2007 年 8 月，本公司被国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局联合评为“第一批国家鼓励的集成电路企业”。

2007 年 8 月，本公司被江苏省科学技术厅评为“高新技术企业”，有效期二年；

2008 年 2 月，本公司被中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究

院联合评为“2007 年度中国最具成长性封装测试企业”。

2008 年 3 月，本公司因影像传感芯片的晶圆级芯片尺寸封装技术荣获苏州市人民政府颁发的“2007 年度苏州市技术进步一等奖”；2010 年 1 月，本公司因双层线路晶圆级芯片尺寸封装技术开发及产业化荣获苏州市人民政府颁发的“苏州市科学技术奖二等奖”；2010 年 1 月 18 日，本公司被苏州市人民政府评为“第三批苏州市科技创新示范企业”。

2008 年 7 月，本公司被江苏省科技企业孵化器协会评为“江苏省百家优秀科技成长型企业”。

2008 年 9 月，本公司再次被江苏省科学技术厅评为“高新技术企业”，有效期三年；

2009 年 1 月，本公司因影像传感器的晶圆级芯片尺寸封装技术被江苏省人民政府表彰为“2008 年度江苏省科学技术进步三等奖”。

2009 年 3 月，本公司被江苏省科学技术厅、江苏省国资委、江苏省总工会、江苏省工商业联合会联合认定为“江苏省创新型企业”。

2009 年 9 月，本公司被江苏省经济和信息化委员会认定为“省级企业技术中心”。

2010 年 1 月，本公司被苏州市人民政府评为“苏州市科学技术二等奖”、“第三批苏州市科技创新示范企业”。

2010 年 4 月，本公司被苏州工业园区劳动和社会保障局（苏州工业园区公积金管理局）评为“2009 年度苏州工业园区 A 级劳动保障信用等级单位”及“苏州市劳动关系和谐企业”。

2010 年 10 月，本公司通过苏州工业园区科技企业“双百工程”认定。

2010 年 12 月，本公司被江苏省科学技术厅认定为“江苏省晶圆级芯片封装测试工程技术研究中心”技改项目承办单位。

2011 年 1 月，本公司被江苏省科学技术厅评为“江苏省晶圆级芯片封装测试工程技术中心”。

2011 年 4 月，本公司被江苏省经济和信息化委员会列入“2011 年江苏省重点工业投资项目”。

2011 年 5 月，本公司被江苏省科学技术厅评为“十一五”江苏省十大自主创新企业。

2011年6月，本公司被江苏省人民政府评为“江苏省创新成果奖”。

2011年9月，本公司通过第一批高新技术企业复审，被江苏省科学技术厅、财政厅、国税局及地税局联合认定为江苏省2011年高新技术企业，有效期三年。

2011年12月，本公司被苏州市人民政府评为“2011年苏州市创新先锋企业”。

2、本公司产品及技术所获得的国家级以及重要单位评定的荣誉

2006年12月，本公司的晶圆级芯片尺寸封装产品被江苏省科学技术厅评为“高新技术产品”，有效期五年。

2007年12月，本公司晶圆级封装的影像传感器芯片 WLCSP-OC-I 被科学技术部评为“国家重点新产品”，有效期三年。

2008年2月，本公司的影像传感芯片及 MEMS 的圆片级尺寸封装技术被中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社联合评为“2007年中国半导体创新产品和技术”。

2009年6月，本公司的影像传感器晶圆级芯片尺寸封装产品被江苏省科技厅评为“江苏省第四批自主创新产品”。

2011年1月，本公司的“双层线路晶圆级芯片尺寸封装技术”被中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报共同评选为第五届（2010年度）中国半导体创新产品和技术。

2011年12月，本公司的“硅基板高功率 LED 的晶圆级封装”被苏州市经济和信息化委员会列入“2011年江苏省重点技术创新项目”。

二、发行人改制重组情况

（一）发行人设立方式

本公司系由晶方半导体科技（苏州）有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司，公司以截至2010年4月30日经审计净资产人民币345,130,259.15元为基数，按1:0.5215比例折合股本180,000,000股，每股面值1元，共计股本金180,000,000元，剩余165,130,259.15元计入资本公积。2010年6月2日，苏州工业园区管理委员会出具了《关于同意晶方半导体科技（苏州）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（苏园管复部委资审

[2010]107 号) 批准晶方有限整体变更为股份公司。2010 年 6 月 7 日, 本公司取得江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2010]59180 号)。2010 年 7 月 6 日, 本公司取得江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》, 注册号 320594400012281, 注册资本人民币 18,000 万元。

(二) 发起人

本公司设立时, 各发起人的持股情况如下:

发起人名称	持股数量(股)	占比(%)	股权性质
EIPAT	66,844,336	37.14	外资股
中新创投	55,048,276	30.58	国有股
OmniH	35,388,178	19.66	外资股
英菲中新	15,728,079	8.74	其他
Gillad Galor	4,128,621	2.29	外资股
泓融投资	1,908,602	1.06	一般法人股
德睿亨风	953,908	0.53	一般法人股
合 计	180,000,000	100.00	-

注: 因英菲中新为非法人企业, 其持有发行人的股权性质为“其他”。

(三) 发行人改制设立前后, 主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人改制设立时, 持股 5% 以上的主要发起人为 EIPAT、中新创投、OmniH 及英菲中新, 分别持有公司 37.14%、30.58%、19.66%、8.74% 的股权。EIPAT 目前无实际经营业务, 拥有的主要资产为对本公司的长期股权投资; 中新创投主要业务系对外股权投资, 其拥有的主要资产为所投资企业的股权; OmniH 是全球最大的 CMOS 影像传感器供应商 OmniVision 在香港设立的子公司, 主要业务系对外股权投资, 其拥有的主要资产除持有本公司股权外, 还持有豪威科技(上海)有限公司; 英菲中新的主要业务系对外股权投资, 其拥有的主要资产为所投资企业的股权。在改制设立发行人前后, 主要发起人的资产状况和实际从事的主要业务均未发生重大变化。

(四) 发行人成立前后拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司整体变更设立时拥有的全部资产为变更设立股份公司时承继的晶方有限整体资产。公司自设立以来一直从事集成电路产品的封装测试服务, 在设立股

份公司前后，其主要业务、经营模式和业务流程均未发生重大变化，主要业务与流程参见“第六节 业务与技术”相关内容。

（五）发行人成立前后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

自 2005 年公司设立以来，第一大股东 EIPAT 为发行人提供晶圆级芯片尺寸封装 ShellOP 和 ShellOC 技术的授权，发行人每年需向其缴纳一定数额的技术使用权利金。

（六）发起人出资资产的产权变更

本公司由晶方半导体（苏州）科技有限公司依法整体变更设立，承继了有限公司的全部资产、负债、权益。截至本招股说明书签署日，发行人已完成了所有资产的产权变更手续。

三、发行人独立经营情况

本公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司主营业务为集成电路封装测试服务，公司已建立了较为完整的职能部门架构，拥有独立的采购、生产、销售和研发系统，能够独立开展业务。公司目前与第一大股东 EIPAT 的技术授权，以及过去与第三大股东兄弟公司 Omnitech 的关联销售，完全系市场化的交易行为，对于双方都具有经济合理性，对公司的业务独立性不存在影响。

（二）资产完整

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人股东及其他关联方之间资产相互独立，其资产具有完整性。

（三）人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

（四）机构独立

根据公司章程、公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权。公司建立了完善的组织机构，生产、办公场所与股东单位的办公机构及生产经营场所分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立

公司设立后，已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。

四、发行人设立以来的股本形成情况

（一）发行人设立背景和投资设立的主导方

公司系在 21 世纪初中国政府与以色列紧密合作的大背景下，由王蔚为主导方，撮合 Shellcase、中新创投、英菲中新三方投资设立。

20 世纪 90 年代，以色列高科技封装公司 Shellcase（后更名为 EIPAT）成功开发了 ShellOP 和 ShellIOC 等晶圆级芯片尺寸封装技术，并在以色列开设工厂，但由于经营管理不善，一直处于亏损状态。Shellcase 第一大股东 Infinity 集团是以色列最大、最有影响力的企业 IDB 控股公司与以色列基金管理人 Amir Galor 先生、Avishai Silvershatz 先生等共同成立的创业基金管理机构，管理着众多科技公司投资组合和创业基金投资组合。

鉴于中国经济的快速发展，高科技产业链的日趋形成，Infinity 集团一直积极在中国寻找投资与合作机会。2005 年 4 月，Infinity 集团旗下基金与中新创投、

华亿创投以及园区科发共同成立了国内第一家非法人制中外合作创业投资基金英菲中新。

基于上述背景，晶方科技现任董事长兼总经理王蔚看好 ShellOP 和 ShellOC 这两项技术的前瞻性和唯一性，同时，2005 年我国消费类电子产品市场发展迅速，王蔚认为轻、小、短、薄化是消费类电子产品发展的必然趋势，晶圆级封装技术能够在照相机及数码摄像等应用领域实现突破，并实现量产。由于苏州工业园区的半导体产业链集中，可为以色列技术与中国制造产业相互结合提供一个良好的产业环境，王蔚建议 Shellcase 在苏州工业园区投资设立晶圆级封装厂。2005 年 6 月，在王蔚的撮合下 Shellcase、中新创投、英菲中新在苏州工业园区共同投资设立了发行人，由王蔚担任总经理负责公司组建、日常经营管理等相关事宜。

（二）股份公司设立以前的股权结构变化情况

发行人设立以来历次股本变动情况如下图所示：



1、晶方有限的设立，注册资本 1,000 万美元

2005 年 4 月 29 日，中新创投、英菲中新及 Shellcase 签订《合作意向书》，在苏州市苏州工业园区共同投资建立中外合作企业，随后三方共同签署的合资合同和公司章程约定：公司注册资本为 1,000 万美元，其中中新创投出资 500 万美元，占注册资本的 50%；英菲中新出资 400 万美元，占注册资本的 40%；Shellcase 以设备出资 100 万元，占注册资本的 10%。

2005 年 6 月 3 日，苏州工业园区经济贸易发展局下发《苏州工业园区总投资三千万美元以下外商投资企业设立、变更登记备案表》（苏园经登字[2005]125

号)，同意中新创投、英菲中新与 Shellcase 合作设立晶方有限。

2005 年 6 月 8 日，江苏省人民政府核发《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2005]59180 号），批准中新创投、英菲中新与 Shellcase 合作设立晶方有限。

2005 年 6 月 10 日，晶方半导体科技（苏州）有限公司在江苏省苏州工业园区工商行政管理局进行了注册登记，注册资本为 1,000 万美元，企业类型为中外合作经营企业，法定代表人为费建江，住所为苏州工业园区星龙街 428 号苏春工业坊 11 号 C 单元，经营范围为研发、生产、制造、封装集成电路产品，销售本公司所生产的产品并提供相关的服务。

公司设立时，各股东的出资比例如下：

股东名称	认缴出资额（万美元）	占注册资本比例
中新创投	500.00	50.00%
英菲中新	400.00	40.00%
Shellcase	100.00	10.00%
合计	1,000.00	100.00%

（1）首期出资

江苏华星会计师事务所对中新创投以人民币折合 500 万美元的出资进行了审验，并于 2005 年 7 月 14 日出具了华星会验资字（2005）第 0289 号《验资报告》，验证出资到位。

2005 年 8 月 16 日，晶方有限取得新的营业执照，注册资本 1,000 万美元，实收资本 500 万美元，累计注册资本实收情况如下：

股东名称	实缴出资		认缴出资	
	金额（万美元）	占注册资本比例	金额（万美元）	占注册资本比例
中新创投	500.00	50.00%	500.00	50.00%
英菲中新	0.00	0.00%	400.00	40.00%
Shellcase	0.00	0.00%	100.00	10.00%
合计	500.00	50.00%	1000.00	100.00%

（2）第二期出资

江苏华星会计师事务所对英菲中新以货币资金 400 万美元的出资进行了审验，并于 2005 年 8 月 15 日出具了华星会验资字（2005）第 0327 号《验资报告》，验证出资到位。

2006 年 6 月 22 日，晶方有限取得新的营业执照，注册资本 1,000 万美元，实收资本 900 万美元，累计注册资本实收情况如下：

股东名称	实缴出资		认缴出资	
	金额（万美元）	占注册资本比例	金额（万美元）	占注册资本比例
中新创投	500.00	50.00%	500.00	50.00%
英菲中新	400.00	40.00%	400.00	40.00%
Shellcase	0.00	0.00%	100.00	10.00%
合计	900.00	90.00%	1,000.00	100.00%

（3）第三期出资

2006年9月30日，苏州检验检疫局对股东 Shellcase 用于出资的设备进行了鉴定，并出具《委托价值鉴定报告》（编号：320020016900120），确定股东 Shellcase 用于出资的设备鉴定价值为 100 万美元。

江苏华星会计师事务所对 Shellcase 以价值 100 万美元设备缴纳的出资进行了审验，并于 2006 年 12 月 5 日出具了华星会验资字（2006）第 0387 号《验资报告》，验证出资到位。

晶方有限设立时适用《中外合作经营企业法（2000 年修正）》并未要求中外合作企业的合作外方的投资和合作条件需要进行评估。根据《江苏省外商投资财产价值鉴定条例》规定，鉴定机构出具的价值鉴定证书是证明外商投资财产价值量的有效依据，会计师事务所等验资机构必须依据价值鉴定证书办理外商投资财产的验资；价值鉴定结论与原作价不一致的，以鉴定结论为准。

晶方有限在设立时已委托苏州出入境检验检疫局对外方股东的投资财产进行价值鉴定，机器设备的作价与价值鉴定的结论不存在差异并以价值鉴定的结论作为验资的依据。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：晶方有限设立时未聘请专业资产评估机构对外方股东 Shellcase 用于出资的机器设备进行评估未违反当时生效的法律法规的规定，以苏州出入境检验检疫局出具的价值鉴定结论作为验资的依据符合江苏省地方性法规的规定，不存在出资不实的情况。

2006 年 12 月 29 日，晶方有限取得新的营业执照，注册资本 1,000 万美元，实收资本 1,000 万美元，累计注册资本实收情况如下：

股东名称	实缴出资		认缴出资	
	金额（万美元）	占注册资本比例	金额（万美元）	占注册资本比例
中新创投	500.00	50.00%	500.00	50.00%
英菲中新	400.00	40.00%	400.00	40.00%
Shellcase	100.00	10.00%	100.00	10.00%
合计	1,000.00	100.00%	1000.00	100.00%

2、晶方有限企业类型变更

2006年12月25日，经晶方有限董事会决议通过，晶方有限的企业类型由中外合作经营企业变更为中外合资经营企业。

2006年12月28日，苏州工业园区经济贸易发展局下发了《苏州工业园区总投资三千万美元以下外商投资企业设立、变更登记备案表》（苏园经登字[2006]302号），批准上述变更。

2006年12月28日，江苏省人民政府核发了《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2006]59180号），批准上述变更。

2006年12月29日，晶方有限取得新的营业执照，企业类型为中外合资经营企业。

3、晶方有限第一次增资，注册资本增至 1,750 万美元

根据有限公司设立时中新创投、英菲中新及 Shellcase 签订的《公司章程》和《中外合作经营合同》，Shellcase 需给予发行人 500 万美元含债转股条款的无息贷款。2005年8月18日，Shellcase 与晶方半导体科技（苏州）签订了《五百万美元贷款协议》，协议对贷款金额、贷款用途、贷款发放的前提条件、偿还和提前还款以及债权转股权作出了约定。2005年9月19日，Shellcase 将 500 万美元的外债汇入晶方有限银行账户，中国银行苏州工业园区支行出具了债务编号为 200532050050202001 的银行凭证。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：晶方有限向 Shellcase 借入 500 万美元的借款系双方真实意思的表示，并且该等外债已根据我国法律法规的有关规定进行了外债登记，该等外债真实有效。

Shellcase 向晶方科技提出债权转股权要求，2006年12月27日，经晶方有限董事会决议通过，晶方有限注册资本由 1,000 万美元增至 1,750 万美元，新增注册资本由股东 Shellcase 出资：其中 250 万美元为货币资金出资，500 万美元为 Shellcase 对晶方有限的债权出资。

2007年1月11日，苏州工业园区管委会下发了《关于晶方半导体科技（苏州）有限公司增资的批复》（苏园管复字[2007]9号），同意上述增资。

2007年1月18日，江苏省人民政府核发了《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2007]59180号），批准上述增资。

(1) 第一期出资

江苏华星会计师事务所对 Shellcase 以 500 万美元债权出资的情况进行了审验，并于 2007 年 2 月 5 日出具了华星会验资字（2007）第 0032 号《验资报告》，验证出资到位。

2007 年 2 月 13 日，晶方有限取得了新的营业执照，注册资本 1,750 万美元，实收资本 1,500 万美元，累计注册资本实收情况如下：

股东名称	实缴出资		认缴出资	
	金额（万美元）	占注册资本比例	金额（万美元）	占注册资本比例
中新创投	500.00	28.57%	500.00	28.57%
英菲中新	400.00	22.86%	400.00	22.86%
Shellcase	600.00	34.29%	850.00	48.57%
合计	1,500.00	85.71%	1750.00	100.00%

(2) 第二期出资

江苏华星会计师事务所对 Shellcase 以 250 万美元货币现金出资的情况进行了审验，并于 2008 年 10 月 22 日出具了华星会验字（2008）第 0042 号《验资报告》，验证出资到位。

2008 年 11 月 4 日，晶方有限取得了新的营业执照，注册资本 1,750 万美元，实收资本 1,750 万美元，累计注册资本实收情况如下：

股东名称	实缴出资		认缴出资	
	金额（万美元）	占注册资本比例	金额（万美元）	占注册资本比例
中新创投	500.00	28.57%	500.00	28.57%
英菲中新	400.00	22.86%	400.00	22.86%
Shellcase	850.00	48.57%	850.00	48.57%
合计	1,750.00	100.00%	1,750.00	100.00%

4、晶方有限第一次股权转让及第二次增资，注册资本增至 2,252.5 万美元

2007 年 3 月 27 日，经晶方有限董事会决议通过，股东英菲中新将其持有的晶方有限 11.43% 的股权计 200 万美元出资以 400 万美元的价格转让给 OmniT，双方于 2007 年 4 月 6 日签订了《股权转让协议》。同时，晶方有限注册资本由 1,750 万美元增至 2,252.50 万美元，其中中新创投以人民币折合 300 万美元认购公司新增注册资本 200 万美元；OmniT 以货币出资 500 万美元认购公司新增注册资本 250 万美元；美籍 Gillad Galor 先生以货币出资 52.50 万美元认购公司新增注册资本 52.50 万美元。

2007 年 4 月 14 日，苏州工业园区管理委员会下发了《关于晶方半导体科技（苏州）有限公司增资及股权转让的批复》（苏园管复字[2007] 59 号文），同

意上述增资及股权转让。

2007年4月16日，江苏省人民政府核发了《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2007]59180号），批准上述增资及股权转让。

（1）第一期出资

中新创投以人民币折合 300 万美元增资，其中 200 万美元作为实收资本，100 万美元计入资本公积；OmniT 以 500 万美元增资，其中 250 万美元作为实收资本，250 万美元计入资本公积。江苏华星会计师事务所对新增注册资本缴纳情况进行了审验，并于 2007 年 5 月 10 日出具了华星会验资字（2007）第 0148 号《验资报告》，验证出资到位。

股东名称	实缴出资		认缴出资	
	金额（万美元）	占注册资本比例	金额（万美元）	占注册资本比例
中新创投	700.00	31.08%	700.00	31.08%
英菲中新	200.00	8.88%	200.00	8.88%
Shellcase	600.00	26.64%	850.00	37.74%
OmniT	450.00	19.98%	450.00	19.98%
Gillad Galor	0.00	0.00%	52.50	2.33%
合计	1,950.00	86.57%	2,252.50	100.00%

（2）第二期出资

EIPAT 以 250 万美元货币资金出资、美籍自然人 Gillad Galor 先生以 52.50 万美元货币现金出资，江苏华星会计师事务所对新增注册资本缴纳情况进行了审验，并于 2008 年 10 月 22 日出具了华星会验字（2008）第 0042 号《验资报告》，验证出资到位。

2008 年 11 月 4 日，晶方有限取得新的营业执照，注册资本 2,252.50 万美元，实收资本 2,252.50 万美元，累计注册资本实收情况如下：

股东名称	实缴出资		认缴出资	
	金额（万美元）	占注册资本比例	金额（万美元）	占注册资本比例
中新创投	700.00	31.08%	700.00	31.08%
英菲中新	200.00	8.88%	200.00	8.88%
Shellcase	850.00	37.74%	850.00	37.74%
OmniT	450.00	19.98%	450.00	19.98%
Gillad Galor	52.50	2.33%	52.50	2.33%
合计	2,252.50	100.00%	2,252.50	100.00%

5、晶方有限第二次股权转让及股东名称变更

2007 年 11 月 14 日，经晶方有限董事会决议通过，股东 OmniT 与其兄弟公司 OmniH 签订《股权转让协议》，将其持有的晶方有限 19.98% 的股权计 450 万

美元出资以 900 万美元的价格转让给 OmniH。

2007 年 12 月 28 日，苏州工业园区管委会下发《关于晶方半导体科技（苏州）有限公司股权转让及股东名称变更的批复》（苏园管复字[2007]293 号），同意上述股权转让，并同意晶方有限股东 Shellcase 名称变更为 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.。

2007 年 12 月 29 日，江苏省人民政府核发了《外商投资企业批准证书》（商外资苏府字[2007]59180 号），同意上述股权转让及股东名称变更。

2008 年 1 月 28 日，晶方有限取得新的营业执照，累计注册资本实收情况如下：

股东名称	实缴出资		认缴出资	
	金额（万美元）	占注册资本比例	金额（万美元）	占注册资本比例
中新创投	700.00	31.08%	700.00	31.08%
英菲中新	200.00	8.88%	200.00	8.88%
EIPAT	600.00	26.64%	850.00	37.74%
OmniH	450.00	19.98%	450.00	19.98%
Gillad Galor	0.00	0.00%	52.50	2.33%
合 计	1,950.00	86.58%	2,252.50	100.00%

6、晶方有限第三次增资，注册资本增至 2,288.90 万美元

公司拟整体变更为股份有限公司，根据《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》第六条：“以发起方式设立的公司，除应符合《公司法》规定的发起人的条件外，其中至少有一个发起人应为外国股东”，《公司法》第七十九条：“设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所”。截至 2009 年 12 月 31 日，晶方有限的股东为中新创投、英菲中新、EIPAT、OmniH、Gillad Galor，其中中新创投、英菲中新在中国境内有住所，未达到过半数的要求，因此公司拟引进两名国内财务投资者以满足在中国境内有住所的发起人过半数的要求。

公司拟通过增资入股的方式引进国内财务投资者苏州泓融投资有限公司、苏州德睿亨风创业投资有限公司，公司就增资事宜委托江苏仁合资产评估有限公司以 2009 年 12 月 31 日为基准日对晶方有限股东全部权益价值进行评估。江苏仁合资产评估有限公司于 2010 年 4 月 7 日出具了苏仁评报字（2010）第 57 号《评估报告》，以 2009 年 12 月 31 日为评估基准日，晶方有限全部股东权益按照收益法评估，评估价值为 51,229.93 万元。

2010年4月21日，晶方有限董事会决议通过：公司注册资本由2,252.50万美元增至2,288.90万美元，泓融投资、德睿亨风以收益法评估值为增资的定价依据，以836.60万元认缴新增注册资金36.40万美元（折合人民币约248.48万元），其中：泓融投资以货币出资557.73万人民币，认购公司新增注册资本24.27万美元；德睿亨风以货币出资278.87万人民币，认购公司新增注册资本12.13万美元，出资额与新增注册资本之间的差额计入公司资本公积。

2010年4月23日，苏州工业园区管委会下发了《关于晶方半导体科技（苏州）有限公司增资、股权变更的批复》（苏园管复字2010第49号），同意上述增资。

2010年4月23日，江苏省人民政府核发了《外商投资企业批准证书》（商外资苏府字[2010]59180号），同意上述增资。

江苏华星会计师事务所对本次增资事项业已审验，并于2010年4月26日出具了华星会验资字（2010）第0086号《验资报告》，验证出资到位。

2010年4月28日，晶方有限取得了新的营业执照，注册资本2,288.90万美元，实收资本2,288.90万美元，累计注册资本实收情况如下：

股东名称	实缴出资		认缴出资	
	金额（万美元）	占注册资本比例	金额（万美元）	占注册资本比例
中新创投	700.00	30.58%	700.00	30.58%
英菲中新	200.00	8.74%	200.00	8.74%
EIPAT	850.00	37.14%	850.00	37.14%
OmniH	450.00	19.66%	450.00	19.66%
Gillad Galor	52.50	2.29%	52.50	2.29%
泓融投资	24.27	1.06%	24.27	1.06%
德睿亨风	12.13	0.53%	12.13	0.53%
合 计	2,288.90	100.00%	2,288.90	100.00%

（三）股份公司设立时的股本情况

2010年5月18日，经晶方有限董事会决议通过，晶方有限以2010年4月30日为审计基准日整体变更为股份公司。根据华普天健出具的会审字[2010]3851号《审计报告》，公司以截至2010年4月30日经审计的净资产人民币345,130,259.15元为基数，按1:0.5215比例折合股本180,000,000股，每股面值1元，共计股本金180,000,000元，剩余净资产165,130.259.15元作为资本公积。华普天健对本次整体变更进行了审验，并于2010年6月17日出

具了会验字[2010]3889号《验资报告》，验证出资到位。

2010年6月2日，苏州工业园区管理委员会下发《关于同意晶方半导体科技（苏州）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（苏园管复部委资审[2010]107号），同意晶方有限整体变更为股份公司。

2010年6月7日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2010]59180号），批准晶方有限整体变更为股份公司。

2010年7月6日，公司在江苏省工商行政管理局注册登记成立，取得注册号为320594400012281的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时，各发起人所认购股份和持股比例如下：

发起人名称	认购股份（股）	占注册资本比例	股权性质
EIPAT	66,844,336	37.14%	外资股
中新创投	55,048,276	30.58%	国有股
OmniH	35,388,178	19.66%	外资股
英菲中新	15,728,079	8.74%	其他
Gillad Galor	4,128,621	2.29%	外资股
泓融投资	1,908,602	1.06%	一般法人股
德睿亨风	953,908	0.53%	一般法人股
合 计	180,000,000	100.00%	-

（四）股份公司设立以后的股权结构变化

1、员工持股公司对发行人增资

为增强发行人团队稳定性，提高员工工作积极性，发行人拟让引入员工持股公司通过增资入股的方式成为公司股东。员工持股公司的参与人员包括公司副科（含技术职称相当于副科）以上且入职超过两年（含两年）的员工，特殊情况需要参加的，由总经理办公会讨论决定并报董事会备案。公司决定由员工设立一个境外公司“晶磊有限”、两个境内有限公司“厚睿咨询”和“豪正咨询”对公司增资。

发行人就增资事宜委托江苏仁合资产评估有限公司以2010年4月30日为基准日对发行人股东全部权益价值进行评估。江苏仁合资产评估有限公司于2010年5月25日出具了苏仁评报字（2010）第149号《评估报告》：以2010年4月30日为评估基准日，发行人全部股东权益按照收益法评估，评估价值为53,155.89万元。

2010年9月19日，经公司股东大会决议通过，公司注册资本由18,000万

元增加至 18,950 万元，由员工持股公司以略高于净资产评估值 53,155.89 万元的 90%（即 47,880 万元）作为增资的定价依据，增资价格为 2.66 元/股。其中：晶磊有限以折合人民币 329.84 万元认购公司新增注册资本 124 万元；厚睿咨询以人民币 1,190.35 万元认购新增注册资本 447.50 万元；豪正咨询以人民币 1,006.81 万元认购新增注册资本 378.50 万元，出资额与新增注册资本之间的差额计入公司资本公积。

2010 年 9 月 19 日，苏州工业园区管理委员会出具了苏园管复部委资审[2010]166 号《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司增资、股权变更、注册地址变更的批复》，同意上述增资事项。同日，江苏省人民政府核发《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2010]59180 号）。

2010 年 9 月 21 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司对本次增资事项进行审验，并出具了苏公 S[2010]B018 号《验资报告》。

2010 年 9 月 27 日，公司取得了新的营业执照，注册资本 18,950 万元人民币，实收资本 18,950 万元人民币，累计注册资本实收情况如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		持股数量（股）	股权比例	持股数量（股）	股权比例
1	EIPAT	66,844,336	37.14%	66,844,336	35.27%
2	中新创投	55,048,276	30.58%	55,048,276	29.05%
3	OmniH	35,388,178	19.66%	35,388,178	18.68%
4	英菲中新	15,728,079	8.74%	15,728,079	8.30%
5	Gillad Galor	4,128,621	2.29%	4,128,621	2.18%
6	泓融投资	1,908,602	1.06%	1,908,602	1.01%
7	德睿亨风	953,908	0.53%	953,908	0.50%
8	厚睿咨询	-	-	4,475,000	2.36%
9	豪正咨询	-	-	3,785,000	2.00%
10	晶磊有限	-	-	1,240,000	0.65%
合 计		180,000,000	100.00%	189,500,000	100.00%

2010 年 10 月 2 日，中新创投向公司出具了《关于提议调整员工持股公司增资定价依据的函》，鉴于中新创投就晶方科技员工持股公司增资事项在园区国资委办理备案的过程中，园区国资对于本次增资价格提出疑义，建议晶方科技员工持股公司增资价格不低于晶方科技以 2010 年 4 月 30 日为基准日按收益法评估每股净资产的评估值，不足部分由晶磊有限、厚睿咨询、豪正咨询追加投资。

2010 年 10 月 28 日，公司股东大会审议通过《关于调整员工增资价格的议案》，将本次员工持股公司的增资价格调整为 53,280 万元，略高于以 2010 年 4 月 30 日为基准日的净资产评估值。根据该定价依据，同意晶磊有限追加投资

37.20 万元，厚睿咨询追加投资 134.25 万元，豪正咨询追加投资 113.55 万元，上述追加投资合计 285 万元，全部计入公司资本公积金，公司注册资本和各股东的股权比例不变。

2010 年 11 月 9 日，苏州工业园区管理委员会出具了苏园管复部委资审[2010]215 号《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司增资变更的批复》，对苏园管复部委资审[2010]166 号中的增资事项予以确认，并明确追加投资部分在新营业执照颁发之日起两年内全部出资到位。

截至 2010 年 12 月 16 日，发行人已经分别收到厚睿咨询、豪正咨询、晶磊有限 134.25 万元、113.55 万元、37.20 万元。华普天健对上述增资的验资报告以及实际出资情况进行了复核，并于 2011 年 1 月 20 日出具了会审字[2011]3522 号《验资复核报告》，验资报告复核意见如下：根据苏州工业园区管理委员会《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司增资变更的批复》（苏园管复部委资审[2010]215 号）规定，公司本次增资应收股东出资 2,812.00 万元，其中股本 950 万元，资本公积 1,862.00 万元。截至 2010 年 9 月 20 日，公司已收到股东出资 2,527.00 万元，经复核，上述出资已到位，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 20 日出具的苏公 S【2010】B018 号验资报告验证。经验证，另外 285.00 万元股东出资款截至 2010 年 12 月 16 日已收到，累计 2,812.00 万元。

2、三家员工持股公司关于股份支付的说明

2010 年员工持股公司对发行人增资的行为符合股份支付准则的相关规定，需按《企业会计准则——股份支付》进行会计处理。

2010 年，员工持股公司与其他财务投资者对发行人增资的价格如下：

增资时点	出资人	新增 注册资本	整体 变更 转股 (万股)	股权 作价 (万元)	每股价格 (元/股)	市盈率		增资时 评估净资产 (万元)	市净率
						2009 年度	2010 年度		
2010 年 4 月	泓融投资	24.27 万美元	190.86	557.73	2.92	10.07	5.84	51,229.93	1.03
2010 年 4 月	德睿亨风	12.13 万美元	95.39	278.87	2.92	10.07	5.84	51,229.93	1.03
2010 年 9 月	厚睿咨询	447.50 万元	447.50	1,324.60	2.96	10.21	5.92	53,155.89	1.06
2010 年 9 月	豪正咨询	378.50 万元	378.50	1,120.36	2.96	10.21	5.92	53,155.89	1.06
2010 年 9 月	晶磊有限	124.00 万元	124.00	367.04	2.96	10.21	5.92	53,155.89	1.06

员工持股公司取得发行人权益工具的定价依据以采用收益法评估的评估值为基础，与当年财务投资者增资入股的作价依据一致，且高于当年财务投资者增资入股价格，价格公允，股权的价值已经一次性体现，不产生股权激励费用。因

此，按照《企业会计准则-股份支付》的规定，不需要确认相关股权激励费用。

经核查，保荐机构和申报会计师认为：发行人实施的股权激励计划的相关会计处理是合理的，符合《企业会计准则—股份支付》的规定。

五、发行人历次验资情况

（一）股份公司改制设立前的验资情况

1、晶方有限设立时注册资本验资情况

（1）首期出资

2005年7月14日，经江苏华星会计师事务所出具的华星会验资字（2005）第0289号《验资报告》审验，截至2005年7月13日，公司已收到股东中新创投以人民币折合500万美元的出资，晶方有限注册资本为1,000万美元，实收资本为500万美元。

（2）第二期出资

2005年8月15日，经江苏华星会计师事务所出具的华星会验资字（2005）第0327号《验资报告》审验，截至2005年8月11日，公司已收到股东英菲中新以货币资金缴纳的出资400万美元，晶方有限注册资本为1,000万美元，实收资本为900万美元。

（3）第三期出资

2006年12月5日，经江苏华星会计师事务所出具的华星会验资字（2006）第0387号《验资报告》审验，截至2006年12月4日，公司已收到股东Shellcase的100万美元实物出资，连同第一期、第二期出资，公司共收到全体股东缴纳的注册资本1,000万美元，晶方有限设立时的注册资金已全部到位。

2、晶方有限第一次增资的验资情况

（1）第一期出资

2007年2月5日，经江苏华星会计师事务所出具的华星会验资字（2007）第0032号《验资报告》审验，截至2007年1月11日，公司已收到股东Shellcase的500万美元债权出资，晶方有限注册资本为1,750万美元，实收资本为1,500万美元。

（2）第二期出资

2008年10月22日，经江苏华星会计师事务所出具的华星会验字（2008）第0042号《验资报告》审验，截至2007年11月29日，公司已收到股东Shellcase以货币资金缴纳的出资250万美元，连同第一期出资，晶方有限第一次增资的注册资金已全部到位。

3、晶方有限第二次增资的验资情况

（1）第一期出资

2007年5月10日，经江苏华星会计师事务所出具的华星会验资字（2007）第0148号《验资报告》审验，截至2007年5月8日，公司已收到股东中新创投以人民币折合300万美元的增资，其中200万美元作为实收资本，100万美元计入资本公积；公司已收到OmniT的500万美元货币资金出资，其中250万美元作为实收资本，250万美元计入资本公积。晶方有限注册资本2,252.5万美元，实收资本1,950万美元。

（2）第二期出资

2008年10月22日，经江苏华星会计师事务所出具的华星会验字（2008）第0042号《验资报告》审验，截至2007年11月29日，公司已收到美国籍Gillad Galor先生以货币资金缴纳的出资52.50万美元，连同第一期出资，晶方有限第二次增资的注册资金已全部到位。

4、晶方有限第三次增资的验资情况

2010年4月26日，经江苏华星会计师事务所出具的华星会验资字（2010）第0086号《验资报告》审验，截至2010年4月23日，公司分别已收到泓融投资与德睿亨风以货币资金缴纳的出资24.27万美元和12.13万美元，晶方有限注册资本2,288.90万美元，实收资本2,288.90万美元。

（二）股份公司设立时的验资情况

2010年6月17日，经华普天健出具的会验字[2010]3889号《验资报告》审验，截至2010年6月17日，公司已收到全体股东拥有的晶方有限截至2010年4月30日经审计的净资产人民币345,130,259.15元，按1:0.5215比例折合股本180,000,000股，每股面值1元，共计股本金180,000,000元，剩余净资产165,130.259.15元作为资本公积。

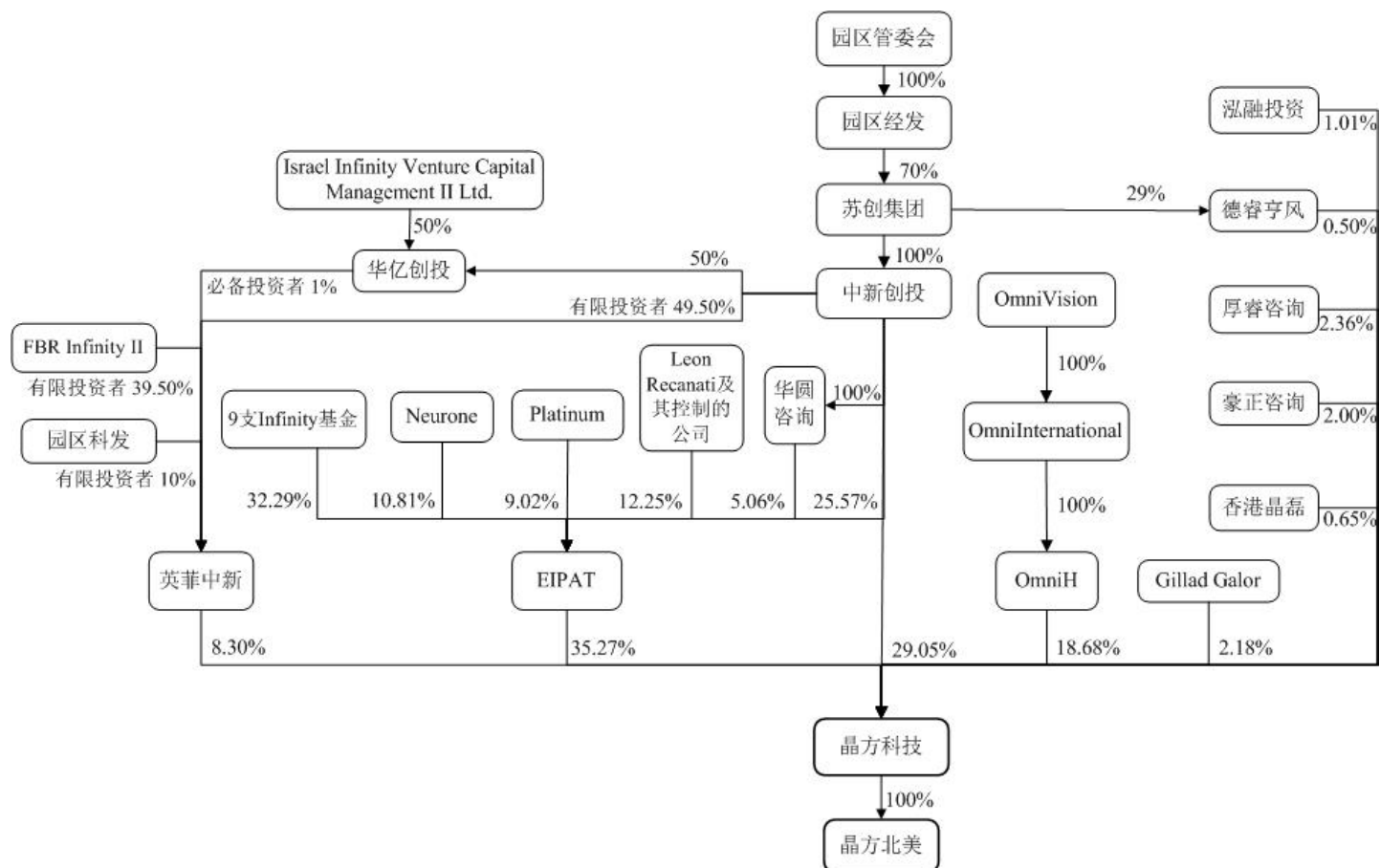
（三）股份公司设立后的验资情况

2010 年 9 月 21 日，经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 S[2010]B018 号《验资报告》审验，截至 2010 年 9 月 20 日，公司已收到厚睿咨询以货币资金缴纳的 1,190.35 万元人民币、豪正咨询以货币资金缴纳的 1,006.81 万元人民币、晶磊有限以美元折合 329.84 万元人民币缴纳的出资。晶方科技注册资本为 18,950 万元人民币，实收资本为 18,950 万元人民币。

2011 年 1 月 20 日，经华普天健出具的会审字[2011]3522 号《验资复核报告》审验，截至 2010 年 12 月 16 日，公司已收到晶磊有限以货币资金缴纳的追加投资款 37.20 万元、厚睿咨询以货币资金缴纳的追加投资款 134.25 万元、豪正咨询以货币资金缴纳的追加投资款 113.55 万元。

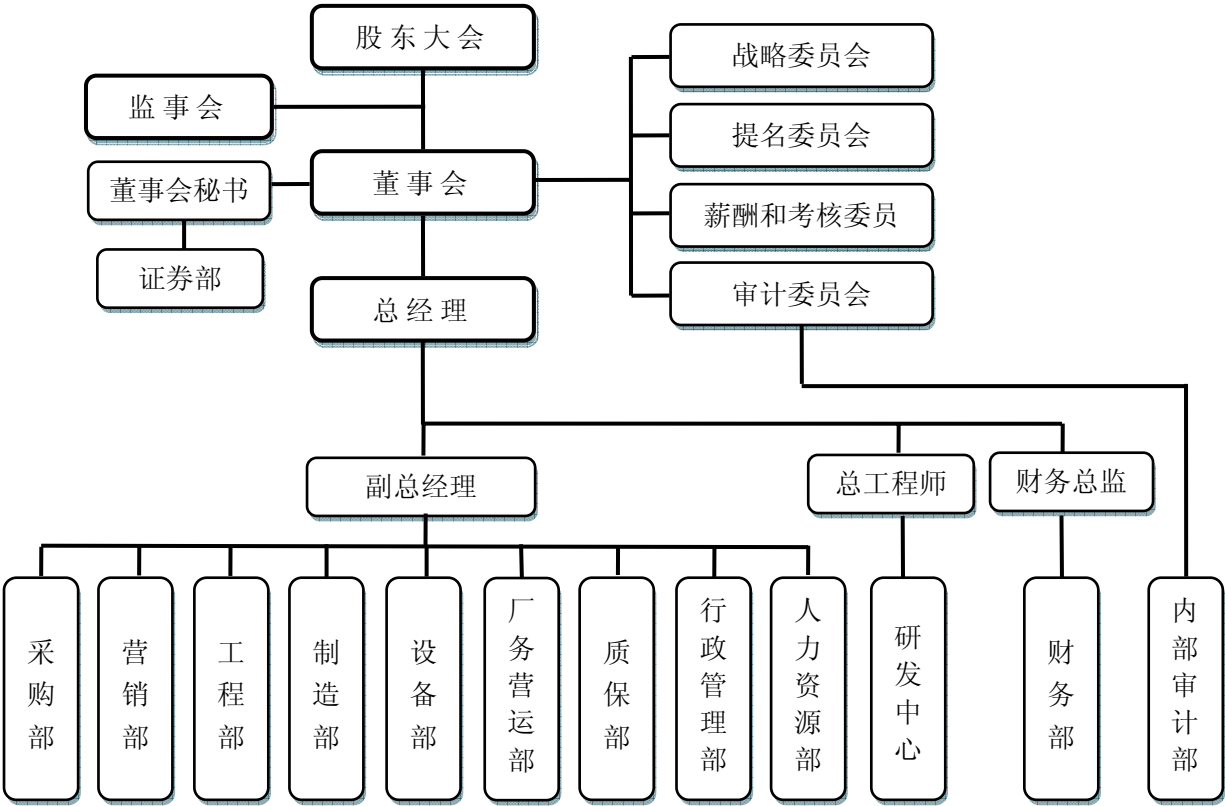
六、发行人的组织结构

（一）发行人的股权结构图



（二）发行人的内部组织结构

本公司内部组织按照生产经营的需要进行设置，具体情况如下：



（三）主要职能部门的工作职责

公司的最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，履行《公司章程》赋予的职权，负责公司重大的生产经营决策和确定公司整体发展战略并监督战略的实施；公司董事会 9 名董事中有 3 名独立董事，有利于健全公司的法人治理结构，使董事会的决策更科学、民主，从而有效地维护中小股东的利益。

公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各主要职能部门的主要职能是：

部门	主要职能
采购部	执行原材料、厂务需求、设备的采购计划；按公司的规定签订和履行采购合约，负责及时地订货，运输，交料，结算等工作，保证质量达到规定的标准；对主要供应商实行定期评估考核；积极跟踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议；密切关注新材料，新工艺，新技术，新设备动态，并及时反馈到研发，工程和设备部门，为其设计制造，改良和更新，提出参考意见。

营销部	负责完成公司年度销售目标；负责合同货款的回收；负责根据潜在客户的需求，提供技术咨询服务；负责销售网络的建设、管理；负责客户关系管理。
工程部	负责制定公司的技术管理制度和产品制造过程实现的策划；负责制定和修改工程技术文件；新设备的评估和组织验收以及现有设备的工程改进；负责组织各部门制订产能提升的方案和成本降低方案，并对其进行评估确认工作；负责工程变更的设计、评审、监督和效果确认。
制造部	负责按生产计划实施生产,确保产品及时交付；负责生产产能的汇总及提报；生产绩效考核制度制订与实施；负责生产线首件检验和制程检验工作；负责制程不合格品的反馈和改善动作执行；负责现场管理及参与工程技术改进，提高产线质量降低不良率。
设备部	负责将公司生产设备进行统一登录管理；负责收集公司的新进生产设备技术资料；负责备品备件的点检、购置、管理；制定公司的设备中长期维护、保养计划、备品备件计划，并组织实施；负责公司所有生产设备和检测仪器的维修；新设备的安装，调试及评估；负责对本部门所涉及的环境因素和法律法规的识别。
厂务营运部	提供符合公司生产/办公需要的环境；公共设施每日点检、巡检；公共设施预防性周/月/季度/年度检查保养；合理的公共设施改造/改善(设备异常情况的预见性与异常发生原因的检讨)；维护公共安全系统/设施降低突发事件或使突发事件对人员和财产损失降到最低；完善的安全制度，安全知识的培训；定期的检查安全隐患并对其进行整改；厂房的工程评估及规划；设备机台进厂定位及安装水、电、气等动力工程；对各部门委托工程的评估及实施。
质保部	负责参与先期产品质量策划的质量控制要求评审工作；制定本公司物料、产品及状态标识标准；进料、出货质量抽样检验执行及制程、成品检验工作监督；制程、产品质量不良追踪及追踪相关部门改善，组织不合格品评审和监督纠正预防措施的制定、实施；无尘室环境运行监视和测量管理；负责对主导全公司环境因素的识别和评价及更新管理工作。
研发中心	负责新产品的设计开发、检测和认证工作，负责样品的研制，负责研发体系的设立、运营及管理，负责科研项目的实施及验收。
行政管理部	负责招待工作；负责公司办公设施的管理；负责公司总务工作，做好后勤保障；负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车；负责组织安排各种文体活动和旅游活动；负责环境法律法规、废弃物的处理和环境绩效监测的管理工作；负责与政府行政机关的沟通联络；负责对本部门所涉及的环境因素和法律法规的识别；负责识别公司各类紧急状态，并制订相应的预案组织评审或演习。
人力资源部	规划、指导、协调公司的人力资源管理与组织建设，最大限度地开发人力资源，满足企业对人力资源的需求。
证券部	负责与证券监管机构、证券服务机构、媒体等的信息沟通和联络，负责公司信息披露事务和投资者关系管理，负责董事会及股东大会会议的筹备、会议材料制作、相关文件的保管等。
财务部	负责公司账务统计、申报纳税、出纳管理等日常财务工作；负责公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，参与公司重大投资融资决策等
内部审计部	组织制定、实施公司年度审计计划，负责对公司进行财务收支、资产管理、内部控制等的管理审计。

七、发行人子公司及分公司情况

本公司目前拥有一家在美国设立的全资子公司，为晶方半导体科技(北美)

有限公司(OptiZ,Inc.), 无参股公司。

晶方北美成立于 2010 年 11 月 24 日, 股本总额 100.00 万股。目前本公司出资 60 万美元, 持股比例 100%。其主营业务范围为技术研发, 专利管理和技术市场应用推广。2012 年 3 月 30 日, 晶方北美的英文名称由 China WLCSP US,Inc 变更为 OptiZ,Inc。

截至 2011 年 12 月 31 日, 晶方北美净资产为 60.20 万元, 2011 年度实现净利润为-300.40 万元。(上述数据业经华普天健审计)

八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

(一) 发起人基本情况

1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

EIPAT 为公司第一大股东, 持有公司 66,844,336 股股份, 占公司本次发行前股本总额的 35.27%, 所持本公司股份性质为外资股。

EIPAT 原名为 Shellcase Ltd., 成立于 1992 年 12 月 22 日, 于 1994 年 11 月 14 日在加拿大渥太华证券交易所 (VSE) 上市, 于 2004 年 2 月 27 日退市, 注册地为以色列耶路撒冷, 创始人为 A.Badih, 注册号码为 52-004212-8, 目前无实际经营业务。

(1) EIPAT 的股权结构

自发行人设立至今, EIPAT 主要股东持股比例的变化情况如下:

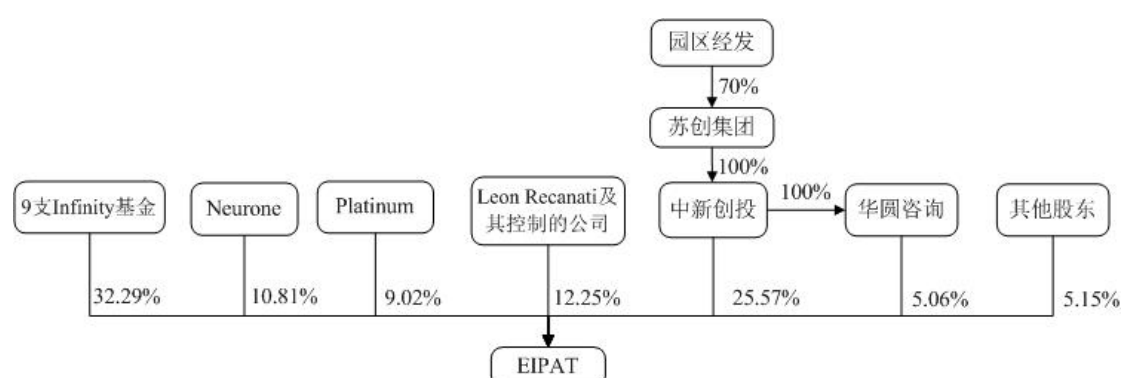
单位: 万股

股东名称		2005/6/10 (发行人设立时)		2010/12/31		2011/12/31	
		股份数	持股 比例	股份数	持股 比例	股份数	持股 比例
Infinity 集团 旗下基金	Israel Infinity Venture Capital Fund(Israel)	1,278.64	0.58%	217.48	0.12%	217.48	0.12%
	Israel Infinity Venture Capital Fund(Delaware) L.P.	2,145.37	0.97%	364.91	0.20%	364.91	0.20%
	Israel Infinity Venture Capital Fund(Cayman I) L.P.	237.04	0.11%	40.32	0.02%	40.32	0.02%
	Israel Infinity Venture Capital Fund(Cayman II) L.P.	490.79	0.22%	83.48	0.05%	83.48	0.05%
	Infinity I Annex Fund, L.P.	9,742.40	4.42%	1,118.56	0.61%	1,118.56	0.61%
	FBR Infinity II Ventures, L.P.	17,302.91	7.85%	17,314.32	9.49%	17,314.32	9.49%
	FBR Infinity II Ventures(Israel), L.P.	18,045.55	8.19%	18,057.45	9.90%	18,057.45	9.90%
	FBR Infinity II Ventures(ERISA), L.P.	6,608.17	3.00%	6,612.53	3.62%	6,612.53	3.62%
	Infinity II Annex Fund (IE) L.P.	-	-	-	-	15,103.04	8.28%

	小计	55,850.87	25.34%	43,809.05	24.01%	58,912.09	32.29%
中新创投及其控股子公司	中新创投	46,618.47	21.15%	46,649.22	25.57%	46,649.22	25.57%
	华圆管理咨询(香港)有限公司	-	-	-	-	9,236.49	5.06%
	小计	46,618.47	21.15%	46,649.22	25.57%	55,885.70	30.63%
KGIF	KGIF Limited Partnership	32,632.93	14.81%	32,654.45	17.90%	-	-
Leon Recanati及其控制的公司	Leon Recanati	1,864.74	0.85%	1,865.97	1.02%	2,798.95	1.53%
	Gov Financial Holdings Ltd.	15,850.28	7.19%	15,860.73	8.69%	15,860.73	8.69%
	Insight Capital Ltd.	-	-	-	-	3,694.60	2.03%
	The GlenRock Group	932.37	0.42%	932.98	0.51%	-	-
	小计	18,647.39	8.46%	18,659.68	10.22%	22,354.28	12.25%
Neurone	Neurone Ventures II Investment(Israel) Ltd.& Neurone II Investment GP. Ltd.	16,316.47	7.40%	16,327.23	8.95%	19,560.00	10.72%
Platinum	Platinum Venture Capital Ltd.	16,316.47	7.40%	16,327.23	8.95%	16,327.23	8.95%
	合计	186,382.60	84.56%	174,426.86	95.60%	173,039.30	94.85%

注：表格中的股份数包括普通股和优先股，未包含认股权。根据 EIPAT 公司章程，只有普通股和优先股股东具有表决权。

截至招股说明书签署日，EIPAT 的股权结构如下：



EIPAT 的主要股东为 Infinity 集团旗下基金、中新创投及其控股子公司华圆咨询、KGIF、Leon Recanati 先生及其控制的公司、Neurone 和 Platinum。截至招股说明书签署日，主要股东合计持有 EIPAT 94.85% 的股份。

自发行人设立以来，Infinity 集团旗下基金与中新创投（及其全资子公司）在 EIPAT 的持股比例相近，一直为 EIPAT 的前两大股东，合计持有 EIPAT 46% 以上的股份。除 KGIF Limited Partnership 外，其他 EIPAT 主要股东自发行人设立以来，所持 EIPAT 股权均未发生重大变化。

2011 年 4 月 23 日，EIPAT 主要股东 KGIF Limited Partnership 将其持有的 EIPAT 17.90% 股权分别转让给 Insight Capital Ltd. (2.03%)、Kfir Capital Group LLC. (0.26%)、Joseph Hackmey (0.5%)、华圆咨询 (5.06%)、Neur

one Ventures II Investment(Israel) Ltd.& Neurone II Investment GP. Ltd.(1.77%)、Infinity II Annex Fund (IE) L.P. (8.28%)。股权转让后, KGIF Limited Partnership 不再是 EIPAT 的股东。根据 EIPAT 公司章程第 24 条, 所有优先股股东及持有 EIPAT 公司 5%以上股份的股东在其他股东有意出售股份时享有优先购买权。KGIF 按章程规定向有权股东优先出售其意愿转让的股份, 余下股份售予第三方。

(2) EIPAT 主要股东的基本情况

1) Infinity 集团旗下基金

Infinity 集团是由以色列最大、最有影响力的企业 IDB 控股公司与以色列基金管理人 Amir Galor 先生和 Avishai Silvershatz 先生等共同成立的创业基金管理机构, 旗下有多个基金, 其中 Israel Infinity Venture Capital Fund(Israel)、Israel Infinity Venture Capital Fund(Delaware) L.P.、Israel Infinity Venture Capital Fund(Cayman II) L.P.等 9 个基金为 EIPAT 的股东。

截至招股说明书签署日, Infinity 集团旗下基金合计持有 EIPAT 32.29%的股权。

2) 中新创投及其控股子公司

中新创投为发行人第二大股东, 持有发行人 55,048,276 股股份, 占公司本次发行前股本总额的 29.05%。华圆管理咨询(香港)有限公司为中新创投全资子公司, 成立于 2006 年 9 月 26 日, 登记注册号为 1076666, 投资总额为 1,490 万美元, 主营业务为股权投资。

截至招股说明书签署日, 中新创投及华圆管理咨询(香港)有限公司合计持有 EIPAT 30.63%的股权。

3) Leon Recanati 先生及其控制的公司

Leon Recanati 先生, 以色列国籍, 为 The GlenRock Group、Gov Financial Holdings Ltd.和 Insight Capital Ltd.的实际控制人。

截至招股说明书签署日, Leon Recanati 先生及其控制的 Gov Financial Holdings Ltd.和 Insight Capital Ltd.合计持有 EIPAT 12.25%的股权。

4) Neurone Ventures II Investment(Israel) Ltd.及 Neurone II Investment GP. Ltd.

Neurone Ventures II Investment(Israel) Ltd.成立于 2000 年 9 月 10 日,

为以色列上市公司；Neurone II Investment GP. Ltd.成立于2001年7月3日，为开曼群岛上市公司。Yigal Livne 先生及 Ami Dotan 先生各持有两家公司 50%的股权。

截至招股说明书签署日，Neurone Ventures II Investment(Israel) Ltd.及 Neurone II Investment GP. Ltd.合计持有 EIPAT 10.72%的股权。

5) Platinum Venture Capital Ltd.

Platinum Venture Capital Ltd.于2001年1月在以色列成立，以色列 S.R. Accord Holdings 及 Keppel IHT(BVI)各持有其 50%股权，该公司主营业务为股权投资。

截至招股说明书签署日，Platinum Venture Capital Ltd. 持有 EIPAT 8.95%的股权。

6) KGIF Limited Partnership

Korean Global IT Fund (KGIF) 由韩国政府于2002年发起设立，股东为韩国 STIC Ventures、韩国 KDB Capital 及以色列 SKFT 公司，主要从事信息技术行业风险投资。

2011年4月23日，KGIF 将其持有 EIPAT 17.90%的股权全部转让，股权转让后，KGIF 不再是 EIPAT 的股东。

(3) EIPAT 各股东与发行人及其股东、董事、监事及高级管理人员的关联关系

EIPAT 各股东与发行人及其股东、董事、监事及高级管理人员的关联关系如下：1) EIPAT 股东中新创投是发行人第二大股东，发行人董事费建江、盛刚以及监事王庆在中新创投中任职，中新创投是发行人股东英菲中新的有限投资者，同时也是股东英菲中新必备投资者华亿创投的股东；2) 华圆咨询系发行人股东中新创投的控股子公司；3) EIPAT 股东 Infinity 集团旗下的基金 FBR Infinity II China Ventures L.P.系发行人股东英菲中新的有限投资者，Infinity 集团旗下基金 Israel Infinity Ventures Capital Management II Ltd.是发行人股东英菲中新必备投资者华亿创投的股东；4) 发行人股东英菲中新必备投资者的外方董事在 EIPAT 股东 Infinity 集团旗下基金中担任管理职务，英菲中新必备投资者的中方董事在中新创投中担任管理职务；5) 在 Infinity 集团旗下基金中担任管理职务的 Amir Galor 和 Ariel Poppel 同时也是发行人董事。

除上述披露的关联关系外，EIPAT 各股东与发行人及其股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系。

(4) EIPAT 的控制权情况

1) EIPAT 的股权特点

EIPAT 的股份由普通股、优先股和认股权三个部分构成，公司章程中规定优先股和普通股股东具有表决权。根据 EIPAT 的公司章程，普通决议需普通股和优先股合计 50%以上通过，特别决议需要优先股 75%以上通过。

根据 EIPAT 的公司章程，需要 75%以上优先股通过的特别决议事项包括：对新章程的修改；优先股权利的变更；创立或发行任何优于优先股的股票；公司发行在外股本的重新分类和资本重组；以现金、股份或资产方式派发任何股息；公司或其任何附属公司的解散或清盘，或公司或其任何附属公司的主要业务的停止；发行股本、权利、期权、认股权或除公司股票期权计划、董事会决议批准外的其他可转换证券；对能够引起公司控制权变更的并购或其他交易的批准；对公司大部分资产的出售或以其他方式的处置，这些资产包括任何实体持股或知识产权；与公司的职员、董事、股东、子公司或其他关联方的重大交易；非公司日常业务的交易；决定除合格的首次公开发行之外的任何公开发行的条件；公司任何超过 100 万美元的债务承诺；对公司业务本质的重大变更；公司的借债或提供担保；以合计超过 100 万美元的公司资产作出承诺、抵押或其他担保权益；以及签订任何前述事项相关的协议。

自发行人设立至今，EIPAT 主要股东优先股持股情况如下：

单位：万股

股东名称	2005/6/10 (发行人设立时)		2010/12/31		2011/12/31	
	优先股 股数	持股 比例	优先股 股数	持股 比例	优先股 股数	持股 比例
Infinity 集团旗下基金	55,563.17	25.40%	43,322.83	23.96%	58,415.92	32.30%
中新创投及其控股子公司	46,618.47	21.31%	46,618.47	25.78%	55,848.88	30.88%
Leon Recanati 及其控制的公司	18,647.39	8.52%	18,647.39	10.31%	223,39.55	12.35%
Neurone Ventures II Investment(Israel) Ltd.& Neurone II Investment GP. Ltd.	16,316.47	7.46%	16,316.47	9.02%	195,47.11	10.81%
Platinum Venture Capital Ltd.	16,316.47	7.46%	163,16.47	9.02%	163,16.47	9.02%
KGIF Limited Partnership	32,632.93	14.92%	32,632.93	18.04%	-	-
合 计	186,094.90	85.07%	141,221.62	96.13%	114,264.80	95.36%

自发行人设立以来，EIPAT 主要优先股股东占比未发生重大变动，Infinity

集团旗下基金、中新创投及其全资子公司华圆咨询、Platinum Venture Capital Ltd.、Neurone Ventures II Investment(Israel) Ltd.& Neurone II Investment GP. Ltd.、Leon Recanati 及其控制的公司等五个主要股东所持 EIPAT 优先股占比未发生重大变动, 合计持有 EIPAT 70%以上优先股股权。截至招股说明书签署日, Infinity 集团旗下基金合计持有 EIPAT 32.30%优先股股权, 中新创投及其全资子公司华圆管理咨询(香港)有限公司合计持有 EIPAT 30.88%优先股股权, Leon Recanati 先生及其控制的公司合计持有 EIPAT 12.35%优先股股权, Neurone Ventures II Investment(Israel) Ltd.& Neurone II Investment G P. Ltd.合计持有 EIPAT 10.81%优先股股权, Platinum Venture Capital Ltd. 持有 EIPAT 9.02%优先股股权。上述各 EIPAT 股东之间不存在通过协议、其他安排一致行动的情形, 无任何单一股东能控制 EIPAT 75%以上优先股股权。

2) EIPAT 董事会成员构成

EIPAT 的公司章程明确规定了具有董事委派权的股东, 中新创投自投资 EIPAT 以来从不具备董事委派权。报告期内, EIPAT 董事会成员席位的委任情况如下:

董事	委派方	委派日期	离任日期
Amir Galor	Infinity 集团	2005/6/14	-
Amiram (Ami) Dotan	Platinum 及 Neurone 共同委派	2005/8/25	-
Vered Molcho Tol	Infinity 集团	2008 年	-
Leon Recanati	The GlenRock Group	2005/5/31	-
Lee Sang Bok ^①	KGIF	2005/8/25	2011/4/23
Nitzan Yanovski ^②	Platinum、Neurone 及 KGIF 共同委派	2005/8/25	2011/5/9

注: ① 自 2011 年 4 月 23 日起, KGIF 不再是 EIPAT 股东, 不再拥有董事委派权。

② 自 Nitzan Yanovski 离任后, Platinum、Neurone 将不再委任新的董事。

③ 自 2011 年 5 月 9 日起, EIPAT 董事会由 4 名董事组成。

从上表董事会成员委派情况来看, 公司董事会会有 4 名董事, 其中: 中新创投未委派董事, 其余单一股东在公司董事会所占席位均未过半, 因此单一股东对公司董事会均不构成实际控制。

根据 EIPAT 的股权特点、公司章程以及董事会成员构成, EIPAT 股权较为分散, 无任何单一股东能控制 EIPAT 50%以上股权(普通股和优先股合计)、75%以上优先股股权, 无任何单一股东在公司董事会所占席位过半数, 因此, EIPAT

PAT 无实际控制人。

(5) EIPAT 财务状况

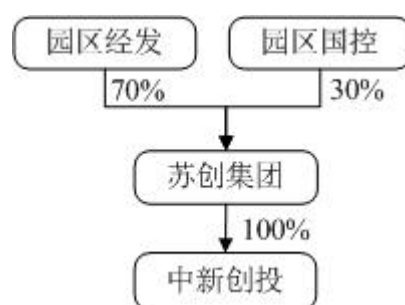
截至 2011 年 12 月 31 日，EIPAT 资产总额为 7,748.46 万元，净资产为 6,420.03 万元，2011 年度实现净利润 1,444.98 万元。（2011 年 12 月 31 日的汇率为 1.64965 新谢克尔/人民币，以上财务数据经 ERNST&YOUNG 审计）

2、中新苏州工业园区创业投资有限公司

中新创投为公司第二大股东，持有公司 55,048,276 股股份，占公司本次发行前股本总额的 29.05%，所持本公司股份性质为国有股。

中新创投成立于 2001 年 11 月 28 日，法定代表人为林向红，注册资本为 173,000 万元，住所为苏州工业园区凤里街 345 号沙湖创投中心 1 座 D 区 2 层，主营业务为高新技术企业的直接投资、相关产业的创业投资基金和创业投资管理公司的发起与管理等。

截至招股说明书签署日，中新创投的股权结构如下：



中新创投控股股东为苏州创业投资集团有限公司，实际控制人为苏州工业园区经济发展有限公司，园区经发系苏州园区管委会直属国有独资企业。

中新创投属于创业投资（VC）与私募投资（PE）行业，主要向具有高成长潜力的未上市创业企业特别是高新技术企业进行权益性投资，为之提供创业管理服务，待所投资企业发育成熟或相对成熟后通过权益转让获得资本增值收益，风险投资的最终目的在于获利退出。依托苏州工业园区良好的地理优势和政府招商优惠措施，中新创投自成立以来，投资增长迅速，行业地位得到迅速提高。苏州创业投资集团有限公司（在中新创投基础上设立后替代中新创投参加排名）在“清科集团—中国创业投资年度排名”之中国创业投资机构 50 强中，2011 年排名第 15 位。

截至 2011 年 12 月 31 日，中新创投资产总额为 321,455.76 万元，净资产为 159,196.82 万元，2011 年度实现净利润为 7,055.00 万元。（以上财务数据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计）

3、OmniVision Holding (Hong Kong) Company Limited

OmniH 为公司第三大股东，持有公司 35,388,178 股股份，占公司本次发行前股本总额的 18.68%，所持本公司股份性质为外资股。

OmniH 是一家于 2007 年 5 月 3 日在香港注册的有限责任公司，注册地址为 Units 1-2, 8/F, Tower 1, Ever Gain Plaza, 88 Container, Fort Rd Kwai Chung, NT, Hong Kong，其业务性质为投资。OmniH 的控股股东为 OmniInternational，除持有 OmniH 的全部股权外，OmniInternational 在香港还持有 OmniT、Omnitech 的全部股权，OmniInternational 的唯一股东为 OmniVision，OmniVision 系纳斯达克上市公司，目前是全球最大的 CMOS 影像传感器供应商。

(1) OmniH 的对外投资情况

除持有发行人股权外，OmniH 还持有豪威科技（上海）有限公司 100% 的股权。豪威科技（上海）有限公司成立于 2002 年 3 月 8 日，注册资本为 1,200 万美元，法定代表人为 XIAO YING HONG，注册号 310115400091003，住所为上海市张江高科技园区上科路 88 号，主营业务为影像传感器和相关的集成电路的设计、开发。从产业链构成上，豪威科技（上海）有限公司处于发行人下游。报告期内，发行人与豪威科技未发生关联交易。

(2) OmniH 的兄弟公司、控股股东以及实际控制人的情况

OmniT、OmniH、Omnitech 为同一实际控制下的兄弟公司，Omnitech、OmniT 分别于 2003 年 4 月 9 日、2003 年 10 月 13 日设立于香港，主营业务均为电子相关产品贸易，控股股东均为 OmniInternational。OmniInternational 于 2000 年 11 月 10 日设立于英属开曼群岛（Cayman Islands），为 OmniVision 的全资子公司，主营业务为股权投资与管理。

OmniVision 最初于 1995 年 5 月在美国加利福尼亚州成立，后于 2000 年 3 月重新注册于美国德拉华州，并于同年 7 月在纳斯达克上市（NASDAQ: OVTI）。OmniVision 总部坐落在美国硅谷 4275 Burton Drive, Santa Clara, California 95054，主营业务为从事 CMOS 影像传感器设计、研发和市场销售，目前是全

球最大的 CMOS 影像传感器供应商。

OmniVision 的晶圆制造和芯片封装均采用服务外包方式，为更好的服务于影响传感芯片晶圆级封装设计，在影像传感器设计时就把晶圆级封装技术的各项技术指标考虑在内，OmniVision 于 2004 年也取得了 Shellcase 晶圆级封装技术的授权。自取得授权以后，OmniVision 及其下属子公司未从事过芯片封装业务，其设计的影像传感芯片均委托发行人或者精材科技进行封装，与发行人不存在同业竞争。

根据 NASDAQ 网站上市公司信息披露：截至 2012 年 3 月 31 日，OmniVision 股份总数约为 5,200 万股，其中约 78%（约 4007 万股）的股份为投资机构所持有，且股权持有比较分散，持股比例最高的股东持股 7.50%，前五大股东合计持股 28.40%。

（3）OmniH 的财务状况

截至 2012 年 1 月 31 日，OmniH 资产总额为 3,355.22 万美元，净资产为 3,351.21 美元，2011 年 5 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日实现净利润 213.44 万美元。

（OmniH 的会计期间为本年 5 月 1 日至次年 4 月 30 日，以上财务数据为未经审计的三季度报。）

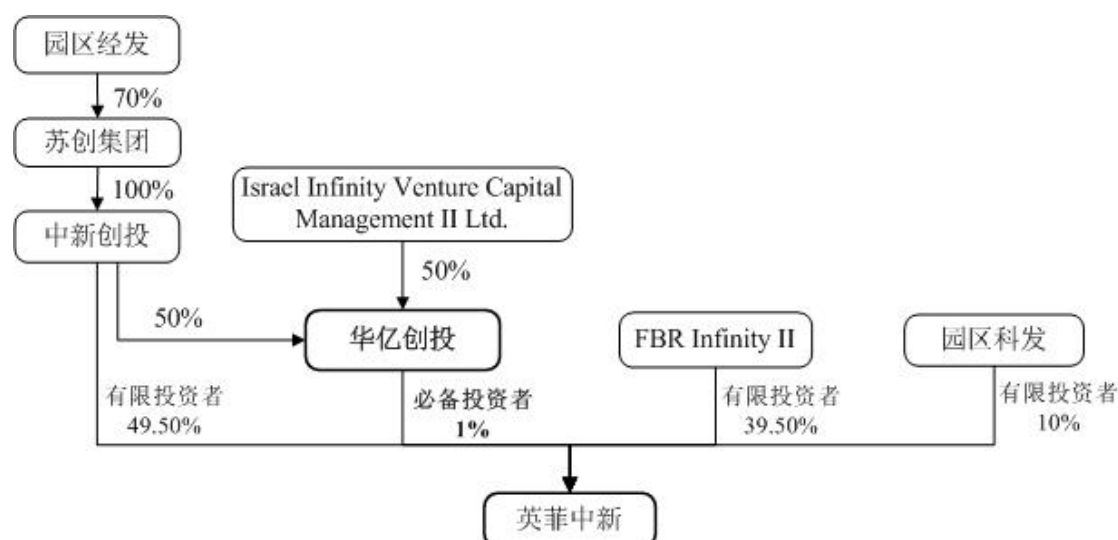
4、英菲尼迪-中创业投资企业

英菲中新为公司第四大股东，持有公司 15,728,079 股股份，占公司本次发行前股本总额的 8.30%。

英菲尼迪一中创业投资企业是由中新苏州工业园区创业投资有限公司、园区科技发展有限公司与以色列 Infinity 基金共同成立的国内第一家非法人制中外合作创业投资基金，组织形式为非法人，于 2005 年 4 月 1 日获得国家工商总局正式批准，取得了企作国非字第 00001 号《营业执照》。英菲中新法定代表人为 Avishai Silvershatz，注册资本为 1000 万美元，住所为江苏省苏州市工业园区机场路 328 号 A309，主营业务为自有资金股权投资、创业投资及管理咨询。

（1）英菲中新的股权结构

截至招股说明书签署日，英菲中新的股权结构如下：



序号	股东名称	投资关系	注册资本（万美元）	持股比例（%）
1	华亿创业投资管理（苏州）有限公司	必备投资者	10.00	1.00
2	中新苏州工业园区创业投资有限公司	有限投资者	495.00	49.50
3	FBR Infinity II China Ventures, L.P.	有限投资者	395.00	39.50
4	苏州工业园区科技发展有限公司	有限投资者	100.00	10.00
合 计			1,000.00	100.00

1) 《外商投资创业投资企业管理规定》中关于必备投资者的规定

根据《外商投资创业投资企业管理规定》，设立创投企业投资者人数在 2 人以上 50 人以下，且应至少拥有一个必备投资者；创投企业可以采取非法人制组织形式，采取非法人制组织形式的创投企业的投资者对创投企业的债务承担连带责任。非法人制创投企业的投资人也可以在创投企业合同中约定在非法人制创投企业资产不足以清偿该债务时由必备投资者承担连带责任，其他投资人以其认缴的出资额为限承担责任。

2) 英菲中新的股东情况

① 必备投资者—华亿创业投资管理（苏州）有限公司

华亿创业投资管理（苏州）有限公司设立于 2004 年 11 月 18 日，是由中新创投和 Israel Infinity Venture Capital Management II Ltd. 合资设立的中外合资经营企业，注册资本为 12.50 万美元，法定代表人为林向红，主营业务为在中国境内和（或）境外发起和管理创业投资基金。

A、华亿创投的股权结构

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
中新创投	6.25	50%
Israel Infinity Venture Capital Management II Ltd.	6.25	50%

合 计	12.50	100%
-----	-------	------

Israel Infinity Venture Capital Management II Ltd.系于 2001 年 6 月 16 日在以色列成立的有限责任公司，主要从事基金管理，地址位于 3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42nd Floor, Tel Aviv, Israel，该公司股权结构如下：

股东名称	股份数（股）	股权比例
Friedman,Billings Ramsey Investment Management, Inc. (FBR)	3,600	30%
Clal Industries and Investments Ltd.	1,800	15%
Clal Electronic Industries Ltd.	1,800	15%
Israel Infinity Managers	4,800	40%
合 计	12,000	100%

该公司董事三名，Friedman,Billings Ramsey Investment Management, Inc. (FBR) 委派 Emanuel Friedman；Clal Industries and Investments Ltd. 和 Clal Electronic Industries Ltd.共同委派 Meir Shannie；Israel Infinity Managers 委派 Amir Galor 担任该公司董事。

B、华亿创投的管理模式

根据华亿创投的《合资经营合同》及《公司章程》，公司设董事会，董事会系公司最高权力机构，有权就公司全部重大事件作出决定，所有董事会决议和行为必须由所有董事一致通过方为有效。董事会职权包括但不限于章程修改、增减注册资本、变更经营范围、公司终止、解散、清算、利润分配、公司财务制度的批准、年度经营计划和年度预算等。

华亿创投董事会由 4 人组成，Israel Infinity Venture Capital Management II Ltd.与中新创投各委派 2 人，合营期限内董事长由中新创投委派，副董事长由 Israel Infinity Venture Capital Management II Ltd.委派。

华亿创投《合资经营合同》及《公司章程》还特别规定：不论是否有相反的约定，所有公司与第三方签订的法律文件，或者所有授权公司高级职员代表公司与第三方签订法律文件，均须获得董事长和副董事长共同签字。

从华亿创投的股权结构和管理模式来看，中新创投和 Israel Infinity Venture Capital Management II Ltd.均无法单独实施控制。

② 有限投资者—FBR Infinity II China Ventures,L.P

FBR Infinity II China Ventures,L.P.系于 2004 年 8 月 25 日在以色列成立的有限合伙企业，主要从事股权投资业务，地址位于 3 Azrieli Center Triangle

Tower, 42nd Floor。该有限合伙企业的普通合伙人为 FBR Infinity II Partners, L.P.负责企业日常经营管理。

③ 有限投资者—苏州工业园区科技发展有限公司

苏州工业园区科技发展有限公司设立于 2000 年 4 月 29 日，注册资本为 14 8,000 万元，法定代表人顾宁，住所为苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园区，主营业务为对科技园进行开发、建设、管理；自有房屋出租；提供为高科技企业服务的技术平台，进行应用软件产品和电子商务软件的研究开发网络增值及系统集成服务；对科技项目进行投资。

截至招股说明书签署日，苏州工业园区科技发展有限公司的股权结构如下：

股东名称	股东类型	注册资本 (万元)	持股比例
苏州工业园区地产经营管理公司	有限公司(国有独资)	94,999	50.53%
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	有限公司(国有独资)	93,001	49.47%
合 计	-	188,000	100.00%

(2) 英菲中新的管理模式

英菲中新系根据《外商投资创业投资企业管理规定》设立的中外合作非法人创业投资企业，华亿创投为其必备投资者。根据英菲中新的《公司章程》规定，有限投资者不参与管理、操作或控制英菲中新的经营活动，并无权约束企业；必备投资者负责英菲中新业务的监督、控制和运营，并具备法律法规赋予必备投资者的权利和权力；有限投资者均不可撤销地委托和授权必备投资者具有唯一及独有授权代表英菲中新行事，而由必备投资者行使的英菲中新的任何权力对英菲中新产生约束力，并且构成英菲中新的行为。

从英菲中新管理模式来看，英菲中新的必备投资者为华亿创投，负责英菲中新业务的监督、控制和运营，单一股东均无法控制华亿创投，因此，英菲中新无实际控制人。

(3) 英菲中新财务状况

截至 2011 年 12 月 31 日，英菲中新资产总额 8,013.20 万元，净资产为 8,013.20 万元，2011 年度实现净利润为 231.90 万元。(以上财务数据未经审计)

5、Gillad Galor

Gillad Galor 先生为公司第六大股东，持有公司 4,128,621 股股份，占公司本次发行前股本总额的 2.18%，所持本公司股份性质为外资股。

Gillad Galor 先生持有美国护照，拥有以色列和香港永久居留权，护照号码为 422023661，住所为 Optima Limited, 1510-1513, 15/F Luen Cheong Can Centre, 8 Yip Wong Road, Tuen Mun, Hong Kong。

6、苏州泓融投资有限公司

泓融投资为公司第八大股东，持有公司 1,908,602 股股份，占公司本次发行前股本总额的 1.01%，所持本公司股份性质为一般法人股。

泓融投资成立于 2010 年 3 月 15 日，法定代表人为张亦斌，注册资本为人民币 10,000 万元，公司住所为苏州工业园区娄葑镇车坊普惠路淞泽家园一区，主营业务为实业投资及投资咨询。泓融投资的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	张亦斌	9,000	90.00
2	张栗涛	1,000	10.00
合计		10,000	100.00

泓融投资的实际控制人为张亦斌，张亦斌系上市公司新海宜的董事长，泓融投资为其在苏州工业园区设立的创业投资公司，主要资产除持有晶方有限的长期股权投资外，还持有法泰电器（苏州）股份有限公司 4.92% 的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，泓融投资资产总额为 19,297.75 万元，净资产为 10,017.75 万元，2011 年度实现净利润-0.97 万元（以上财务数据未经审计）。

7、苏州德睿亨风创业投资有限公司

德睿亨风为公司第十大股东，持有公司 953,908 股股份，占公司本次发行前股本总额的 0.50%，所持本公司股份性质为一般法人股。

德睿亨风成立于 2010 年 4 月 21 日，法定代表人为林向红，注册资本为 25,000 万元人民币，公司住所为苏州工业园区凤里街 345 号沙湖创投中心 1 座 308 室，主营业务为创业投资及投资咨询，该公司无实际控制人，德睿亨风股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	苏州创业投资集团有限公司	7,250.00	29.00
2	苏州金枫门窗有限公司	4,000.00	16.00
3	苏州工业园区设计研究院有限责任公司	2,000.00	8.00
4	苏州明鑫科技集团有限公司	2,000.00	8.00
5	苏州地平线投资管理有限公司	2,000.00	8.00
6	苏州工业园区锦丰企业集团有限公司	1,500.00	6.00

7	苏州汉璞艺术中心	1,000.00	4.00
8	苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司	1,000.00	4.00
9	苏州领潮文化传媒有限公司	1,000.00	4.00
10	沈福根	1,000.00	4.00
11	苏州工业园区华东城建发展有限公司	1,000.00	4.00
12	苏州工业园区普利杰机电制品有限公司	1,000.00	4.00
13	苏州景风正德创业投资管理有限公司	250.00	1.00
合 计		25,000.00	100.00

(1) 德睿亨风股东的基本情况

德睿亨风的股东的股权结构、主营业务等基本情况如下：

股东名称	股权结构				经营范围
	股东名称	股东类型	股东认缴额 (万元)	持股比例 (%)	
苏州创业投资集团有限公司	苏州工业园区经济发展有限公司	有限公司 国有独资	210,000	70.00	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
	苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	有限公司 国有独资	90,000	30.00	
苏州金枫门窗有限公司	邱九芳	中国公民	210	70.00	加工、制造、销售塑料门窗、铝材门窗；销售：建材、五金交电
	邱玥芳	中国公民	90	30.00	
苏州工业园区设计研究院有限责任公司	冯正功	中国公民	215.625	23.96	承接建筑（甲级）、规划、市政设计；勘察、测量工程的勘察设计任务。工程承包、室内外装修、工程咨询、建筑材料及与工业园区建设相关的其他服务业务。
	邹金新	中国公民	79.6875	8.85	
	张谨	中国公民	75	8.33	
	廖晨	中国公民	37.5	4.17	
	詹新建	中国公民	51.5625	5.73	
	徐宏韬	中国公民	51.5625	5.73	
	王干	中国公民	37.50	4.17	
	徐海英	中国公民	37.50	4.17	
	史明	中国公民	37.50	4.17	
	张延成	中国公民	37.50	4.17	
	陆学君	中国公民	37.50	4.17	
	付卫东	中国公民	37.50	4.17	
	袁靖怡	中国公民	18.75	2.08	
	杨昭辉	中国公民	9.375	1.04	
	丘琳	中国公民	18.75	2.08	
	陈露	中国公民	9.375	1.04	
	谈丽华	中国公民	9.375	1.04	
	沈卫平	中国公民	9.375	1.04	
	冯洪斌	中国公民	9.375	1.04	
	周丽健	中国公民	9.375	1.04	
	蒋文蓓	中国公民	9.375	1.04	
	薛金海	中国公民	9.375	1.04	
	唐镒	中国公民	4.6875	0.52	
	陈琛	中国公民	4.6875	0.52	
	刘晶	中国公民	4.6875	0.52	

	王志翔	中国公民	4.6875	0.52	
	薛学斌	中国公民	9.375	1.04	
	陈叶美	中国公民	4.6875	0.52	
	张渊	中国公民	4.6875	0.52	
	周蔚	中国公民	4.6875	0.52	
	许彬	中国公民	4.6875	0.52	
	赵宝利	中国公民	4.6875	0.52	
苏州明鑫科技集团有限公司	苏州鑫凯建设发展有限公司（注）	有限公司（自然人控股）	9,600	80.00	高科技产业投资与开发；商业地产投资、管理与开发；文化产业的投资与咨询；财务管理咨询；酒店、旅游开发；自有房屋出租；装修施工及设计；销售：金属材料、水性涂料、建筑材料、五金、机电、电子产品，办公用品。
	黄哲从	中国公民	2,400	20.00	
苏州地平线投资管理有限公司	戚远	中国公民	150	75.00	投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划。
	沈琼	中国公民	30	15.00	
	杨虞	中国公民	10	5.00	
	陈荠超	中国公民	10	5.00	
苏州领潮文化传媒有限公司	陆惠英	中国公民	45	90.00	设计、制作、代理发布国内各类广告；企业形象策划、多媒体设计、室内装饰设计。
	陆敏浩	中国公民	5	10.00	
苏州汉璞艺术中心	周文华	中国公民	500	100.00	艺术品销售：展览、艺术品鉴赏培训、沙龙会议、艺术设计创意指导。
苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司	许学雷	中国公民	375	75.00	承接建设工程项目管理，招投标管理，造价管理以及其他工程管理。
	姚其妹	中国公民	100	20.00	
	居全明	中国公民	25	5.00	
苏州工业园区锦丰企业集团有限公司	李惠芳	中国公民	7,975	79.75	自有房屋出租管理。计算机软硬件开发、计算机网络系统和楼宇智能化工程、自动化控制设备安装。销售建材、计算机及配件、电子设备、通讯设备、工艺玩具、服饰服装、金属材料、纺织原料、建筑化工材料、机电设备。
	严晓君	中国公民	2,025	20.25	
苏州工业园区华东城建发展有限公司	汤建男	中国公民	1,718.5	42.06	市政工程、公路桥梁工程、土石方工程、给排水工程、绿化工程、建筑安装工程、建筑装修装饰工程、地基与基础围护工程、房屋建筑工程施工。
	陈芸	中国公民	1,000	24.47	
	汤二男	中国公民	1,367.5	33.47	
苏州工业园区普利杰机电制品有限公司	刘钟	中国公民	35	70.00	金属箱柜配件的组装生产；销售机电产品、金属箱柜及零配件、五金交电、日用百货、建筑材料、钢材。
	傅毅	中国公民	15	30.00	
苏州景风正德创业投资管理有限公司	茹华杰	中国公民	100	25.00	创业投资管理、投资咨询。
	孔勇军	中国公民	40	10.00	
	孟爱民	中国公民	100	25.00	
	姚骅	中国公民	120	30.00	
	刘华斌	中国公民	40	10.00	

注：苏州鑫凯建设发展有限公司注册资本 1,200 万元，主要从事建筑工程施工。自然人王亚芳出资 588 万元，持股 49%，朱烨出资 612 万元，持股 51%。王亚芳系该公司董事长，朱烨担任董事。

（2）德睿亨风的财务状况

截至 2011 年 12 月 31 日，德睿亨风资产总额为 24,457.22 万元，净资产为 24,580.25 万元，2011 年度实现净利润-103.05 万元。（以上财务数据未经审计）

（二）发起人以外的其他法人股东基本情况

1、苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司

厚睿咨询为公司第五大股东，持有公司 4,475,000 股股份，占公司本次发行前股本总额的 2.36%，所持本公司股份性质为一般法人股。

厚睿咨询是发行人员工持股公司，成立于 2010 年 9 月 3 日，法定代表人为王蔚，注册资本为 1,200 万元人民币，公司住所为苏州工业园区凤里街 345 号沙湖创投中心 2 座 B 区 105 室，公司目前无实际经营业务。

截至招股说明书签署日，厚睿咨询股权结构及其股东在发行人任职情况如下：

序号	投资者名称	厚睿咨询		晶方科技			
		注册资本（元）	持股比例	职务	间接持有发行人股份（股）	持股比例	价格（元/股）
1	王蔚	5,577,500	46.48%	董事长、总经理	2,080,000	1.10%	2.96
2	钱小洁	1,019,000	8.49%	副总经理	380,000	0.20%	2.96
3	俞国庆	965,300	8.04%	副总经理、总工程师	360,000	0.19%	2.96
4	段佳国	509,500	4.25%	财务总监、董事会秘书	190,000	0.10%	2.96
5	刘芸	388,800	3.24%	销售部副理	145,000	0.08%	2.96
6	吴志云	388,800	3.24%	行政经理	145,000	0.08%	2.96
7	陆健	362,000	3.02%	副主任	135,000	0.07%	2.96
8	周丹	335,200	2.79%	行政人事部副理	125,000	0.07%	2.96
9	杨芹	295,000	2.46%	副理	110,000	0.06%	2.96
10	徐琴琴	187,700	1.56%	采购部课长	70,000	0.04%	2.96
11	虞国平	187,700	1.56%	研发部副科长	70,000	0.04%	2.96
12	刘群	187,700	1.56%	QRA 课长	70,000	0.04%	2.96
13	李瀚宇	174,300	1.45%	研发部项目主管	65,000	0.03%	2.96
14	胡津津	174,300	1.45%	课长	65,000	0.03%	2.96
15	刘渊非	174,300	1.45%	课长	65,000	0.03%	2.96
16	王鑫琴	174,300	1.45%	设计部课长	65,000	0.03%	2.96
17	郑立柱	147,500	1.23%	生产部课长	55,000	0.03%	2.96
18	刘春	134,100	1.12%	设备部课长	50,000	0.03%	2.96
19	陈兵	107,300	0.89%	课长	40,000	0.02%	2.96
20	李孝阳	93,900	0.78%	厂务领班	35,000	0.02%	2.96

21	邵晓鹰	93,800	0.78%	工程师	35,000	0.02%	2.96
22	陈志斌	80,500	0.67%	工程师	30,000	0.02%	2.96
23	莫小韦	80,500	0.67%	制程工程师	30,000	0.02%	2.96
24	喻 琼	80,500	0.67%	设计工程师	30,000	0.02%	2.96
25	谢国梁	80,500	0.67%	工程师	30,000	0.02%	2.96
合 计		12,000,000	100.00%	-	4,475,000	2.36%	2.96

2、苏州豪正企业管理咨询有限公司

豪正咨询为公司第七大股东，持有公司 3,785,000 股股份，占公司本次发行前股本总额的 2.00%，所持本公司股份性质为一般法人股。

豪正咨询是发行人员工持股公司，成立于 2010 年 9 月 3 日，法定代表人为王蔚，注册资本为 1,015 万元人民币，公司住所为苏州工业园区凤里街 345 号沙湖创投中心 2 座 B 区 105 室，公司目前无实际经营业务。

截至招股说明书签署日，豪正咨询股权结构及其股东在发行人任职情况如下：

序号	投资者名称	豪正咨询		晶方科技			
		注册资本（元）	持股比例	职务	间接持有发行人股份（股）	持股比例	价格（元/股）
1	王 蔚	3,043,800	29.99%	董事长、总经理	1,135,000	0.60%	2.96
2	王文龙	1,019,000	10.04%	副总经理	380,000	0.20%	2.96
3	钱祺凤	1,019,000	10.04%	内审部经理	380,000	0.20%	2.96
4	吴勇军	549,700	5.42%	采购部经理	205,000	0.11%	2.96
5	吴国良	415,700	4.10%	计划部副理	155,000	0.08%	2.96
6	王之奇	415,700	4.10%	研发部副理	155,000	0.08%	2.96
7	张 志	415,700	4.10%	制造部副理	155,000	0.08%	2.96
8	刘国涛	415,700	4.10%	制造部副理	155,000	0.08%	2.96
9	李 森	174,300	1.72%	厂务课长	65,000	0.03%	2.96
10	陆月红	174,300	1.72%	采购课长	65,000	0.03%	2.96
11	吴海洋	174,300	1.72%	课长	65,000	0.03%	2.96
12	石 强	93,900	0.93%	品保部副课长	35,000	0.02%	2.96
13	殷彩琴	93,900	0.93%	计划、物控副课长	35,000	0.02%	2.96
14	曹 枫	93,900	0.93%	采购部副课长	35,000	0.02%	2.96
15	叶 磊	93,900	0.93%	行政人事部副课长	35,000	0.02%	2.96
16	沈戌霖	93,900	0.93%	工程师	35,000	0.02%	2.96
17	张力兵	93,900	0.93%	制程工程师	35,000	0.02%	2.96
18	黄秋江	93,900	0.93%	工程师	35,000	0.02%	2.96
19	李传银	93,900	0.93%	设备部副课长	35,000	0.02%	2.96
20	李海峰	93,900	0.93%	工程部副课长	35,000	0.02%	2.96
21	胡 译	93,900	0.93%	公司副课长	35,000	0.02%	2.96

22	徐小菊	93,900	0.93%	计划部 PC	35,000	0.02%	2.96
23	姚丽花	93,900	0.93%	行政人事部副课长	35,000	0.02%	2.96
24	王 琦	93,800	0.92%	制造部课长	35,000	0.02%	2.96
25	邓 绪	93,800	0.92%	设备部工程师	35,000	0.02%	2.96
26	张 坚	93,800	0.92%	研发工程师	35,000	0.02%	2.96
27	陆建英	80,400	0.79%	财务部资深管理员	30,000	0.02%	2.96
28	沈 军	80,400	0.79%	工程部副课长	30,000	0.02%	2.96
29	陈 胜	80,400	0.79%	工程师	30,000	0.02%	2.96
30	吴 超	80,400	0.79%	工程师	30,000	0.02%	2.96
31	夏赞飞	80,400	0.79%	工程师	30,000	0.02%	2.96
32	夏承禹	80,400	0.79%	设备工程师	30,000	0.02%	2.96
33	廖周芳	80,400	0.79%	设备工程师	30,000	0.02%	2.96
34	陈俊飞	80,400	0.79%	设备工程师	30,000	0.02%	2.96
35	王文斌	80,400	0.79%	研发工程师	30,000	0.02%	2.96
36	李俊杰	80,400	0.79%	研发工程师	30,000	0.02%	2.96
37	洪新峰	67,000	0.66%	仓库主管	25,000	0.01%	2.96
38	王凤平	53,600	0.53%	厂务领班	20,000	0.01%	2.96
合 计		10,150,000	100.00%	-	3,785,000	2.00%	2.96

3、晶磊有限公司

晶磊有限公司第九大股东，持有公司 1,240,000 股股份，占公司本次发行前股本总额的 0.65%，所持本公司股份性质为外资股。

晶磊有限是发行人员工持股公司，成立于 2010 年 9 月 3 日，注册地为香港，注册资本为 1 万元港币，公司住所为 FLAT/RM 1105 LIPPO CENTRE TOWER 189 QUEENSWAY ADMIRALTY，公司目前无实际经营业务。

截至招股说明书签署日，晶磊有限股权结构及其股东在发行人任职情况如下：

序号	投资者名称	国籍	晶磊有限		晶方科技			
			注册资本 (港元)	持股比例	职务	间接持有发行人股份 (股)	持股比例	价格 (元/股)
1	刘宏钧	加拿大	3,588	35.88%	副总经理	445,000	0.23%	2.96
2	黄福龙	中国台湾	2,742	27.42%	副总经理	340,000	0.18%	2.96
3	王卓伟	中国台湾	2,097	20.97%	副总经理、副总工程师	260,000	0.14%	2.96
4	李建国	中国台湾	1,573	15.73%	厂务部经理	195,000	0.10%	2.96
合 计			10,000	100.00%	-	1,240,000	0.65%	2.96

(三) 公司无实际控制人的认定

1、发行人无实际控制人

由于发行人的股权结构、董事会决议及成员构成特点，无任何单一股东对公

司的经营方针及重大事项的决策能够决定和作出实质影响，并且股东之间不存在一致行动的情形，因此，发行人无控股股东、无实际控制人。

（1）股份公司设立之前（有限公司阶段）

2009 年 1 月至今，公司董事会成员构成情况如下表所示：

2009 年 1 月-股份公司设立				股份公司设立后至今			
姓名	国籍	职务	委派方	姓名	国籍	职务	委派方
费建江	中国	董事长	中新创投	费建江	中国	董事	中新创投
盛刚	中国	董事	中新创投	盛刚	中国	董事	中新创投
Amir Galor	以色列	董事	英菲中新	Amir Galor	以色列	董事	英菲中新
Ariel Poppel	以色列	董事	EIPAT	Ariel Poppel	以色列	董事	EIPAT
廖宇平	美国	董事	OmniH	KAH-ONG TAN	马来西亚	董事	OmniH
王蔚	中国	董事	共同委派	王蔚	中国	董事长	共同委派
-	-	-	-	杨柯	中国	独立董事	-
-	-	-	-	杨辉	中国	独立董事	-
-	-	-	-	黄彩英	中国	独立董事	-

注：晶方科技设立之初，EIPAT 和中新创投双方约定：为保证中方和以方在晶方科技董事席位的均衡，中方通过中新创投委派两名董事，以方通过 EIPAT 和英菲中新各委派一名董事，中方委派的董事费建江、盛刚均在中新创投控股股东苏创集团任职，以方委派的董事 Amir Galor、Ariel Poppel 均在 Infinity 基金管理公司任职。

在股份公司成立以前，发行人为中外合资企业，有限公司的最高权力机构为董事会。根据《公司章程》规定，下列事项由出席董事会的全体董事一致投票表决批准后方可通过：（1）对章程的修改；（2）公司注册资本增资或减资、任何股权利益的转让、出售或处置公司的全部或绝大部分股权利益、业务和或财产（包括但不限于以许可的方式）；（3）公司与任何其他经济实体的合并或整合、公司组织结构的任何分裂或变化或重组、公司的解散或清算；（4）以公司的任何资产作出抵押、质押或担保；（5）公司的经营范围的重大改变；（6）授予、修改或取消分类签署权权限和有关的代理权限。除了上述事项或合同另有规定的事项之外，董事会作出的所有批准、授权和其他行动应由出席董事会的全体董事（或其代表）过半数通过。

公司董事会由 6 名董事组成，第一大股东 EIPAT 委派一名、第二大股东中新创投委派两名，第三大股东 OmniH 和第四大股东英菲中新各委派一名，剩余一名董事由各方股东共同委派，各股东在董事会席位上的分配比较均衡。单一股东在公司董事会所占席位均未过半，无法控制董事会或对董事会决议产生决定性

影响。发行人全体董事均参加了历次董事会并进行了相应的表决，且该等董事均依据自己的意愿对会议议案进行表决，不存在任何单一股东单独控制董事会的情形，因此，在有限公司阶段，发行人无实际控制人。

（2）股份公司成立以后

股份公司成立以后，股东大会为最高权力机构。除股东大会决议的事项外，公司日常业务活动中的具体事项，均由董事会决定。

变更为股份公司后，除 OmniH 更换了其所委派的董事以及增加了三名独立董事之外，发行人其他股东委派的董事未发生变化。公司董事会由 9 名董事组成，第一大股东 EIPAT 委派一名、第二大股东中新创投委派两名，第三大股东 OmniH 和第四大股东英菲中新各委派一名，还有一名为共同委派，其余三名为独立董事，各股东在董事会席位上的分配仍然比较均衡。单一股东在公司董事会所占席位均未过半，无单一股东对董事会有实质影响，单一股东对发行人董事会均不构成实际控制。

根据《公司法》及公司章程的规定，股东大会作出决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，特殊事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。截至招股说明书签署之日，发行人共有 10 名股东，股权结构较为分散，第一大股东 EIPAT 和第二大股东中新创投持股比例分别为 35.27% 和 29.05%，无任何股东直接持股比例高于 50%；中新创投及其全资子公司合计持有公司第一大股东 EIPAT 30.63% 的股权，中新创投作为有限投资者持有公司第四大股东英菲中新的 49.50% 的股权，并且持有英菲中新必备投资者华亿创投 50% 的股权，中新创投的控股股东苏创集团持有公司第十大股东德睿亨风 29% 的股权，但是由于中新创投对 EIPAT、英菲中新、德睿亨风均无实际控制权，因此，中新创投及其子公司、控股股东在发行人其他股东中持股不会影响中新创投作为发行人股东的实际表决权；发行人各股东均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；其各自亦与其他发行人股东之间不存在通过协议、其他安排，与其他股东共同扩大其所能支配的发行人股份表决权数量的行为或者事实。因此，单一股东对公司的普通及重大决议均不产生实质影响，在股份公司阶段，发行人无实际控制人。

1) 中新创投对 EIPAT 无实际控制权

中新创投成为 EIPAT 股东的主要原因为：2005 年，EIPAT、中新创投和英

菲中新三方共同出资设立晶方科技，但 EIPAT 由于自身缺乏资金，只能提供设备和技术支持，占晶方科技股份比例较小。为了能让 EIPAT 的利益与晶方科技更加紧密，促使 EIPAT 将相关技术毫无保留的授权给公司使用，并提供全方面的技术支持，协助公司迅速消化吸收技术，全力辅佐公司开拓市场和业务渠道，中新创投和 EIPAT 双方约定：中新创投先对 EIPAT 进行增资，EIPAT 再将该资金对晶方科技进行可转股的债权投资，但中新创投不具有 EIPAT 董事委派权。

中新创投全资子公司华圆咨询成为 EIPAT 股东的主要原因为：2011 年，KGIF Limited Partnership 由于基金合同经营期限到期，需要将其持有 EIPAT 17.90% 的股份予以转让，根据 EIPAT 公司章程，所有优先股股东及持有 EIPAT 公司 5% 以上股份的股东享有优先购买权，中新创投具有优先购买权，出于获得财务投资收益考虑，中新创投子公司华圆咨询受让了 KGIF 持有的 EIPAT 5.06% 的股权。

EIPAT 公司章程中明确规定了具有董事委派权的股东，而中新创投不具备该权力，故自中新创投成为 EIPAT 股东以来，一直无权委派董事，其对 EIPAT 董事会决策无任何影响。另外根据公司章程，EIPAT 股东会一般事项需要 50% 以上股权通过，特别决议事项需要 75% 以上股权通过。由于仅持有 EIPAT 30.63% 的股权，中新创投无法对 EIPAT 的股东会形成控制，由于修改公司章程属特别决议事项，从而，中新创投无法单方面通过修改章程来获得董事的委派权。因此，中新创投对 EIPAT 的日常经营决策无法构成重大影响，更无法形成控制。

2) 中新创投对英菲中新无实际控制权

英菲中新系 2005 年 4 月根据《外商投资创业投资企业管理规定》设立的中外合作非法人创业投资企业，华亿创投为其必备投资者，负责英菲中新业务的运营、控制与监督，并具备法律法规赋予必备投资者的权利和权力，有限投资者不参与企业的运营和管理。中新创投和 Israel Infinity Venture Capital Management II Ltd. 各持有英菲中新的必备投资者华亿创投 50% 的股权，各委派了两名董事，均无法单独实施控制，因此，中新创投对英菲中新不存在实际控制权。

3) 中新创投对德睿亨风无实际控制权

公司第二大股东中新创投的控股股东苏州创业投资集团有限公司持有发行人第十大股东德睿亨风 29.00% 股权，但由于德睿亨风股权较为分散，单一股东持股均不超过 30%，无任何单一股东对公司经营方针及重大事项的决策能够决

定和作出实质影响；同时德睿亨风的董事会席位也较分散，13 个董事会席位中苏创集团仅占 1 席，无任一股东委派的董事足以决定董事会的决策，因此，德睿亨风无实际控制人，中新创投对德睿亨风不存在实际控制权。

4) 股东之间不存在一致行动

虽然中新创投及其全资子公司持有公司第一大股东 EIPAT 30.63%的股权；中新创投作为有限投资者持有公司第四大股东英菲中新的 49.50%的权益，同时，中新创投持有英菲中新必备投资者华亿创投 50%的股权；中新创投的控股股东苏创集团持有公司第十大股东德睿亨风 29%的股权，但是中新创投对 EIPAT、英菲中新、德睿亨风均无实际控制权，EIPAT、中新创投、英菲中新、德睿亨风自成为发行人股东以来，各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；其各自亦与其他发行人股东之间不存在通过协议、其他安排，与其他股东共同扩大其所能支配的发行人股份表决权数量的行为或者事实。

EIPAT、中新创投、英菲中新、德睿亨风于 2010 年 12 月 31 日出具《确认函》，确认其自成为发行人股东以来，各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；其各自亦与其他发行人股东之间不存在通过协议、其他安排，与其他股东共同扩大其所能支配的发行人股份表决权数量的行为或者事实。除前述股东外，发行人的其他股东 OmniH、Gillad Galor、泓融投资均出具《确认函》：确认其自成为发行人股东以来，与发行人其他股东之间不存在关联关系，亦不存在通过协议、其他安排，与其他股东共同扩大其所能支配的发行人股份表决权数量的行为或者事实，即无通过投资、协议或者其他安排实现共同拥有公司控制权的情形。

2、发行人控制权在报告期内没有发生变更

(1) 发行人的股权及控制结构没有发生重大变化

发行人自 2009 年 1 月至今，股东的出资比例变化情况如下：

股东名称	2009 年 1 月 -2010 年 4 月	2010 年 4 月 -2010 年 9 月	2010 年 9 月 至今
EIPAT	37.73%	37.14%	35.27%
中新创投	31.08%	30.58%	29.05%
OmniH	19.98%	19.66%	18.68%
英菲中新	8.88%	8.74%	8.30%
Gillad Galor	2.33%	2.29%	2.18%
泓融投资	0.00%	1.06%	1.01%

德睿亨风	0.00%	0.53%	0.50%
厚睿咨询	0.00%	0.00%	2.36%
豪正咨询	0.00%	0.00%	2.00%
晶磊有限	0.00%	0.00%	0.65%
合 计	100.00%	100.00%	100.00%

报告期内，公司前四大股东 ETPAT、中新创投、OmniH、英菲中新未发生变化。2010 年 4 月 21 日，发行人以增资方式引入泓融投资及德睿亨风两家国内投资机构，共持有公司 1.51%的股权。2010 年 9 月 19 日，为实施管理层激励计划，发行人以增资方式引入厚睿咨询、豪正咨询、晶磊有限等三家员工持股公司，共持有公司 5.01%的股权。

(2) 发行人的经营管理层没有发生重大变化

1) 报告期内，高管人员变更情况

报告期内，对公司生产经营中起核心作用的经营管理人员任职变动情况如下：

	2009 年 1 月- 2010 年 6 月	2010 年 6 月-9 月	2010 年 9 月-11 月	2010 年 11 月- 2011 年 1 月	2011 年 1 月至今
高级 管理 人员 名 称 和 职 位	王蔚（总经理）	王蔚（总经理）	王蔚（总经理）	王蔚（总经理）	王蔚（总经理）
	王文龙（部门负责人， 分管工程、设备和制造）	王文龙（副总经理）	王文龙（副总经理）	王文龙（副总经理）	王文龙（副总经理）
	黄福龙（部门负责人， 分管品保、厂务和计划）	黄福龙（副总经理）	黄福龙（副总经理）	黄福龙（副总经理）	黄福龙（副总经理）
	刘宏钧（部门负责人， 分管采购和销售）	刘宏钧（副总经理）	刘宏钧（副总经理， 分管采购和销售）	刘宏钧（副总经理， 分管采购和销售）	刘宏钧（副总经理， 分管采购和销售）
	俞国庆（总工程师）	俞国庆（副总经理、 总工程师）	俞国庆（副总经理、 总工程师）	俞国庆（副总经理、 总工程师）	俞国庆（副总经理、 总工程师）
	王卓伟（副总工程师）	王卓伟（副总经理、 副总工程师）	王卓伟（副总经理、 副总工程师）	王卓伟（副总经理、 副总工程师）	王卓伟（副总经理、 副总工程师）
	钱小洁（部门负责人， 分管行政人事和公共关 系）	钱小洁（副总经理）	钱小洁（副总经理）	钱小洁（副总经理）	钱小洁（副总经理）
	-	刘立冬（董事会秘 书、副总经理）	刘立冬（董事会秘 书、副总经理）	段佳国（董事会秘 书）	段佳国（董事会秘 书）
	盛刚（财务总监）	盛刚（财务总监）	段佳国（财务总监）	段佳国（财务总监）	段佳国（财务总监）
	-	-	-	-	Vage Oganision （副总经理）

2010 年 6 月前，王文龙、黄福龙、俞国庆、刘宏钧、王卓伟、钱小洁虽职衔未定为副总经理级别，但均为其部门负责人，属公司管理人员。因此，报告期内发行人经营管理层人员未发生重大变动。

2) 报告期内，高管人员的履职情况

报告期内，共有 11 人在本公司担任过高管职务，除 2010 年 11 月副总经理、

董事会秘书刘立冬离职以外，其余 10 人均仍在本公司履职，具体履职情况如下：

王蔚，公司设立的主导者，撮合 Shellcase、中新创投、英菲中新三方投资设立了晶方科技。自公司设立后，王蔚一直担任本公司总经理，全面主持经营管理工作，成功带领公司团队在2006年实现量产。2010年6月，公司整体变更为股份公司，经公司第一届董事会第一次决议通过，聘任王蔚为公司总经理。报告期内，王蔚一直在公司任职，且职责范围未发生变动。

王文龙，2005 年加入公司，担任工程部、制造部、设备部的部门负责人，分管工程技术指标以及技术管理制度、设备评估、安装、改进以及维护、生产绩效考核以及质量控制。2010 年 6 月，公司整体变更为股份公司，经公司第一届董事会第一次决议通过，聘任王文龙为公司副总经理。报告期内，王文龙一直在公司任职，且职责范围未发生变动。

黄福龙，2006 年加入公司，担任生产厂长，分管生产线质检以及公共设施的改造和完善。2010 年 6 月，公司整体变更为股份公司，经公司第一届董事会第一次决议通过，聘任黄福龙为公司副总经理。报告期内，黄福龙一直在公司任职，且职责范围未发生变动。

刘宏钧，2008 年加入公司，担任采购部、营销部的部门负责人，分管采购计划以及供应商评估、销售网络建设和客户关系管理。2010 年 6 月，公司整体变更为股份公司，经公司第一届董事会第一次决议通过，聘任刘宏钧为公司副总经理。报告期内，刘宏钧一直在公司任职，其职责范围未发生变动。

俞国庆，2006 年加入公司，担任研发中心负责人、总工程师，分管新产品的设计、样品的研制以及科研项目实施。2010 年 6 月，公司整体变更为股份公司，经公司第一届董事会第一次决议通过，聘任俞国庆为公司副总经理。报告期内，俞国庆一直在公司任职，其职责范围未发生变动。

王卓伟（曾用名：王宥军），2005 年加入公司，担任工程经理和品管经理，2007 年离职，2008 年返回公司，担任副总工程师，协助总工程师管理研发中心。2010 年 6 月，公司整体变更为股份公司，经公司第一届董事会第一次决议通过，聘任王卓伟为公司副总经理。报告期内，王卓伟一直在公司任职，其职责范围未发生变动。

钱小洁，2005 年加入公司，担任行政总监，分管行政管理部和人力资源部，2010 年 6 月，公司整体变更为股份公司，经公司第一届董事会第一次决议通过，

聘任钱小洁为公司副总经理。报告期内，钱小洁一直在公司任职，其职责范围未发生变动。

段佳国，2010 年加入公司，经公司第一届董事会第二次会议通过，聘任段佳国为财务总监，分管财务部，负责账务管理、纳税申报以及内部控制等工作，原财务总监盛刚目前仍然担任公司董事。2010 年 11 月，经公司第一届董事会第一次临时会议通过，同意刘立冬辞去董事会秘书职务，同时聘任段佳国为公司董事会秘书。自此，段佳国在分管财务部的同时，还分管证券部，负责董事会及股东大会会议的筹备、与证券监管机构、证券服务机构、媒体等的信息沟通和联络等，职责范围有所增加。

Vage Oganestion，2011 年 1 月加入公司，经公司第一届董事会第五次会议通过，聘任 Vage Oganestion 为公司副总经理，分管公司全资子公司晶方北美。公司于 2010 年 11 月在美国设立全资子公司晶方北美，增加高级管理人员 Vage Oganestion 主管子公司的工作系正常生产经营的需要。

（3）发行人的主营业务没有发生重大变化

发行人自成立以来一直从事晶圆级芯片尺寸封装测试服务业务，公司的主营业务未发生过重大变化。

（4）发行人的股权及控制结构不影响公司治理有效性

发行人的董事会、股东大会运作规范，同时华普天健已对发行人内部控制制度出具了无保留意见的《内部控制审核报告》，发行人内部控制制度健全且运行良好。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行人的股权及控制结构、经营管理层和主营业务在首发前 3 年内没有发生重大变化；发行人的股权及控制结构不影响公司治理有效性；由于发行人的股权结构、董事会决议及成员构成特点，无任何单一股东对公司的经营方针及重大事项的决策能够决定和作出实质影响，并且股东之间不存在一致行动的情形。

3、发行人经营决策的稳定性措施

针对发行人股权分散、无实际控制人的情况，发行人采取如下措施保证公司经营决策的稳定性、公司治理的有效性以及避免公司内部人控制对股东利益带来的影响。

(1) 发行人股东承诺上市后锁定股份

发行人全体股东签署了《关于本次发行前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺函》，其中，中新创投承诺其间接所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 36 个月，其直接所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 60 个月；EIPAT、厚睿咨询、豪正咨询、晶磊有限承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 36 个月；OmniH、英菲中新、泓融投资、德睿亨风、Gillad Galor 承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 12 个月。发行人通过股东承诺锁定股份的方式，保持发行人在上市后的股权结构稳定，保证股东大会作为经营决策层的稳定性。

(2) 发行人建立了健全的内部管理制度保证公司治理的有效性

公司依法制定了健全的内部管理制度；公司设置独立董事，强化对董事会及经理层的约束和监督；公司任何股东单独均不能通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任。公司历次股东大会、董事会、监事会均按照公司法和公司章程规定的职权履行职责，该等股东大会、董事会、监事会会议议案均是由全体股东、董事、监事一致表决通过。

(3) 发行人建立了健全的内部控制制度防范内部人控制以保障股东利益

公司制定了《对外担保管理规定》、《关联交易公允决策制度》、《投资管理制度》，从而避免因可能的内部人控制而损害股东利益；同时考虑到上市后公众股东的利益保障，公司还制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，确保本公司上市后公众股东能及时、准确的获取本公司对外披露的信息，从而有利于公众股东有效的参与公司治理，保障公众股东的利益。公司制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循。

华普天健对公司的内部控制制度进行了专项审核，于 2012 年 3 月 12 日出具了会审字[2012]0091 号《内部控制审核报告》，证明本公司的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

综上所述，发行人股权分散、无实际控制人的状况，并未影响公司经营业绩的稳定和公司治理的有效性，公司已采取了有效措施确保公司股权结构的稳定性、经营决策的稳定性和避免内部人控制。

（四）公司股东直接持有发行人的股份的质押及其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，本公司股东持有发行人的股份无质押或其他争议情形。

九、发行人股本情况

（一）本次发行前后发行人股本变化情况

本次发行前发行人总股本为 18,950 万股，本次拟发行 6,317 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。

股东名称	发行前		发行后	
	持股数（股）	占比（%）	持股数（股）	占比（%）
EIPAT	66,844,336	35.27	66,844,336	26.37
中新创投	55,048,276	29.05	55,048,276	21.79
OmniH	35,388,178	18.68	35,388,178	14.01
英菲中新	15,728,079	8.30	15,728,079	6.22
Gillad Galor	4,128,621	2.18	4,128,621	1.63
泓融投资	1,908,602	1.01	1,908,602	0.76
德睿亨风	953,908	0.50	953,908	0.38
厚睿咨询	4,475,000	2.36	4,475,000	1.77
豪正咨询	3,785,000	2.00	3,785,000	1.50
晶磊有限	1,240,000	0.65	1,240,000	0.49
本次发行	-	-	63,170,000	25.00
合 计	189,500,000	100.00	252,670,000	100.00

（二）发行人前十名股东

序号	股东名称	持股数（股）	占比（%）	股权性质
1	EIPAT	66,844,336	35.27	外资股
2	中新创投	55,048,276	29.05	国有股
3	OmniH	35,388,178	18.68	外资股
4	英菲中新	15,728,079	8.30	其他
5	厚睿咨询	4,475,000	2.36	一般法人股
6	Gillad Galor	4,128,621	2.18	外资股
7	豪正咨询	3,785,000	2.00	一般法人股
8	泓融投资	1,908,602	1.01	一般法人股
9	晶磊有限	1,240,000	0.65	外资股
10	德睿亨风	953,908	0.50	一般法人股
合 计		189,500,000	100.00	-

根据江苏省国有资产监督管理委员会 2011 年 3 月 10 日出具的苏国资复【2011】28 号《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司国有股权管理有关事项的批

复》，中新创投所持本公司股份为国有股。2011年3月14日，中新创投已按《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》取得了【2011】31号《财政部关于豁免中新苏州工业园区创业投资有限公司国有股转持义务有关问题的批复》。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：鉴于中新创投的国有股转持义务已被豁免，发行人的其他股东均为非经国有资产监督管理机构确认的国有股东，因而在发行人首次公开发行股票并上市时，发行人各股东均无须按照《转持办法》向全国社会保障基金理事会转持股份。

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署之日，发行人共有1名外籍自然人股东，其持有发行人4,128,621股股份，占发行前总股本的2.18%，该股东未在发行人单位任职。

（四）股东中的战略投资者持股及其简况

发行人不存在战略投资者持股情形。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

公司第二大股东中新创投及其全资子公司合计持有公司第一大股东EIPAT 30.63%的股权；中新创投作为有限投资者持有公司第四大股东英菲中新 49.50%股权，同时，中新创投持有英菲中新的必备投资者华亿创投 50%的股权；公司第二大股东中新创投的控股股东苏创集团持有发行人第十大股东德睿亨风 29.00%股权；公司第五大股东厚睿咨询、第七大股东豪正咨询与第九大股东晶磊有限均为发行人员工持股公司。

EIPAT 持有公司 66,844,336 股股份，占公司本次发行前股本总额的 35.27%；中新创投持有公司 55,048,276 股股份，占公司本次发行前股本总额的 29.05%；英菲中新持有公司 15,728,079 股股份，占公司本次发行前股本总额的 8.30%；德睿亨风持有公司 953,908 股股份，占公司本次发行前股本总额的 0.50%；厚睿咨询持有公司 4,475,000 股股份，占公司本次发行前股本总额的 2.36%；豪正咨询持有公司 3,785,000 股股份，占公司本次发行前股本总额的 2.00%；晶磊有限持有公司 1,240,000 股股份，占公司本次发行前股本总额的 0.65%。

除上述情形以外，其他股东之间不存在关联关系。

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司第一大股东 EIPAT 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司第二大股东中新创投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，自公司股票上市之日起六十个月后，每年转让直接持有的发行人股份不超过其所直接持有发行人股份总数的百分之二十五。

公司股东厚睿咨询、豪正咨询、晶磊有限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东 OmniH、英菲中新、泓融投资、德睿亨风、Gillad Galor 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员王蔚、陆健、黄福龙、段佳国、俞国庆、王文龙、刘宏钧、钱小洁、王卓伟承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。

十、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况

发行人没有发行过内部职工股。发行人不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

十一、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工人数及结构情况

1、员工人数及变化

报告期内，本公司及其子公司员工人数如下表所示：

项 目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
员工人数	484	479	402

2、员工专业结构

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及其子公司的员工专业结构如下：

项 目	人数	占员工总数的比例
研发技术人员	94	19.42%
管理人员	18	3.72%
生产制造人员	318	65.70%
业务人员	21	4.34%
行政后勤人员	33	6.82%
合 计	484	100.00%

3、员工受教育程度

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及其子公司的员工受教育程度如下：

项 目	人数	占员工总数的比例
硕士及以上	6	1.24%
本科	95	19.63%
大专	54	11.16%
中专及以下	329	67.97%
合 计	484	100.00%

4、员工年龄分布

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及其子公司的员工年龄分布如下：

项 目	人数	占员工总数的比例
30 岁以下	443	91.53%
31—40 岁	21	4.34%
41—50 岁	20	4.13%
合 计	484	100.00%

(二) 员工社会保障情况

本公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定，实行全体员工劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。发行人按照国家 and 地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理了养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等社会保障。公司员工的工资、福利和劳动保护均按照国家和地方政府的有关规定执行。

十二、持有发行人 5%以上股份的股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺

（一）股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

持有发行人 5%以上股份的股东及作为股东的董事、监事及高管人员作出关于股份流通限制和自愿锁定的承诺。其具体内容详见本节“九、发行人股本情况”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

（二）避免同业竞争的承诺

公司股东 EIPAT 和中新创投，以及公司董事、监事、高级管理以及核心技术人员分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，其具体内容详见“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（三）避免同业竞争的承诺”。

第六节 业务与技术

一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

本公司主营业务为集成电路的封装测试业务，主要为影像传感芯片、环境光感应芯片、微机电系统（MEMS）、发光电子器件（LED）等提供晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）及测试服务。

公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）量产服务的专业封测服务商。公司拥有多样化的 WLCSP 量产技术，包括超薄晶圆级芯片尺寸封装技术（ThinPac）、光学型晶圆级芯片尺寸封装技术（ShellOP）、空腔型晶圆级芯片尺寸封装技术（ShellOC）、晶圆级凸点封装技术（RDL Wafer Bumping）、硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术（TSV），以及应用于微机电系统（MEMS）、发光电子器件（LED）的晶圆级芯片尺寸封装技术。发行人及其子公司通过自主创新，已成功申请并获得国家知识产权局授权的专利共 19 项，另有 5 项美国发明专利，并且还有 19 项发明专利正在受理中。

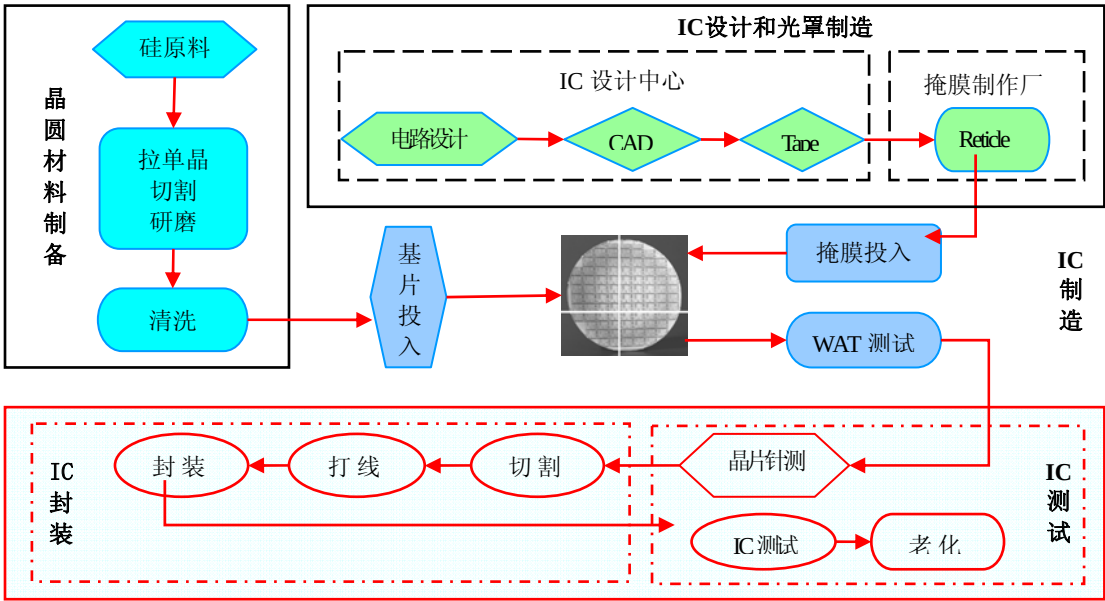
公司目前封装产品主要有影像传感芯片、环境光感应芯片、医疗电子器件、微机电系统（MEMS）、射频识别芯片（RFID）等，该些产品被广泛应用在消费电子（手机、电脑、照相机等）、医学电子、电子标签身份识别、安防设备等诸多领域。

本公司自设立以来，一直从事提供晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）及测试服务，主营业务未发生变更。

二、行业基本情况

公司属于半导体集成电路（IC）产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路（IC）和半导体分立器件两大分支，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。集成电路产业链是半导体产业的典型代表，因为其技术的复杂性，产业结构向高度专业化转化，可细分为 IC 设计业、芯片制造业及 IC 封装测试业三个子产业群。

图：集成电路封装在产业链中的角色



集成电路（IC）封装是集成电路产业链里必不可少的环节。封装是指将通过测试的晶圆加工得到独立芯片的过程，使电路芯片免受周围环境的影响（包括物理、化学的影响），起着保护芯片、增强导热（散热）性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以沟通芯片内部与外部电路的作用，它是集成电路和系统级板如印制板（PCB）互连实现电子产品功能的桥梁。

（一）行业管理体制

1、行业主管部门

国家工业与信息化部是国内集成电路制造业的产业行政主管部门，主要负责制定我国半导体行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

中国半导体行业协会是国内集成电路制造业行业的自律性组织，主要负责行业引导和服务，其主要职能是：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；调查、研究、预测本行业产业与市场，根据授权开展行业统计，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准。推动标准的贯彻执行；促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善。

本行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进

行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

2、行业主要政策

集成电路产业是电子信息产业的基础，是国际竞争力的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志，国家高度重视和大力支持集成电路产业的发展。与集成电路产业相关的政策如下：

（1）《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

该政策由国务院于 2000 年 6 月颁布，是集成电路产业的核心政策，主要是为软件企业和集成电路生产企业给予税收方面的优惠。财政部、国家税务总局于 2002 年发布了《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路发展税收政策的通知》（财税[2002]70 号），把优惠范围扩大到集成电路产业上游的设计企业和下游的制造商。

（2）《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》

该规划纲要由原信息产业部于 2006 年 9 月颁布，纲要的发展目标为：2020 年，我国建立较为完善的科技创新体系。在未来 5 年-15 年间，重点发展集成电路、软件技术、新型元器件技术等 15 个领域的关键技术，其中集成电路领域重点发展的关键技术包括 MEMS 技术和新型、高密度集成电路封装、测试技术。同时，在规划纲要中提出加强芯片设计、制造、封装和测试之间的分工、协作与配套，加大集成电路产业链各环节的建设力度。

（3）《电子信息产业调整和振兴规划》

该规划作为电子信息产业综合性应对金融危机措施的行动方案，由国务院于 2009 年 4 月颁布，规划期为 2009 年至 2011 年。《电子信息产业调整和振兴规划》指出，今后三年，电子信息产业围绕九个重点领域，完成如下三个任务：第一，确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长；第二，突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术；第三，通过新应用带动新增长。同时继续完善集成电路产业体系，支持骨干制造企业整合优质资源，加大创新投入，推进工艺升级，支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合。

（4）《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

该政策由国务院于 2011 年 1 月 28 日颁布，为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业

领先企业，在财税、投融资、研究开发、进出口等各方面制定了许多优惠政策。在投融资方面，积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道。

（5）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》

该政策由国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合发布，确定了当前优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的 137 项高技术产业化重点领域，其中，线宽 65 纳米以下的纳米级集成电路芯片封装和测试被归入当前优先发展的高技术产业化重点领域。

（6）《集成电路产业“十二五”发展规划》

该发展规划由工业和信息化部于 2011 年 12 月正式颁布，规划的发展目标为到“十二五”末，产业规模再翻一番以上，关键核心技术和产品取得突破性进展，结构调整取得明显成效，产业链进一步完善，形成一批具有国际竞争力的企业，基本建立以企业为主体的产学研用相结合的技术创新体系。顺应集成电路产品向功能多样化的重要发展方向，大力发展先进封装和测试技术，推进高密度堆叠型三维封装产品的进程，支持封装工艺技术升级和产能扩充。提高测试技术水平和产业规模。

（二）公司所处行业发展概况

1、集成电路封装行业发展概况

（1）我国集成电路整体产业呈高速发展趋势

近几年来，随着国内市场需求增长以及全球半导体领域产业向我国转移，我国集成电路行业得到了较快的发展。从 2000 年到 2007 年间，我国集成电路产量和销售收入年均增长速度超过 30%。虽然 2008 年第三季度爆发的全球经济危机波及实体经济后，国内外半导体市场出现大幅下滑，致使 2008 年和 2009 年我国集成电路产业的销售收入出现负增长。但是随着国家拉动内需政策的迅速制定与深入实施，以及国际市场环境的逐步好转，国内集成电路产业在 2009 年第二季度开始出现销售收入环比增长趋势，目前已恢复至金融危机发生前的水平。2011 年度，我国集成电路产业实现销售收入 1,572.21 亿元，同比增长了 9.2%，而全球集成电路产业销售收入增长率仅为 0.2%。

图：我国集成电路行业销售收入变化情况



资料来源：《中国半导体产业发展状况报告（2012年版）》，中国半导体行业协会

表：2005-2011 年我国集成电路销售额占世界集成电路市场的份额

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
比重 (%)	4.49	6.06	7.54	8.65	8.54	8.60	9.80

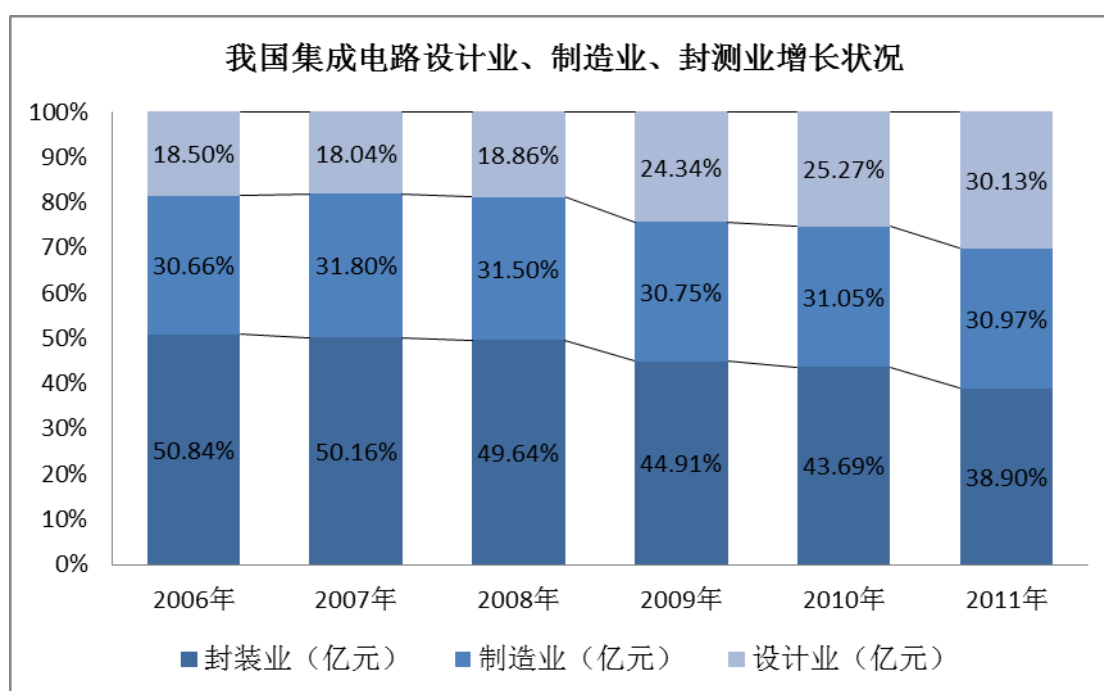
资料来源：中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告（2012年版）》、江苏省半导体行业协会《2011年江苏省半导体产业发展运行分析报告》

从上表可以看出，我国集成电路产业规模从 2005 年以来在世界半导体产业占的比例正在逐年上升。

（2）封装测试业已为我国集成电路的重要组成部分

相对 IC 设计、芯片制造业而言，封装测试行业具有投入资金较小，建设快等优势，因此，许多发展中国家和地区都是先发展封装测试业，积累资金、市场和技术后再逐步发展 IC 设计业和芯片制造业。我国在集成电路领域首先发展的即是封装测试业，由于具备成本和地缘优势，我国半导体封装测试企业快速成长，同时国外半导体公司也向中国大举转移封装测试产能，目前我国已经成为全球主要封装基地之一。封装测试业已成为中国半导体产业的主体，在技术上也开始向国际先进水平靠拢。2011 年度我国封装测试业销售收入规模为 611.56 亿元，占集成电路产业销售收入的 38.90%。

图：我国集成电路设计业、制造业、封测业结构



资料来源：《中国半导体产业发展状况报告（2012年版）》，中国半导体行业协会

（3）集成电路封装行业的竞争格局

1）全球封装行业的竞争格局

伴随着世界集成电路产业的成长与发展，集成电路封装产业与其他产业一样，经历了在国际间不断进行产业转移的历程。集成电路封装产业转移始于 20 世纪 60 年代，现已从欧美发达国家转移至亚太地区，目前主要从事半导体封装的国家（或地区）是中国台湾、中国大陆、新加坡、日本和美国。中国台湾地区依靠集成电路封装起家，在全球集成电路封装行业占据领先地位，2010 年度全球前十大封装公司（专业代工）排名中，台湾地区的企业占据了 5 席。

表： 2010 年度全球前十大专业封装厂商

单位：亿美元

序号	企业名称	所在地	2010 年封测总收入	市场份额 (%)
1	日月光半导体公司 (ASE)	中国台湾	38.52	25.95
2	艾克尔 (Amkor)	美国	29.39	21.79
3	矽品精密工业公司 (SPIL)	中国台湾	19.56	17.21
4	星科金朋公司 (STATS ChipPAC)	新加坡	16.78	13.26
5	力成科技 (PTI)	中国台湾	11.59	9.02
6	神钢电机株式会社 (Shinko)	日本	10.58	11.39
7	优特半导体 (UTAC)	新加坡	10.00	6.01
8	南茂科技 (ChipMOS)	中国台湾	5.73	3.68
9	长电科技 (JCET)	中国	4.82	3.47

10	久元电子 (YTEC)	中国台湾	4.36	3.18
----	-------------	------	------	------

资料来源: Digitimes Research

2) 国内封装行业的竞争格局

为了降低生产成本, 以及看重中国国内巨大且快速成长的终端电子应用市场, 国际半导体制造商和封装测试代工企业纷纷将其封装产能转移至中国, 直接拉动了中国半导体封装产业规模的迅速扩大。目前, 全球大型的 IDM 厂商和专业封装测试代工厂大都已在中国大陆建有生产基地, 由此造成我国封装测试业外资企业占比很高。同时, 经过多年的努力, 我国内资和内资控股的封测企业得到了较快的发展, 正在逐步缩小与国际厂商在技术、市场方面的差距。部分内资封装测试企业 (如长电科技、通富微电、华天科技) 已在国内发行股票上市。

表: 2011 年度我国半导体封装测试行业销售额前十名企业

排名	企业名称	销售额 (亿元)	类型
1	英特尔产品 (成都) 有限公司	188	IDM
2	飞思卡尔半导体 (中国) 有限公司	72.30	IDM
3	江苏新潮科技集团有限公司	62.60	专业封测服务商
4	南通华达微电子集团有限公司	40.10	专业封测服务商
5	上海松下半导体有限公司	39.20	IDM
6	威讯联合半导体 (北京) 有限公司	37.80	IDM
7	海太半导体 (无锡) 有限公司	29.02	专业封测服务商
8	上海凯虹科技有限公司	28.53	IDM
9	深圳赛意法微电子有限公司	27.20	专业封测服务商
10	日月光封装测试 (上海) 有限公司	29.7	IDM

资料来源: 中国半导体行业协会

注: ① 江苏新潮科技集团有限公司为上市公司长电科技 (600584) 之控股股东, 南通华达微电子集团有限公司为上市公司通富微电 (002156) 之控股股东; IDM 系集成器件制造商, 其囊括设计、芯片制造、芯片封装测试所有工序。

② 英特尔产品 (成都) 有限公司的销售额为协会预估数据

从封装测试企业所处的地区分布来看, 我国封装测试业企业最为集中的地区为长江三角洲, 2011 年度该地区封装测试业销售收入占 55.80%, 其次为京津环渤海地区, 占比为 22.70%。

2、发行人所处细分行业的发展概况

本公司主要从事影像传感芯片的晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP) 服务。WLCSP 封装是近年来发展起来的新兴封装方式, 与传统的封装方式相比, 其主要区别是先整片晶圆上封装、测试作业, 再切割成尺寸与裸片完全一致的芯片

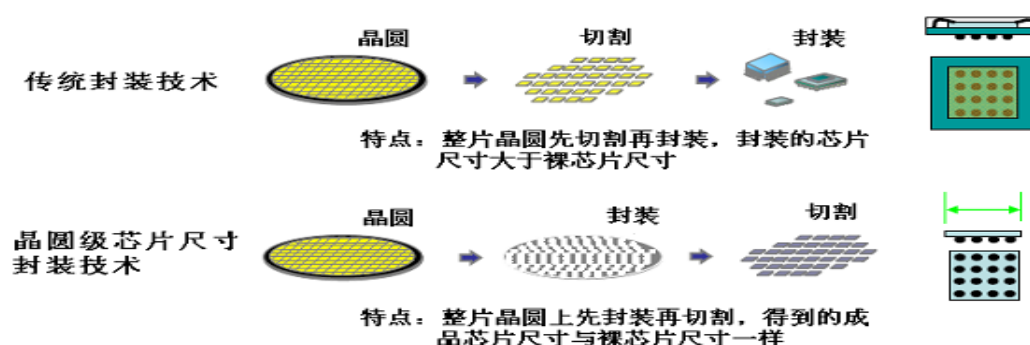
成品，达到了微型化的极限，符合消费类电子产品轻、小、短、薄化的市场趋势，其封装成本的优势随着晶圆尺寸的增大和芯片尺寸的减小而愈加明显。目前，全球只有本公司和台湾精材科技（台积电控股）两家专业封测公司能大规模提供影像传感器晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）量产服务。

（1）晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）简介

1) 晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）的概念及特征

晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）是将芯片尺寸封装（CSP）和晶圆级封装（WLP）融合为一体的新兴封装技术。芯片尺寸封装（CSP）是指封装面积与芯片面积之比小于 1.2:1 的技术，该技术有效促进集成电路的小型化；晶圆级封装（WLP）是指在晶圆前道工序完成后，直接对晶圆进行封装，再切割分离成单一芯片，相对于传统封装将晶圆切割成单个芯片后再进行封装，WLP 技术在封装成本方面具有明显的优势。晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）结合上述两种封装方式的优点，先在整片晶圆上进行封装和测试，然后才切割成单一芯片，无需经过打线和填胶程序，封装后的芯片尺寸与裸芯片几乎一致。因此，晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）的封装方式，不仅能明显缩小 IC 尺寸，符合移动电子产品对高密度体积空间的需求，同时，由于芯片可以以最短的电路路径，通过锡球直接与电路板连接，还能大幅度提升信息传输速度，有效降低杂讯干扰几率。与传统封装技术 QFP 和 BGA 封装产品相比，晶圆级芯片尺寸封装的产品比 QFP 产品小 75%、重量轻 85%，比 BGA 尺寸小 50%、重量轻 40%。

图：晶圆级芯片尺寸封装与传统封装的区别



目前晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）主要采用晶圆凸点封装（Wafer Bumping）和 Shellcase 系列 WLCSP 两种封装技术。晶圆凸点封装是一种技术

难度相对较低的 WLCSP 封装形式,它的主要特点是在芯片正面直接引出电路及焊垫,而 Shellcase 系列 WLCSP 不仅可以在芯片正面直接引出电路及焊垫,也可以将芯片的电路引至芯片的背面后再制作焊垫,Shellcase 系列 WLCSP 封装包括了 Wafer Bumping 的技术要点,其技术难度要高于晶圆凸点封装,且工艺流程也较晶圆凸点封装复杂。

虽然晶圆凸点封装 (Wafer Bumping) 本身也是一种先进的封装形式,但 Shellcase 系列 WLCSP 优势比较明显,其应用领域更广且更符合封装技术的发展趋势:首先,Shellcase 系列 WLCSP 在影像传感器芯片封装领域具有天然优势。由于影像传感芯片的作用主要是光学成像,其功能的实现需要吸纳、反馈物体光线,这势必要求芯片正面无视觉障碍物,即封装的焊垫不能放在芯片正面,否则会阻碍光线成像。Shellcase 系列 WLCSP 在芯片的正反面黏贴玻璃基板 (或其他绝缘材料),将芯片线路、焊垫引至背面,玻璃基板具有透明特性,因此,Shellcase 系列 WLCSP 在影像传感器封装上具有绝佳的优势,而晶圆凸点封装由于在芯片正面引出焊垫,无法应用至影像传感器等领域。Shellcase 系列 WLCSP 从诞生之日起,慢慢侵占传统封装在影像传感器市场的份额,至今全球约 35% 的 CMOS 影像传感器采用 Shellcase 系列 WLCSP 技术封装 (资料来源:

《A Market&Technology Analysis Of WLP Solution For Ics,CMOS Image Sensors&MEMS》,Yole Développement);其次,Shellcase 系列 WLCSP 技术更符合三维 (3D) 封装发展趋势。硅通孔 (TSV) 的三维封装技术被业界认为是超越摩尔定律的主要解决方案,是未来半导体封装技术发展的趋势,而 Shellcase 系列 WLCSP 技术由于能够在芯片正反面引出电路及焊垫,两者工艺十分相似,掌握 Shellcase 系列 WLCSP 技术能快速进入硅通孔技术领域。目前本公司封装产品微机电系统 (MEMS) 芯片就是采用 Shellcase 系列 WLCSP 技术来实现硅通孔 (TSV) 的三维封装。

表: Shellcase 系列 WLCSP 和晶圆凸点封装的特征和应用领域比较

特征和应用领域	
Shellcase 系列 WLCSP	晶圆凸点封装
1、芯片正面或反面引出焊垫	1、芯片正面引出焊垫
2、三明治结构:盖板 (或芯片)/芯片/盖板 (或芯片) (或其他材料)	2、无三明治结构
3、芯片上方有空腔	3、无空腔
4、芯片背部引出焊垫	4、芯片正面引出焊垫

5、适用于任何产品，尤其对影像传感芯片和有密封要求的产品有独特的优势。

5、只是一种电连接引出技术，对影像传感芯片和有密封要求的产品不适合。

目前全球只有少数专业封测服务商掌握了 Shellcase 系列 WLCSP 封装相关技术，能大规模为影像传感器提供量产服务的专业封测商全球仅本公司和精材科技股份有限公司。

2) 晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）的主要优势

晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技术出现伊始，即被业界看好，其完全符合消费电子发展的需求和趋势（产品的轻小短薄化和低价化）。晶圆级芯片尺寸封装与传统封装相比，其主要优势体现在：

① WLCSP 优化了封装产业链

传统封装方式是先将晶圆划片成颗粒芯片，经测试为合格芯片后，将其放到引线框架或封装衬底（基板）上，而后再进行封装测试，产业链涉及晶圆厂、基板厂、封装厂、测试厂。而晶圆级芯片尺寸封装是先对晶圆进行封装、测试作业，然后再对封装测试后的晶圆进行切割。

相对传统封装而言，首先，WLCSP 封装能将传统封装的产业链中的基板厂、封装厂、测试厂整合为一体，使得芯片从制造、封装到进入流通环节的周期大大缩短，从而提高了生产效率，降低生产成本；其次，WLCSP 封装能减少封装前合格芯片的测试环节，且在封装过程中无需打金线、无需使用基板、无需底部填充介电材料（underfill），从而能有效降低封装成本；最后，就技术角度而言，WLCSP 封装是晶圆制造技术的延伸，极大地缩小了半导体后段（即封装）与前段（即晶圆制造）的技术差异，容易实现半导体后段与前段的技术对接。

由于半导体产业具有产品生命周期短、投资金额巨大等特点，IDM 模式越来越无法适应半导体未来发展趋势，因此，专业代工将成为全球集成电路封装测试的未来主流形式，而 WLCSP 封装是可把 IC 设计、晶圆制造、封装测试、基板厂整合为一体的先进封装形式，优化了产业链，解决专业代工模式在 IC 设计、晶圆制造、封装测试、基板厂等各环节的技术与标准对接问题，更加推动了专业代工模式的发展。

② 封装成本随晶圆上芯片数量增加而降低

晶圆级芯片尺寸封装是在整片晶圆上进行封装后再切割得到几百、几千颗芯片，而传统封装是将晶圆先切割成芯片后，再对芯片实施单独的封装。一般而言，

WLCSP 的封装成本是按照晶圆数计量的，与切割后的芯片数无必然联系，而传统封装的封装成本是按封装芯片的个数计量的。因此，WLCSP 的封装成本随晶圆尺寸的增大和芯片数量增加而降低。在消费类电子产品轻、小、短、薄化的市场发展趋势下，晶圆级芯片尺寸封装的成本优势愈加明显，将逐步挤占传统封装的市场份额。

③ WLCSP 将成为未来的主流封装方式

半导体器件的研发、生产和发展一直遵循着著名的摩尔定律（每十八个月芯片上的晶体管数目增加一倍），由于光刻设备、工艺以及物理极限等问题，摩尔定律在更小技术节点（32 纳米和 22 纳米）碰到了前所未有的挑战，这意味着从芯片制造着手来改善电子产品的尺寸、性能、价格已越来越困难，业界已普遍认识到，芯片封装将在顺应电子产品尺寸、性能和价格上的市场需求方面，扮演越来越重要的角色。业界认为基于硅通孔（TSV）的三维封装技术为是超越摩尔定律的主要解决方案，是未来半导体封装技术发展趋势。而 WLCSP 封装是硅通孔技术的基础，两者工艺十分相似，通过掌握 WLCSP 封装技术（尤其是 Shellcase 系列 WLCSP）能快速进入硅通孔技术领域，在未来三维封装技术中扮演主要角色。

（2）晶圆级芯片尺寸封装行业最近几年的发展状况

在 2008 年金融危机发生前，WLCSP 封装市场处于供不应求的局面，主要是由于：一方面，供给有限。全球仅精材科技与本公司能大规模提供影像传感器 WLCSP 封装量产服务；另一方面，影像传感芯片作为数字影像产品的门户，有巨大的市场需求。近几年来，全球数字影像产品如相机、手机、数字相机、PC Camera、数字摄录像机、光学鼠标等在市场均出现热卖，从 2003 年到 2007 年间影像传感器需求复合增长率为 30.30%。基于对影像传感器未来良好的发展前景预期，公司与精材科技相继扩产产能。

2008 年三季度金融危机爆发，波及实体经济后，造成各国居民消费能力欲望的下降，引致全球半导体行业陷入低迷状态。由于电子消费产品需求的减少，全球影像传感器芯片出货量有所下降，公司与精材科技在一定程度出现产能利用率不足的情况，但由于竞争不强，WLCSP 封装细分行业的经营状况仍好于集成电路封装测试整体行业。

自 2009 年二季度开始，全球半导体行业开始复苏，电子消费市场的强劲反

弹，带动影像传感器出货量的剧增。2010 年 WLCSP 封装市场的供求关系又转变为供不应求的局面，公司承接的生产订单超过了现有生产设备的设计产能，需不断的改进制程工艺，最大限度的释放产能，以满足市场的需求。

（3）晶圆级芯片尺寸封装行业的未来发展前景

由于晶圆级芯片尺寸封装的自身优势，其未来必将成为集成电路封装行业的主流封装方式，有广阔的发展前景。据 Yole Développement 预测，应用 WLCSP 技术的封装产品对外出售实现的销售收入将由 2009 年的 36 亿美元左右增长至 2012 年的 70 亿美元，晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）服务收入年均复合增长率将达到 25%-30%。

晶圆级芯片尺寸封装广阔的发展前景主要体现在以下两个方面：一方面，现有最主要应用领域影像传感器芯片封装的存量增长。据法国著名市场调研公司 Yole Développement 出具研究报告显示，2007 年，全球约 35%用于手机和笔记本电脑的 CMOS 影像传感芯片是采用晶圆级芯片尺寸封装，至 2014 年，绝大多数影像传感芯片将采用晶圆级芯片尺寸封装；另一方面，对传统封装应用领域的渗透，主要包括 MEMS、LED 等新兴应用领域的增量增长。晶圆级芯片尺寸封装最初局限于少电极数的芯片，随着技术的发展，现已慢慢渗透至多电极数的芯片，其应用领域将从现在的影像传感器，拓展至 MEMS、LED 等领域，根据法国著名市场调研公司 Yole Développement 的分析，晶圆级芯片尺寸封装向主流半导体领域的渗透率将从 2009 年的 1%增长至 2012 年的 2%。

1) 影像传感芯片（CIS）封装的发展前景分析

受益于照相机（Camera Phone）的持续蓬勃发展，影像传感器市场未来的需求将不断攀升。与此同时，Skype 等网络实时通讯服务的流行、安全监控市场的兴起，以及全球汽车电子的快速成长，亦为影像传感器创造可观的应用规模。

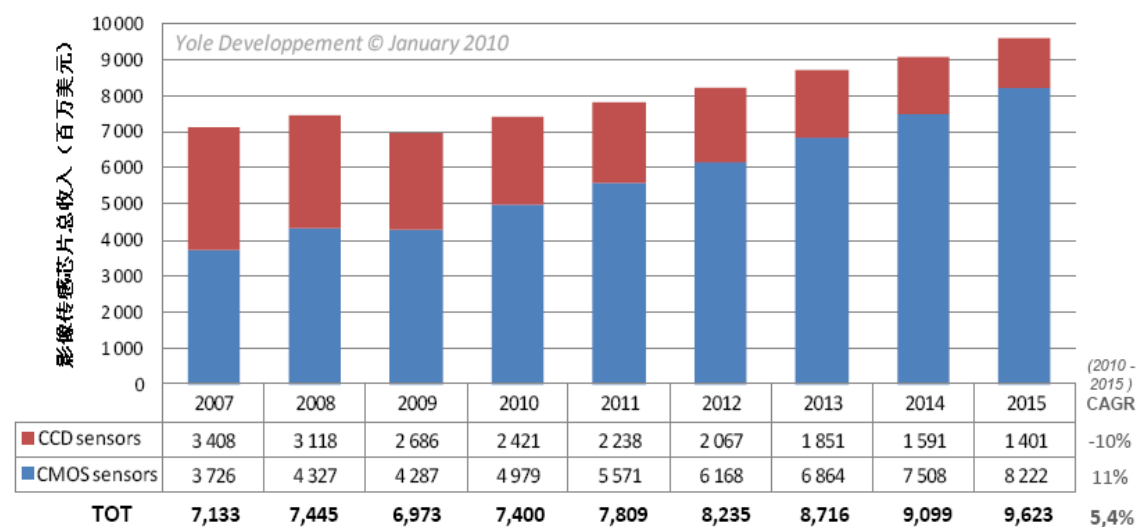
图：影像传感器的应用领域



影像传感芯片主要有两种：CCD 和 CMOS，前者由光电耦合器件构成，后者由金属氧化物器件构成。两者都是光电二极管结构感受入射光并转换为电信号，将图像转换为数字数据，主要区别在于数字数据传送的方式不同，相应地，读出信号所用的方法也不同。与 CCD 相比，CMOS 影像传感器具有图框显示率快，高度的整合性（可减少周边组件使用量，降低系统成本），以及较低的功耗等特性，且 CMOS 影像传感器是标准工艺制程，在制造成本、产品售价方面具有明显的优势，因此 CMOS 影像传感器近年来在照相手机应用中得到快速发展，2008 年全球 CMOS 影像传感器出货数首次超越 CCD 影像传感器出货数。未来几年，随着 CMOS 影像传感器技术的发展，CCD 技术在市场中所占比重将日益下降。

据 Yole Développement 预测，2015 年，CMOS 影像传感器市场收入将超过 80 亿美元，收入较 2009 年增长 91.79%，与之相反，CCD 影像传感芯片在同期的收入将呈逐年递减趋势，说明 CMOS 影像传感器是未来发展的主流方向，其将逐步挤占 CCD 影像传感器的市场。

图：未来几年影像传感器市场的销售收入预测



资料来源：Yole Développement

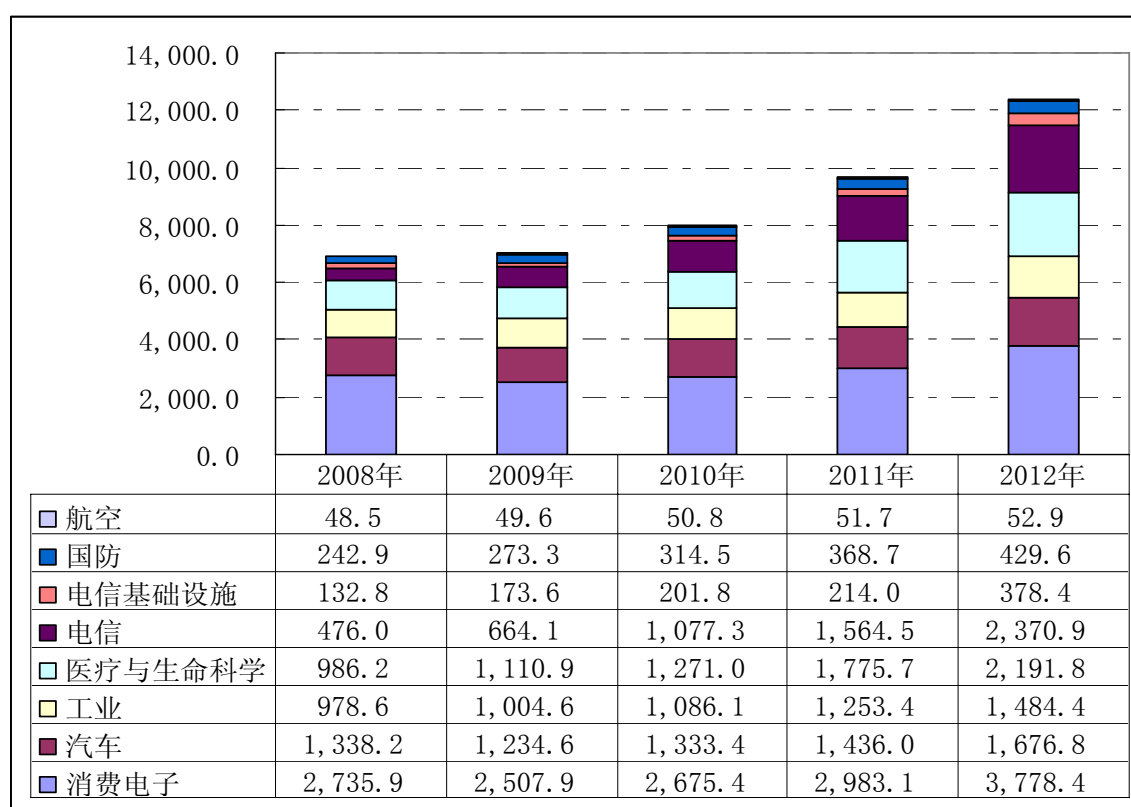
晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)主要面向 CMOS 影像传感器提供封装服务，未来几年 CMOS 影像传感器的快速发展，蕴意着 WLCSP 封装技术在 CMOS 影像传感器市场具有广阔的发展空间。

2) 微机电系统 (MEMS) 芯片封装的发展前景分析

MEMS 即 Micro-Electro-Mechanical System，它是以微电子、微机械及材料科学为基础，研究、设计、制造具有特定功能的微型装置，包括微结构器件、微传感器、微执行器和微系统等。MEMS 技术的发展开辟了一个全新的技术领域和产业，采用 MEMS 技术制作的微传感器、微执行器、微型构件、微机械光学器件、真空微电子器件、电力电子器件等在航空、航天、汽车、生物医学、环境监控、军事以及人们日常生活中常用的消费电子中都有着十分广阔的应用前景。目前 MEMS 市场的主导产品为压力传感器、加速度计、微陀螺仪、墨水喷嘴和硬盘驱动头等。

据 Yole Développement 预测，源于游戏机、笔记本电脑和数码相机等消费电子的快速增长，以及汽车领域、工业生产过程与控制的拉动，预计 2012 全球微机电系统 (MEMS) 市场将由 2008 年的 70 亿美元扩展到 120 亿美元。

图：MEMS 未来市场的预测



注：单位为百万美元。资料来源：Yole Développement

传统的 MEMS 封装没有统一的形式，且封装只能单个进行而不能大批量同时生产，因此封装成本在 MEMS 产品总费用中占据 70%~80%，封装技术已成为 MEMS 生产中的瓶颈。传统的 MEMS 封装不能同时满足消费电子领域中低成本、气体密封性、小尺寸等要求。晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）利用薄膜再分布工艺，使 I/O 可以分布在 IC 芯片的整个表面，而不仅仅局限于狭小的芯片周围区域，成功解决了高密度、细间距 I/O 芯片电气连接的问题。WLCSP 封装采用批量生产工艺制造技术，可将封装尺寸减小至 IC 芯片的尺寸，大大降低了生产成本，使得 MEMS 可以大范围地应用到消费类电子产品领域成为可能。

3）发光芯片（LED）封装的发展前景分析

LED 是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。LED 被誉为 21 世纪的绿色照明光源，预计在未来会取代大部分的传统光源。LED 最大的特点是节能环保，发展 LED 产业有利于发展我国的低碳经济，在我国具有非常重要的现实意义。

2009 年 9 月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房和城

乡建设部、国家质检总局联合发布了《半导体照明节能产业发展意见》，提出我国半导体照明节能产业的发展目标为：到 2015 年，半导体照明节能产业产值年均增长率在 30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到 20%左右，液晶背光源达到 50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到 70%以上。

目前，LED是电子领域投资最活跃的题材之一，也是发展最快的领域之一。以LED背光源为例：2009年，笔记本电脑采用LED背光比例从2008年底的15%飞速增长到近60%；液晶电视采用LED背光比例从2008年底的0.01%增长到10%。调研机构iSuppli预测，2006-2012年全球LED市场销售额复合增长率约为14.6%，大尺寸LCD 背光源和通用照明的应用，将刺激LED加速增长，到2012年达到123亿美元。

应用WLCSP封装的LED芯片具有“散热性好、低成本、微型化、高功率”的优势。发行人已获得LED的晶圆级封装结构及其制造方法的发明专利，可提供散热性好、微型化、低成本、高集成度的高功率LED封装服务。该封装技术采用硅基板取代树脂和陶瓷等基板，导热性好且易集成LED的外围功能电路，对多芯片模组集成优势明显；由于采用LED倒装，散热不受蓝宝石衬底的影响，避免LED正装因阻碍光线而导致的光效损失，也避免了热循环引线断裂失效问题。

4）射频识别芯片（RFID）封装的发展前景分析

RFID（Radio Frequency Identification）的中文全称是无线射频识别技术。RFID技术是一种应用电磁波频谱，以非接触、无视觉、高可靠的方式，传递特定识别信息的系统。RFID源于无线电通讯技术，它综合了现代计算机技术、智能控制、智能识别等许多高新技术，顺应了CMIS（计算机集成制造系统）、电子商务等热点应用的发展需要。

RFID系统至少应包含阅读器、电子标签、数据处理和存储的设备以及系统软件。RFID本身包含很小的标签，该标签又包含有一个硅芯片和一个天线，可以记录数量、款式、大小和颜色，以及如货物来源地、装运和分销、零售等等相关信息数据。

来自国际数据公司（International Data Corporation）的市场数据表明，2005~2009年，我国RFID年复合增长率约为65.6%。根据中国RFID产业联盟和工信部电子科学技术情报研究所物联网研究与促进中心的研究显示的数据，2010年中国RFID产业市场规模快速增长，RFID纯收入达到121.5亿元人民币，

比2009年增长了42.8%；2011年中国RFID产业的市场规模达到了179.7亿元，比2010年增长了47.94%。

RFID 产业链主要包括了以下六个方面：芯片制造、模块制造、封装、读写设备生产制造、应用系统软件、系统集成。其中模块制作的关键技术是芯片倒装焊（flip-chip）技术，就是直接将切割好的芯片反向通过焊球（bondpin）或单向导电胶（acf）和软性 pcb 或 pet 材料形成连通，焊接点周围用非导电的固化胶填充，固化后即形成模块。而晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）是一种可以替代以上芯片倒装焊（flip-chip）技术的工艺。

目前发行人所掌握的 WLCSP 等离子体蚀刻切割技术在未来 RFID 芯片封装中发挥重要作用，等离子蚀刻技术是采用化学方式切割晶圆得到单颗芯片，有别于现在通用的使用机械刀等物理方式。目前，一片 8 英寸的晶圆，RFID 芯片颗数为 20,000 颗左右，芯片间距 80 μ m；随着生产技术的提升，将来 8 英寸的晶圆上 RFID 芯片颗数将达到 80,000 颗以上，芯片间距缩短至 20 μ m 的水平，使用机械刀等物理切割技术已无法达到要求，此时等离子蚀刻技术将发挥重要作用。

3、进入本行业的主要障碍

（1）技术水平要求高，需要持续的生产实践积累

集成电路封装行业属于技术密集型的行业，技术水平要求较高，进入该行业需要丰富的生产加工经验的积累。集成电路封装行业的创新主要体现在两个方面：一方面，封装技术的提升。集成电路产业具有技术开发、更新换代快的特点，全球半导体封装的主流技术已经经历了三个阶段，目前正处于第三阶段的成熟期，以 CSP 和 BGA 等主要封装技术为主，企业需不断研究开发并储备新技术以备封装技术的更新换代；另一方面，制程工艺水平的提高。集成电路生产工艺复杂，精度高，需要在生产过程中不断改善制程工艺。技术水平和制程工艺的创新主要来源于企业长时间、大规模的生产实践和研究开发，需要持续的生产经验的积累。

晶圆级芯片尺寸封装是集成电路封装测试行业的全新的领域，它集合了 IC 设计公司、晶圆厂、封装测试厂、PCB 基板厂的各种技术，其技术壁垒更高，即使是已经从事集成电路封装测试的大型企业想涉足这一领域，同样也要面临较

高的技术壁垒。

（2）资本需求大

集成电路封装行业属于资本密集型行业，生产所需的机器设备投入规模较大，且大部分要从国外进口，资金需求量较大。同时集成电路产业具有技术开发、更新换代快的特点，摩尔定律即是最典型的例子，这就要求集成电路封装企业紧随产业链上下游的技术步伐，投入大量资金用于开发先进的封装技术。

（3）人才要求高

集成电路行业属于高科技行业，专业技术归根结底都掌握在人才的手中，企业的人才供应主要为内部培养和外部引进。目前行业内掌握专业技术的人才供给有限，不能满足行业发展的需求。因此，对新进入的企业而言，如何解决人才供应是比较棘手的问题，尤其是晶圆级芯片尺寸封装细分行业，需要的是集 IC 设计、晶圆制造、封装测试、PCB 基板等技术的混合型高端人才，目前行业非常稀缺，主要靠公司内部培养，从外部引进的难度很大。

4、行业利润水平的变动趋势及变动原因

专业的封装测试企业，由于其采取代工的经营模式，通常采用成本加成的定价方式，整体上毛利率趋于稳定，但也随着半导体行业的景气状况变化而呈现相应的波动。

新技术的应用对利润的影响日益明显。由于高端产品的需求快速增长，而该领域中竞争对手相对较少，且竞争主要集中在技术的先进性和产品的可靠性，因而掌握高端技术的企业利润率相对较高。WLCSP 封装技术作为近几年兴起的新技术，目前只被少数厂商掌握，该市场的竞争程度低于其他封装技术市场，因此，WLCSP 封测厂对下游客户的议价能力强于普通的封装厂。报告期内，公司主营业务的毛利率分别为 46.00%、52.81%、56.21%，远高于封装行业 10% 的平均毛利率。

（三）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）集成电路市场前景广阔

近年来我国集成电路产业持续繁荣发展，已成为全球半导体制造增速最快的

市场。在以 3G 为代表的网络通信市场和以多媒体化为代表的数字消费市场日益增长的需求驱动下，我国集成电路产业将继续保持较快的发展速度，进而拉动我国集成电路封装行业的发展。如前所述，晶圆级芯片尺寸封装作为一种先进的封装形式，随着影像传感器、MEMS、LED 等行业的高速发展，其应用前景和市场空间将更为广阔。

（2）产业政策环境持续向好

集成电路封装行业为国家行业政策鼓励和支持发展的行业，近几年，国家已出台一系列政策，支持该行业的发展，这些政策促进了国内电子信息产业及集成电路产业的快速发展，详细情况请参考本章前文“二、行业的基本情况”之“（一）行业管理体制”。根据国家发展规划，预期未来国家还将出台更多针对集成电路产业的优惠，这将有力推动我国集成电路产业的健康稳步发展。

（3）行业技术水平日益提高

为了适应电子产品多功能、小型化、便携性等需要，新的封装技术不断涌现。新的封装技术推动了整个半导体封装行业的发展。半导体封装厂商通过加大技术投入，引进先进的生产设备，不断提高产品的技术含量，开发新型产品，取得了较高的利润率水平，获得优势地位；同时，随着产品技术含量的提升，提高了行业进入门槛，避免了行业内的恶性竞争，保障了行业的健康发展。

晶圆级芯片尺寸封装技术最先由 Shellcase 研制成功，技术许可给精材科技和本公司使用，精材科技和本公司均在其基础上，投入巨资进行吸收消化和自主创新。目前，本公司已经拥有许多自主知识产权的新技术，且将应用领域由影像传感器扩展至 MEMS、LED 等新领域，并掌握了未来进入 3D 封装领域的 TSV 技术等。

2、不利因素

（1）面临封装技术人才紧缺的严峻局面

集成电路封装产业发展速度快，技术又涵盖多个学科，我国面临封装技术人才紧缺的严峻形势。到目前为止，我国高等院校中只有少数大学建立先进封装技术专业，输送的专业人才有限，远不能满足封装产业对其需求。这需要我国教育部门增加封装技术专业的设置，系统性培养集成电路封装人才。

（2）成本提高将削弱我国半导体封装测试行业的竞争优势

半导体行业属技术密集型行业，技术升级更新快，行业竞争激烈，低端产品的利润空间逐渐减小，我国目前大部分企业仍为低端产品的低成本竞争策略，如果劳动力和原材料成本提高而企业又不能有效地进行新技术的研发应用和产品结构的调整，将削弱我国半导体封装测试企业的竞争优势。

（四）行业技术水平及特点、行业经营模式及行业特性

1、集成电路封装行业的技术水平及特点

集成电路封装技术的演进主要为了符合终端系统产品的需求，为配合系统产品多任务、小体积的发展趋势，集成电路封装技术的演进方向即为高密度、高脚位、薄型化、小型化。半导体行业对芯片封装技术水平的划分存在不同的标准，目前国内比较通行的标准是采取封装芯片与基板的连接方式来划分，总体来讲，集成电路封装技术的发展可分为四个阶段：

第一阶段：20 世纪 80 年代以前（插孔原件时代），封装的主要技术是针脚插装（PTH），其特点是插孔安装到 PCB 上，主要形式有 SIP、DIP、PGA，它们的不足之处是密度、频率难以提高，难以满足高效自动化生产的要求。

第二阶段：20 世纪 80 年代中期（表面贴装时代），表面贴装封装的主要特点是引线代替针脚，引线为翼形或丁形，两边或四边引出，节距为 1.27 到 0.4 mm，适合于 3-300 条引线，表面贴装技术改变了传统的 PTH 插装形式，通过细微的引线将集成电路贴装到 PCB 板上。主要形式为 SOP（小外型封装）、PLCC（塑料有引线片式载体）、PQFP（塑料四边引线扁平封装）、J 型引线 QFJ 和 SOJ、LCCC（无引线陶瓷芯片载体）等。它们的主要优点是引线细、短，间距小，封装密度提高；电气性能提高；体积小，重量轻；易于自动化生产。它们所存在的不足之处是在封装密度、I/O 数以及电路频率方面还是难以满足 ASIC、微处理器发展的需要。

第三阶段：20 世纪 90 年代出现了第二次飞跃，进入了面积阵列封装时代。该阶段主要的封装形式有焊球阵列封装（BGA）、芯片尺寸封装（CSP）、无引线四边扁平封装（PQFN）、多芯片组件（MCM）。BGA 技术使得在封装中占有较大体积和重量的“管脚”被“焊球”所替代，芯片与系统之间的连接距离大大缩短，BGA 技术的成功开发，使得一直滞后于芯片发展的封装终于跟上芯

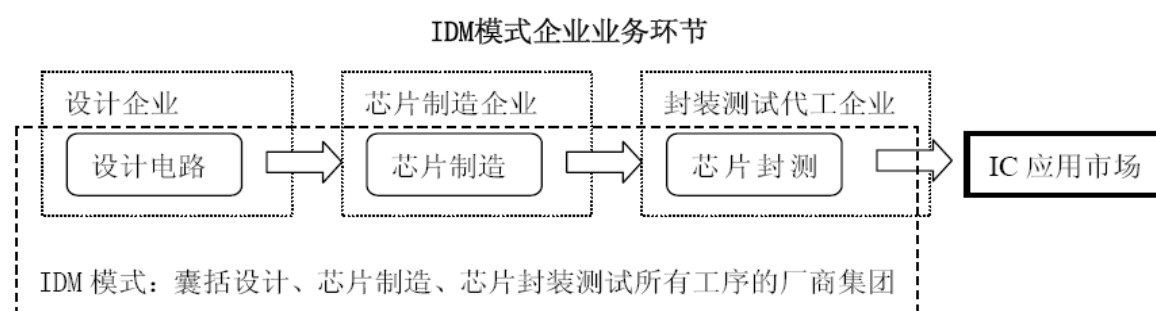
片发展的步伐。CSP 技术解决了长期存在的芯片小而封装大的根本矛盾，引发了一场集成电路封装技术的革命。

第四阶段：进入 21 世纪，迎来了微电子封装技术堆叠式封装时代，它在封装观念上发生了革命性的变化，从原来的封装元件概念演变成封装系统。

目前，全球半导体封装的主流正处在第三阶段的成熟期，以 PQFN 和 BGA 等主要封装技术进行大规模生产，部分产品已开始在向第四阶段发展。发行人所掌握的 WLCSP 封装技术可以进行堆叠式封装，发行人封装的微机电系统（MEMS）芯片就是采用堆叠式的三维封装。

2、行业特有的经营模式

集成电路封装行业的模式主要分为两大类，一类是 IDM 模式，由国际 IDM 公司设立的全资或控股的封装厂，作为集团的一个生产环节，实行内部结算，不独立对外经营；另一类是专业代工模式，专业的集成电路封装企业独立对外经营，接受集成电路芯片设计或制造企业的订单，为其提供专业的封装服务，按封装量收取封装加工费。



由于半导体产业具有产品生命周期短、投资金额巨大等特点，IDM 模式越来越无法适应半导体未来发展趋势，因此，专业代工将成为全球集成电路封装测试的未来主流形式。专业代工加工模式能使得最好的 IC 设计、IC 制造及 IC 封装厂商结合在一起，加快半导体产品的更新换代步伐。

3、行业特性

（1）周期性

受国际芯片发展准则——摩尔定律的制约，半导体产业的发展必然会有技术、时间和价格的波动，经过一段长时间的高速增长后，增速趋缓属于产业的正常调整，半导体产业具有技术呈周期性发展、市场呈周期波动的特点。以往历史

上，全球半导体表现出较强的周期性，但随着半导体市场规模的进一步扩大，2005 年以后全球半导体行业增长趋于温和，周期性的特征逐渐弱化，更多的表现出小幅波动的特征。受国内消费电子产品、整机的市场需求高涨的影响，我国集成电路发展市场周期性并不明显。

（2）区域性

全球集成电路封装产业主要集中在亚太地区，从事封装的国家和地区主要是中国台湾、马来西亚、中国内地、菲律宾、韩国和新加坡。

从国内市场来看，从事半导体封装测试的企业集中在长三角、环渤海及珠三角地区，西部地区由于投资环境的改善、政策扶持及成本优势的体现，将成为集成电路封装企业未来重要的投资区域。

（五）公司所处行业与上下游之间的关系

1、公司所处行业上下游的界定

集成电路产业链分为电路设计、芯片制造、封装及测试三个环节，该三个环节已经发展成为独立的子行业，另外还形成了生产封装材料的集成电路支撑行业。

集成电路产业链是以电路设计为主导，由集成电路设计公司设计出集成电路，然后委托芯片制造厂生产晶圆，再委托封装厂进行集成电路封装、测试，最后销售给电子整机产品生产企业。对本公司而言，集成电路设计企业委托公司进行封装加工，是客户；封装支撑企业为公司提供生产所需的原材料，是公司的供应商。

2、上下游行业对本行业的影响

集成电路封装测试行业的上游是封装测试材料行业。上游原材料的供应影响封测行业的生产，原材料价格的波动影响封测行业的成本。近年来我国集成电路封装测试行业的快速稳定发展，也带动了上游企业的稳定增长，以不断满足封装测试行业的市场需求。

集成电路封装测试行业的下游是集成电路芯片设计业。下游芯片设计业需求直接带动封测行业的销售增长，集成电路设计的需求变化也导致封测行业的工艺变化和技术更新。公司主要为影像传感器、MEMS、LED 等芯片提供 WLCSP

封装服务，目前公司的客户主要为 Galaxycore、BYD、Hynix。影像传感器、MEMS、LED 行业的未来高速发展将为公司晶圆级芯片尺寸封装业务提供广阔的市场空间，具体情况详见本节“二、行业基本情况”之“2、发行人所处细分行业的发展概况”。

三、公司在行业中的竞争地位

（一）竞争地位概述

1、本公司在影像传感器晶圆级芯片尺寸封装领域的竞争地位

公司是中国大陆首家、全球第二大为影像传感器提供晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）量产服务的专业封装测试服务商。

全球从事影像传感器晶圆级芯片尺寸封装的公司，除了少数 IDM 公司（如东芝、三星）采用自主研发的晶圆级芯片尺寸封装技术封装自身产品外，其他均为专业封测服务商，国外有日本 Sanyo（三洋）、韩国 AWLP、摩洛哥 Namotek 等三家公司，国内有台湾台积电控股的精材科技、本公司、长电科技控股子公司长电先进、昆山西钛等四家公司。这些专业封测公司的 WLCSP 封装技术均来源于 Shellcase 的技术许可。

台湾精材科技于 2000 年获得 Shellcase 技术许可，获得授权时间最早。精材科技取得 Shellcase 的技术许可后，母公司台积电作为晶圆代工厂给予了精材科技巨大的支持，台积电在产业链垂直整合的过程中，精材科技得到了共同成长、共同进步的机会，成功达成晶圆级芯片尺寸封装量产服务，目前产能位于全球第一。

晶方科技于 2005 年公司成立之初就获得 Shellcase 技术许可，是中国大陆最早获得该项技术许可的公司。Shellcase 作为晶方科技第一大股东给予了很大的技术指导，协助发行人对技术进行消化吸收；同时，发行人进入半导体封装行业的时点正值消费类电子产品升级换代的高峰期，市场对消费类电子产品的外观和物理性能提出了更高的要求，而公司采用的晶圆级芯片尺寸封装能更好满足产品“短、小、轻、薄”的需求；并且，OmniVision 在 2007 年 3 月成为公司股东并给予发行人大量订单，发行人在封装实践中实现了技术进步和突破，发行人 2008 年实现量产达 58,067 片，2009 年在金融危机的背景下，发行人自主开发了 Galaxycore (HK) Ltd.和 BYD(HK)Co.,Ltd.等优质客户，2010 年、2011 年封

装产能分别达 12 万片、14 万片，是全球第二家能大规模提供影像传感器晶圆级芯片尺寸封装量产服务的专用封测公司。

日本 Sanyo（三洋）于 2001 年获得 Shellcase 技术许可，封装其公司内部的影像传感芯片，但在 2005 年宣布停产；摩洛哥 Namotek、韩国 AWLP 和昆山西钛均于 2008 年获得 Shellcase 技术许可，目前处于小规模量产阶段；江阴长电先进封装于 2010 年获得 Shellcase 技术许可，目前还处于消化吸收阶段。

由此可见，取得 Shellcase 技术授权只是能够达成晶圆级芯片尺寸封装量产服务的必要条件。

2、本公司在 MEMS、LED 等其他封装领域的竞争地位

微机电系统（MEMS）主要应用在汽车电子、工业电子和医疗领域。随着消费类电子产品（如 iPhone4）的发展，其功能越来越强，同时要求成本降低。解决这一难题的主要方法是在消费类电子产品中引入 MEMS（如加速度计、陀螺仪、压力器等）。功能越来越强，实际上是要求在一定的空间内，电子产品能纳入更多的芯片，这就要求封装的芯片在电子产品中的占位面积小。本公司所应用的晶圆级芯片尺寸封装技术封装的 MEMS 芯片呈现“短、小、轻、薄”，而且由于晶圆级封装的特性，使得封装的 MEMS 芯片成本显著降低，并随着晶圆尺寸的增大，成本优势进一步凸显，符合消费类电子产品发展的需求。公司已为客户封装了数百片加速度计 MEMS 芯片，封装工艺已经成熟，并拥有自主专利。随着 MEMS 在消费类电子产品的逐渐普及，公司在 MEMS 封装技术的竞争优势明显。目前全球掌握晶圆级芯片尺寸 MEMS 芯片封装技术的企业主要为精材科技和发行人。

公司在 LED 的晶圆级芯片尺寸封装中，采用硅作为衬底，取代传统的热绝缘衬底，由于硅的良好导热性和众所周知的可集成性，解决了影响高功率 LED 广泛应用的两个主要技术问题：散热性和集成性。目前，公司正和客户通力合作，解决与 WLCSP 封装 LED 芯片相配套的后续技术，尽快使得相应的产业链完善。本公司研发的 LED 芯片封装技术本身已经成熟，拥有自主专利，一旦产业链成熟，晶圆级芯片尺寸 LED 封装技术将快速推向市场。

（二）公司的竞争优势

1、自主创新优势

公司由 **Shellcase**、中新创投和英菲中新于 2005 年组建，目的是实现技术、资本和市场的结合，致力于成为高端专业封装测试服务商。公司经营、研发团队由以色列、台湾、中国大陆专业人士组成，均具有丰富的集成电路研发和生产管理经验。自设立以来，公司通过技术引进、消化吸收，及在此基础上自主创新，逐步积累研发实力和提高集成电路生产管理经验，拥有较强的自主创新能力。

公司在引进 **ShellOP** 和 **ShellOC** 技术后，仅用了 1 年时间就实现量产，量产速度快于同行业竞争对手。在成功消化、吸收 **ShellOP** 和 **ShellOC** 技术的基础上，公司于 2007 年开始实施江苏省重大科技成果转化专项“晶圆级芯片尺寸封装技术在影像传感芯片及 **MEMS** 中的开发和应用”，投入巨资成功研发拥有自主知识产权的超薄晶圆级芯片封装技术（**ThinPac**）、**MEMS** 和 **LED** 晶圆级芯片封装技术，成功地将 **WLCSP** 封装的应用领域扩展至 **MEMS** 和 **LED**。目前，公司拥有自主知识产权的超薄晶圆级芯片封装技术（**ThinPac**）已经替代了向 **Shellcase** 引进的 **ShellOP** 和 **ShellOC** 技术，成为公司的主流产品技术，提供服务的收入已占到销售收入的 99% 以上。此外，随着研发能力和自主创新能力的提高，公司着手制定规范的封装工艺标准，并推广至上下游产业链，有效促进上下游产业链协调发展。

公司在技术创新和产品开发上取得了较多成果，公司及其子公司已成功申请并获得国家知识产权局授权的专利共 19 项，另有 5 项美国发明专利， 并且还有 19 项发明专利正在受理中。公司先后承担多项国家及省级科研项目，其中：

“晶圆级封装关键技术研究”被科技部列入国际科技合作与交流专项基金，“晶圆级芯片尺寸封装技术在影像传感芯片中的开发和应用”被科技部列入国家火炬计划项目，“晶圆级芯片尺寸封装技术在影像传感芯片及 **MEMS** 中的开发和应用”被列入江苏省重大科技成果转化专项。公司产品和技术也获得诸多重要荣誉，其中：“影像传感芯片及 **MEMS** 的圆片级尺寸封装技术”和“双层线路晶圆级芯片尺寸封装技术”分别被中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报共同评选为第二届（2007 年度）、第五届（2010 年度）中国半导体创新产品和技术，晶圆级芯片尺寸封装芯片被江苏省科学技术厅评为“高新技术产品”，晶圆级封装的影像传感器芯片 **WLCSP-OC-I** 被科学技术部评为“国家重点新产品”，影像传感器晶圆级芯片尺寸封装产品被江苏省科技厅评为“江苏省第四批自主创新产品”。

2、先进制程工艺优势

集成电路行业是技术密集型的产业，主要体现在：第一，技术开发快，摩尔定律即是最典型的例子，这要求集成电路企业需要不断的投入研发力量开发、储备先进的技术，保持竞争优势；第二，制程要求高，集成电路生产工艺复杂，精度要求高，这需要集成电路企业紧追技术发展的步伐，及时提高制程水平，而制程水平又取决于生产装备及工艺管理能力，工艺管理能力是企业在生产过程中经日积月累形成的。

公司于 2006 年 6 月实现量产，至今已完成 40 多万片晶圆的封装，积累了丰富的工艺管理经验，整体技术实力也得到全面的提升，从而使得公司能制定规范的封装工艺标准，并推广至上下游产业链。公司有 10 来家影像传感器客户，而这 10 来家客户又面对其下游几百上千家手机模组厂，模组厂又对应着不同品牌和型号的手机生产商。原先产业链上各厂商的标准要求不同，造成公司每个客户，甚至同一客户不同批次芯片的封装标准不同，从而影响公司封装的效率。在技术消化、吸收再创新的过程中，公司提高了研发能力和自主创新能力，并积累了丰富的工艺管理经验，公司已具备制定规范的封装工艺标准的实力。在集成电路企业因金融危机加快研发的背景下，公司于 2009 年积极、及时地向上下游产业链推广规范的封装工艺标准，并获得认可。目前，影像传感器客户按照公司的封装工艺标准设计芯片，手机模组厂遵循公司的标准调整其工艺参数。

制定规范的封装工艺标准能有效地改善公司在行业中的竞争地位，主要表现在两方面：第一，规范的封装工艺标准能最大限度的释放公司现有生产设备的产能，集成电路产品一般具有定制的特点，这就要求封装企业根据集成电路的设计功能和芯片的类型提供不同标准、工艺的封装，这势必会影响公司额定产能下的利用率，若客户能接受公司规范的封装标准，并按该标准设计芯片的功能和芯片的制造，则公司就能以同一标准的模式设定生产设备的参数，无需因为封装产品的特性调整不同批次产品的封装，最大限度地提高现有生产设备的产出率，从而增强公司的盈利能力。第二，若客户接受公司规范的封装标准后，则其原先的芯片设计及后续的晶圆制造均会按照该标准来执行，这给行业新进入者及竞争对手形成一定的技术壁垒，新进入者或者竞争对手的封装服务必须达到公司制定的标准时，客户才会在本公司产能无法满足其要求的情况考虑让他们封装。但是，公

司通过愈 40 万片生产实践日积月累所形成的工艺标准，对于行业新进入者是很难以短期内达到的。

3、成本优势

公司所应用的晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP），较传统的封装方式，在封装成本方面有较明显的成本优势：其一，WLCSP 封装优化了封装产业链。应用 WLCSP 封装，能减少封装前合格芯片的测试环节，且在封装过程中无需使用基板，从而能有效降低封装成本。同时，WLCSP 能将基板厂、封装厂、测试厂整合为一体，使芯片从制造、封装到进入流通环节的周期大大缩短，提高了生产效率，降低生产成本。其二，WLCSP 的封装成本是按照晶圆数计量的，与切割后的芯片数无必然联系，而传统封装的封装成本是按封装芯片的个数计量的。因此，WLCSP 的封装成本随晶圆尺寸的增大和芯片数量增加而降低。在消费类电子产品轻、小、短、薄化的市场发展趋势下，晶圆级芯片尺寸封装的成本优势愈加明显。

4、技术领先优势

目前全球范围内，能大规模为影像传感器提供 WLCSP 量产服务的专业封测服务商仅两家，为本公司和精材科技股份有限公司。公司始建于 2005 年，通过技术引进、消化吸收及自主创新的过程，所掌握的封装技术日益多样化，现已拥有 Shellcase 系列晶圆级芯片尺寸封装技术、超薄晶圆级芯片尺寸封装技术（ThinPac）、硅通孔封装技术、晶圆级凸点封装技术（Wafer Bumping）及用于微机电系统（MEMS）、LED 的晶圆级芯片尺寸封装技术。其中，硅通孔封装技术被誉为未来进入三维封装领域的关键技术，公司掌握硅通孔封装技术将为未来的可持续发展提供技术保障。

公司的封装技术除使用传统封装中的部分技术外（如丝网印刷技术和回流焊技术、压合技术、划片技术），还几乎使用了半导体制造中所有的技术，如光刻技术（光刻胶工艺和光刻成像）、晶圆清洗技术、薄膜沉积技术、等离子体蚀刻技术和等离子体表面处理技术、化学镀和电镀技术等。从这个角度上讲，公司的 WLCSP 封装在资金和技术的准入门槛上远比传统的封装技术高。

5、人才优势

公司经营管理团队由以色列、台湾、大陆三方的人士共同组成，均具有丰富的集成电路研发和生产管理经验，充分融合以色列的技术和营销、台湾的建厂管理和成本控制、大陆的市场渠道和客户服务三方面的优势。

公司以技术创新为核心，设立研发中心和工程部，形成研发中心、工程部相结合的研发体系。公司研发机构系省级研发中心，研发团队由欧、美等海外留学人员和国内知名大学毕业生组成。成立至今八年间，公司研发团队已承担多项国家和省部级科研项目，公司及其子公司已成功申请并获得国家知识产权局授权的专利共 19 项，另有 5 项美国发明专利， 并且还有 19 项发明专利正在受理中。

6、地域优势

以上海、苏州、无锡、杭州、宁波等为代表的长江三角洲地区形成了研发、设计、芯片制造、封装测试、半导体物料和设备等相关产业较完整的集成电路产业链，集中了大陆集成电路产业链的主要力量，是大陆集成电路产业发展最成熟的区域。随着全球产业链向中国大陆的转移，晶方科技在人才资源、成本控制、政府政策扶持上的优势更显突出。

（三）竞争对手情况

目前，发行人与精材科技是全球最主要的两家晶圆级芯片尺寸封装专业封装测试服务商，精材科技为发行人的主要竞争对手。

1、竞争对手基本情况

精材科技股份有限公司成立于 1998 年 9 月，为台湾兴柜市场（三板）上市公司，法定代表人为关欣，注册资本为 228,384.90 万新台币（约 51,653.81 万元人民币），总公司住所为桃园县中坜工业区吉林路 23 号 9 楼。公司主要从事集成电路晶圆级芯片尺寸封装测试服务，于 2000 年获 Shellcase OP 技术许可，2004 年，台积电策略性投资精材科技，成为其第一大股东。全球最大的影像传感器供应商 OmniVision 为精材科技第一大客户，2010 年度，精材科技实现营业收入 39.62 亿新台币（约合人民币 8.96 亿元），其中 OmniVision 的订单占其营业收入的比例为 57%。

精材科技与发行人 2009-2011 年度的总资产、产量、销售额对比如下：

项 目	总资产（万元人民币）		产量（片八寸晶圆）		销售额（万元人民币）	
	精材科技	发行人	精材科技	发行人	精材科技	发行人
2011 年末/年度	-	59,797	-	138,767	-	30,612
2010 年末/年度	123,250	48,626	605,000	126,064	89,623	27,068
2009 年末/年度	105,806	40,152	258,000	58,102	50,246	13,885

数据来源：① 精材科技数据摘自其对外发布的 2009、2010 年年报；精材科技尚未公布其 2011 年年报；② 2009 年度汇率为 4.686 元新台币/人民币，2010 年度汇率为 4.421 元新台币/人民币，2011 年度汇率为 4.800 元新台币/人民币。

2、发行人竞争优势劣势

与竞争对手相比，发行人竞争优势劣势具体情况如下表所示：

项目		具体内容
竞争优势	成本优势	封装测试行业是技术密集、知识密集的重资产行业，人力成本占总营业成本比重较高，与中国台湾相比，中国大陆技术和管理人员工资较低，更具人力成本优势。另外，相对于中国台湾，中国大陆物流成本较低，这主要由于中国是全球最大的消费类电子制造基地，且晶圆设计、晶圆制造、封装测试产业链比较齐全。
	独立性高	本公司系独立封装测试服务商，能自主选择优质客户，议价能力较强。精材科技系晶圆制造商台积电的控股子公司，精材科技相当于台积电的产业链延伸，芯片设计公司的晶圆由台积电代工，再由精材科技封装测试。由于精材的客户主要是台积电的客户，且晶圆制造是芯片制造主要利润环节，因此，台积电从产业链垂直整合的角度出发，为与芯片设计厂商建立长期战略合作关系，精材科技主要产能用于满足台积电客户的晶圆级封装测试业务，精材科技的业务独立性和议价能力都受到较大限制，因此，精材科技虽然规模大于发行人，但是 2008 年至 2010 年单位晶圆的封装价格低于发行人，毛利率也低于发行人。
竞争劣势	规模差距	2010 年，精材科技的资产规模为发行人的 2.53 倍，产量为发行人的 4.80 倍，营业收入为发行人的 3.31 倍。
	技术差距	精材科技是台积电的直属封测服务商，台积电为全球第一大晶圆代工企业，资金规模雄厚，研发实力强。另外，由于精材科技较发行人早成立 7 年，获得 Shellcase 技术许可的时间也较发行人早 5 年，其量产时间和量产规模均大于公司，对于工艺的管控具有一定的优势，其工艺制程一直处于晶圆级封装领域的前沿。

四、发行人主营业务情况

（一）主要产品用途

公司可提供多样化的晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）量产技术，应用于封装影像传感芯片、环境光感应芯片、医疗电子器件、微机电系统（MEMS）、发光电子器件（LED）、射频识别芯片（RFID）、电源 IC 等多种产品。该些产品广泛应用在消费电子、医学电子、电子标签身份识别等诸多领域。公司封装产品的具体应用领域如下：



1、影像传感芯片被广泛应用在照相手机、数码相机、电脑摄像头、光学鼠标、可吞咽医疗电子诊疗设备、安防监控等领域。

2、环境光感应芯片可根据环境光度的变化自动调节各种系统和仪器，被广泛应用在移动设备如 PDA、移动电话、笔记本电脑和数码相机的按键和显示屏背光控制，汽车中的显示屏、仪表盘、前照灯控制、HUD 抬头显示系统，也适用于其他任何需要对于周围光线情况进行高精度测量的系统。

3、MEMS 是集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统，是未来主导的产业之一。MEMS 器件较多，如加速度计、喷墨头、陀螺仪、硅麦克风、DLP 及 RF 开关等等，可应用在运动、打印、显示领域等。

4、射频识别芯片作为电子标签芯片，在食品安全、物流、医疗安全和诊断、超市、交通运输、国防等具有广泛的应用。RFID 可以传递各种产品信息，包括产品的原产地、生产日期和有效日期等。它可以帮助企业有效地管理供应链和产品目录，防止产品被偷盗，同时还能降低企业的劳动力成本。

（二）封装技术及生产工艺流程

1、发行人使用的封装技术

（1）发行人的封装技术为晶圆级芯片尺寸封装技术

目前发行人使用的封装技术为晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）相关技术，主要包括超薄晶圆级芯片尺寸封装技术（ThinPac）、光学型晶圆级芯片尺寸封

装技术（ShellOP）、空腔型晶圆级芯片尺寸封装技术（ShellOC）、晶圆级凸点封装技术（RDL Wafer Bumping）、硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术（TSV），以及应用于微机电系统（MEMS）、发光电子器件（LED）的晶圆级芯片尺寸封装技术。

（2）晶圆级芯片尺寸封装与传统封装的区别

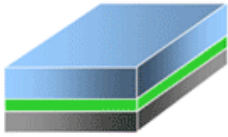
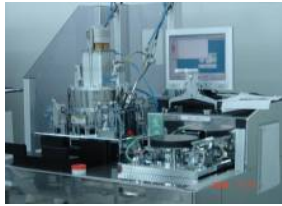
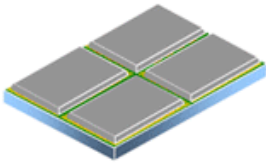
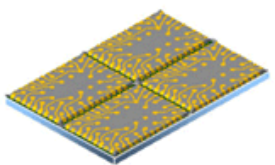
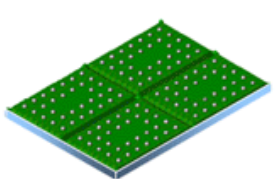
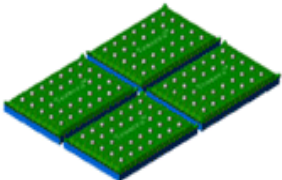
晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）的特点就是“先封后切，封装后的芯片尺寸几乎与裸芯片一致”，而传统封装的特点是“先切后封，封装后的芯片尺寸一般大于裸芯片”。

与传统封装技术相比，晶圆级芯片尺寸封装相关技术具有较为明显的优势：首先，晶圆级芯片尺寸封装有效提高封装效率，降低封装成本。晶圆级芯片尺寸封装是在整片晶圆上进行封装后再切割得到几百、几千颗芯片，而传统封装是将晶圆先切割成芯片后，再对芯片实施单独的封装。一般而言，WLCSP的封装成本是按照晶圆数计量的，与切割后的芯片数无必然联系，而传统封装的封装成本是按封装芯片的个数计量的。因此，WLCSP的封装成本随晶圆尺寸的增大和芯片数量增加而降低；其次，晶圆级芯片尺寸封装形式有效整合了产业链。传统的封装厂产业链涉及芯片测试、基板厂、传统封装厂、再测试，而晶圆级封装厂集芯片测试、基板厂、封装厂、再测试为一体，缩短了芯片进入流通环节的周期，提高了生产效率并降低了芯片生产成本。最后，业界已普遍认识到，基于硅通孔（TSV）的三维封装技术是超越摩尔定律的主要解决方案，是未来半导体封装技术发展趋势。晶圆级芯片尺寸封装是硅通孔技术的基础，两者工艺十分相似，通过掌握晶圆级芯片尺寸封装技术能快速进入硅通孔技术领域。晶圆级芯片尺寸封装将在未来三维封装技术中扮演重要角色。

2、发行人的生产工艺流程

晶圆级芯片尺寸封装技术（WLCSP）制程在晶圆尚未切割前进行，整片晶圆由薄膜、黄光及蚀刻等工序完成封装，最后再切割成单颗的IC，此种制程可视为前段半导体晶圆厂制程的延伸。

整个封装制程的基本步骤如下所述：

制程名称	制程	制程主要内容	主要设备选例
制程 1: 晶圆与玻璃粘贴		以粘贴剂将一片高透光性的薄玻璃粘贴于客户晶圆的正面，保护晶圆表面不受污染。	
制程 2: 晶圆背面减薄和切割道蚀刻		研磨粘有玻璃的晶圆背面，使晶圆的厚度变薄，以降低封装厚度。并沿晶圆的切割道蚀刻暴露 IC 芯片的焊垫。	
制程 3: 线路形成		将玻璃（或绝缘保护层）粘贴于晶圆背面，切割露出芯片焊垫侧面；再用金属沉积和光刻技术布线，使线路与 IC 芯片焊垫相连通，形成线路。	
制程 4: 锡球形成		在金属线路上覆盖上一层保护层，并在准备制备焊接点的所在位置露出金属。将锡膏印刷在整片晶圆上焊接点所在位置，回流焊（Reflow）形成锡球。	
制程 5: 晶圆切割，封装芯片分离		沿晶圆的切割道切割，形成分离的成品 IC 芯片。	

（三）主要经营模式

本公司为专业封测代工企业，采用集成电路封装测试行业全球通用的贸易模式，由客户提供芯片委托公司封装，公司自行采购原辅材料，按照技术标准将芯片封装、测试后交还委托方，公司向委托方收取封装测试加工费。

1、销售模式

公司客户主要为 IC 设计公司，IC 设计公司主要负责芯片电路功能设计与芯片产品的销售，其本身无晶圆制造工厂和封装测试厂。IC 设计公司完成芯片设计，交给晶圆代工厂（Foundry）制造晶圆芯片，晶圆芯片完工后交付公司，由公司组织进行芯片封装、测试。除提供封装、测试服务外，公司还提供封测设计服务，封测设计业务主要是为客户设计能满足其要求的封装技术，每次设计收取

一定数额设计费用。

公司与某些客户建立合作关系时，一般会签署委托加工框架合同，具体的委托加工事项一般由客户每期发送的加工订单确定，加工订单会明确当期的加工数量和采购价格。

2、采购模式

公司生产所需的原材料主要通过采购部直接向国内外供应商采购。公司生产计划部门根据客户订单量确定加工计划，制定原材料采购清单；采购部门根据请购单安排采购，并跟催物料交货进度；质保部门负责主辅材料的检验。公司与供应商建立了长期的合作关系，根据市场状况决定交易价格。

3、生产模式

公司具有完整的生产体系。公司根据客户订单制定每月加工任务，待客户将需加工的晶圆发到公司后，由生产部门组织芯片封装、测试，待加工完成、检验合格后发给客户。

（四）主要产品产销情况

1、主要产品或服务产销情况

项 目	产能（片）	产量（片）	销量（片）	封装测试收入（万元）	销售价格（元/片）
2011 年度	140,000	138,767	140,760	30,429.16	2,161.78
2010 年度	120,000	126,064	119,623	26,904.33	2,249.09
2009 年度	85,000	58,102	58,284	13,722.24	2,354.38

（1）报告期内公司产能利用情况

报告期内，公司产能利用率分别为 68.36%、105.05%和 99.12%。

公司 2009 年的产能利用率不高，主要是由于 2008 年三季度发生的金融危机，造成全球半导体行业陷入低迷状态，集成电路产业链上的各企业均出现开工率不足的问题，此种现象一直延续至 2009 年四季度。2009 年度，我国集成电路封装行业销售收入同比下降了 11.04%。面对金融危机，公司积极利用自身技术和成本优势，努力开拓市场，成功开发了 Galaxycore、BYD 等优质客户，新客户的成功开发使公司封装测试业务保持稳定增长，未因金融危机出现大幅的下滑，成功渡过了金融危机，但受限于半导体产业整体市场的不景气，2009 年公

司产能利用率相对较低。

2010 年和 2011 年，公司承接的加工订单均达到现有生产设备的产能极限，产能利用率分别为 105.05%和 99.12%。为顺利完成日益增加的订单任务，公司一直在不断地进行工艺改进,对制约产能的相关工艺环节添置生产设备，同时改善和加强制程管理，最大限度地增加产量，以满足市场日益增长的需求，缓解了产能不足的矛盾。

（2）报告期内公司产品产销率的情况

由于公司经营模式为受托加工，生产任务根据加工订单来安排，所以报告期内，公司产销率维持在 100%左右，符合委托加工模式的特点。

（3）销售价格的变动趋势

报告期内，公司每片晶圆封装服务单价呈逐年下降，主要原因为：第一，出于市场开拓考虑，针对单一客户，公司根据其订单数量收取不同的封装服务价格，一般而言，订单数量大，对公司具有规模效益，收取的服务单价会相对低些。以 Galaxycore 为例，2009 年度至 2011 年度，公司为 Galaxycore 封装的平均单价分别为 2,348 元/片、2,162 元/片、2,041 元/片，同期加工的晶圆数分别为 35,484 片、68,624 片、93,345 片，Galaxycore 为公司第一大客户，2011 年度公司对其销售占比为 62.23%，因此其加工单价的下降会引致报告期内公司加工平均单价的下降；第二，公司与客户签订封装服务合同均以美元计价，报告期内人民币对美元的缓慢升值，会造成折算为人民币计价的封装服务单价呈逐年下降。

2、产品内销和外销情况

报告期内，公司主营业务收入绝大部分均由外销实现，具体情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外销	30,554.16	99.86%	27,041.49	99.98%	13,863.15	99.84%
内销	43.04	0.14%	5.38	0.02%	21.72	0.16%
合 计	30,597.20	100.00%	27,046.87	100.00%	13,884.87	100.00%

3、向前五名客户销售情况

报告期内，公司向前五名客户销售的具体情况如下：

年度	客户名称	销售金额 (万元)	所占比例 (%)
2011 年度	Galaxycore (HK) Ltd. 格科微电子(香港)有限公司	19,051.35	62.23
	Hynix Semiconductor Inc. 海力士半导体公司	5,496.56	17.96
	BYD(HK)CO Ltd. 比亚迪(香港)有限公司	5,433.10	17.75
	Brigates (kunshan) Logistics Co.Ltd. 昆山锐芯微电子有限公司	395.86	1.29
	Pixelplus Co.Ltd. 派视尔信息科技有限公司	30.85	0.10
	合 计	30,407.71	99.33
2010 年度	Galaxycore (HK) Ltd. 格科微电子(香港)有限公司	14,835.75	54.80
	BYD(HK)CO Ltd. 比亚迪(香港)有限公司	8,660.46	32.00
	Hynix Semiconductor Inc. 海力士半导体公司	2,741.93	10.13
	Brigates (kunshan) Logistics Co.Ltd. 昆山锐芯微电子有限公司	536.05	1.98
	Generalplus Technology Inc. 凌通科技股份有限公司	81.22	0.30
	合 计	26,855.41	99.21
2009 年度	Galaxycore (HK) Ltd. 格科微电子(香港)有限公司	8,330.32	60.00
	BYD(HK)CO Ltd. 比亚迪(香港)有限公司	3,908.92	28.15
	Brigates (kunshan) Logistics Co.Ltd. 昆山锐芯微电子有限公司	461.71	3.33
	Supergold Enterprise International Ltd. 超淦企业国际有限公司	358.42	2.58
	Taos Korea Co.Ltd.	320.15	2.30
	合 计	13,379.51	96.36

公司前五大客户中不存在受同一实际控制的情形,公司与上述客户不存在关联关系,亦不存在公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方或持有公司5%以上股份股东在上述其他客户中持有股份的情形。

4、报告期各期发行人主要客户的基本情况

单位: 万元

公司名称	注册地	主营业务	资产规模 2010/12/31	销售规模 2010 年度	资产规模 2011/12/31	销售规模 2011 年度
Galaxycore (HK) Ltd 格科微电子(香港)有限公司	香港	CMOS 芯片采购、 委托加工和销售	-	-	-	-

BYD(HK)CO Ltd. 比亚迪（香港）有限公司	香港	集成电路设计与线宽 0.18 微米及以下大规模集成电路、新型电子元器件及其相关附件的生产、销售	5,296,340 (母公司 比亚迪股份)	4,844,842 (母公司 比亚迪股份)	6,562,439 (母公司 比亚迪股份)	4,882,692 (母公司 比亚迪股份)
Hynix Semiconductor Inc 海力士半导体公司	韩国	致力生产以 DRAM 和 NAND Flash 为主的半导体产品	10,339,540	7,114,016	9,446,505	5,696,904
Brigates (kunshan) Logistics Co.Ltd. 昆山锐芯微电子有限公司	昆山	集成电路芯片和电子产品的研发、加工、测试和销售, 自营和代理商品及技术进出口业务	-	-	-	-
Generalplus Technology Inc. 凌通科技股份有限公司	台湾	IC 设计与销售	59,570	82,512	58,468	82,613

数据来源：① 公开披露的财务数据以及客户提供，已根据汇率换算为人民币万元。2010 年 12 月 31 日，美元/人民币汇率为 6.6227；韩币/人民币汇率为 0.00588；港币/人民币汇率为 0.8509；新台币/人民币汇率为 0.22617。2011 年 12 月 31 日，美元/人民币汇率为 6.3009；韩币/人民币汇率为 0.00548；港币/人民币汇率为 0.8107；新台币/人民币汇率为 0.20833。

② 发行人主要客户系芯片设计公司，主要负责芯片的设计和銷售，中间的晶圆制造或封装测试等生产环节，均外包给晶圆制造厂和芯片封装测试厂，自身一般不涉及具体产品生产制造。

③ 格科微电子（香港）有限公司、昆山锐芯微电子有限公司等公司为非上市公司，无公开披露的财务数据。

5、公司客户较为集中的原因

报告期内，公司第一大客户占公司营业收入的比例分别为 60.00%、54.80%、62.23%；前五大客户占公司营业收入的比例分别为 96.36%、99.21%、99.33%，公司客户集中度较高，这主要是由公司下游客户影像传感器行业竞争格局和公司生产工艺的特点决定的，公司不存在因客户集中度高而引致的经营风险。

（1）下游影像传感器行业的竞争格局直接影响公司客户的结构

目前，Shellcase 系列晶圆级芯片尺寸封装技术最大的应用领域为影像传感器芯片，而全球影像传感器行业是一个集中度很高的行业。2009 年，全球前七大 CMOS 影像传感器厂商占据了近 86% 的市场份额。下游行业集中度高直接决

定了本公司和本公司竞争对手精材科技的客户集中度均比较高。根据精材科技对外披露的年报信息显示，2008 年度-2010 年度，精材科技对 OmniVision 销售额占当年营业收入的比重分别为 81%、77%、57%。

目前全球主要 CMOS 影像传感器厂商封装业务的提供方及运用的相关封装技术具体情况如下表所示：

序号	公司名称	封装服务提供商	采用的封装技术	备注
1	Galaxycore(格科微)	晶方科技、精材科技	Shellcase 系列晶圆级封装技术	芯片设计公司
2	OmniVision (豪威)	精材科技	Shellcase 系列晶圆级封装技术	芯片设计公司
3	SETi (赛特)	主要外包	非 Shellcase 系列晶圆级封装技术/Shellcase 系列晶圆级封装技术	芯片设计公司
4	Aptina/Micron (美光)	主要自己封装	自主研发技术/Shellcase 系列晶圆级封装技术	IDM、正尝试外包
5	Samsung (三星)	主要自己封装	自主研发技术	IDM
6	Toshiba (东芝)	主要自己封装	自主研发技术/Shellcase 系列晶圆级封装技术	IDM、正尝试外包
7	STMicro (意法半导体)	主要自己封装	自主研发技术	IDM

Galaxycore (格科微)、OmniVision (豪威) 以及 SETi (赛特) 均为芯片设计公司，芯片封装主要系外包；Aptina/Micron (美光)、Samsung (三星)、Toshiba (东芝)、STMicro (意法半导体) 均为 IDM 公司，芯片主要系自己封装。

Galaxycore (格科微) 的影像传感芯片全部采用 Shellcase 系列晶圆级封装技术，自 2009 年起，Galaxycore 成为发行人第一大客户。OmniVision (豪威) 的影像传感芯片大部分采用 shellcase 系列晶圆级芯片尺寸封装技术，曾为发行人 2008 年度第一大客户，占当年营业收入的 33.76%。SETi (赛特) 的影像传感芯片部分采用 Shellcase 系列晶圆级封装技术，SETi 曾为发行人 2008 年度第五大客户，占当年营业收入的 5.43%。

Aptina/Micron (美光)、Samsung (三星)、Toshiba (东芝) 等都是 IDM 公司，均采用自己开发的非 Shellcase 系列晶圆级芯片尺寸封装技术进行芯片封装。随着芯片功能越来越强且体积越来越小，高精度要求下使得芯片制造与封装的资本投入越来越高，IDM 公司将封装业务外包的趋势日趋明显。Aptina/Micron (美光) 已开始少量的封装服务外包，采用 Shellcase 系列晶圆级芯片尺寸封装技术，

目前由昆山西钛微电子提供小批量的生产，同时 Aptina/Micron（美光）也开始与发行人就技术和工艺进行对接，部分型号的产品已进入设计阶段。Toshiba（东芝）也开始寻求将封装业务外包，采用 Shellcase 系列晶圆级芯片尺寸封装技术，目前也开始与发行人接触。STMicro（意法半导体）正尝试将封装服务外包，采用 Shellcase 系列晶圆级芯片尺寸封装技术，目前正与摩洛哥 Namotek 接触。

据法国著名市场调研公司 Yole Développement 出具研究报告显示，2007 年，全球约 35% 用于手机和笔记本电脑的 CMOS 影像传感芯片是采用晶圆级芯片尺寸封装，至 2014 年，绝大多数影像传感芯片将采用晶圆级芯片尺寸封装。

（2）公司生产工艺要求客户订单数量应具备一定的经济规模效应

不同客户设计的芯片具有不同的功能，同时所委托封装的晶圆性能也不同，这要求公司结合不同客户的具体质量、性能标准，提供类似于定制化的封装服务。公司的生产设备具有通用性，可根据客户的具体要求，相应地选择工艺参数，同一质量标准的晶圆可同批次进行封装，不同标准的不可同批次进行封装。客户订单数量大，公司能一批次足额完成一定数额晶圆的封装，不存在产能浪费的情形；同时，客户订单数量大，公司能连续组织生产，无需经常调整工艺参数，有利于扩大产量，提高产能利用率。因此，对公司而言，执行订单数量大的合同具有规模经济效益。发行人在产能不足的情况下，公司更倾向于执行订单数量大的合同，一方面有利于提高公司盈利能力，另一方面有利于稳定公司与老客户的合作关系。

6、公司不存在因客户集中度高而引致的经营风险

虽然报告期内，公司客户集中度较高，但不存在由此而引致的经营风险，主要原因为：

（1）发行人与客户之间是一种相互依赖的关系。

受益于下游消费类电子市场的高速增长，格科微电子和比亚迪对晶圆级芯片封装服务的需求旺盛，由于发行人产能受限，发行人并未承接格科微电子和比亚迪的全部订单。报告期内，发行人承接的格科微电子、比亚迪晶圆级封装订单占其各自订单总量的 50% 以上，格科微电子和比亚迪剩余的晶圆级封装订单主要由精材科技承接。目前，全球能提供晶圆级芯片尺寸封装量产服务专业封装测试服务商主要为发行人和精材科技，供需矛盾决定了格科微电子和比亚迪依赖于与

发行人的长期合作，发行人与格科微电子和比亚迪之间是一种互相依赖的关系。

（2）晶圆级封装的特点决定了客户更换封装服务供应商的成本较高。

客户产品从设计到最终进入市场需要通过多重的工程试样和认证，只有了解设计下游产业链，能准确把握终端客户需求的封装测试厂商才能参与到芯片设计，与下游客户共同成长。芯片设计厂商每更换一次产品设计或者封装形式，都需要付出相应的代价，包括金额不菲的设计费，开模费，测试费、大量工程人力进行功能性和可靠性试验。因此，客户一般不会轻易改变现有合作模式和生产供应渠道。另外，半导体行业客户对于生产供应链的认证也非常严格，包括品质管控认证，绿色产品无有害物质认证等，周期较长，如无特殊原因，一般客户不会擅自更换现有的合格供应商。

（3）公司现有客户成长性较好，经营业绩稳定。

公司第一大客户格科微电子（香港）有限公司由硅谷归国的专业人员创办。格科微立足于国内巨大的电子消费市场，在中芯国际（晶圆代工）及发行人（WLCSP 封装）的协助下，近几年成长迅速，目前已经成为国内前五大的芯片设计公司之一，国内最大的手机用影像传感器厂商。

公司第二大客户海力士半导体 1983 年由现代电子产业株式会社成立，1996 年正式在韩国上市。1999 年收购 LG 半导体，2001 年从现代集团中分离出来，并更名为海力士半导体。2004 年 10 月，海力士半导体将系统 IC 业务出售给花旗集团，成为专业的半导体制造商，在全球半导体公司中排名第九位。2009 年度至 2011 年度，海力士半导体的销售额分别为 4,633,121 万元、7,114,016 万元、5,696,904 万元。

公司第三大客户 BYD (HK) Co., Ltd.为上市公司比亚迪股份有限公司全资子公司，成立于 1999 年，注册资本 3,123 万港元，主要生产销售锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池及相关产品。比亚迪股份有限公司目前主要经营两大业务：汽车业务和 IT 零部件业务，其中 IT 零部件业务主要由二次充电电池和手机部件及组装服务组成。2009 年度至 2011 年度，比亚迪手机部件及及组装业务收入分别为 1,458,595 万元、2,079,854 万元、1,997,241 万元。

（4）公司开拓新客户和扩展晶圆级芯片尺寸封装的应用领域的能力可以保障公司的可持续发展。

与传统封装相比，晶圆级芯片尺寸封装在消费类电子领域具有显著的比较优

势，具有广阔的市场前景。一方面，目前影像传感器封装领域应用晶圆级芯片尺寸封装的比例较低，晶圆级芯片尺寸封装对传统封装技术的替代是行业发展的必然趋势，原使用传统封装技术的影像传感器厂商正逐步采用晶圆级芯片尺寸封装技术；另一方面，目前在 MEMS、LED 等非影像传感器封装领域晶圆级芯片尺寸封装量还较小，但随着这些产品对“短、小、轻、薄”要求越来越高，降低成本压力越来越大，晶圆级芯片尺寸封装技术在这些领域的应用将越来越广泛。

凭借公司的技术实力，公司具有较强的客户开拓能力。目前，Aptina、东芝等国际半导体企业与发行人均有合作意向，待公司募投项目达产后，将有能力承接这些大客户的订单。此外，公司已将 WLCSP 封装推广应用到了 MEMS、LED 等非影像传感器领域，现已通过客户的样品测试，处于小批量生产阶段，待募投项目实施后，向 MEMS、LED 领域提供 WLCSP 封装服务的比例将大幅提高，届时公司客户结构将趋于均衡。

从发行人经营历史来看，发行人在全球金融危机以及不再为其 2008 第一大客户 Omnitech 提供封装服务的背景下，发行人在 2009 年度也成功开发了 Galaxycore、BYD 等优质客户，成功渡过金融危机。这足以证明发行人开发新客户的能力，最重要的是 WLCSP 技术经过多年的发展，其技术特点和优势十分显著，已经得到行业 and 市场的充分认可，该技术的应用领域将会持续扩大，目前客户集中度较高不会对公司的持续经营能力构成重大不确定性。

7、发行人市场推广及客户开发的策略

（1）产品市场推广

1) 巩固和扩大在影像传感芯片应用领域的市场份额

随着市场需求的发展，尤其是受消费类电子产品的推动，原使用传统封装技术的影像传感器厂商正逐步采用晶圆级芯片尺寸封装技术，以兼顾尺寸、性能、成本的要求。目前，影像传感器封装领域应用晶圆级芯片尺寸封装的比例较低，晶圆级封装技术对传统封装技术的渗透将带来巨大的市场容量，发行人将抓住市场机遇，进一步巩固和深化在影像传感芯片领域的领先优势，进一步扩大市场占有率。

2) 拓展除影像传感芯片外的新应用领域

发行人通过持续的技术创新，不仅研发了用于影像传感器应用领域的超薄晶

圆级芯片尺寸封装技术（ThinPac）、硅通孔封装技术、晶圆级凸点封装技术（Wafer Bumping），还掌握了用于微机电系统（MEMS）、LED 等产品的晶圆级芯片尺寸封装技术。本次募投项目，公司将利用这些非影像传感器应用领域的封装技术以扩大 MEMS、LED、SIM 等产品的封装应用。目前，发行人已通过样品可行性设计和验证，在产能充足的情况下，发行人将开发新工艺的应用客户和应用领域。

（2）客户开发策略

1) 进一步巩固和扩大现有客户群

公司为发挥规模生产的优势，集中力量服务于 Galaxycore、BYD、Hynix 三家主要客户。由于产能受限，发行人并未承接上述三家主要客户的全部订单。随着产能增加，发行人将进一步巩固和深化与 Galaxycore、BYD、Hynix 的战略合作关系，扩大对上述三家主要客户的销售量。

2) 找回因产能不足而逐渐流失的客户，恢复和巩固业务合作关系

在产能充足的情况下，发行人除了巩固和扩大与主要客户的合作之外，还要找回以前年度由于产能限制而流失的客户，与其恢复和巩固业务合作关系，2011 年，公司与 PIXELPLUS、SUPERPIX 等前客户重新取得合作，其中 PIXELPLUS 已成为公司目前第五大客户。对一些潜在的大客户（如东芝和 Aptina），发行人与其保持密切的关系，并已经开始着手产品设计，一旦产能大幅度提升，能立即与其达成合作意向。

（五）主要原材料、能源供应情况

1、主要原材料的供应

公司生产所需的主要原材料为玻璃、刀片、感光油墨、硅晶片粘着剂等。玻璃主要向 SCHOTT AG,BS Flat Pannel 采购，刀片主要向 Adamas Company Ltd. 和 DISCO HI-TEC CHINA Co.Ltd.采购，感光油墨主要向 Rohm and Haas 采购，硅晶片粘着剂主要向 Dow Chemical Pacific Ltd.采购。公司与上述供应商建立了长期的合作伙伴关系，能够保证原材料的稳定供应。

2、主要能源供应

公司生产所需的主要能源包括水、电、气。水由苏州工业园区清源华衍水务

有限公司供应,电由苏州工业园区供电局供应,气由苏州港华燃气有限公司供应。公司自设立以来,以上能源的供应均保持稳定。

3、报告期内公司主要原材料以及能源平均采购价格变动情况

本部分所涉及的原材料及能源采购价格均不含增值税。

(1) 原材料采购单价

材料名称	2011 年度	2010 年度	2009 年度
光学玻璃 (元/片)	69.48	69.03	86.42
刀片 (元/把)	151.33	152.42	143.39
感光油墨 (元/升)	489.57	502.68	540.87
硅晶片粘着剂 (元/克)	549.31	574.22	610.62
液氮/氮气 (元/升)	0.89 (氮气)	0.63 (液氮)	0.63 (液氮)
八氟化四碳 (元/公斤)	683.42	717.95	725.20

(2) 能源采购单价

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
水 (元/吨)	3.37	3.35	2.62
电 (元/度)	0.72	0.66	0.66
气 (元/m ³)	2.96	2.67	2.63

4、产品主要原材料所占成本比例

期间	原材料 (万元)	能源 (万元)	原材料比例 (%)	能源比例 (%)
2011 年度	4,408.03	899.86	32.88	6.71
2010 年度	4,034.52	873.09	31.58	6.83
2009 年度	2,811.08	836.99	37.49	11.16

报告期内,公司营业成本中原材料占比整体呈下降趋势,主要是由于公司使用自主创新 ThinPac 技术后,芯片封装由原来采用两片玻璃保护层减至一片玻璃保护层和一层绝缘层,由于玻璃的采购成本占原材料采购成本的比例最大,从而造成报告期内公司原材料占比呈下降趋势。

5、向前五名供应商合计采购情况

报告期内,公司向前五名供应商采购的具体情况如下:

年度	客户名称	采购金额 (万元)	占比
2011 年度	SCHOTT AG,BS Flat Panel Display	511.90	8.42%
	上海福纬国际贸易有限公司	498.60	8.20%
	Rohm and Haas Electronic Materials Asia Ltd.	454.71	7.48%
	上海亿钶气体有限公司	367.72	6.04%
	ADAMAS COMPANY LIMITED	328.69	5.40%
	合 计	2,161.62	35.54%
2010 年度	SCHOTT AG,BS Flat Panel Display	935.84	11.39%

	ADAMAS COMPANY LIMITED	552.32	6.72%
	Rohm and Haas Electronic Materials Asia Ltd.	504.40	6.14%
	上海亿珂气体有限公司	380.66	4.63%
	Dow Chemical Pacific Ltd.	293.87	3.58%
	合 计	2,667.09	32.46%
2009 年度	SCHOTT AG,BS Flat Panel Display	644.28	22.92%
	Rohm and Haas Electronic Materials Asia Ltd.	228.72	8.14%
	上海亿珂气体有限公司	210.78	7.50%
	DISCO HI-TEC CHINA CO.Ltd.	184.84	6.57%
	苏州市晶协高新电子材料有限公司	161.78	5.75%
	合 计	1,430.40	50.88%

公司不存在向单个供应商采购比例超过公司采购总额 50% 的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5% 以上股份的股东在上述供应商中不占权益。前五大供应商中不存在受同一实际控制的情形。

（六）环境保护与安全生产

公司所处半导体封装测试行业，该行业不属于高危险、重污染行业，且日常生产经营过程中产生的废水、废气也较少。

尽管如此，公司历来非常重视安全生产与环境保护，建立了一套完备的安全生产管理控制制度和环境保护制度，以及与此相关的安全生产、环保设施，并于 2006 年 10 月通过英国 SGS 机构的 ISO14001:2004 版环境管理认证。公司严格控制废水排放，将污染物集中存放妥善处理；对噪音污染源采取严格的隔音、隔离措施。公司生产过程中排放的废气、废水和厂界噪声达到国家规定的排放标准，未受到环保部门的处罚。

根据苏州市工业园区环境保护局 2012 年 4 月 18 日出具的《环境保护守法证明》（苏园环证字（2012）第 056 号），公司近三年能够较好地贯彻执行国家有关环境保护法律法规，未因违反环境保护法律法规而被处罚。

五、固定资产及无形资产

（一）固定资产

1、固定资产基本情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下表所示：

单位：万元

类 别	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋建筑物	6,309.00	186.09	6,122.90	97.05%
机器设备	25,826.19	8,375.02	17,451.17	67.57%
办公及其他设备	3,744.14	1,823.60	1,920.54	51.29%
运输工具	144.07	79.08	64.99	45.11%
合 计	36,023.40	10,463.79	25,559.61	70.95%

公司的固定资产使用状况良好，不存在闲置、报废等减值情形。

2、主要生产设备

截至 2011 年 12 月 31 日，公司主要设备情况如下表所示：

序号	名称	数量(台)	折旧期限(年)	剩余使用年限(年)	账面原值(万元)
1	真空溅镀机	4.00	10.00	6.44	4,976.31
2	气相蚀刻机	8.00	10.00	6.15	6,037.23
3	切割机	60.00	10.00	5.95	4,053.37
4	研磨机	3.00	10.00	5.33	1,388.78
5	压合机	11.00	10.00	6.57	2,741.30
6	曝光机	3.00	10.00	5.00	1,165.30
7	涂布机	11.00	10.00	6.98	1,176.34
8	PP 机	13.00	10.00	7.19	1,039.97
9	对位机	3.00	10.00	6.39	554.83

3、房屋建筑物

(1) 自有厂房

公司拥有的房产总建筑面积为 26,487.36 平方米，主要是厂房和办公用房，已取得《房屋所有权证》，明细如下：

所有者	证书号码	地址	面积(m ²)	取得方式	抵押情况
晶方科技	苏房权证园区字第 00350397 号	苏州工业园区 汀兰巷 29 号	26,487.36	自建	无

(2) 租赁厂房

1) 发行人租赁厂房

发行人系生产型企业，设立之初，生产经营用厂房均为租赁取得。公司租赁中新置地处于苏春工业坊的厂房，用于生产经营。

2005 年 7 月，公司与中新置地签署《苏春工业坊租赁合约》，约定公司租赁中新置地处于苏州工业园区苏春工业坊标准厂房第 11B 单元和 C 单元、建筑面积为 10,748 平方米的厂房，租赁期自 2005 年 7 月 6 日起至 2015 年 10 月 5 日止，租金分三阶段支付：1) 第一阶段，2005 年 10 月 6 日至 2007 年 4 月 5 日，

租金总额为 1,268,195.40 元；第二阶段，2007 年 4 月 6 日至 2008 年 10 月 5 日，租金总额为 2,677,191.48 元，每季度平均支付；第三阶段，2008 年 10 月 6 日至 2015 年 10 月 5 日，租金总额为 16,663,295.04 元，每季度平均支付。合约到期后发行人拥有优先续租权。厂房租赁价格主要由中新置地和发行人根据苏春工业坊同类工业厂房（面积相近、地理位置相近）的月租赁价格、租赁期限以及租约签订时的市场价格等因素协商确定。发行人向中新置地租赁厂房的价格系按市场定价，价格公允。

上述租赁厂房目前是发行人的主要生产经营地，未来还将继续使用。发行人新厂房自 2011 年 7 月已经陆续投入使用，新厂房将成为发行人主要生产经营地。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：苏春工业坊系园区国控下属企业中新置地配合园区招商引资为高新技术企业开发建设的工业地产，用于向园区科技企业出租，发行人租赁厂房的所有权人中新置地与发行人不存在关联关系，发行人向中新置地租赁厂房不属于关联交易；发行人向中新置地租赁厂房租期较长，价格公允，且租赁合约中对发行人到期有优先续租权作出了约定；自 2011 年 7 月起，发行人已经开始启用自有产权的新厂房，因此，发行人租赁经营状况不影响发行人资产完整性和独立性，符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定，发行人租赁苏春工业坊标准厂房的情况不会对发行人的持续经营产生不利影响。

2) 发行人子公司租赁的办公室

发行人子公司晶方北美目前租赁 PBC Palo Alto, LLC（以下简称“PBC”）位于美国加州 Palo Alto Pacific Business Center 第 208 号办公室作为办公场所。

2011 年 1 月 18 日，晶方北美与 PBC 签署《租赁合约》，约定晶方北美租赁 PBC 位于美国加州 2225 East Bayshore Road, Suite 200, Palo Alto, CA 94303-3220 的 Palo Alto Pacific Business Center 第 208 号办公室。租金按月支付，每月租金为 1,088.00 美元。合约有效期为六个月，如协议双方未在合约到期日前 30 天作出书面声明终止该合约，合约将自到期日起自动延续六个月。

（二）无形资产

1、商标

截至本招股说明书出具日，公司已申请获得了 21 项商标，正在申请 3 项商

标，公司所拥有的商标及正在申请的商标具体情况如下：

(1) 已拥有的商标

序号	图案	权利人	证书号码	权利到期日	取得方式	核定使用商品	他项权利
1	晶方	发行人	第 6530657 号	2020 年 4 月 20 日	申请	第 9 类	无
2	晶方	发行人	第 6530658 号	2020 年 3 月 27 日	申请	第 40 类	无
3	晶方	发行人	第 6530659 号	2020 年 7 月 20 日	申请	第 42 类	无
4		发行人	第 6530655 号	2020 年 3 月 27 日	申请	第 40 类	无
5		发行人	第 6530654 号	2020 年 4 月 27 日	申请	第 9 类	无
6		发行人	第 6530656 号	2020 年 7 月 20 日	申请	第 42 类	无
7	TSIWL MCP	发行人	第 9247280 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 40 类	无
8	TSIWL MCP	发行人	第 9247281 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 9 类	无
9	TSIWL MCP	发行人	第 9247279 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 42 类	无
10	TSIWL CSP	发行人	第 9247282 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 42 类	无
11	TSIWL CSP	发行人	第 9247283 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 40 类	无
12	TSIWL CSP	发行人	第 9247284 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 9 类	无
13	TEIWL CSP	发行人	第 9247234 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 42 类	无
14	TEIWL CSP	发行人	第 9247235 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 40 类	无
15	TEIWL CSP	发行人	第 9247236 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 9 类	无
16	TEIWL MCP	发行人	第 9247231 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 42 类	无
17	TEIWL MCP	发行人	第 9247232 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 40 类	无
18	TEIWL MCP	发行人	第 9247233 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 9 类	无
19	WLMCP	发行人	第 9247228 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 42 类	无
20	WLMCP	发行人	第 9247229 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 40 类	无
21	WLMCP	发行人	第 9247230 号	2022 年 4 月 6 日	申请	第 9 类	无

(2) 正在申请的商标

序号	图案	申请人	申请号	申请日期	核定使用商品	他项权利
1	TEI	发行人	第 9247225 号	2011 年 3 月 23 日	第 42 类	无
2	TEI	发行人	第 9247226 号	2011 年 3 月 23 日	第 40 类	无
3	TEI	发行人	第 9247227 号	2011 年 3 月 23 日	第 9 类	无

上述已拥有的及正在申请的商标均属本公司所有，不存在与他人共享所有权的情形。

2、专利

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司已成功申请并获得国家知识产权

局授权的发明专利 18 项，实用新型专利 1 项，另有 5 项美国发明专利， 并且还有 19 项发明专利正在受理中。公司所拥有的专利及正在申请的专利具体情况如下：

(1) 在国内已获授权的专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权到期日
1	N 型电连接晶圆级芯片尺寸封装结构及其制造方法	发明专利	ZL2006 1 0096807.5	2026.10.16
2	双层引线封装结构及其制造方法	发明专利	ZL2006 1 0096808.X	2026.10.16
3	光波导及其制造方法	发明专利	ZL 2007 1 0151335.3	2027.09.24
4	光波导	发明专利	ZL 2009 1 0126377.0	2027.09.24
5	光波导	发明专利	ZL 2009 1 0126378.5	2027.09.24
6	微机电系统的晶圆级芯片尺寸封装结构及其制造方法	发明专利	ZL 2007 1 0131491.3	2027.08.30
7	一种晶圆级芯片尺寸封装的线路及其制作方法	发明专利	ZL 2007 1 0134026.5	2027.10.17
8	封装结构及其制造方法	发明专利	ZL 2008 1 0098168.5	2028.05.25
9	封装结构、封装方法及感光装置	发明专利	ZL 2008 1 0042930.8	2028.09.11
10	晶圆级封装对象及其形成的方法	发明专利	ZL 2008 1 0041985.7	2028.08.19
11	晶圆级芯片封装方法及封装结构	发明专利	ZL 2008 1 0178977.7	2028.12.02
12	光转换器及其制造方法和发光二极管	发明专利	ZL 200910000394.X	2029.01.06
13	封装方法	发明专利	ZL 2009 1 0046893.2	2029.02.24
14	封装结构	发明专利	ZL 2009 1 0151226.0	2029.06.28
15	发光二极管的晶圆级封装结构及其制造方法	发明专利	ZL 2009 1 0152235.1	2029.07.06
16	半导体器件封装结构及其封装方法	发明专利	ZL 200910222168.6	2029.11.17
17	超薄半导体芯片封装结构及其制造工艺	发明专利	ZL 201010116257.5	2030.02.25
18	半导体器件的封装结构及制造方法	发明专利	ZL 201010123443.1	2030.03.11
19	半导体芯片的压合结构	实用新型	ZL 2010 2 0170687.0	2020.04.21

(2) 在美国已获授权的专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权到期日
1	Wafer level chip size packaged chip device with an n-shape junction inside and method of	发明专利	US 7,394,152 B2	2026.11.12

	fabricating the same			
2	Wafer level chip size packaged chip device with a double-layer lead structure and method of fabricating the same	发明专利	US 7,663,213 B2	2026.11.12
3	Wafer level chip size packaged MEMS device and method of fabricating the same	发明专利	US 7,781,250 B2	2028.06.03
4	Packaging Structure and method for fabrication the same	发明专利	US 7,755,155 B2	2028.09.18
5	WLCSP Target and method for forming the same	发明专利	US 7,795,074 B2	2029.01.12

(3) 向国家知识产权局正在申请的专利

序号	申请专利的名称	专利类型	申请号	申请日期
1	半导体芯片的封装结构及其制造工艺	发明专利	2009 1 0186275.8	2009.10.16
2	半导体器件的封装结构及其制造方法	发明专利	2010 1 0123452.0	2010.03.12
3	晶圆级芯片尺寸封装结构及其封装方法	发明专利	201110240043.3	2011.08.19
4	晶圆级封装结构及其形成方法	发明专利	201110256649.6	2011.09.01
5	晶圆级封装结构及封装方法	发明专利	201110257344.7	2011.09.01
6	感光半导体器件的封装结构（实用新型）	实用新型	201120326562.7	2011.09.01

(4) 向美国正在申请的专利

序号	申请专利的名称	专利类型	申请号	申请日期
1	Pattered leads for WLCSP and method for fabricating the same	发明专利	12/135,331	2008.06.09
2	packaging method and packaging structure	发明专利	12/434,199	2009.05.01
3	Optical converter and manufacturing method thereof and light emitting diode	发明专利	12/482,230	2009.06.10
4	WLCSP LED device and method of fabricating the same	发明专利	12/708,943	2010.02.19
5	3D Integration Microelectronic Assembly For Integrated Circuit Devices And Method of Making Same	发明专利	13/157,193	2011.06.09
6	3D Integration Microelectronic Assembly With Stress Reducing Interconnects And Method of Making Same	发明专利	13/157,202	2011.06.09
7	3D Integration Microelectronic Assembly For Integrated Circuit Devices And Method of Making Same	发明专利	13/157,207	2011.06.09
8	Low Stress Cavity Package For	发明专利	13/186,357	2011.07.19

	Back Side Illuminated Image Sensor, And Method Of Making Same			
9	Stepped Package For Image Sensor And Method Of Making Same	发明专利	13/225,092	2011.09.02
10	Interposer Package For CMOS Image Sensor And Method Of Making Same	发明专利	13/301,683	2011.11.21
11	Wire Bond Interposer Package For CMOS Image Sensor And Method Of Making Same	发明专利	13/312,826	2011.12.06
12	Improved Quantum Efficiency Back Side Illuminated CMOS Image Sensor And Package, And Method Of Making Same	发明专利	13/343,682	2012.01.04
13	Multi polymer lens structure and lens manufacturing method	发明专利	13/356,328	2012.01.23

上述已获得的专利及正在申请的专利均属本公司及本公司全资子公司晶方北美所有，不存在与他人共享所有权的情形。

3、ShellOP 和 ShellOC 技术的许可

(1) ShellOP 和 ShellOC 两项技术许可和出售的相关情况

1) Shellcase 将 ShellOP 和 ShellOC 两项技术授权发行人

Shellcase 于 20 世纪 90 年代成功开发了 ShellOP 和 ShellOC 两项晶圆级芯片尺寸封装技术，ShellOP 和 ShellOC 是专利技术和非专利技术的组合。Shellcase 当时研发的封装技术具有超前性，在走出实验室后未能投入大批量生产，庞大的研发费用支出未能产生实际效益，Shellcase 于 2005 年关闭了以色列的工厂。

为引进以色列高科技技术推动苏州本地科技发展，中新创投与 Shellcase 合资设立晶方科技，Shellcase 将 ShellOP、ShellOC 两项授权技术许可给晶方科技使用，将以色列的技术、园区良好的基础设施和创业投资环境相结合，发挥各自的优势。2005 年 5 月 30 日，晶方科技与 Shellcase 签订了《许可协议》。

2) Shellcase 将 ShellOP 和 ShellOC 两项技术转让给 Tessera

Tessera Technologies, Inc. 为电子行业小型化技术供应商，系美国纳斯达克上市公司。2005 年 10 月 31 日，Shellcase 与 Tessera Technologies, Inc. 签署了《Asset Purchase Agreement》(以下简称“《资产购买协议》”)，约定：Shellcase 将包括 ShellOP、ShellOC 专利所有权在内的资产转让予 Tessera。

同时，双方又签署了《License and Services Agreement》（以下简称“《许可和服务协议》”），约定：①Shellcase 之前与晶方科技、精材科技等公司签订的相关专利许可协议仍有效，Shellcase 仍需履行其在相关专利许可协议中的义务；②Tessera 公司授予 Shellcase 在履行其相关专利许可协议中义务时所必要的非专属许可；③Shellcase 应向 Tessera 支付费用，包括但不限于 Shellcase 根据相关专利许可协议向第三方（即晶方科技、精材科技等公司）收到的任何专利许可费用。

根据 Shellcase 与 Tessera 签订的《资产购买协议》和《许可服务协议》，Tessera 对 Shellcase 之前与晶方科技签订的《许可协议》确认有效。发行人仍然按照与 Shellcase 签订的《许可协议》行使权利和履行义务，专利权利金仍支付给 Shellcase，Shellcase 与 Tessera 之间的资产转让对 Shellcase 与发行人之间的技术许可不构成影响。

（2）发行人不存在授权方终止许可发行人使用 ShellOP、ShellOC 技术而导致发行人无法正常生产经营风险。

发行人已经逐步用自主创新的改进技术替代了 ShellOP、ShellOC 技术，目前直接使用 ShellOP、ShellOC 技术比例较小。鉴于发行人对改进技术拥有自主知识产权，目前 ShellOP、ShellOC 技术对生产经营的作用较小并且被终止技术许可的风险也较小，发行人不存在授权方终止许可发行人使用 ShellOP、ShellOC 技术而导致发行人无法正常生产经营的风险。

1) 发行人目前绝大部分产品使用自主创新技术，自主创新技术属于发行人自主知识产权。

2011 年度，发行人使用 ThinPac 等自主创新技术进行封装的收入占主营业务收入比重已经高达 99.89%，直接使用授权许可技术 ShellOP、ShellOC 技术进行封装的收入占比很小。根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《技术许可协议》，发行人在 ShellOP 和 ShellOC 技术上的改进及新补充所形成的知识产权属于发行人，且发行人已就 ShellOP、ShellOC 基础上研发成功的技术申请了专利保护。

由于发行人在 ShellOP、ShellOC 基础上研发成功的部分自主创新技术在某些工艺环节上与 ShellOP、ShellOC 技术相似，所以尽管发行人已经很少直接使用 ShellOP、ShellOC，但仍然需向 Shellcase 支付一定的权利金。

2) 许可协议未约定明确期限, 可以无限期执行

《License Agreement》从生效日起生效, 在被许可方根据中国法律合法存在的期限内持续有效, 许可协议并未约定明确期限, 只要发行人合法存续, 该许可协议可无限期执行。

3) 只要发行人按规定履约, 许可方无权终止许可协议

Shellcase 可以单方面中止《许可协议》的情况包括: ①许可协议规定的应付款被拖欠未付, 在向发行人发出说明付款日已过的书面通知后 30 日内仍未支付; ②发行人或发行人董事和高级管理人员使得发行人违反许可协议的条款和条件, 并在收到 Shellcase 要求其改正的书面通知后 30 日内仍未改正其违约; ③发行人停止提供服务超过连续 90 日; ④发行人或其任何重大资产提出了清算、解散、行政托管、接收或破产的法律程序或任何类似程序的申请, 并且该等申请未在提出之日起的 45 日内被撤消。

发行人可以单方面中止《许可协议》的情况包括: ①Shellcase 违反本协议的任何条款和条件, 并在收到受让方要求其改正的书面通知后 30 日内仍未改正其违约; ②服务被法院不可上诉的裁决认定侵犯了第三方的权利, 及受让方在为之向 Shellcase 发出通知后, 仍然无法根据本协议的规定进行服务的期限超过 30 日; ③某第三方侵犯或盗用 Shellcase 专利 (该等 Shellcase 专利又是使用 ShellOC 技术或 ShellOP 技术所必需的), Shellcase 在获悉或应该获悉上述事实后 60 天内, 未能合理及时地开始采取任何合理的法律程序或另行设法改正该等第三方的侵犯或盗用; ④针对 Shellcase 或其任何重大资产提出了清算、解散、行政托管、接受或破产法律程序或任何类似程序的申请, 并且该等申请未在提出之日起的 45 日内被撤消。

报告期内, 发行人履行情况良好, 只要发行人按协议规定持续履约, EIPAT 无权单方面终止《许可协议》。

4) 发行人目前履约成本较低, 违约可能性较小

报告期内, 发行人应付 EIPAT 技术使用权利金分别为 180.52 万元、190.62 万元、195.44 万元, 分别占发行人当期营业收入的 1.30%、0.70%、0.64%。目前, 发行人应付权利金占营业收入比重较低, 且随着发行人对 TSV、wafer bumping 等非 ShellOC 和 ShellOP 基础上开发技术的大量使用, 其比例还将继续下降, 因此, 发行人履约成本较低, 出现违约的可能性较小。

综上所述，发行人不存在授权方终止许可发行人使用 ShellOP、ShellOC 技术而导致发行人无法正常生产经营风险。

(3) ShellOP 和 ShellOC 两项技术包含专利到期对发行人经营的影响

ShellOP 和 ShellOC 两项技术包含专利到期不会对发行人经营造成影响，具体分析如下：

首先，ShellOP 和 ShellOC 技术是专利和非专利技术的组合体，Shellcase 只是对某些技术环节申请了专利，许多技术和工艺并未申请专利，拟涉及晶圆级封装行业的企业仅凭到期的专利无法将 ShellOP 和 ShellOC 技术全面掌握并运用吸收；其次，随着消费类电子产品的迅速发展，芯片设计公司对封装测试的要求也日益提高，ShellOP 和 ShellOC 技术本身已经不是最好的晶圆级芯片尺寸封装技术，经过精材科技和发行人的多年实践和自主创新，已经研发出更为先进的晶圆级封装技术，并申请了专利保护，发行人和精材科技已经在行业中占据了领先优势；最后，ShellOP 和 ShellOC 技术的量产门槛较高，全球获得 Shellcase 晶圆级封装技术许可的企业中，目前只有发行人与精材科技能够提供大规模量产封装服务。

(4) 技术许可权利金的缴纳情况

发行人与 Shellcase 签订的《License Agreement》中约定：发行人从使用该项技术实现收入之日起至商业性销量触及 2000 片晶圆后三年内，按与 ShellOP、ShellOC 技术直接相关的服务收入总额的 5% 计缴权利金；协议期限的其他时间，按与 ShellOP、ShellOC 技术直接相关的服务收入总额的 3% 计缴权利金。

由于整个封装过程包含很多生产环节，而某些生产环节并不需要采用 ShellOP、ShellOC 技术，如：电性测试、功能测试、切割、减薄等环节，另外，发行人 2009 年初推出的 ThinPac 技术，该技术虽然是发行人自主研发，但某些生产环节仍要使用 ShellOP、ShellOC 技术。因此，协议中的“ShellOP、ShellOC 技术直接相关的服务收入”，主要指使用 ShellOP、ShellOC 直接相关的生产环节所产生的收入，不包含使用自主研发的封装技术收入、电性测试费、功能测试费等。

“ShellOP、ShellOC 技术直接相关的服务收入”具体金额确定，需授权双方根据产品型号、制程数量等信息，并按共同约定的程序确定，具体确定程序如下：

1) 当发行人涉及新产品类型或新技术投入使用时, 发行人需将产品和技术相关信息发送给 EIPAT 审核确认, 发行人根据产品类型以及技术使用情况, 每季度计算出应付权利金, 并将计算明细发给 EIPAT 确认;

2) EIPAT 根据明细进行审核, 确定无误后, EIPAT 开具发票;

3) 发行人根据 EIPAT 开具的发票予以付款;

4) EIPAT 定期派人员至发行人处再次对权利金的计算正确性进行现场审核, 并出具相应的确认函。

报告期内, 公司应向 Shellcase 支付的技术使用权利金分别为 180.52 万元、190.62 万元、195.44 万元。EIPAT 对发行人自公司成立至今已经足额计提和缴纳技术使用权利金进行了确认。

4、土地使用权

截至本招股说明书签署日, 公司通过出让形式获得 1 宗土地使用权, 用作厂房、办公楼等生产经营场所, 该宗土地面积为 17,339.15 平方米。

所有者	产权证书	地址	面积(m ²)	终止日期	取得方式	抵押情况
晶方科技	苏工园国用(2010)第00196号	苏州工业园区汀兰巷南	17,339.15	2057 年 6 月 24 日	出让	无

六、公司特许经营权

截至本招股说明书签署日, 公司未拥有任何特许经营权。

七、公司的生产技术

(一) 主要产品生产技术所处的阶段

公司主要产品所应用的核心技术情况如下:

序号	生产技术	技术来源	封装领域	所处阶段	先进程度
1	光学型晶圆级芯片尺寸封装技术 (Shell OP)	许可使用	影像传感器	大批量生产	国际先进
2	空腔型晶圆级芯片尺寸封装技术 (Shell OC)	许可使用	影像传感器	大批量生产	国际先进
3	超薄晶圆级芯片尺寸封装技术 (ThinPac)	自主研发	影像传感器	大批量生产	国际先进
4	密封型晶圆级芯片尺寸封装技术 (Hermetic WLCS P)	自主研发	MEMS	小批量生产	国际先进
5	发光二极管的晶圆级芯片	自主研发	LED	小批量生产	国际先进

	尺寸封装				
6	硅通孔封装技术（TSV）	自主研发	影像传感器、MEMS、LED	小批量生产	国际先进

自 2009 年起，公司主要使用自主研发的 ThinPac 晶圆级芯片尺寸封装技术，许可使用的 Shell OP 和 Shell OC 两项技术使用比例较低。

（二）正在从事的研发项目情况

截至本招股说明书签署日，本公司正在开发的产品、技术情况如下：

项目名称	内容或特点	目前进度	技术先进性
LED 倒装式晶圆级芯片尺寸封装技术	1.用晶圆级芯片尺寸封装技术一次性制备 LED 倒装所需要的支架；2.封装中用硅取代传统 PVC 或陶瓷基底；3.封装中引入热沉，达到有效散热	在完成反光杯方案的基础上，正尝试用硅通孔方案，此方案应用领域更广、成本更低	国内领先
硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术改进方案 1	用另外一种电绝缘材料，并需要激光	正在进行中	国际领先
硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术改进方案 2	用等离子体增强化学气相沉积技术沉积绝缘层，再用光刻技术暴露焊垫	正在进行中	国际领先
硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术改进方案 3	用等离子体增强化学气相沉积技术沉积绝缘层，但不用光刻技术暴露焊垫	正在进行中	国际领先
RDL 技术在智能卡芯片中的应用	封装厚度和大小均小于传统封装技术如 QFN	正在进行中	国际领先

（三）研发投入情况

公司为保证研发工作顺利进行，为研发工作提供良好的硬件和软件设施，每年都根据需从销售收入中提取一定的研发费用。

报告期内，公司研发费用投入情况如下：

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费用支出（万元）	1,689.47	2,647.89	923.40
占当期收入之比（%）	5.52%	9.79%	6.65%

2010 年度研发的项目（如硅通孔技术、LED 技术、微机电系统封装工艺等）均已进入样品试验阶段，需领用的原材料较多，因此，2010 年研发费用中的原材料领用金额较大，而 2011 年度的研发项目大部分还处研究开发阶段，进入样品试验阶段的研发项目较少，领用的原材料相对较少，因此研发费用较去年同期减少 958.42 万元。

公司于 2008 年 9 月 24 日被江苏省科技厅、财政厅、国税局及地税局联合

认定为江苏省 2008 年第一批高新技术企业，有效期三年。2011 年 9 月，公司高新技术企业通过复审，认定有效期为 3 年（2011 年至 2013 年）。

（四）保持技术不断创新和机制、技术储备及技术创新的安排

1、公司技术创新组织

公司的产品研究开发由公司研发中心承担，公司的研发人员主要由研发工程师、制程工程师、设计工程师构成，其中研发工程师在项目先期阶段起主导作用，项目转小批量量产后，制程工程师开始主导，设计工程师负责设计制图工作。

公司项目研发流程如下：研发项目立项前，设立项目组，项目组由项目负责人和成员组成，主要包含研发、制程、设计工程师。项目负责人对项目作市场和技术的调研，与客户沟通，了解客户的要求，确定项目的可行性；立项后，给出技术方案，制订进度表。工艺开发完成后，由小批量逐渐过渡到量产，至此完成项目的研发。

2、技术储备

公司已有的技术储备有等离子体切割技术、玻璃上集成光学涂层后的晶圆级芯片尺寸封装技术、多层线路的晶圆级芯片尺寸封装技术。等离子切割技术克服了机械切割的缺陷（硅背崩、不能处理小切割道晶圆、耗时）；玻璃上集成光学涂层后的晶圆级芯片尺寸封装技术可以使组装后的 CIS 模组厚度减小，透光率增加 2%-4%左右，可应用于封装更高端的 CIS；多层线路的晶圆级芯片尺寸封装技术解决了晶圆级芯片尺寸封装中芯片焊垫更多导致芯片背面无空间可引线的技术瓶颈问题，使封装多焊垫的芯片成为可能。

公司针对市场对晶圆级芯片尺寸封装技术的要求，未来将开发并储备更为先进的晶圆级芯片尺寸封装技术，即：芯片焊垫节距更小、切割道宽度更窄、锡球节距和直径更窄的晶圆级芯片尺寸封装技术；开拓晶圆级芯片尺寸封装技术的应用领域；关注三维的晶圆级封装技术，并做技术储备。

3、技术创新安排

为稳定研发队伍，充分调动技术研发人员积极性，公司建立了股权激励平台，并针对技术人才特点，建立了管理职务与技术职称双轨晋升机制，使得专业技术人员也同样具有晋升发展的空间。为提高项目开发的效益与质量，公司以“项目

负责制”为基础，针对项目研发的不同阶段特点，建立了各种奖励制度，公司还建立了内部和外部相结合的培训机制，内部培训主要有案例讲座、邀请供应商的技术人员讲座，外部培训主要有参加国内外会议、参加展览会、参加大专院校的学术讲座。

八、公司主要产品的质量控制情况

（一）质量控制标准

公司坚持质量第一、用户至上的服务宗旨，在企业内部推行国际质量标准认证。公司于 2006 年 9 月通过了 ISO9001: 2008 质量管理体系认证；于 2006 年 10 月通过 ISO14001: 2004 环境管理体系认证；于 2008 年通过 SONY GP 认证；于 2009 年 8 月通过 QC080000 认证；于 2010 年 6 月通过 ISO/TS16949: 2009 认证，认证范围为汽车多媒体数码影像处理用的晶圆级芯片的封装和技术研发，该认证为生产汽车用电子产品的前置条件。

公司通过贯彻实施 ISO9001: 2008 质量认证标准，使企业的质量方针目标得到深入地贯彻和实施。公司定期开展质量体系内部审核和管理评审，及时纠正解决体系运行中出现的问题，保证质量体系不断完善和持续有效，形成企业自我完善的机制。

（二）质量控制措施

1、建立并不断完善质量管理体系，通过定期和不定期的内部审核和管理评审，及时发现体系运行中存在的问题，分析原因并加以解决，以确保产品质量管理绩效和体系的有效性和适宜性。

2、建立完善的质量管理制度，质量管理部门直属于总经理，并都由专人负责，从组织上为产品提供了强有力的保证。原材料检验、工序检验、委外加工检验、成品检验、出货检验、不合格品控制、仪器计量、客户投诉处理、纠正和预防措施等制度的执行更为产品质量提供了软件上的保证。

3、注重与客户的质量反馈，每年向客户发放《客户满意度调查表》，收集客户对公司产品和服务的意见，分析客户反馈意见、投诉信息，建立“客户抱怨处理程序”，及时处理客户投诉，不断提高客户的满意度。

（三）质量纠纷

报告期内，公司未出现质量纠纷情况。

九、冠名“科技”的依据

公司作为省级高新技术企业、省级企业技术中心及第一批国家鼓励的集成电路企业，一直注重发展技术创新能力。公司目前是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封测服务商，公司技术中心被江苏省经济和信息化委员会认定为省级企业技术中心，在技术创新和产品开发上取得了多项成果，公司及其子公司已申请并获得国家知识产权局授权的专利共 19 项，还有 5 项美国发明专利，另有 19 项专利正在受理中。公司先后承担了多项国家及省级科研项目，并获得许多产品和技术相关荣誉。因此公司名称含有“科技”字样。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）与控股股东、实际控制人的同业竞争情况

本公司无控股股东及实际控制人，因此不存在与控股股东、实际控制人同业竞争的情况。本公司主要股东为 EIPAT 和中新创投，合计持有公司 121,892,612 股股份，占公司本次发行前总股本的 64.32%。

1、与第一股东 EIPAT 的同业竞争情况

EIPAT 目前无实际经营业务，与发行人不存在同业竞争。

2、与第二股东中新创投的同业竞争情况

中新创投主营业务为高新技术企业的直接投资、相关产业的创业投资基金和创业投资管理公司的发起与管理等，中新创投与发行人不存在同业竞争。

发行人与原中新创投下属子公司智瑞达科技是否存在同业竞争的核查情况：

（1）智瑞达科技的基本情况

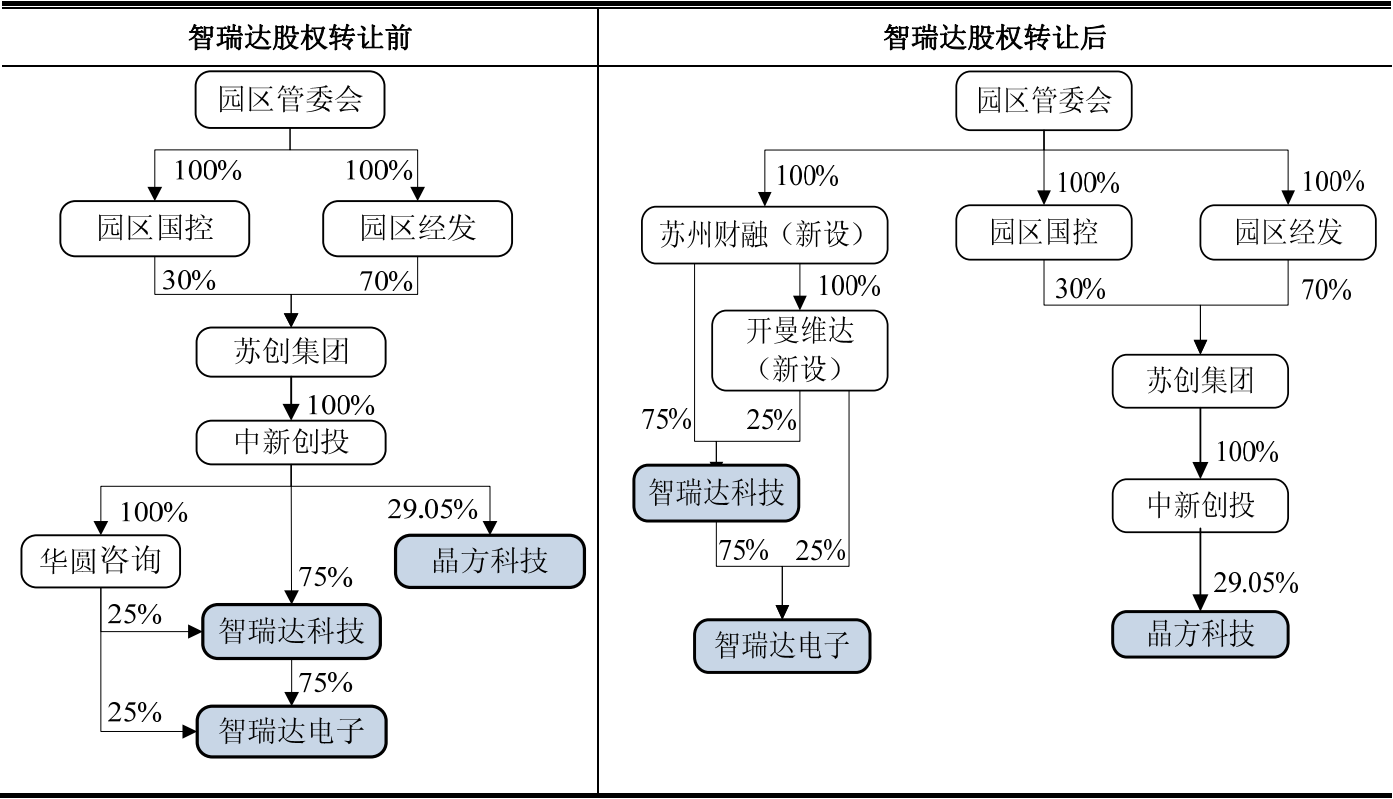
智瑞达科技系由英飞凌科技（中国）有限公司和中新创投于 2003 年 7 月出资组建的中外合资公司，原名为英飞凌科技（苏州）有限公司，经营范围为从事集成电路记忆体产品的研发、生产制造和封装测试，销售本公司产品，并提供相关服务。根据双方的合作协议，中新创投仅作为财务投资方，不参与公司的经营决策，但英飞凌科技（苏州）有限公司需每年支付固定的收益比例向中新创投支付红利。

2006 年 5 月，英飞凌集团内部业务分拆，将逻辑内存业务剥离，成立了奇梦达公司，英飞凌科技（中国）有限公司将其持有英飞凌科技（苏州）有限公司的股权转让给奇梦达公司，并将英飞凌科技（苏州）有限公司更名为奇梦达（苏州）有限公司。由于产能过剩和内存芯片价格不断下滑，奇梦达公司于 2009 年 1 月 23 日宣告破产，中新创投在无法收回其投资收益的情况下，受让了奇梦达公司所持有奇梦达（苏州）有限公司的股权，并将其更名为智瑞达科技（苏州）有限公司。受让股权后，中新创投与其全资子公司华圆咨询对智瑞达科技的持股比例分别为 75%、25%。

2012 年 4 月 11 日，为了进一步加强国有资产的管理力度，提高国有资产的管理效率，苏州工业园区管委会根据苏州市政府的批复（苏府复【2012】23 号），新设了资产处置平台苏州财融产业投资有限公司（以下简称“苏州财融”），定位于配合苏州工业园区管委会设立的国有资产管理与运营平台，处置运营效率不高或闲置的资产，以实现资产价值最大化，保证国有资产的保值增值。由于智瑞达科技自奇梦达公司破产倒闭以来，长期亏损，大部分产能处于闲置状态，工业园区管委会一直致力于将智瑞达科技的股权予以处置，以达到国有资产的保值目的。因此中新创投于 2012 年 4 月 28 日将持有智瑞达科技 75%的股权受让给苏州财融，中新创投全资子公司华圆咨询将其持有智瑞达科技 25%的股权受让给苏州财融的全资子公司开曼维达有限公司。苏州财融受让智瑞达科技股权后，将根据苏州工业园区管委会、苏州市人民政府对其资产处置职责的定位，全权负责对智瑞达科技的处置工作。

截至 2011 年 12 月 31 日，智瑞达科技总资产为 39,311.26 万元，未分配利润为-201,256.34 万元，净资产为 30,773.20 万元；智瑞达科技 2011 年度营业收入为 8,877.43 万元，净利润为-3,748.58 万元。

智瑞达科技股权转让前后的股权结构图如下：



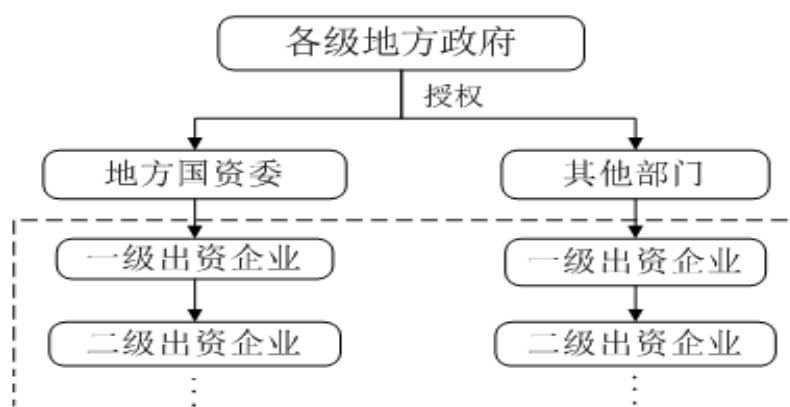
（2）发行人与智瑞达科技不存在同业竞争

1) 智瑞达科技股权变更后，与发行人第二大股东中新创投不存在关联关系。

第一、苏州市国资委与苏州工业园区管委会同是代表苏州市人民政府履行出资人职责的机构。

根据《国务院关于开发建设苏州工业园区有关问题的批复》（国函【1994】9号）和《关于加快苏州工业园区建设若干问题的通知》（苏委【1994】214号），苏州工业园区管委会系苏州市人民政府的派出机构，代表苏州市人民政府履行出资人职责，不在国家行政区划范围，不属于独立的区级行政政府单位。

《中华人民共和国企业国有资产法》第十一条规定：①国务院国有资产监督管理机构和地方人民政府按照国务院的规定设立的国有资产监督管理机构，根据本级人民政府的授权，代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责；②国务院和地方人民政府根据需要，可以授权其他部门、机构代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责。



根据上述法条规定，苏州市人民政府可以授权苏州市国资委代表其履行出资人职责；也可以授权其他机构（如：苏州工业园区管委会）代表其履行出资人职责。另根据苏州市人民政府对苏州工业园区管委会设立一级出资企业出具的批复，明确苏州工业园区管委会是代表苏州市人民政府履行出资人职责的机构。因此苏州市国资委与苏州工业园区管委会都是代表苏州市人民政府履行出资人职责的机构。

第二、根据《公司法》对关联关系的界定，园区经发与苏州财融不存在关联关系，从而智瑞达科技和中新创投也不存在关联关系。

智瑞达科技股权变更后，智瑞达科技受苏州财融控制，中新创投受园区经发控制，园区经发与苏州财融同是园区管委会直接出资平台，同受园区管委会控制。

《公司法》规定：“关联关系，是指公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系”。

苏州工业园区管委会属代表苏州市人民政府履行出资人职责的机构。根据上述《公司法》规定，园区经发与苏州财融虽同受苏州工业园区管委会控股，但苏州工业园区管委会系代表苏州市人民政府履行国有出资人职责的机构，因此园区经发与苏州财融不存在关联关系，从而智瑞达和发行人第二大股东中新创投不存在关联关系。

2) 发行人与智瑞达科技所经营业务完全不同，不存在同业竞争。

第一、在产品、技术、客户等方面，发行人与智瑞达科技均存在较大的差异，不存在同业竞争。

发行人主要从事影像传感芯片的封装，采用晶圆级封装技术，而智瑞达科技主要从事随机存储器的封装，采用传统封装技术，二者在产品、技术、客户等方面均不同。

2012年5月4日，中国半导体行业协会就“晶方科技和智瑞达科技的业务和技术性质”出具了说明，认为：晶方科技和智瑞达科技分别所从事的影像传感器芯片和随机存储器领域是集成电路中两个很大的分支，属于完全不同的两个领域，所采用的封装方式完全不同。

项 目	智瑞达科技	发行人
产品	随机存储器（DRAM）	影像传感芯片
技术	DRAM 封装技术	晶圆级尺寸封装技术
客户	随机存储器（DRAM）设计公司。	影像传感芯片设计公司。
供应商	主要供应商为：ADVANTEST; ASE Shanghai; Advantest(Shanghai) ASM; Advantest Japan; Nippon DNIV Int; Kinsus 等等	主要供应商为：SCHOTT AG,BS Flat Panel Display、上海福纬国际贸易有限公司、Rohm and Haas Electronic Materials Asia Ltd、上海亿钶气体有限公司

第二、智瑞达科技未来进入晶圆级芯片尺寸封装测试领域可能性较小，无法与发行人构成同业竞争

首先，智瑞达科技本身是一家濒临破产的待处置公司，未来对发行人形成竞争威胁的可能性很小。由于智瑞达科技自奇梦达公司破产倒闭以来，长期亏损，大部分产能处于闲置状态，苏州园区管委会一直致力于处置智瑞达科技的股权，以达到国有资产保值的目的，因此，中新创投于 2012 年 4 月 28 日将持有智瑞达科技 75%的股权转让给苏州财融，中新创投全资子公司华圆咨询将其持有智瑞达科技 25%的股权转让给苏州财融的全资子公司开曼维达有限公司。苏州财融受让智瑞达股权后，将根据苏州工业园区管委会、苏州市人民政府对其资产处置职责的定位，全权负责对智瑞达科技的处置工作。

其次，从事晶圆级芯片尺寸封装测试业务门槛很高。传统封装行业与晶圆级芯片尺寸封装行业间存在较高的技术专利壁垒，智瑞达科技未获得晶圆级芯片尺寸封装技术授权，加上发行人已成功研发多项自主创新技术，并为其申请了多项中国及美国专利，因此，智瑞达科技在未取得相关专利授权的情况下，无法进入晶圆级芯片尺寸封装行业领域，与发行人竞争。

综上所述，保荐机构和发行人律师认为：发行人与智瑞达科技不构成同业竞争。

（二）拟投资项目的同业竞争情况

本次募集资金投资的项目均围绕本公司现有主营业务开展，用于提升服务能力，而本公司主要股东均不从事与本公司拟投资项目相同或相近的业务。因此，本公司拟投资项目与主要股东不存在潜在的同业竞争关系。

（三）避免同业竞争的承诺

1、公司主要股东 EIPAT 和中新创投向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“（1）本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与股份公司相同、相似业务的情形；

（2）在直接或间接持有股份公司股份的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营与股份公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与股份公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业（如有）

比照前述规定履行不竞争的义务；

(3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与股份公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；

(4) 如本公司违反上述承诺，股份公司及股份公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺。”

2、公司董事、监事、高级管理人员以核心技术人员向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“（1）自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；

（2）自本人从发行人离职后的二年内，上述承诺仍然有效；

（3）如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。”

二、关联方与关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，截至本招股说明书签署日，发行人的关联方包括：

（一）持有发行人 5%以上股份的股东

企业名称	与发行人关系
Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	持发行人 35.27%股份的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司	持发行人 29.05%股份的股东
Omnivision Holding (Hong Kong) Company Limited	持发行人 18.68%股份的股东
英菲尼迪—中新创业投资企业	持发行人 8.30%股份的股东

（二）关键管理人员和核心技术人员投资设立的公司

企业名称	与发行人关系
苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	关键管理人员投资设立的公司，且为发行人股东
苏州豪正企业管理咨询有限公司	关键管理人员投资设立的公司，且为发行人股东

晶磊有限公司

关键管理人员投资设立的公司，且为发行人股东

（三）关键管理人员和核心技术人员以及与其关系亲密的家庭成员

关键管理人员主要指本公司的董事、监事和高级管理人员，详见本招股说明书之“第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”。

（四）关键管理人员担任董事、高管的兼职单位

截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员担任董事、高管的兼职单位如下：

兼职单位名称	与发行人关系
华亿创业投资管理（苏州）有限公司	发行人董事费建江、Amir Galor 在该公司担任董事
苏州华亿创业投资中心（有限合伙）	发行人董事费建江、Amir Galor 在该公司担任董事
苏州创业投资集团有限公司	发行人董事费建江、盛刚在该公司均担任董事、副总裁
苏州相城高新创业投资有限公司	发行人董事费建江在该公司担任董事
苏州工业园区原点创业投资有限公司	发行人董事费建江在该公司担任执行董事
凯风创业投资有限公司	发行人董事费建江在该公司担任执行董事
盛科网络（苏州）有限公司	发行人董事费建江在该公司担任董事长
凯瑞斯德生化（苏州）有限公司	发行人董事费建江在该公司担任董事长
神州数码信息技术服务有限公司	发行人董事费建江在该公司担任董事
苏州工业园区方正国际软件有限公司	发行人董事费建江在该公司担任董事
沪士电子股份有限公司	发行人董事费建江在该公司担任董事
苏州融创担保投资有限公司	发行人董事盛刚在该公司担任董事长
苏州工业园区金鸡湖农村小额贷款有限公司	发行人董事盛刚在该公司担任董事长
华圆管理咨询（香港）有限公司	发行人董事费建江在该公司担任执行董事
苏州工业园区银瑞资产管理有限公司	发行人董事盛刚在该公司担任董事长
苏州市融达科技小额贷款有限公司	发行人董事盛刚在该公司担任董事长
苏州工业园区银杏科技金融服务有限公司	发行人董事盛刚在该公司担任董事长
江苏常铝铝业股份有限公司	发行人监事王庆在该公司担任董事
豪威科技（上海）有限公司	发行人董事陈家旺、监事王永锋分别在该公司担任副总裁、北京分公司负责人
China Medicine On-Line	发行人董事 Amir Galor、Ariel Poppel 在该公司均担任董事
Mango DSP Ltd.	发行人董事 Amir Galor、Ariel Poppel 在该公司担任董事
United Water Corporation	发行人董事 Ariel Poppel 在该公司担任董事
THT Heat Transfer Technology	发行人董事 Ariel Poppel 在该公司担任董事
Nicast Ltd.	发行人董事 Ariel Poppel 在该公司担任董事
Unity Wireless Systems Corporation	发行人董事 Ariel Poppel 在该公司担任董事
哈尔滨第一工具制造有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
苏州华亿基金管理有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事

苏州苏以创业投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任执行董事、总经理
英飞尼迪（北京）创业投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事长
哈尔滨哈以创业投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事长
石家庄石以创业投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事长
常州常以创业投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事长
宁波新以创业投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor、Ariel Poppel 分别在该公司担任董事长、董事
中以智库（苏州）有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事长
英飞尼迪投资管理（苏州）有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
双流英飞尼迪创业投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事长
天津天英创业投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事长
天以红日医药创新科技发展(天津)有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
天津天以生物医药股权投资基金有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
扬州英飞尼迪创业投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事长
济宁英飞尼迪创业投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事长
重庆英飞尼迪投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事长
洪泽英飞尼迪创业投资管理有限公司	发行人董事 Amir Galor、Ariel Poppel 分别在该公司担任董事长、董事
河北九派制药有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
石家庄市兴柏生物工程有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
北京忆恒创源科技有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
哈尔滨同为电气股份有限公司	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
Nanosoft	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
Infinity IP Bank International (Suzhou) Co. Ltd	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
FBR Infinity II China (I-CSVC) Management	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
Maayan Technology Ventures Ltd.	发行人董事长王蔚、董事 Amir Galor 在该公司担任董事
Power ID	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
Power Paper	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
Redent-Nova Ltd.	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
Applisonix Ltd.	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
Nanomotion Ltd.	发行人董事 Amir Galor 在该公司担任董事
华灿光电股份有限公司	发行人独立董事杨辉在该公司担任独立董事
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	发行人独立董事杨辉在该公司担任所长
北京石星汇远餐饮管理有限公司（乐石咖啡）	发行人独立董事杨柯在该公司担任总经理
苏州禾盛新型材料股份有限公司	发行人独立董事黄彩英在该公司担任独立董事
上海龙韵广告传播股份有限公司	发行人独立董事黄彩英在该公司担任独立董事
上海沪邑科技信息咨询有限公司	发行人独立董事黄彩英在该公司担任行政总监
苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	发行人董事长兼总经理王蔚、高管俞国庆、钱小洁、段佳国分别在该公司担任董事长、董事、董事、董事
苏州豪正企业管理咨询有限公司	发行人董事长兼总经理王蔚、高管王文龙分别在该公司担任董

	事长、董事
晶磊有限公司	发行人高管刘宏钧、黄福龙、王卓伟均在该公司担任董事
晶方半导体科技（北美）有限公司	发行人董事长兼总经理王蔚、高管刘宏钧、Vage Oganesion 分别在该公司担任董事、董事、董事/总经理

（五）其他关联方

企业名称	与本企业关系
Omnitech	与本公司第三大股东 OmniH 受同一实际控制人控制

三、关联交易

（一）经常性关联交易

1、关联销售

单位：万元

企业名称	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
Omnitech	-	-	-	-	9.75	0.07%

Omnitech 系公司第三大股东 OmniH 的兄弟公司，同受纳斯达克上市公司 OmniVision Technologies, Inc. 控制。发行人为 Omnitech 提供封装测试服务，销售价格为市场价格。报告期内，除 2009 年度公司与 Omnitech 发生少量交易外，2010 年度和 2011 年度公司未与 Omnitech 发生交易。

目前，公司主要客户为 Galaxycore、BYD(HK) Co.Ltd.、Hynix Semiconductor Inc.，这些客户系金融危机时期由公司自主开拓。经过近几年的相互合作、共同成长，公司与这些主要客户都经历了快速的发展，这种相互合作-共同成长的发展经历，造就了彼此间的良性合作关系，为双方长期的战略合作奠定了基石。公司从自身的发展策略来讲，首先是继续稳定与这些主要客户的长期合作关系，目前公司由于产能的原因，尚不能完全满足主要客户的发展需求，公司在产能存在瓶颈的前提下首先是满足现有客户的需求。

目前，公司未对与 Omnitech 以及 OmniVision 今后的业务往来作出安排。如果今后公司的产能能够顺利提升，在产能允许的情况下，公司不排除会继续向 Omnitech 提供封装服务，若发生交易，公司会严格履行《公司章程》、《关联交易制度》中规定的相关程序，以保证关联交易的公允性。

2、技术许可

根据 2005 年发行人与 EIPAT（原名为 Shellcase）签署的《许可协议》，授权本公司使用其拥有的 ShellOP 和 ShellOC 技术。根据 ShellOP、ShellOC 技术授权协议约定，发行人从使用该项技术实现收入之日起至商业性销量触及 2000 片晶圆后三年内，按与 ShellOP、ShellOC 技术直接相关的服务收入总额的 5% 计缴权利金；协议期限的其他时间，按与 ShellOP、ShellOC 技术直接相关的服务收入总额的 3% 计缴权利金。报告期内，本公司应付 EIPAT 技术使用权利金分别为 180.52 万元、190.62 万元、195.44 万元。技术许可方 EIPAT 已经对公司自设立以来技术使用权利金已经足额缴纳进行了确认。

公司在充分消化吸收所引进的 ShellOP、ShellOC 技术基础上，积极自主创新，通过多年的努力，公司成功研发超薄晶圆级芯片封装技术（ThinPac）、MEMS 和 LED 晶圆级芯片封装技术等。报告期内，公司直接使用 ShellOP、ShellOC 技术所产生的收入及其占主营业务收入的比重逐年降低，2011 年度公司直接使用 ShellOP、ShellOC 技术所产生的收入仅为 32.85 万元，占当年主营业务收入的比重为 0.11%。

（二）关联方往来期末余额

发行人与关联方资金往来各期末余额情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
应收账款	Omnitech	-	-	9.89
预收款项	Omnitech	-	-	-
应付账款	EIPAT	38.17	48.21	28.93

2009 年末发行人对 Omnitech 的应收账款余额为 9.89 万元，该款项系发行人应收的封装测试服务费用；报告期各期末，发行人对 EIPAT 应付账款为 28.93 万元、48.21 万元、38.17 万元，均为发行人应付 EIPAT 的技术使用权利金。

（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

发行人具有完整的业务体系以及直接面向市场经营的能力。报告期内，发行人与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、规范关联交易的制度安排

公司已建立了完善的公司治理制度，在公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《关联交易规则》等制度中，规定了

有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。主要规定如下：

（一）公司章程中有关关联交易的制度安排

“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

关联股东可以自行回避，也可由任何其他参加股东大会的股东或股东代表提出回避请求，如有其他股东或股东代表提出回避请求，但有关股东认为自己不属于应回避范围的，应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东的，股东大会可将有关议案的表决结果就关联关系身份存在争议、股东参加或不参加投票的结果分别记录。股东大会后应由董事会提请有权部门裁定关联关系股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中做出详细说明。

关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。

股东大会在审议关联交易事项时，主持人应宣布有关关联股东的名单，并对关联事项作简要介绍，再说明关联股东是否参与表决。如关联股东参与表决，该关联股东应说明理由及有关部门的批准情况。如关联股东回避而不参与表决，主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代表表决权股份的总数和占公司总股份的比例之后再进行审议并表决。

第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。”

(二) 董事会议事规则中的有关关联交易的制度安排

“第二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。”

(三) 独立董事工作制度中的有关关联交易的制度安排

“第十八条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还享有以下特别职权:

(一) 重大关联交易(指公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易,或者公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

(三) 向董事会提请召开临时股东大会;

(四) 提议召开董事会;

(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构;

(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

第十九条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所,应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权,应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意,独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。”

（四）关联交易管理制度关于关联交易的主要制度安排

“第十四条 公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联方不得以任何方式干预公司的决定；

（三）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

1、交易对方；

2、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职的；

3、拥有交易对方的直接或间接控制权的；

4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；

5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；

6、中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

（四）股东大会审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：

1、交易对方；

2、拥有交易对方直接或间接控制权的；

3、被交易对方直接或间接控制的；

4、与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

5、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

6、中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

第十五条 公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联

董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

第十七条 公司与关联自然人发生的金额在 30 万元（含 30 万元）至 500 万元（含 500 万元）之间的关联交易，由董事会批准，独立董事发表单独意见。

前款交易金额在 500 万元以上的关联交易由股东大会批准。

第十八条 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，应当及时披露并由董事会批准，独立董事发表单独意见。

第十九条 公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

第二十条 独立董事对公司拟与关联方达成的金额在 3,000 万元以上（含 3,000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 以上（含 5%）的关联交易发表单独意见。”

五、公司独立董事对关联交易事项的意见

公司独立董事对公司的关联交易决策程序及前述关联交易事项进行了核查，认为：公司最近三年发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事会成员简介

公司本届董事会共有成员 9 名，分别为王蔚、费建江、盛刚、KAH-ONG TAN（陈家旺）、Ariel Poppel、Amir Galor、杨柯、杨辉、黄彩英。其中杨柯、杨辉、黄彩英三人为独立董事。各董事均由公司股东大会选举产生。

王蔚，公司董事长兼总经理，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB 等领域的工作经验，非常熟悉 EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate 等。1995-1999 年间任职于上海凯胜电子有限公司，担任副总经理；1999-2004 年任职于 Camtek Ltd.，担任大中国区总经理；2005-2010 年间任职于晶方半导体科技（苏州）有限公司，担任总经理、董事。现任本公司董事长兼总经理。

费建江，公司董事，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 6 月出生，会计师，硕士研究生。2001-2007 年间任职于中新苏州工业园区创业投资有限公司，先后担任财务总监、副总裁；2007 年至今任职于苏州创业投资集团有限公司，担任副总裁；2005 年至 2010 年 6 月 17 日担任晶方半导体科技（苏州）有限公司董事长、法定代表人；现任本公司董事。

盛刚，公司董事，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 10 月出生，会计师，硕士研究生。1993-1997 年间任职于中国人民银行苏州分行，担任办事员、秘书；1997-2002 年间任职于苏州市商业银行，担任支行行长助理、支行副行长；2002-2007 年间任职于中新苏州工业园区创业投资有限公司，先后担任担保部经理、总经济师、财务总监；2007 年至今任职于苏州创业投资集团有限公司，曾任财务总监，现任副总裁；2007 年至今担任本公司董事。

KAH-ONG TAN（陈家旺），公司董事，男，马来西亚国籍，1969 年 10 月出生，硕士研究生。1995-2005 年间任职于 Inventec Group，担任产品发展及市场主管；2005 年至今任职豪威科技（上海）有限公司，担任市场销售主管、中国区副总裁。现任本公司董事。

Ariel Poppel，公司董事，男，以色列国籍，1953 年出生，硕士研究生。

1980-1994 年间任职于以色列泛亚科技电子系统有限公司，先后担任定价经理、财务总监；1994-2001 年间任职于 Nexus Telocation Systems，先后担任财务总监、高级副总裁、运营总监；2001-2004 年间任职于 OTM,INC.，先后担任督导委员会负责人，业务发展顾问；2004 至今任职于 Shellcase Ltd.，（现更名为 EIPAT）担任首席执行官；2006 年至今任本公司董事。

Amir Galor，公司董事，男，以色列国籍，1962 年 9 月出生，硕士研究生。曾任以色列空军 F-16 战机及特技飞行队飞行员；2004 年，在 Amir 先生的倡议和领导下，FBR INFINITY II CHINA VENTURES, L.P.与中新创投合作成立了中国第一支非法人制中外合作创业投资基金——英菲中新，现任 INFINITY 集团总裁、英菲中新管理合伙人；2005 年至今任本公司董事。

杨柯，公司独立董事，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 6 月出生，大学本科。1998-2002 年间任职于台湾大众电脑北京办事处，担任营销部经理；2002-2007 年间任职于控创（北京）科技有限公司（原北京同普中视科技发展有限公司，2003 年 10 月被德国控创公司并购），担任营销总监、副总经理（合伙人）。2008 年至今任北京石星汇远餐饮管理有限公司（乐石咖啡）总经理。

杨辉，公司独立董事，男，中国国籍，无境外居留权，1961 年 12 月出生，博士生导师。1993-1996 年间任职于德国柏林 Paul-Drude-Institute for Solid state electronics，担任博士后及客座研究员；1998 年获国家杰出青年基金，任国家 863 计划光电子主题专家组成员，主要从事 III-V 族化合物半导体的材料生长、物理分析，以及器件研究；现为中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所所长、研究员、博士生导师，同时为香港大学荣誉教授、北京邮电大学和同济大学客座教授、中国电子学会电子材料分会主任委员。

黄彩英，公司独立董事，女，中国国籍，无境外居留权，1967 年 4 月出生，硕士研究生、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1991 年-1999 年间先后任职于厦门集美大学财经学院、厦门集友会计师事务所，担任教师、会计师、注册资产评估师；1999 年-2001 年间，任职于大华会计师事务所，担任项目经理；2001 年-2002 年间任职于上海凌云幕墙科技股份有限公司，担任财务主管；2002-2005 年间任职于上海和陆投资咨询有限公司，担任行政经理；2005 年 2 月至今，任职于上海沪邑科技信息咨询公司，担任行政总监。

（二）监事会成员简介

公司本届监事会设监事三名，其中监事王永锋由全体发起人股东共同讨论提名，经公司 2010 年 6 月 18 日创立大会选举产生；监事陆健经公司 2010 年 6 月 17 日职工代表大会选举产生；监事王庆经公司 2010 年 9 月 19 日 2010 年第一次临时股东大会选举产生。

陆健，公司监事会主席，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 9 月出生，大学本科。1991-2002 年间任职于苏州市农业生产资料总公司，担任经理；2002-2005 年间任职于苏州市相城农资公司，担任副总经理；2005-2007 年间任职于江苏苏农农资集团股份有限公司，担任经理；2007 年至今任职于本公司，担任新厂人事行政部副经理。

王庆，公司监事，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 10 月出生，会计师，硕士研究生。2001-2004 年间任职于江苏天衡会计师事务所，担任注册会计师；2004-2006 年间任职于江苏华星会计师事务所，担任项目经理；2006-2007 年间任职于肖特玻璃科技（苏州）有限公司，担任财务部经理；2007-2009 年间任职于苏州创业投资集团有限公司担任投资管理经理；2009 年至今任职于中新苏州工业园区创业投资有限公司，担任综合管理部经理。

王永锋，公司监事，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 3 月出生，硕士研究生，具有清华大学工程学士和硕士学位。1988-1996 年间任职于清华大学微电子所，担任副研究员；1996-2000 年间任职于奥威电子技术有限公司，担任总工程师；2000 年 8 月至今任职于豪威科技（上海）有限公司北京分公司，担任首席代表。

（三）高级管理人员简介

根据公司《章程》，本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师为本公司高级管理人员。

王蔚，总经理，简历参见本节“（一）董事会成员简介”。

王文龙，公司副总经理，男，中国国籍，1976 年 11 月出生，大学本科。2000-2004 年间任职于沪士电子（昆山）有限公司，担任高级工程师；2004-2005 年间任职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，担任高级工程师；2005 年至今任职于本公司，先后担任工程经理、技术中心经理。

黄福龙，公司副总经理，男，中国台湾，1957年7月出生，大学专科。1999-2003年间任职于台湾精材科技股份有限公司，担任生产、工程部经理；2003-2005年间任职于艾克尔科技股份有限公司，担任生产、设备部经理；2005-2006年间任职于南太电子（深圳）有限公司，担任制造、设备、生产经理及总经理助理；2006年至今任职于本公司，先后担任生产厂长、营运副总裁。

刘宏钧，公司副总经理，男，加拿大国籍，1970年5月出生，硕士研究生。1996-1998年间任职于Dynamotion/ATI Corp.，担任应用工程师；1998-2001年间任职于Electro Scientific Industries，担任战略客户经理；2002-2004年间任职于Photon Dynamics，担任中国区总经理；2005-2008年间任职于Triad Engineering Applications, INC.，担任总监；2008年至今任职于本公司，先后担任销售总监、采购总监。

俞国庆，公司副总经理和总工程师，男，中国国籍，无境外居留权，1971年5月出生，博士学历，中国科学院院长优秀奖学金获得者。2000年在中国科学院任助理研究员，同年8月至2005年4月在韩国国立汉城大学、新加坡南洋理工大学从事博士后科研工作，主要研究真空薄膜的制备，发表学术论文四十多篇，累计申请二十多项专利，其中五项已获授权；2005年5月至12月任职于N.V. Bekaert S.A.公司，担任项目经理；2006年3月至今任职于本公司，先后担任研发部经理、总工程师。

王卓伟（曾用名：王宥军），公司副总经理和副总工程师，男，中国台湾，1974年5月出生，本科学历。1999-2001年间任职于耀文电子工业股份有限公司，担任研发工程师、研发主管；2001-2005年间任职于精材科技股份有限公司，担任生产主管、工程经理；2005-2007年间任职于本公司，担任工程经理、品管经理；2007-2008年间任职于美商豪威科技股份有限公司，担任外包工程主管；2008年至今任职于本公司，担任副总工程师。

Vage Oganessian，公司副总经理，男，以色列国籍，1969年1月出生，硕士研究生。1992-1994年在Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia担任工艺工程师；1994-1997年在NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；1998-2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；2005-2006年在TESSERA - ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel担任研发副总；2006-2010年在TESSERA - San Jose, USA

先后担任技术转让部副总、研发副总；2011年1月至今任职于本公司，担任副总经理，主要分管晶方北美。

段佳国，公司董事会秘书和财务总监，男，中国国籍，无境外居留权，1979年6月出生，硕士研究生，注册会计师。2006-2008年间任职于安永华明会计师事务所，担任审计员；2008-2010年间任职于苏州工业园区银杏投资管理有限公司，担任投资经理。2010年至今任职于本公司，担任财务总监、董事会秘书。

钱小洁，公司副总经理，女，中国国籍，无境外居留权，1968年9月出生，本科学历。1991-1997年间任职于苏州第三人民医院，担任中医师；1997-2003年间任职于深圳尤尼吉尔通讯有限公司，担任行政经理；2003-2005年间任职于苏州易德龙电器有限公司，担任行政主管；2005年至今任职于本公司，担任行政总监，分管行政人事和公共关系。

（四）核心技术人员简介

1、俞国庆，总工程师，简历参见本节“（三）高级管理人员简介”。

2、王卓伟（曾用名：王宥军），副总工程师，简历参见本节“（三）高级管理人员简介”。

3、Vage Oganestion，副总经理、美国子公司总经理，简历参见本节“（三）高级管理人员简介”。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

（一）直接持股情况

截至本招股说明书签署日，现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接持有本公司股份情况。

（二）间接持股情况

截至本招股说明书签署之日，现任董事、监事、高级管理人员、核心技术及其近亲属间接持有公司股份的情况如下表：

序号	姓名	职务	股数（万股）	持股比例
1	王 蔚	董事长、总经理	321.50	1.70%
2	陆 健	监事会主席	13.50	0.07%
3	刘宏钧	副总经理	44.50	0.23%

4	王文龙	副总经理	38.00	0.20%
5	钱小洁	副总经理	38.00	0.20%
6	俞国庆	总工程师、副总经理	36.00	0.19%
7	黄福龙	副总经理	34.00	0.18%
8	王卓伟	副总工程师、副总经理	26.00	0.14%
9	段佳国	财务总监、董事会秘书	19.00	0.10%

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均无对外投资。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

2011 年度，本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术的薪酬情况如下：

序号	姓名	本公司职务	薪酬（元）	是否在公司专职领薪
1	费建江	董事	-	否
2	Ariel Poppel	董事	-	否
3	Amir Galor	董事	-	否
4	盛刚	董事	-	否
5	王蔚	董事长、总经理	1,466,140	是
6	KAH-ONG TAN（陈家旺）	董事	-	否
7	杨柯	独立董事	50,000	否
8	杨辉	独立董事	50,000	否
9	黄彩英	独立董事	50,000	否
10	王庆	监事	-	否
11	王永锋	监事	-	否
12	陆健	监事会主席	281,241	是
13	王文龙	副总经理	799,999	是
14	黄福龙	副总经理	558,529	是
15	刘宏钧	副总经理	651,098	是
16	俞国庆	副总经理	646,225	是
17	王卓伟	副总经理	609,233	是
18	钱小洁	副总经理	683,280	是
19	段佳国	董事会秘书 财务总监	744,913	是
20	Vage Oganesion	副总经理	270,833 美元	是

除以上薪酬外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员目前均未享有认股权；本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过员工持股公司共同间接持有公司 3.01% 的股权。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员退

休后由养老保险和社会保障体系安置。

2010年6月18日，公司召开的创立大会暨第一次股东大会会议决议通过杨柯、杨辉、黄彩英为独立董事，独立董事年津贴为每年5万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的关系及兼职情况

（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的关系

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间均不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在其他单位的任职情况如下表所示：

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	所兼职单位与本公司关系
王蔚	董事长 总经理	晶方半导体科技（北美）有限公司	董事	公司全资子公司
		苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	董事长	公司参股股东（员工持股公司）
		苏州豪正企业管理咨询有限公司	董事长	公司参股股东（员工持股公司）
		Maayan Technology Ventures Ltd.	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
费建江	董事	苏州创业投资集团有限公司	董事 副总裁	公司第二大股东的控股股东
		中新苏州工业园区创业投资有限公司	董事 总经理	公司第二大股东
		苏州相城高新创业投资有限公司	董事	公司第二大股东控股股东的参股公司
		苏州工业园区原点创业投资有限公司	执行董事	公司第二大股东的子公司
		凯风创业投资有限公司	执行董事	公司第二大股东的控股子公司
		盛科网络（苏州）有限公司	董事长	公司第二大股东参股公司
		凯瑞斯德生化（苏州）有限公司	董事长	公司第二大股东参股公司
		神州数码信息技术服务有限公司	董事	公司第二大股东参股公司
		苏州工业园区方正国际软件有限公司	董事	公司第二大股东参股公司
		沪士电子股份有限公司	董事	公司第二大股东参股公司
		华圆管理咨询（香港）有限公司	执行董事	公司第二大股东的子公司
		华亿创业投资管理（苏州）有限公司	董事	公司第四大股东的必备投资者
盛刚	董事	苏州华亿创业投资中心（有限合伙）	董事	公司第二大股东控股子公司
		苏州创业投资集团有限公司	董事 副总裁	公司第二大股东的控股股东
		中新苏州工业园区创业投资有限公司	监事	公司第二大股东

		苏州工业园区银杏科技金融服务有限公司	董事长	公司第二大股东的兄弟公司
		苏州工业园区创业投资引导基金有限公司	监事	公司第二大股东的控股股东的参股公司
		苏州元风创业投资有限公司	监事	公司第二大股东的控股股东的参股公司
		苏州工业园区银瑞资产管理有限公司	董事长	公司第二大股东的控股股东的参股公司
		苏州融创担保投资有限公司	董事长	公司第二大股东的兄弟公司的子公司
		苏州市融达科技小额贷款有限公司	董事长	公司第二大股东的控股股东的参股公司
		苏州工业园区金鸡湖农村小额贷款有限公司	董事长	公司第二大股东的控股股东的参股公司
陈家旺	董事	豪威科技（上海）有限公司	副总裁	公司第三大股东的控股子公司
Ariel Poppel	董事	EIPAT	执行官	公司第一大股东
		Mango DSP Ltd.	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		China Medicine On-Line	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		United Water Corporation	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		宁波新以创业投资管理有限公司	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		洪泽英飞尼迪创业投资管理有限公司	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		THT Heat Transfer Technology	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		哈尔滨第一工具制造有限公司	监事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		Nicast Ltd.	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		Unity Wireless Systems Corporation	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		华亿创业投资管理（苏州）有限公司	董事	公司第四大股东的必备投资者
		苏州华亿创业投资中心（有限合伙）	董事	公司第二大股东控股子公司
		EIPAT	董事	公司第一大股东
		Infinity 集团	总裁	Infinity 集团旗下基金投资了发行人第一大股东 EIPAT
		China Medicine On-Line Ltd.	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		Mango DSP Ltd.	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		苏州华亿基金管理有限公司	董事	公司第四大股东的必备投资者的全资子公司
		苏州苏以创业投资管理有限公司	执行董事 总经理	公司第二大股东的母公司及公司第一大股东的股东 Infinity 集团共同管理的公司的全资子公司

Amir Galor	董事			司
		英飞尼迪（北京）创业投资管理有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		哈尔滨哈以创业投资管理有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		石家庄石以创业投资管理有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		常州常以创业投资管理有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		宁波新以创业投资管理有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		中以智库(苏州)有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		英飞尼迪投资管理（苏州）有限公司	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		双流英飞尼迪创业投资管理有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		天津天英创业投资管理有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		天以红日医药创新科技发展（天津）有限公司	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		天津天以生物医药股权投资基金有限公司	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		扬州英飞尼迪创业投资管理有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		济宁英飞尼迪创业投资管理有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		重庆英飞尼迪投资管理有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		洪泽英飞尼迪创业投资管理有限公司	董事长	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		河北九派制药有限公司	董事	公司第二大股东的控股子公司的参股公司、发行人第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		石家庄市兴柏生物工程有限公司	董事	公司第二大股东控股子公司的参股公司、发行人第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		哈尔滨第一工具制造有限公司	董事	公司第二大股东的控股子公司的参股公司、发行人第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		北京忆恒创源科技有限公司	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		哈尔滨同为电气股份有限公司	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		Nanosoft	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		Infinity IP Bank International (Suzhou) Co. Ltd.	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业

		FBR Infinity II China (I-CSVC) Management	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		Maayan Technology Ventures Ltd.	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		Power ID	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		Power Paper	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		Redent-Nova Ltd.	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		Applisonix Ltd.	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
		Nanomotion Ltd.	董事	公司第一大股东的股东 Infinity 集团投资的企业
杨辉	独立董事	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	所长、研究员、博士生导师	无
		香港大学	荣誉教授	无
		北京邮电大学	客座教授	无
		同济大学	客座教授	无
		中国电子学会电子材料分会	主任委员	无
		华灿光电股份有限公司	独立董事	无
杨柯	独立董事	北京石星汇远餐饮管理有限公司(乐石咖啡)	总经理	无
黄彩英	独立董事	苏州禾盛新型材料股份有限公司	独立董事	无
		上海龙韵广告传播股份有限公司	独立董事	无
		上海沪邑科技信息咨询有限公司	行政总监	无
陆健	监事会主席	苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	监事	参股股东（员工持股公司）
王庆	监事	中新苏州工业园区创业投资有限公司	综合管理部经理	第二大股东
		江苏常铝铝业股份有限公司	董事	无
		苏州工业园区原点创业投资有限公司	监事	第二大股东的子公司
		凯风创业投资有限公司	监事	第二大股东的控股子公司
王永锋	监事	豪威科技（上海）有限公司	北京分公司负责人	第三大股东的控股子公司
王文龙	副总经理	苏州豪正企业管理咨询有限公司	董事	参股股东（员工持股公司）
黄福龙	副总经理	晶磊有限公司	董事	参股股东（员工持股公司）
俞国庆	副总经理 总工程师	苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	董事	参股股东（员工持股公司）
王卓伟	副总经理 副总工程师	晶磊有限公司	董事	参股股东（员工持股公司）
刘宏钧	副总经理	晶磊有限公司	董事	参股股东（员工持股公司）
		晶方半导体科技（北美）有限公司	董事	公司全资子公司
钱小洁	副总经理	苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	董事	参股股东（员工持股公司）
段佳国	董事会秘书 财务总监	苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	董事	参股股东（员工持股公司）
Vage Ogane sion	副总经理	晶方半导体科技（北美）有限公司	董事 总经理	公司全资子公司

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、所作承诺及其履行情况

（一）发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议

截至本招股说明书签署日，公司与在本公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签订了《劳动合同》，上述人员均按照《劳动合同》和《公司章程》的规定履行了义务。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的避免同业竞争承诺具体情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（三）避免同业竞争的承诺”。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的锁定股份承诺具体参见“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

截至本招股说明书签署日，上述承诺人履行承诺的情况良好。

七、董事、监事与高级管理人员的任职资格

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

八、报告期内董事、监事与高级管理人员变动情况

报告期内，发行人董监高变动情况如下：

（一）董事

晶方有限系中外合资企业，按照《中外合资经营企业法》和公司章程的规定，晶方有限董事由股东委派。

2009年1月1日，晶方有限共有董事6名，其中：股东中新创投委派费建江、盛刚，股东Shellcase委派Ariel Poppel，股东英菲中新委派Amir Galor，股东OmniT委派廖宇平，投资方共同委派王蔚，其中费建江出任董事长。

2010年6月18日，股份公司创立大会选举费建江、Ariel Poppel、Amir Galor、

盛刚、王蔚、KAH-ONG TAN（陈家旺）、杨柯、杨辉、黄彩英等 9 人为董事组成第一届董事会，其中杨柯、杨辉和黄彩英为独立董事。同日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举王蔚为董事长。

（二）监事

2009 年 1 月 1 日，晶方有限共有监事 2 名，分别为陈光录、孟爱民

2010 年 6 月 17 日，公司职工代表大会选举陆健为职工监事。2010 年 6 月 18 日，公司创立大会选举魏洪波、王永锋为监事，与公司职工代表监事陆健组成第一届监事会。2010 年 6 月 18 日，公司第一届监事会第一次会议选举魏洪波为监事会主席。

2010 年 9 月 3 日，公司第一届监事会第二次会议同意魏洪波因工作原因辞去监事职务。

2010 年 9 月 19 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，选举王庆为公司监事。

2010 年 9 月 19 日，发行人第一届监事会第三次会议通过决议，选举陆健先生担任公司监事会主席。

（三）高级管理人员

2009 年 1 月 1 日，公司总经理为王蔚，盛刚为财务总监。

2010 年 6 月 18 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，聘任王蔚为公司总经理；聘任刘立冬为公司董事会秘书；聘任黄福龙为副总经理，分管品保、厂务和计划；聘任俞国庆为副总经理、总工程师；聘任王文龙为副总经理，分管工程、设备和制造；聘任刘宏钧为副总经理，分管采购和销售；聘任王卓伟为副总经理、副总工程师，分管研发中心；聘任钱小洁为副总经理，分管行政人事和公共关系。上述高管变动主要系公司在变更设立股份有限公司后，为完善公司治理结构重新聘任高级管理人员，2010 年 6 月前，王文龙、黄福龙、俞国庆、刘宏钧、王卓伟、钱小洁虽职衔未定为副总经理级别，但均为其部门负责人，属公司管理人员。

2010 年 9 月 3 日，公司第一届董事会第二次会议通过决议：聘任段佳国先生担任公司财务总监。

2010 年 11 月 4 日，公司召开了第一届董事会第一次临时会议，同意刘立冬

辞去董事会秘书职务，同时聘任段佳国为公司董事会秘书。

2011 年 1 月 20 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，聘任 Vage Oganेशन 为公司副总经理。

上述董事、监事和高级管理人员的变化都履行了法定程序，报告期内未发生重大变化。

第九节 公司治理结构

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

依据《公司法》及有关规定，公司于2010年6月18日召开了创立大会，选举产生了第一届董事会六名董事和三名独立董事、第一届监事会除职工代表监事外的两名监事，并审议通过了公司《章程》，对股东大会、董事会和监事会、独立董事的权责和运行进行了具体规定。本公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《对外担保制度》、《内部审计制度》、《关联交易规则》、《对外投资管理制度》等相关制度，并在实际经营中严格遵照执行。

公司在制定有关制度时，主要按照《公司法》、《证券法》、《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》及中国证监会和证券交易所的有关上市公司治理的规范性文件之要求和指引，并结合了其他同行业上市公司及部分在公司治理方面表现良好的上市公司的成功经验，在公司法律顾问的指导下完成了有关制度内容的拟定，并经法定程序审议通过后实施。上述制度的制定依据、制定目的及主要内容如下：

项 目	股东大会 议事规则	董事会 议事规则	监事会 议事规则	独立董事 工作规则	董事会秘书 工作细则
制订依据	根据《公司法》以及其他法律、行政法规和公司章程的规定制定。	根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定制定。	根据《公司法》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程等有关规定。	根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》。	根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《公司章程》、《董事会议事规则》而制定。
制订目的	规范公司行为，保证股东依法行使职权，规范股东大会的	明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促	规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职	促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合	促使董事会秘书承担高级管理人员的有关法律责任，保障

	职权范围	使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平。	责，完善公司法人治理结构。	法权益不受损害。	公司相关决策程序规范运行。
主要内容	股东大会的职权范围、召集程序、提案与通知、召开程序、表决和决议、会后事项以及规则的修改等。	董事会的组成和职权范围、董事长的职权范围、董事会组织机构的设置、董事会议案的提出、董事会会议的召集、董事会会议的通知、董事会会议的召开和表决、董事会会议记录、决议的执行等。	监事会的组成和职责、监事会的召集和通知、监事会会议的召开和表决、监事会会议记录、决议的执行、规则的修改等。	独立董事的任职资格、独立董事的独立性、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的特别职权、独立董事的独立意见、公司为独立董事提供的必要条件等。	董事会秘书的任职资格、董事会秘书的职责、董事会秘书的任免和工作细则等。

由于公司在制定上述制度过程中已基本按照中国证监会和证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引执行，因此除考虑到公司目前系未上市股份有限公司的实际情况，对于部分现阶段并不适用的内容如股东大会的通知应采取公告形式、召开股东大会应由律师现场见证并出具法律意见书、有关对证券交易所的重大事项报告和信息披露义务等未予以规定外，上述有关制度已基本符合有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。公司于 2010 年 9 月 19 日召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了上市后适用的《苏州晶方半导体科技股份有限公司股东大会议事规则》、《苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会议事规则》和《苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会议事规则》，按照拟申请发行上市的实际情况对该等制度的内容进行了修订和完善，自公司首次公开发行股票并上市之日起施行。

前述修订完成后，公司上市后适用的上述有关制度符合有关上市公司治理的规范性文件之要求，不存在差异。

（一）“三会”制度的建立健全情况及运行情况

1、“三会”制度的建立健全情况

（1）股东大会制度的建立健全情况

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准

公司的年度财务预算方案和决算方案。公司《章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据《章程》和相关法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立以来，公司股东大会运行规范。

（2）董事会制度的建立健全况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照公司《章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。此外公司独立董事还按照《独立董事工作条例》的规定，履行独立董事的职责。

（3）监事会制度的建立健全情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

公司监事会成员包括两名股东代表监事及一名职工代表监事，其中监事王庆和王永锋均未在公司担任其他职务。公司监事均亲自出席了有关监事会会议，不存在缺席的情况，其对有关事项的表决意见均系独立作出，未出现对有关政策事项曾提出异议的情形。

2、“三会”制度的运行情况

公司始终严格按照公司章程和有关制度的规定完善公司治理，股东大会、董事会、监事会运行情况良好。

报告期内，发行人“三会”制度运行情况如下：

项 目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	4	7	4
出席会议情况	全体股东及部分董事、 监事出席会议	全体董事出席会议；部 分监事及非董事高级 管理人员列席会议	全体监事出席会议；董 事会秘书列席会议

报告期内，公司历次“三会”均按照公司章程及有关议事规则的规定召集和召开，履行了有关通知程序，召集人和召开的过程严格按照相应议事规则执行，通过的有关决议内容不存在违反法律、法规及公司章程规定的情形。公司股东大会决议由出席会议的股东签署，董事会决议由出席会议的董事签署，监事会决议由出席会议的监事签署，符合有关法律和相关制度要求。

报告期内，公司规范运作情况良好，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。

（二）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事的提名和人数

董事会设独立董事，根据《独立董事工作制度》，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提名推荐独立董事候选人。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司现有三名独立董事，均系由全体发起人股东提名，于2010年6月18日经公司创立大会审议通过产生。公司独立董事的提名与任职符合《公司法》及公司《章程》的规定。

2、独立董事履行职责的制度安排

依据《公司法》、《证券法》、及公司《章程》的规定，公司制定了《独立董事工作制度》，其主要内容包括：

“独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

独立董事除应当具有《公司法》及其他有关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别权利：

（1）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论并发表独立意见；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

（2）公司聘用或解聘会计师事务所，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；

（3）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（4）向董事会提请召开临时股东大会；

（5）提议召开董事会会议；

（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

（7）独立聘请外部审计机构和咨询机构。

独立董事出履行上述职责外，还应对以下事项向董事会或股东大会发表独立书面意见：

（1）提名、任免董事；

（2）聘任或解聘高级管理人员；

(3) 公司董事、高级管理人员的薪酬;

(4) 上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来, 以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(5) 股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展, 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益;

(6) 在公司年度报告中, 对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明, 并发表独立意见;

(7) 董事会作出的利润分配预案中不含现金派息时;

(8) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

(9) 公司章程规定的其他事项。独立董事应当就上述事项发表以下四类意见之一: 同意; 保留意见及其理由; 反对意见及其理由; 无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露事项, 公司应当将独立董事意见予以公告, 独立董事出现意见分歧无法达成一致时, 董事会应将各独立董事的意见分别披露。”

报告期内, 公司独立董事均亲自出席有关董事会和股东大会, 不存在缺席或应亲自出席而未能亲自出席会议的情况。独立董事参与有关事项的审议并发表了独立董事意见, 其对有关事项的表决意见均系独立作出, 未出现对有关政策事项曾提出异议的情形。

(三) 董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 为公司与上海证券交易所之间的指定联络人, 对董事会和公司负责。本公司董事会秘书自被聘任以来, 严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定, 认真履行了各项职责。

二、董事会专门委员会的设置情况

为进一步完善公司治理, 按照中国证监会和证券交易所的有关规定, 公司建立了董事会专门委员会制度, 在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会, 并制定了有关议事规则, 确保董事会专门委员会制度的规范执行。公司上述四个董事会专门委员会设立于2010年9月19日, 系经第一届董事会第三次会议决定设立并选举了委员会成员。

公司董事会专门委员会成员构成、各委员会职责以及运行情况如下：

项 目	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
人员构成	主任委员：杨辉 其他委员：黄彩英、杨柯、王蔚、Amir Galor	主任委员：黄彩英 其他委员：杨辉、杨柯、盛刚、Ariel Poppel	主任委员：杨柯 其他委员：杨辉、黄彩英、费建江、陈家旺	主任委员：杨柯 其他委员：黄彩英、杨辉、Ariel Poppel、陈家旺
主要职责	对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	提议聘请或更换公司外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。	研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。	研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
召开次数	三次	四次	二次	三次
审议事项	审议年度经营计划，制订经营方针；制订股利分配政策及股东分红回报规则；审议发行人首次公开发行股票并上市相关事宜；审议发行人新研发项目可行性研究报告等事项。	审议公司财务部提交的半年度财务报告及年度财务报告；审议发行人每年年度《审计报告》；提请董事会聘请会计师事务所及其对会计师事务所上一年的工作提出建议；审议公司内部财务制度等事项。	在公司聘任高级管理人员时，向公司董事会提出建议；研究制定公司董事、监事、高级管理人员选任标准；对董事、监事、高管的任职情况进行评价等事项。	接受高管及董事会成员的述职并听取他们的自我评价报告；听取财务部门对上一年度薪酬考核情况的汇报；对董事及高级管理人员进行绩效评价；制订高管及其他管理人员每年薪酬及考核标准等事项。

董事会各专门委员会均按照公司章程及其工作细则的规定履行职责，建立了定期会议制度，对于所审议事项均形成了书面决议并提交董事会，作为董事会及股东大会有关决策的重要依据，在公司治理过程中发挥了积极的作用。

三、报告期内违法违规行情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书工作制度。报告期内，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和公司《章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

四、报告期内对外担保和资金占用的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在资金被股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占有的情形。公司的《章程》中已明确对外

担保的审批权限和审议程序，不存在为股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

报告期内，公司与关联方之间不存在资金往来情况。

五、公司内部控制制度的情况

（一）公司的内控制度建设

公司在改制设立股份公司后即已建立并不断完善有关内控制度，且根据公司本身特点在有关内控制度中做了针对性规定和设计。

1、与股权结构特点相关的针对性措施

针对发行人股权分散、无实际控制人的情况，发行人采取如下措施保证公司经营决策的稳定性、公司治理的有效性以及避免公司内部人控制对股东利益带来的影响。

（1）发行人股东承诺上市后锁定股份

发行人全体股东签署了《关于本次发行前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺函》，其中，中新创投承诺其间接所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为36个月，其直接所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为60个月；EIPAT、厚睿咨询、豪正咨询、晶磊有限承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为36个月；OmniH、英菲中新、泓融投资、德睿亨风、Gillad Galor承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为12个月。发行人通过股东承诺锁定股份的方式，保持发行人在上市后的股权结构稳定，保证股东大会作为经营决策层的稳定性。

（2）发行人建立了健全的内部管理制度保证公司治理的有效性

公司依法制定了健全的内部管理制度；公司设置了独立董事，强化对董事会及经理层的约束和监督；公司任何股东单独均不能通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任。公司历次股东大会、董事会、监事会均按照公司法和公司章程规定的职权履行职责，该等股东大会、董事会、监事会会议议案均是由全体股东、董事、监事一致表决通过。

（3）发行人建立了健全的内部控制制度防范内部人控制以保障股东利益

公司制定了《对外担保管理规定》、《关联交易公允决策制度》、《投资管

理制度》，从而避免因可能的内部人控制而损害股东利益；同时考虑到上市后公众股东的利益保障，公司还制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，确保本公司上市后公众股东能及时、准确的获取本公司对外披露的信息，从而有利于公众股东有效的参与公司的治理，保障公众股东的利益。公司制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循。

2、与行业特点相关的针对性措施

公司主要从事晶圆级芯片尺寸封装，属于半导体集成电路（IC）产业中的封装测试行业。行业特点决定了公司在制定有关内控制度时除应按照中国证监会、证券交易所有关上市公司治理的要求执行外，还应按照其生产经营的特点制定和完善有关特别制度。根据日常生产经营需要，公司各职能部门其工作职责和要求制订了生产经营相关的多项制度，包括但不限于《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《合同管理制度》、《印章管理制度》等。

上述制度的制定与实施系公司从生产经营的实际需求出发，为加强内部控制而制定的有关专项制度，有利于公司根据行业特点采取具有针对性的内控完善举措。

（二）公司管理层对内控制度的自我评价

公司管理层认为：“认为本公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。”

（三）注册会计师的鉴证意见

华普天健对公司的内部控制制度进行了专项审核，于2012年3月12日出具了会审字[2012]0091号《内部控制审核报告》，报告的结论性意见为：“我们认为，贵公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。”

第十节 财务会计信息

华普天健会计师事务所（北京）有限公司接受本公司的委托，对本公司 2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度、2010 年度、2009 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的“会审字[2012]0090 号”审计报告。

本节的财务会计数据及有关分析引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的合并财务报表（注：本节所引用的财务数据除非另有说明，单位均为人民币元）。投资人欲对本公司进行更详细的了解，应当认真阅读财务报表的审计报告全文。

一、最近三年经审计的财务报表

（一）资产负债表

单位：万元

资 产	2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31
	合并数	母公司	合并数	母公司	
流动资产：					
货币资金	24,884.88	24,823.38	21,930.89	21,837.06	17,706.76
应收账款	2,635.98	2,635.98	1,983.50	1,983.50	2,107.11
预付款项	1,134.01	1,134.01	1,913.74	1,913.74	189.03
其他应收款	109.93	109.93	82.37	82.37	32.41
存货	1,507.53	1,507.53	1,686.60	1,686.60	539.20
一年内到期的非流动资产	15.64	15.64	-	-	-
其他流动资产	20.57	20.57	26.36	26.36	78.59
流动资产合计	30,308.54	30,247.04	27,623.46	27,529.63	20,653.08
非流动资产：					
长期股权投资	-	390.01	-	100.18	-
固定资产	25,559.61	25,559.61	19,120.32	19,120.32	15,612.15
在建工程	3,230.23	3,230.23	671.21	671.21	2,091.05
无形资产	226.80	226.80	231.79	231.79	236.78
长期待摊费用	461.19	461.19	971.76	971.76	1,511.98
递延所得税资产	11.30	11.30	7.04	7.04	47.35
非流动资产合计	29,489.12	29,879.13	21,002.12	21,102.30	19,499.32
资产总计	59,797.66	60,126.17	48,625.58	48,631.93	40,152.41

负债和所有者权益	2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31
	合并数	母公司	合并数	母公司	
流动负债：					
短期借款	3,860.88	3,860.88	1,000.00	1,000.00	3,000.00
应付账款	3,444.19	3,444.19	2,715.33	2,715.33	809.76
预收款项	-	-	-	-	17.39
应付职工薪酬	808.49	808.49	437.33	416.64	137.97
应交税费	-413.38	-413.38	-125.63	-125.63	42.05
应付股利	-	-	-	-	2,000.00
其他应付款	179.76	178.46	146.80	146.80	40.59
一年内到期的非流动负债	-	-	1,000.00	1,000.00	375.00
流动负债合计	7,879.93	7,878.63	5,173.84	5,153.14	6,422.77
非流动负债：					
长期借款	-	-	-	-	1,000.00
其他非流动负债	-	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-	1,000.00
负债合计	7,879.93	7,878.63	5,173.84	5,153.14	7,422.77
股东权益：					
股本	18,950.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	17,751.15
资本公积	18,375.03	18,375.03	18,375.03	18,375.03	2,695.39
盈余公积	1,792.25	1,792.25	615.38	615.38	1,428.31
未分配利润	12,803.54	13,130.26	5,512.07	5,538.39	10,854.78
外币报表折算差额	-3.09	-	-0.73	-	-
归属于母公司股东权益	51,917.73	-	43,451.74	-	32,729.63
少数股东权益	-	-	-	-	-
股东权益合计	51,917.73	52,247.54	43,451.74	43,478.79	32,729.63
负债和股东权益总计	59,797.66	60,126.17	48,625.58	48,631.93	40,152.41

(二) 利润表

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度
	合并数	母公司	合并数	母公司	
一、营业收入	30,611.99	30,611.99	27,068.00	27,068.00	13,884.88
减：营业成本	13,406.31	13,406.31	12,774.06	12,774.06	7,498.40
营业税金及附加	165.41	165.41	75.30	75.30	16.33
销售费用	160.29	160.29	256.41	256.41	153.96
管理费用	4,013.03	3,712.72	4,540.55	4,514.24	1,763.00
财务费用	224.99	224.89	26.09	26.08	63.31
资产减值损失	16.64	16.64	3.18	3.18	5.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,625.34	12,925.74	9,392.41	9,418.73	4,384.66

加：营业外收入	346.12	346.12	650.69	650.69	1,221.84
减：营业外支出	0.08	0.08	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	0.08	0.08	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,971.38	13,271.78	10,043.11	10,069.42	5,606.51
减：所得税费用	1,503.03	1,503.03	968.87	968.87	515.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,468.35	11,768.75	9,074.24	9,100.55	5,090.72
归属于母公司所有者的净利润	11,468.35	-	9,074.24	-	-
少数股东损益	-	-	-	-	-
五、每股收益					
（一）基本每股收益（元）	0.61	0.61	0.50	0.50	-
（二）稀释每股收益（元）	0.61	0.61	0.50	0.50	-
六、其他综合收益	-2.36	-	-0.73	-	-
七、综合收益总额	11,465.98	11,768.75	9,073.50	9,100.55	5,090.72

（三）现金流量表

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度
	合并数	母公司	合并数	母公司	
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	29,948.71	29,948.71	27,180.33	27,180.33	13,665.78
收到的税费返还	2,697.73	2,697.73	1,602.25	1,602.25	499.70
收到其他与经营活动有关的现金	583.89	583.89	275.69	275.69	893.84
经营活动现金流入小计	33,230.32	33,230.32	29,058.27	29,058.27	15,059.32
购买商品、接受劳务支付的现金	11,083.43	11,083.43	9,574.16	9,574.16	4,377.34
支付给职工以及为职工支付的现金	3,730.44	3,518.28	3,427.20	3,427.20	1,383.04
支付的各项税费	1,864.89	1,864.89	960.35	960.35	408.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,118.10	2,010.99	2,954.70	2,949.16	1,197.41
经营活动现金流出小计	18,796.86	18,477.60	16,916.41	16,910.87	7,365.94
经营活动产生的现金流量净额	14,433.46	14,752.72	12,141.86	12,147.40	7,693.38
二、投资活动产生的现金流量：	-	-			
收回投资收到的现金	-	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	301.42	301.42	208.47	208.47	134.94
投资活动现金流入小计	301.42	301.42	208.47	208.47	134.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,120.07	10,120.07	5,542.69	5,542.69	1,567.90
投资支付的现金	-	289.83	-	100.18	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	10,120.07	10,409.90	5,542.69	5,642.87	1,567.90
投资活动产生的现金流量净额	-9,818.65	-10,108.48	-5,334.22	-5,434.40	-1,432.96
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-			

吸收投资收到的现金	-	-	3,648.60	3,648.60	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-	-
取得借款收到的现金	3,955.81	3,955.81	3,000.00	3,000.00	3,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,955.81	3,955.81	6,648.60	6,648.60	3,000.00
偿还债务支付的现金	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,063.84	3,063.84	4,131.77	4,131.77	155.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,936.84	2,936.84	-	-	-
筹资活动现金流出小计	8,000.67	8,000.67	9,131.77	9,131.77	3,155.27
筹资活动产生的现金流量净额	-4,044.86	-4,044.86	-2,483.17	-2,483.17	-155.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-552.79	-549.89	-100.34	-99.53	-42.49
五、现金及现金等价物净增加额	17.16	49.49	4,224.13	4,130.30	6,062.66
加：期初现金及现金等价物余额	21,930.89	21,837.06	17,706.76	17,706.76	11,644.09
六、期末现金及现金等价物余额	21,948.05	21,886.55	21,930.89	21,837.06	17,706.76

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）合并财务报表范围及变化情况

晶方半导体科技（北美）有限公司于 2010 年 11 月 24 日成立，股本总额为 100.00 万股，本公司目前出资 60 万美元，持股比例 100%，2010 年度和 2011 年度本公司将其纳入合并范围。

三、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认原则

1、销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计

量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

提供劳务收入在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，同时满足下列条件：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工进度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：（1）相关的经济利益很可能流入企业；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（二）金融工具

1、金融资产划分为以下四类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际

利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

（4）可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

2、金融负债在初始确认时划分为以下两类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

（2）其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

3、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

（2）金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

4、金融资产转移

(1) 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值。
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

5、金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- 7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- 9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

1) 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

2) 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

3) 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(三) 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

对单项测试未发生减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

本公司按信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	2%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-5 年	50%

5 年以上

100%

（四）存货

1、存货分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。

3、周转材料的摊销方法：在领用时采用一次摊销法摊销。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

5、资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

（3）存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

（4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（五）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40 年	10	4.50~2.25
机器设备	5-12 年	10	18.00~7.50
运输设备	5-10 年	10	18.00~9.00
办公及其他设备	3-5 年	10	30.00~18.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

（1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

- (2) 由于技术进步等原因, 已不可使用的固定资产;
- (3) 虽然固定资产尚可使用, 但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- (4) 已遭毁损, 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- (5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(六) 在建工程

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出, 作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查, 如果有证据表明在建工程已经发生了减值, 估计可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的, 对在建工程进行减值测试:

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;
- (2) 所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(七) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

(八) 无形资产

1、无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

- (1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用权

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进

行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

1) 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

2) 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

3) 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(3) 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的残值一般为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

3、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(1) 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

(2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(3) 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(九) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销, 其中: 经营租赁方式租入的固定资产改良支出, 按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(十) 政府补助

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时, 确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

1) 政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

2) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 以名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

3) 与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

① 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益;

② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 计入当期损益。

(十一) 递延所得税资产

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时

性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

1、递延所得税资产的确认

(1) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该项交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：1) 暂时性差异在可预见的未来可能转回；2) 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

2、递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：1) 商誉的初始确认；2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

四、非经常性损益明细表

公司非经常性损益明细表以合并报表数据为基础，业经华普天健审核。报告期内公司非经常性损益的具体情况如下表：

单位：万元			
项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损益	-0.08	-	-

计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	341.25	650.29	1,221.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4.87	0.40	-
合计	346.04	650.69	1,221.84
减：所得税影响额	41.52	71.58	118.43
归属母公司股东的非经常性损益	304.52	579.12	1,103.41
归属母公司股东的净利润	11,468.35	9,074.24	5,090.72
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润	11,163.83	8,495.12	3,987.31
非经常性损益净额占当期净利润比例	2.66%	6.38%	21.67%

报告期内，发行人非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为 21.67%、6.38%、2.66%，近两年，非经常性损益对发行人盈利能力影响很小。公司非经常性损益主要为政府补助。

五、最近一期末主要固定资产及对外投资情况

（一）固定资产

截至 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项 目	原值	累积折旧	减值准备	净值
房屋及建筑物	6,309.00	186.09	-	6,122.90
机器设备	25,826.19	8,375.02	-	17,451.17
办公及其他设备	3,744.14	1,823.60	-	1,920.54
运输工具	144.07	79.08	-	64.99
合 计	36,023.40	10,463.79	-	25,559.61

报告期末，发行人固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

（二）对外投资

截至 2011 年 12 月 31 日，发行人只有一家全资子公司晶方半导体科技（北美）有限公司，投资额为 60.00 万美元。

六、最近一期末无形资产情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无形资产情况如下：

无形资产分类	摊销期限	取得方式	初始金额	摊余价值	剩余摊余期限
土地使用权	50 年	出让	249.68 万元	226.80 万元	545 月

报告期末，发行人无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提无形资产减值准备。

七、最近一期末主要债项

（一）短期借款

截至 2011 年 12 月 31 日，公司短期借款明细如下：

单位：万元

借款类别	2011/12/31
信用借款	1,000.00
抵押借款	2,860.88
合 计	3,860.88

（二）应付款项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应付账款明细情况如下：

账 龄	2011/12/31	
	金额（万元）	占比（%）
1 年以内	3,294.46	95.65
1-2 年	145.06	4.21
2-3 年	4.66	0.14
3 年以上	-	-
合 计	3,444.19	100.00

2011 年末应付账款余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 EIPAT 的款项为 38.17 万元。除此之外，无应付其他关联方款项。

（三）对内部员工和关联方的负债

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对内部员工的负债为应付职工薪酬，对关联方的负债主要为应付 EIPAT 的技术使用权费，具体情况如下：

单位：万元

项 目	2011/12/31
应付职工薪酬	808.49
应付技术使用权费-EIPAT	38.17

报告期末，公司无拖欠职工薪酬的情形。

（四）逾期债项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在逾期债项。

八、股东权益变动情况

报告期内，发行人股东权益变动情况如下：

单位：万元

项 目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
股本	18,950.00	18,950.00	17,751.15
资本公积	18,375.03	18,375.03	2,695.39
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,792.25	615.38	1,428.31
未分配利润	12,803.54	5,512.07	10,854.78
外币报表折算差额	-3.09	-0.73	-
归属于母公司股东权益	51,917.73	43,451.74	32,729.63
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	51,917.73	43,451.74	32,729.63

九、现金流量情况

单位：万元

项 目	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	14,433.46	12,141.86	7,693.38
投资活动产生的现金流量净额	-9,818.65	-5,334.22	-1,432.96
筹资活动产生的现金流量净额	-4,044.86	-2,483.17	-155.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-522.79	-100.34	-42.49
现金及现金等价物净增加额	17.16	4,224.13	6,062.67
期末现金及现金等价物余额	21,948.05	21,930.89	17,706.76

报告期内，公司不存在涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

十、财务报表附注中的或有事项、期后事项和其他重要事项

（一）或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

（二）资产负债表期后事项

根据本公司 2012 年 3 月 12 日召开的第一届董事会议第七次会议决议，公司按照 2011 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积后，以 2011 年末总股本 18,950 万股为基数，向全体股东派发现金红利 3,000 万元（含税）。

截至 2012 年 3 月 12 日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

（三）其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、最近三年的主要财务指标

（一）主要财务指标

主要财务指标	2011 年末/ 2011 年度	2010 年末/ 2010 年度	2009 年末/ 2009 年度
流动比率	3.85	5.34	3.22
速动比率	3.65	5.01	3.12
资产负债率（母公司）（%）	13.10	10.60	18.49
应收账款周转率（次/年）	12.99	12.97	6.72
存货周转率（次/年）	8.39	11.48	11.34
息税折旧摊销前利润（万元）	15,879.14	12,901.07	8,373.55
归属于发行人股东的净利润（万元）	11,468.35	9,074.24	5,090.72
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	11,163.83	8,495.12	3,987.31
利息保障倍数	204.19	77.22	37.11
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.76	0.64	0.41
每股净现金流量（元/股）	0.0009	0.22	0.32
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.74	2.29	1.84
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	-	-	-

主要财务指标计算说明：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货 - 待摊费用) / 流动负债

资产负债率 = (负债总额 / 资产总额) × 100% (以母公司数据为基础)

年度应收账款周转率 = 产品销售收入 / 应收账款平均余额

存货周转率 = 产品销售成本 / 存货平均余额

息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息支出 + 计提折旧 + 摊销

利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) / 利息支出

每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 报告期末股本总额

每股净现金流量 = 现金流量净额 / 报告期末股本总额

归属于发行人股东的每股净资产 = 归属于母公司股东权益数 / 报告期末股本

总额

无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例＝
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）/净资产

上述指标除资产负债率以母公司财务报表的数据为基础计算外，其余指标均以合并财务报表的数据为基础计算。

（二）净资产收益率及每股收益

按照证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算如下：

1、净资产收益率及每股收益

期 间	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益 （元/股）	稀释每股收益 （元/股）
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	22.52	0.61	0.61
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.92	0.59	0.59
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	24.23	0.50	0.50
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.68	0.47	0.47
2009 年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.15	-	-
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.65	-	-

2、净资产收益率和每股收益的计算公式

（1）加权平均净资产收益率

加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 $= P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$ 。其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东

的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（2）基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 。其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（3）稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

十二、发行人历次资产评估情况

（一）股份公司改制设立前的资产评估情况

1、晶方有限第一次增资时的资产评估情况

2006 年 10 月 25 日，江苏华星会计师事务所出具华星会评报字（2006）第 042 号《资产评估报告》，就晶方有限增资事宜对公司截至 2006 年 9 月 30 日的净资产进行了评估，公司账面净资产为 6,065.05 万元，评估价值为 7,344 万元。

2、晶方有限第二次增资时的资产评估情况

2007 年 3 月 20 日，江苏华星会计师事务所出具华星会评报字（2007）第 020 号《资产评估报告》，就晶方有限增资事宜对公司截至 2007 年 2 月 28 日

的股权价值进行了评估，公司股权评估价值为 21,006 万元。

3、晶方有限第三次增资时的资产评估情况

2010 年 4 月 7 日，仁合评估出具苏仁评报字（2010）第 57 号《资产评估报告》，就晶方有限增资事宜对公司截至 2009 年 12 月 31 日的股权价值进行了评估，公司股权评估价值为 51,229.93 万元。

（二）股份公司设立时的资产评估情况

2010 年 5 月 19 日，仁合评估出具苏仁评报字（2010）第 83 号《资产评估报告》，就晶方有限整体变更为股份公司对公司截至 2010 年 4 月 30 日的股权价值进行了评估，公司账面净资产为 34,513.03 万元，评估价值为 35,636.16 万元，评估增值率为 3.25%。

（三）股份公司设立后的资产评估情况

2010 年 5 月 25 日，仁合评估出具苏仁评报字（2010）第 149 号《资产评估报告》，就晶方科技增资事宜对公司截至 2010 年 4 月 30 日的股权价值进行了评估，公司股权评估价值为 53,155.89 万元。

十三、发行人历次验资情况

发行人历次验资情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人历次验资情况”。

第十一节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

(一) 资产的构成及结构分析

报告期内, 公司的总资产构成如下:

单位: 万元

项目	2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	24,884.88	41.62%	21,930.89	45.10%	17,706.76	44.10%
流动资产合计	30,308.54	50.69%	27,623.46	56.81%	20,653.08	51.44%
固定资产净值	25,559.61	42.74%	19,120.32	39.32%	15,612.15	38.88%
非流动资产合计	29,489.12	49.31%	21,002.12	43.19%	19,499.32	48.56%
资产总计	59,797.66	100.00%	48,625.58	100.00%	40,152.41	100.00%

报告期内, 公司总资产规模持续增长, 主要是由公司持续经营的积累所致。固定资产和货币资金是发行人主要资产, 随着公司新厂房的建设完成, 投资规模扩大, 固定资产规模也持续增长; 随着公司自身业务的发展, 滚存利润的积累, 货币资金也持续增长。

公司的资产结构与同行业公司类似, 具有固定资产和货币资金占比高的特点。截至 2011 年 12 月 31 日, 发行人与同行业公司上市公司的资产结构如下:

单位: 万元

项目	华天科技		通富微电		发行人	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	87,933.75	38.12%	137,069.62	40.43%	30,308.54	50.69%
其中: 货币资金	33,160.57	14.37%	86,962.14	25.65%	24,884.88	41.62%
非流动资产	142,769.27	61.88%	201,952.69	59.57%	29,489.12	49.31%
其中: 固定资产	96,960.39	42.03%	152,417.64	44.96%	25,559.61	42.74%
资产总计	230,703.01	100.00%	339,022.31	100.00%	59,797.66	100.00%

1、流动资产

公司的流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货等。报告期内公司的流动资产结构如下:

单位: 万元

项目	2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	24,884.88	82.11%	21,930.89	79.39%	17,706.76	85.73%
应收账款	2,635.98	8.70%	1,983.50	7.18%	2,107.11	10.20%

预付款项	1,134.01	3.74%	1,913.74	6.93%	189.03	0.92%
其他应收款	109.93	0.36%	82.37	0.30%	32.41	0.16%
存货	1,507.53	4.97%	1,686.60	6.11%	539.2	2.61%
一年内到期的非流动资产	15.64	0.05%	-	-	-	-
其他流动资产	20.57	0.07%	26.36	0.10%	78.59	0.38%
流动资产合计	30,308.54	100.00%	27,623.46	100.00%	20,653.08	100.00%

(1) 货币资金

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司货币资金总额为 24,884.88 万元, 占流动资产的 82.11%。公司货币资金在流动资产占比较高, 且总体呈上升趋势, 这主要是由于公司经营状况良好, 持续盈利不断流入现金较多。

(2) 应收账款

报告期内, 公司应收账款余额、营业收入增长幅度以及应收账款余额占营业收入的比例如下:

单位: 万元

项 目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
应收账款余额	2,689.77	2,023.98	2,150.11
项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	30,611.99	27,068.00	13,884.88
月平均收入	2,551.00	2,255.67	1,157.07
应收账款余额占当期营业收入比例	8.79%	7.48%	15.49%

报告期内, 发行人信用政策以月结 30 天为主, 应收账款余额基本稳定在月平均收入的一倍至两倍之间。

1) 应收账款账龄分析

报告期内公司应收账款余额及账龄结构如下:

单位: 万元

项 目	2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	2,689.77	100%	2,023.98	100%	2,150.11	100%
合 计	2,689.77	100%	2,023.98	100%	2,150.11	100%

报告期内, 公司应收账款账龄均在一年以内, 无一年以上账龄的应收账款。表明公司的信用政策得到有效执行, 应收账款管理良好, 客户信誉良好, 账款回收速度快, 坏账风险很小。

2) 应收账款集中度

报告期内, 公司应收账款前五名客户的余额占应收账款余额比例如下:

单位: 万元

项 目	2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
前五名客户余额	2,688.93	99.97%	2,018.60	99.73%	2,140.22	99.54%
应收账款余额	2,689.77	100.00%	2,023.98	100.00%	2,150.11	100.00%

报告期内,前五名客户应收账款余额占发行人应收账款余额的 99.50%以上,主要是由于报告期内发行人客户集中度比较高,前五大客户营业收入占比在 95%以上,尤其是 2010 年度和 2011 年度前五大客户营业收入占比在 99%以上。

3) 应收账款管理制度

公司制定了严格的应收账款管理制度,谨慎选取信用状况良好的客户,在销售业务中严格按照合同约定收款日收款;同时,公司制定了完善的应收账款催收制度,由专人负责每笔应收账款的回款情况进行统计汇总,并定期制定风险提示。此外,公司将应收账款的回款情况作为对销售人员及管理层绩效考核的重要指标,对于超出合同约定收款日的应收款项,由专人负责提示管理层加强催收力度。

(3) 预付款项

报告期内,发行人预付账款余额分别为 189.03 万元、1,913.74 万元、1,134.01 万元。2010 年末比 2009 年末增长 912.41%,主要原因为预付新厂房设备款;2011 年末比 2010 年末下降 40.74%,主要原因为本年度订购设备数量较上年减少。

截至 2011 年 12 月 31 日,预付款项余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项,无预付其他关联方的款项,预付款项前五名单位如下:

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	预付时间	未结算原因
EV Group Europe&Asia/pacific Gmbh	非关联方	771.35	2011 年 7 月	货未到
中华人民共和国苏州工业园区海关	非关联方	207.83	2011 年 12 月	预付税款
Longhill Industries Limited	非关联方	107.18	2011 年 11 月	货未到
GES Ltd.	非关联方	15.36	2011 年 12 月	货未到
苏州市环境保护有限公司	非关联方	7.60	2011 年 11 月	设备订金
合 计		1,109.32	-	-

(4) 其他应收款

报告期内,发行人其他应收款账面价值分别为 32.41 万元、82.37 万元、109.93 万元。

2009 年末其他应收款余额为 44.89 万元,其中主要包括应收出口退税 4.72

万元，房屋租赁押金和保证金 33.28 万元，向江苏省电力公司苏州供电公司缴纳的 3.15 万元临时用电押金。2009 年末不存在关联方占用公司资金情形。

2010 年末其他应收款余额为 100.56 万元，其中主要包括公司本期支付给苏州工业园区海关的报关手册押金 50.00 万元，房屋租赁押金和物业保证金 35.86 万元。2010 年末不存在关联方占用公司资金情形。

2011 年末其他应收款余额为 131.44 万元，其中主要包括支付给江苏省电力公司苏州供电公司电量押金 41.99 万元，房屋租赁押金 30.36 万元。2011 年末不存在关联方占用公司资金情形。

(5) 存货

报告期内，公司存货构成结构如下：

单位：万元

项 目	2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	401.37	26.62%	651.26	38.61%	293.24	54.38%
在产品	365.40	24.24%	135.24	8.02%	45.62	8.46%
周转材料	308.60	20.47%	338.36	20.06%	188.63	34.98%
库存商品	432.15	28.67%	561.74	33.31%	11.71	2.17%
合 计	1,507.53	100.00%	1,686.60	100.00%	539.20	100.00%

公司的存货主要包括库存商品、原材料、在产品和周转材料等。报告期内，公司存货占流动资产的比例分别为 2.61%、6.11%、4.97%。报告期内公司存货占流动资产的比例较低，这主要是由于公司通过合理调整营销策略，加快了产成品流转速度，通过对国际、国内原材料市场价格波动的把握调整自己的采购和库存策略，使库存水平一直保持在合理的水平上，体现了公司良好的存货管理能力。2010 年末存货比 2009 年末增加了 1,147.40 万元，这主要是由于发行人 2010 年收入规模增长幅度较大，相应材料储备和库存商品规模也相应增加。2011 年公司强化存货管理，2011 年末存货余额较 2010 年末减少 179.07 万元。

公司按照期末存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。报告期内，公司产品销售情况良好，期末存货可变现净值高于成本，不存在减值情况，未计提减值准备。

2、非流动资产

公司的非流动资产包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和递延所得税资产。报告期内公司的非流动资产结构如下：

单位：万元

项 目	2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	25,559.61	86.67%	19,120.32	91.04%	15,612.15	80.07%
在建工程	3,230.23	10.95%	671.21	3.20%	2,091.05	10.72%
无形资产	226.80	0.77%	231.79	1.10%	236.78	1.21%
长期待摊费用	461.19	1.56%	971.76	4.63%	1,511.98	7.75%
递延所得税资产	11.30	0.04%	7.04	0.03%	47.35	0.24%
非流动资产合计	29,489.12	100.00%	21,002.12	100.00%	19,499.32	100.00%

(1) 固定资产

公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他设备。报告期内公司的固定资产净值构成如下：

单位：万元

项 目	2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	6,122.90	23.96%	3,714.38	19.43%	-	-
机器设备	17,451.17	68.28%	14,597.36	76.34%	14,801.38	94.81%
办公及其他设备	1,920.54	7.51%	726.15	3.80%	787.89	5.05%
运输工具	64.99	0.25%	82.43	0.43%	22.89	0.14%
合 计	25,559.61	100.00%	19,120.32	100.00%	15,612.15	100.00%

发行人专注于主营业务的发展，最主要的固定资产为机器设备，报告期各期末机器设备占固定资产净值平均比例达 60% 以上。2011 年末房屋建筑物占固定资产的比例较 2010 年末大幅提高，主要原因为 2011 年 7 月发行人新厂房建设完成，投入使用。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产财务成新率如下：

项 目	原值（万元）	净值（万元）	成新率
房屋及建筑物	6,309.00	6,122.90	97.05%
机器设备	25,826.19	17,451.17	67.57%
办公及其他设备	3,744.14	1,920.54	51.29%
运输工具	144.07	64.99	45.11%
合 计	36,023.40	25,559.61	70.95%

目前公司固定资产使用、维护状况良好，生产质量稳定，不存在减值情形，未计提减值准备。

(2) 在建工程

报告期内，公司在建工程账面价值为 2,091.05 万元、671.21 万元、3,230.23 万元。2010 年末在建工程账面价值比 2009 年末下降了 67.90%，主要原因是新厂房建设工程 2010 年 12 月份基本完工，已由在建工程转入固定资产；2011 年末在建工程账面价值比 2010 年末增长 381.25%，主要原因是新厂房的无尘室装

修投入较大。

(3) 无形资产

截至 2011 年 12 月 31 日，公司的无形资产账面净值为 226.80 万元，全部为土地使用权，不存在减值情形，未计提减值准备。

(4) 长期待摊费用

截至 2011 年 12 月 31 日，公司长期待摊费用账面净值为 461.19 万元，主要为发行人对经营租赁方式租入的厂房等固定资产进行改良时所发生的各项支出。

3、主要资产减值准备提取情况

报告期内，公司资产减值准备提取情况如下：

单位：万元

项 目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
坏账准备	75.30	58.66	55.48
其中：应收账款	53.80	40.48	43.00
其他应收款	21.50	18.18	12.48

本公司制订了具体可行的资产减值准备计提政策，按照资产减值准备政策的规定以及各项资产的实际情况，足额地计提了各项资产减值准备。公司资产减值准备计提政策稳健，与公司资产质量状况相符，能够保障公司的资本保全和持续经营能力，近三年不存在利用资产减值准备的提取和冲回来调节利润的情况。

(二) 负债的构成及结构分析

报告期内，公司负债构成如下：

单位：万元

项 目	2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	3,860.88	49.00%	1,000.00	19.33%	3,000.00	40.42%
应付账款	3,444.19	43.71%	2,715.33	52.48%	809.76	10.91%
预收款项	-	-	-	-	17.39	0.23%
应付职工薪酬	808.49	10.26%	437.33	8.45%	137.97	1.86%
应交税费	-413.38	-5.25%	-125.63	-2.43%	42.06	0.57%
应付股利	-	-	-	-	2,000.00	26.94%
其他应付款	179.76	2.28%	146.80	2.84%	40.59	0.55%
一年内到期的非流动负债	-	-	1,000.00	19.33%	375.00	5.05%
流动负债合计	7,879.93	100.00%	5,173.84	100.00%	6,422.77	86.53%
长期借款	-	-	-	-	1,000.00	13.47%
非流动负债合计	-	-	-	-	1,000.00	13.47%

负债合计	7,879.93	100.00%	5,173.84	100.00%	7,422.77	100.00%
------	----------	---------	----------	---------	----------	---------

公司的负债主要由流动负债构成，主要包括短期借款、应付账款等。报告期内，公司的负债总额基本保持稳定。

1、流动负债

（1）短期借款

公司 2010 年末短期借款较 2009 年末减少 2,000 万元，主要原因为公司盈利能力提高，使得 2010 年度经营活动产生的现金流量净额较上年增加 4,448.48 万元，公司缩减短期银行借款规模。

公司 2011 年末短期借款较 2010 年末增加 2,860.88 万元，主要原因为新厂房已建成，公司采购设备需支付预付款，因此，公司适度增加短期银行借款规模。

（2）应付账款

2010 年末应付账款余额较 2009 年末增加 1,905.57 万元，增长 235.33%，主要原因为公司 2010 年为缓解产能瓶颈，加大设备采购，同时，公司受行业复苏的影响，生产和销售规模大幅增加，原材料采购规模相应也增加。

2011 年末应付账款余额较 2010 年末增加 728.86 万元，增长 26.84%，主要原因为公司生产和销售规模扩大。

（3）其他应付款

公司 2010 年末其他应付款余额为 146.80 万元，比 2009 年末增加 106.21 万元，主要原因为 2010 年末应付未付报关费金额较大。

公司 2011 年末其他应付款余额为 179.76 万元，比 2010 年末增加 32.96 万元，主要原因为 2011 年末应付未付报关费金额较大。

2011 年末其他应付款余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无应付其他关联方款项。

（4）一年内到期的非流动负债

公司 2009 年末一年内到期的非流动负债余额为 375.00 万元，主要系江苏省科技成果转化专项资金项目补助款项摊余金额。根据《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》的规定，公司应收江苏省科技厅资助款 1,500.00 万元（2008 年收到 1,350 万元，2009 年收到 150 万元），用于公司专项研发项目补助，项目期限为 2007 年 10 月至 2010 年 9 月。该补助资金在项目期间内平均摊销，

2008 年、2009 年、2010 年度，摊销金额分别为 625.00 万元、500.00 万元、375.00 万元。

公司 2010 年末一年内到期的非流动负债余额为 1,000.00 万元，该款项系江苏国际信托有限责任公司为公司江苏省科技成果转化项目派发的 1,000 万元无息贷款，作为该项目的配套资金。该笔无息贷款于 2011 年 2 月到期，因此，会计处理上将其从“长期借款”科目转入“一年以内到期的非流动负债”核算。

2011 年 2 月，该笔无息贷款已经到期归还，2011 年末一年内到期的非流动负债余额为零。

2、非流动负债

(1) 长期借款

公司 2010 年末长期借款比 2009 年末减少 1,000 万元，主要原因是 2010 年末已将江苏国际信托有限责任公司派发的 1,000 万元无息贷款于 2011 年 2 月到期，因此，会计处理上将其从“长期借款”科目转入“一年以内到期的非流动负债”核算。

(三) 偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期内，公司的流动比率、速动比率、资产负债率、息税折旧摊销前利润及利息保障倍数有关数据如下：

主要财务指标	2011 年末 /2011 年度	2010 年末 /2010 年度	2009 年末 /2009 年度
流动比率	3.85	5.34	3.22
速动比率	3.65	5.01	3.12
母公司资产负债率 (%)	13.10	10.60	18.49
息税折旧摊销前利润 (万元)	15,879.14	12,901.07	8,373.55
利息保障倍数	204.19	77.22	37.11

报告期内，流动比率、速动比率先上升后下降，资产负债率先下降后上升，主要原因为报告期内公司短期借款先减少后增加。2011 年末公司流动比率和速动比率分别为 3.85 和 3.65，资产负债率为 13.10%，利息保障倍数达 204.19 倍，公司具有较强的债务偿还能力。

同行业可比上市公司的偿债能力指标如下表所示：

主要财务指标		通富微电	华天科技	发行人
流动比率	2011/12/31	1.58	1.85	3.85
	2010/12/31	1.70	1.52	5.34
	2009/12/31	1.21	1.95	3.22
速动比率	2011/12/31	1.33	1.57	3.65
	2010/12/31	1.54	1.29	5.01
	2009/12/31	1.00	1.68	3.12
资产负债率 (母公司)	2011/12/31	35.68%	37.21%	13.10%
	2010/12/31	41.33%	41.53%	10.60%
	2009/12/31	49.14%	29.89%	18.49%

数据来源：通富微电、华天科技财务数字摘自其对外的公布的年报。

从上表可以看出，发行人流动比率和速动比率高于行业平均水平，负债率也低于行业平均水平，可见发行人偿债能力优于行业平均水平。

2、偿债能力其他因素分析

截至本招股书签署日，公司银行资信状况良好，无任何不良信用记录，且公司没有或有负债、表外融资等影响偿债能力的事项。

(四) 资产周转能力分析

公司的主要资产周转能力与同行业可比上市公司的比较如下：

主要财务指标		通富微电	华天科技	发行人
应收账款周转率 (次/年)	2011/12/31	6.44	5.55	12.99
	2010/12/31	6.43	5.50	12.97
	2009/12/31	5.48	4.74	6.72
存货周转率 (次/年)	2011/12/31	6.64	8.39	8.39
	2010/12/31	7.95	8.29	11.48
	2009/12/31	6.96	7.59	11.34
总资产周转率 (次/年)	2011/12/31	0.46	0.65	0.56
	2010/12/31	0.60	0.76	0.61
	2009/12/31	0.62	0.63	0.37

数据来源：通富微电、华天科技的数据摘自其对外公布财务报告。

由上表可以看出，公司应收账款周转率逐年提升，应收账款周转率高于行业平均水平，主要原因在于公司技术实力雄厚，客户群稳定，同时公司制定了严格的应收账款管理制度。报告期内，应收账款账龄全部在一年以内，公司应收账款账期较短，回款情况良好。

公司的存货周转率较高，高于行业平均水平，这主要得益于公司“以销定产，适度库存”的政策、严格有效的库房管理制度、采购制度以及稳定的客户群体。此外，公司每年选取优质稳定的供应商，确保了原材料的供应及时稳定。

2009 年公司总资产周转率低于行业平均水平，主要原因为抵御金融危机的影响，发行人未进行固定资产投资，账面现金占总资产比例较高，从而导致总资产周转率偏低。2010 年和 2011 年，公司扩大固定资产投资规模，提高资产利用效率，同时，收入规模大幅增长，公司总资产周转率达到了行业平均水平。

二、盈利能力分析

（一）营业收入分析

公司收入主要来源于集成电路封装测试服务业务，主营业务收入占营业收入的比例很高，占比在 99.90%以上，其他业务收入来自废弃原材料的销售。

报告期内，公司营业收入情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	30,597.20	99.95%	27,046.87	99.92%	13,884.88	100.00%
其他业务收入	14.79	0.05%	21.13	0.08%	-	-
合 计	30,611.99	100.00%	27,068.00	100.00%	13,884.88	100.00%

1、营业收入变动趋势分析

发行人 2010 年度营业收入为 27,068.00 万元，较 2009 年度增长 94.95%，主要原因为：（1）随着国家拉动内需政策的迅速制定与深入实施，以及国际市场环境的逐步好转，2010 年度国内集成电路封装测试产业全面复苏，从而带动公司营业收入的大幅增长；（2）通过积极开拓市场，公司与 Galaxycore (HK) Ltd.、BYD(HK) Co.Ltd.建立了长期稳定的合作关系，2009 年度和 2010 年度 Galaxycore (HK) Ltd.、BYD(HK) Co.Ltd.分别为公司第一大客户、第二大客户；（3）发行人自主创新技术在 2010 年度已经得到全面应用，深受客户青睐。2010 年度，发行人采用 ThinPac 等自主研发技术封装收入占主营业务收入比重 98.35%。

发行人 2011 年营业收入为 30,611.99 万元，较去年同期增长 13.09%，主要原因为随着发行人在生产过程中推广使用 ThinPac 等自主研发技术，市场和客户对技术的认可度进一步提高，主要客户格科微电子和海力士半导体的采购额分别较去年同期增长 28.42%、100.46%。

2、营业收入构成分析

(1) 按产品类别分类

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
芯片封装	30,429.16	99.40%	26,904.33	99.40%	13,722.24	98.83%
设计收入	168.03	0.55%	142.54	0.53%	162.64	1.17%
其他收入	14.79	0.05%	21.13	0.08%	-	-
合 计	30,611.99	100.00%	27,068.00	100.00%	13,884.88	100.00%

公司主要收入来源于芯片封装服务和设计服务收入。

1) 芯片封装测试业务

芯片封装测试业务，按照集成电路封装测试行业世界通用的贸易模式，一般由客户提供芯片委托发行人封装，发行人自行采购原辅材料，按照技术标准将芯片封装测试后交由客户，发行人向客户收取封装测试加工费。

报告期内，发行人芯片封装测试服务占营业收入的比重在 98%以上，是公司营业收入的主要来源。

2) 封装设计业务

发行人与芯片设计公司共同设计封装方案，使芯片设计公司在产品设计的初期就将晶圆级芯片尺寸封装的技术特点考虑在内。发行人提供封装设计业务的流程如下：首先，由晶方科技工程师进行设计可行性研究，确定封装规格，提出布局设计方案；其次，客户提出修改或认可方案之后，发行人设计并定制所需的光罩并送交产线；最后，试生产的结果交予客户。

报告期内，发行人封装设计收入较低，且占营业收入的比重非常小。

(2) 按技术类别分类

单位：万元

技术类别		2011 年度		2010 年度		2009 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
引进	ShellIOC	15.71	0.05%	354.76	1.31%	4,997.43	35.99%
技术	ShellOP	17.14	0.06%	91.15	0.34%	405.85	2.92%
ThinPac 等		30,564.35	99.89%	26,600.96	98.35%	8,481.59	61.09%
合 计		30,597.20	100.00%	27,046.87	100.00%	13,884.87	100.00%

ShellOP 和 ShellIOC 技术是从 Shellcase 引进的晶圆级芯片尺寸封装技术，ThinPac 等技术为发行人自主创新技术。从上表可以看出，发行人自主创新技术产品占主营业务收入比重逐年上升，2011 年度自主创新技术类产品占主营业务收入为 99.89%。

(3) 按芯片种类分类

报告期内，发行人目前封装芯片主要应用于手机、计算机、监视器、汽车等领域，营业收入按封装芯片的用途分类如下：

单位：万元

项 目		2011 年度		2010 年度		2009 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
封 装 测 试	手机	17,926.62	58.91%	19,729.58	73.33%	10,852.69	79.09%
	计算机	7,737.04	25.43%	3,925.71	14.59%	2,211.38	16.12%
	监视器	4,710.26	15.48%	2,228.89	8.28%	301.59	2.20%
	汽车	35.97	0.12%	156.96	0.58%	91.9	0.67%
	其他	19.28	0.06%	863.2	3.21%	264.69	1.93%
	小 计	30,429.17	100.00%	26,904.33	100.00%	13,722.24	100.00%
芯片设计		168.03	0.55%	142.54	0.53%	162.64	1.17%
合 计		30,597.20	100.00%	27,046.87	100.00%	13,884.87	100.00%

(4) 按销售区域分类

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外销	30,554.16	99.86%	27,041.49	99.98%	13,863.15	99.84%
内销	43.04	0.14%	5.38	0.02%	21.72	0.16%
合 计	30,597.20	100.00%	27,046.87	100.00%	13,884.87	100.00%

从销售的地区分布看，本公司绝大部分营业收入来自于出口销售收入。报告期公司出口产品形成的收入主要以美元结算。

(二) 毛利率分析

1、报告期内公司产品毛利及毛利率情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	30,611.99	27,068.00	13,884.88
其中：封装收入	30,429.16	26,904.33	13,722.24
设计收入	168.03	142.54	162.64
其他收入	14.79	21.13	0.00
营业成本	13,406.31	12,774.06	7,498.40
其中：封装成本	13,392.67	12,743.04	7,486.86
设计成本	9.94	26.37	11.54
其他成本	3.70	4.66	0.00
综合毛利率	56.21%	52.81%	46.00%
其中：封装毛利率	55.99%	52.64%	45.44%
设计毛利率	94.09%	81.50%	92.90%
其他毛利率	74.99%	77.96%	-

报告期内，发行人综合毛利率持续增长。由于发行人封装测试收入占营业收

入 98%以上，综合毛利率取决于封装测试毛利率的变动。

(1) 封装测试毛利率变动分析

报告期内，封装测试的平均单价如下：

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
封装销售量（片）	140,760	119,623	58,284
封装收入毛利率	55.99%	52.64%	45.44%
平均销售单价（元/片）	2,161.78	2,249.09	2,354.37
美元计价（美元/片）	333.89	331.37	344.68
平均汇率	6.4745	6.7863	6.8306

报告期内，封装测试的单位晶圆成本构成如下：

单位：元/片

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	216.09	22.71%	223.86	21.01%	312.65	24.34%
其中：玻璃	72.29	7.60%	74.26	6.97%	126.34	9.84%
感光油墨	20.20	2.12%	22.32	2.10%	25.71	2.00%
硅晶片粘着剂	19.60	2.06%	19.58	1.84%	19.41	1.51%
其他	104.00	10.93%	107.70	10.11%	141.19	10.99%
直接人工	104.52	10.99%	107.24	10.07%	111.15	8.65%
制造费用	630.85	66.30%	734.16	68.92%	860.75	67.01%
平均单位成本	951.46	100.00%	1,065.26	100.00%	1,284.55	100.00%

1) 公司 2010 年度封装收入毛利率比 2009 年上升 7.20%，主要原因为：一方面，半导体行业景气度复苏，公司 2010 年度产量大幅增长，稀释固定成本，使得单位产品成本下降；另一方面，2010 年度 ThinPac 等自主研发技术产品收入占主营业务收入比重由 61.09% 上升至 98.35%，使得单位原材料成本进一步下降。

A：收入因素影响分析

2010 年度单位晶圆封装价格同比下降 105.28 元，降幅为 4.47%，主要是由于电子产品更新换代快，以美元计价封装价格下降了 3.86%。

B：成本因素影响分析

2010 年度单位晶圆封装成本同比下降 219.29 元，降幅为 17.07%，主要原因为发行人 2010 年度全面使用自主研发的 ThinPac 等技术，以及 2010 年度产量大幅增长，稀释固定成本。

a. 直接材料：2010 年度单位直接材料成本同比下降 88.79 元，降幅为 28.40%，主要原因为：一方面，发行人全面使用自主研发的 ThinPac 等技术，

ThinPac 等自主创新技术产品收入占当年主营业务收入比重提升至 98.35%，2010 年度玻璃平均耗用率约为 1.08 片/片晶圆，较 2009 年度的单位晶圆封装玻璃单耗减少 0.39 片，玻璃采购成本占直接材料的比重进一步降低；另一方面，2010 年度玻璃、硅晶片粘着剂等原材料平均采购价格均同比下降，2010 年度玻璃单价同比下降 18.16 元，降幅为 21.01%。

b. 直接人工：2010 年度单位直接人工同比下降 3.91 元，降幅为 3.52%，主要原因为公司全面采用 ThinPac 等自主创新技术，对制造工艺进行了改良，效率更高，摊薄了人工费。

c. 制造费用：2010 年度单位制造费用同比下降 126.59 元，降幅为 14.71%，主要原因为 2010 年度产量较上年同期增长了 205.27%，导致单位加工费中固定成本大幅摊薄。

2) 公司 2011 年度封装收入毛利率比 2010 年度上升 3.35%，主要原因为公司 2011 年度产量较去年进一步提高，稀释固定成本，使得单位产品成本下降。

A：收入因素影响分析

由于晶圆级封装需求市场供不应求，2011 年度发行人以美元计价的单位晶圆封装平均单价较 2010 年上升 0.76%，但是由于人民币继续保持升值趋势，平均汇率下降了 4.59%，从而以人民币计价的单位晶圆封装价格较 2010 年度略有下降。

B：成本因素影响分析

2011 年度单位晶圆封装成本同比下降 113.80 元，降幅为 10.68%，主要原因为发行人 2011 年度产量进一步增加，稀释固定成本。

a. 直接材料：2011 年度单位直接材料成本较 2010 年下降 7.77 元，下降幅度不大，为 3.47%，基本保持稳定。

b. 直接人工：2011 年度单位直接人工较 2010 年度下降 2.72 元，降幅为 2.54%，主要原因为产量上升摊薄了人工费。

c. 制造费用：2011 年度单位制造费用较 2010 年下降 103.31 元，降幅为 14.07%，主要原因为 2011 年度工艺进一步改进，物料消耗中耗用刀片成本下降以及产量上升摊薄了制造费用中折旧、机器修理费用等。

(2) 设计服务毛利率变动分析

报告期内，发行人设计服务收入毛利率较高，但是由于该项收入占营业收入

的比重较小，对综合毛利率的影响非常小。

2、同行业综合毛利率比较

与同行业上市公司相比，综合毛利率如下：

项 目	华天科技	通富微电	精材科技	发行人
2009 年度	23.23%	17.07%	9.40%	46.00%
2010 年度	23.09%	17.10%	23.26%	52.81%
2011 年度	18.79%	13.88%	-	56.21%

注：华天科技、通富微电、精材科技数据摘自其对外发布的财务报告

（1）发行人综合毛利率高于国内同行业公司

发行人综合毛利率高于同行业公司华天科技、通富微电，主要原因为发行人封装技术与华天科技、通富微电有本质区别。华天科技、通富微电采用传统封装技术，发行人采用全球领先的晶圆级芯片尺寸封装技术。传统的封装厂上下游产业链是芯片设计——芯片制造——芯片重置——基板厂——传统封装厂——测试厂，而晶圆级封装厂上下游产业链是芯片设计——芯片制造——晶圆级封装厂，晶圆级封装厂集芯片重置、基板厂、封装厂、测试厂为一体，有效缩短了产业链，并且省去了封装前的测试、打金线、基板、填充材料等环节，显著降低了成本。

（2）发行人综合毛利率高于主要竞争对手精材科技

发行人和精材科技均采用晶圆级芯片尺寸封装技术，发行人综合毛利率高于精材科技的原因如下：

1) 精材科技单位晶圆封装成本高于发行人，主要原因为半导体封装测试行业是技术密集、知识密集的重资产行业，人员成本占总营业成本比重较高。与中国台湾相比，中国大陆技术和管理人员工资较低，单位晶圆人工成本较低。

2) 精材科技单位晶圆的封装价格低于发行人。精材科技系晶圆制造商台积电的控股子公司，精材科技相当于台积电产业链的延伸，芯片设计公司先通过台积电进行晶圆制造，然后在精材科技进行封装测试。由于精材的客户主要是台积电的客户，且晶圆制造是芯片制造主要利润环节，因此，台积电从产业链垂直整合的角度出发，为与芯片设计厂商建立长期战略合作关系，精材科技主要产能用于满足台积电客户的晶圆级封装测试业务，精材科技的业务独立性和议价能力都受到较大限制。发行人系独立封装测试服务商，能自主选择优质客户，销售价格议价能力较强。

OmniVision 为台积电优质客户，OmniVision 设计的芯片，由台积电代工晶圆，再由精材科技进行封装测试，2009 年度、2010 年度精材科技对 OmniVision 的销售分别占其当年营业收入的 77%、57%，精材科技对 OmniVision 封装测试服务价格较低。2009 年度、2010 年度，精材科技的晶圆封装价格分别 2,034 元/片和 1,479 元/片，而发行人同期晶圆封装价格分别为 2,354 元/片、2,249 元/片。

项 目	精材科技			晶方科技		
	2011 年度	2010 年度	2009 年度	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入（万元）	-	89,623	50,246	30,612	27,068	13,885
营业成本（万元）	-	68,781	45,524	13,406	12,774	7,498
销售量（片）	-	606,000	247,000	140,760	119,623	58,284
单价（元/片）	-	1,479	2,034	2,162	2,249	2,354
单位成本（元/片）	-	1,135	1,843	951	1,065	1,285
毛利率	-	23.26%	9.40%	56.21%	52.81%	46.00%

注：2009 年度为 4.686 元新台币/人民币，2010 年度为 4.421 元新台币/人民币，精材科技尚未披露 2011 年年报。

（三）公司利润的主要来源分析

1、公司主营业务利润的主要来源

报告期内，公司分产品的毛利构成情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
封装毛利	17,036.49	99.02%	14,161.29	99.07%	6,235.38	97.63%
设计毛利	158.10	0.92%	116.17	0.81%	151.10	2.37%
其他业务毛利	11.09	0.06%	16.47	0.12%	0.00	0.00%
合 计	17,205.68	100.00%	14,293.94	100.00%	6,386.48	100.00%

报告期内，公司主要产品毛利构成与主营业务收入构成基本一致，主要来自影像传感器封装产品，该等产品的毛利分别占报告期毛利总额的 97%以上。

2010 年度公司产品毛利较 2009 年度增加了 7,907.46 万元，同比增长 123.82%，主要原因为：（1）半导体行业复苏，公司 2010 年度产量大幅增长，营业收入比 2009 年度增长了 94.95%；（2）由于发行人自主创新技术在 2010 年度已经得到全面应用，深受客户青睐。

2011 年度公司产品毛利较去年同期增加了 2,911.74 万元，同比增长 20.37%，主要原因为：（1）发行人产量较去年同期增长 16.81%，摊薄了产品固

定成本，有效的提高了产品毛利率；（2）市场和客户发行人的 ThinPac 等自主研发技术的认可度进一步提高，发行人营业收入较去年同期增长 13.09%。

2、影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

公司主营集成电路封装测试业务，处集成电路产业链中游，未来持续盈利能力与半导体行业的景气周期、主要原材料价格波动密切相关。

（1）半导体行业的景气周期影响

国际半导体产业存在一定的周期性，虽然由于中国目前还是新兴经济体，整体经济正处于快速发展阶段，宏观经济景气度远好于国际上大多数国家特别是发达国家，国内半导体产业体现出与国际市场不同特点，目前还处在吸收和追赶国外先进技术阶段，发展速度较快，发展空间较大。但如果国际半导体行业受到如 2008 年金融危机等不可抗力因素的影响，国内半导体行业增长也将受到不利影响，从而影响发行人盈利的稳定性。

（2）市场拓展能力影响

晶方科技是中国大陆首家、全球第二大能用 WLCSP 量产技术封装影像传感芯片的专业封装测试服务商，在集成电路封装测试行业有较高的知名度，目前公司产品的销量和产销率持续保持了较高水平，具有较强的市场拓展能力。但随着募集资金项目的投产，公司的集成电路封装产能将大幅提高，市场拓展能力将决定产品的销售情况，销量的高低直接影响公司的利润水平。

（3）募投项目的成功实施

本公司目前的产能已接近饱和状态，在加强市场开拓的同时，如无足够的产能保障，将会影响公司的成长性。本次募集资金主要投资先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目。该募投项目达产后，将使公司的封装产能增加 36 万片/年，预计达产后每年将新增营业收入 60,315.00 万元，新增净利润总额 18,237 万元，保证本公司盈利能力的连续性、稳定性。

（四）利润表逐项分析

报告期内，公司利润表各项目及占营业收入比例如下：

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、营业收入	30,611.99	100.00%	27,068.00	100.00%	13,884.88	100.00%

减：营业成本	13,406.31	43.79%	12,774.06	47.19%	7,498.40	54.00%
营业税金及附加	165.41	0.54%	75.30	0.28%	16.33	0.12%
销售费用	160.29	0.52%	256.41	0.95%	153.96	1.11%
管理费用	4,013.03	13.11%	4,540.55	16.77%	1,763.00	12.70%
财务费用	224.99	0.73%	26.09	0.10%	63.31	0.46%
资产减值损失	16.64	0.05%	3.18	0.01%	5.22	0.04%
二、营业利润	12,625.34	41.24%	9,392.41	34.70%	4,384.66	31.58%
加：营业外收入	346.12	1.13%	650.69	2.40%	1,221.84	8.80%
减：营业外支出	0.08	-	-	-	-	-
三、利润总额	12,971.38	42.37%	10,043.11	37.10%	5,606.51	40.38%
减：所得税费用	1,503.03	4.91%	968.87	3.58%	515.78	3.71%
四、净利润	11,468.35	37.46%	9,074.24	33.52%	5,090.72	36.66%

1、营业收入

报告期内，公司营业收入分别为 13,884.88 万元、27,068.00 万元、30,611.99 万元，2010 年度、2011 年度分别同比增长 94.95%、13.09%。公司营业收入情况详见本节“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入分析”。

2、营业成本

报告期内，公司营业成本构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度
	金额	同比	金额	同比	金额
营业收入	30,611.99	13.09%	27,068.00	94.95%	13,884.88
营业成本	13,406.31	4.95%	12,774.06	70.36%	7,498.40

报告期内，营业收入和营业成本变动的趋势一致，营业收入的增长率始终大于营业成本的增长率，因此，报告期内公司综合毛利率持续上升。

2010 年度营业成本较 2009 年度增加 5,275.66 万元，同比增长 70.36%，2011 年营业成本较 2010 年增加 632.25 万元，同比增长 4.95%，主要原因为金融危机的影响已经消除，半导体行业景气度复苏，发行人 2010 年度和 2011 年度销售收入较去年同期均有所增长，相应的营业成本也有所增长。

3、期间费用

报告期内，期间费用及其占当期营业收入比例情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	160.29	0.52%	256.41	0.95%	153.96	1.11%

管理费用	4,013.03	13.11%	4,540.55	16.77%	1,763.00	12.70%
财务费用	224.99	0.73%	26.09	0.10%	63.31	0.46%
期间费用合计	4,398.31	14.36%	4,823.05	17.82%	1,980.27	14.26%

报告期内，发行人期间费用占营业收入的比例基本保持稳定，始终处于较低水平，体现出发行人较强的费用控制能力。

（1）销售费用

报告期内销售费用主要为销售人员薪酬、差旅费、招待费等。报告期内公司销售费用金额较小，占营业收入的比例较低，且呈下降趋势，主要因为公司产品畅销，多采用订单式生产，销售部门机构精简，相关费用较少。

（2）管理费用

报告期内，发行人管理费用明细如下：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费用	1,689.47	2,647.89	923.40
职工薪酬	1,111.10	739.09	204.32
审计/咨询/顾问费	167.73	330.01	151.18
技术使用费	195.44	190.62	180.52
办公及其他费用	849.29	632.94	303.59
合 计	4,013.03	4,540.55	1,763.00
管理费用占营业收入比例	13.11%	16.77%	12.70%
其中：研发费用占营业收入比例	5.52%	9.78%	6.65%

管理费用主要包括研发费用、人员工资、技术使用权利金、办公费、以及各种中介机构费用等等。

2010 年度管理费用较 2009 年度上升 2,777.55 万元，同比增长 157.55%，主要原因为研发投入大幅增加，以及受半导体行业复苏的影响，公司 2010 年度销售收入大幅增长，比 2009 年度增长了 94.95%，相应管理人员薪酬等费用也相应增长。

2011 年度管理费用较 2010 年度下降 527.52 万元，同比下降 11.62%，主要原因是公司 2010 年度研发的项目（如硅通孔技术、LED 技术、微机电系统封装工艺等）均已进入样品试验阶段，需领用的原材料较多，因此，2010 年研发费用中的原材料领用金额较大，而 2011 年度的研发项目大部分还处研究开发阶段，进入样品试验阶段的研发项目较少，领用的原材料相对较少，因此研发费用较去年同期减少 958.42 万元。

（3）财务费用

财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益、和金融机构手续费等。

2010 年度公司财务费用较 2009 年度下降 37.22 万元，主要原因为银行存款利息收入增加。

2011 年度公司财务费用较 2010 年度上升 198.90 万元，主要原因为公司产品以外销为主，人民币对美元汇率持续上升，公司出口收入汇兑损失较去年上升 363.11 万元。

4、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失均为坏账准备。公司坏账准备计提政策稳健，详见本节“一、财务状况分析”之“（一）资产的构成及结构分析”之“3、主要资产减值准备提取情况”。

5、营业外收入

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
政府补助	341.25	650.29	1,221.84
营业外收入	346.12	650.69	1,221.84
利润总额	12,971.38	10,043.11	5,606.51
政府补助/营业外收入	98.59%	99.94%	100.00%
营业外收入/利润总额	2.67%	6.48%	21.79%

报告期内，公司营业外收入主要为政府补助，营业外收入占利润总额分别为 21.79%、6.48%、2.67%，公司经营成果对政府补助不存在重大依赖。

报告期内，发行人政府补助分别为 1,221.84 万元、650.29 万元、341.25 万元，主要内容如下：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
上市奖励	150.00	-	-
2010 年市级工业产业转型升级专项资金	60.00		
2011 年度苏州市级工业产业转型升级专项资金	75.00		
江苏省科技成果转化专项资金项目资金补贴	-	375.00	500.00
江苏省科技成果转化专项资金项目贴息	37.00	161.00	283.00
苏州市 2010 年第六批科技发展资金	-	30.00	-
2010 年度节能与发展循环经济扶持项目专项资金	-	25.00	-
苏州市 09 年市技术创新资金补贴	-	15.00	25.00
苏州工业园区 2010 年第四批科技发展资金	-	15.00	-
江苏省现代服务业专项引导资金补贴	-	-	200.00
2009 年苏州工业园区第四批科技发展资金补贴	-	-	80.00
江苏省 08 国家科技支撑和重点新产品补贴	-	-	30.00
硅通孔三维封装关键工艺开发及应用项目补贴	-	-	20.00

国际科技合作与交流专项经费补贴	-	-	-
晶圆级封装的影像传感器 WLCSP-OC-I	-	-	-
其他	19.25	29.29	83.84
合 计	341.25	650.29	1,221.84

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	14,433.46	12,141.86	7,693.38
投资活动产生的现金流量净额	-9,818.65	-5,334.22	-1,432.96
筹资活动产生的现金流量净额	-4,044.86	-2,483.17	-155.27
现金及现金等价物净增加额	17.16	4,224.13	6,062.66
期末现金及现金等价物余额	21,948.05	21,930.89	17,706.76

报告期内公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

（一）经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	30,611.99	27,068.00	13,884.88
营业成本	13,406.31	12,774.06	7,498.40
销售商品、提供劳务收到的现金	29,948.71	27,180.33	13,665.78
购买商品、接受劳务支付的现金	11,083.43	9,574.16	4,377.34
经营活动产生的现金流量净额	14,433.46	12,141.86	7,693.38
净利润	11,468.35	9,074.24	5,090.72
经营活动产生的现金流量净额 /当期净利润	1.26	1.34	1.51

报告期内，公司各期的营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金基本相当，表明公司对下游厂商的信用政策制定得当，应收账款管理能力强，回款情况良好；公司各期的营业成本均大于购买商品、接受劳务支付的现金，表明公司对上游厂商具有较强谈判能力，取得优惠的信用政策。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额占当期净利润的比例分别为 1.51、1.34 和 1.26，表明公司产品销售收入能及时转化为现金流入，主营业务获取现金能力强，公司收益质量高。

报告期，公司现金流量表补充材料如下：

单位：万元

补充资料	2011 年度	2010 年度	2009 年度
净利润	11,468.35	9,074.24	5,090.72

加：资产减值准备	16.64	3.18	5.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,329.00	2,180.98	2,083.93
无形资产摊销	4.99	4.99	4.99
长期待摊费用摊销	509.93	540.22	522.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.08	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	217.37	15.15	56.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4.25	40.31	45.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	179.07	-1,147.40	244.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-714.65	29.21	-77.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	426.93	1,400.98	-282.32
经营活动产生的现金流量净额	14,433.46	12,141.86	7,693.38

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量表如下：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	301.42	208.47	134.94
投资活动现金流入小计	301.42	208.47	134.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,120.07	5,542.69	1,567.90
投资支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	10,120.07	5,542.69	1,567.90
投资活动产生的现金流量净额	-9,818.65	-5,334.22	-1,432.96

公司 2009 年度投资活动产生的现金流量净额为-1,432.96 万元，其中投资活动现金流量流入金额为 134.94 万元，主要系公司账面现金产生的银行利息；投资活动现金流量流出金额为 1,567.90 万元，主要系发行人 2009 年因新厂房建设购建固定资产和其他长期资产支付的现金。

公司 2010 年度投资活动产生的现金流量净额为-5,334.22 万元，其中投资活动现金流量流入金额为 208.47 万元，主要系公司账面现金产生的银行利息；投资活动现金流量流出金额为 5,542.69 万元，主要系发行人因新厂房建设购建固定资产和其他长期资产所支付的现金。

公司 2011 年度投资活动产生的流量净额为-9,818.65 万元，其中投资活动现金流量流入金额为 301.42 万元，主要系公司账面现金产生的银行利息；投资活动现金流量流出金额为 10,120.07 万元，主要系发行人因新厂房建设购建机器

设备和其他长期资产。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，本公司主要依靠股权融资筹集资金，现金流量筹资活动表如下：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
吸收投资收到的现金	-	3,648.60	-
取得借款收到的现金	3,955.81	3,000.00	3,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,955.81	6,648.60	3,000.00
偿还债务支付的现金	2,000.00	5,000.00	3,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,063.84	4,131.77	155.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,936.84	-	-
筹资活动现金流出小计	8,000.67	9,131.77	3,155.27
筹资活动产生的现金流量净额	-4,044.86	-2,483.17	-155.27

公司 2009 年度筹资活动产生的现金流量净额为-155.27 万元，其中筹资活动现金流入为 3,000.00 万元，主要系银行借款；筹资活动现金流出净额为 3,155.27 万元，主要包括偿还银行借款 3,000 万元和支付借款利息 155.27 万元。

公司 2010 年度筹资活动产生的现金流量净额为-2,483.17 万元，其中筹资活动现金流入净额为 6,648.60 万元，主要包括股东增资 3,648.60 万元和银行借款 3,000.00 万元；筹资活动现金流出净额为 9,131.77 万元，主要包括偿还银行借款 5,000.00 万元、支付股利和借款利息 4,131.77 万元。

公司 2011 年度筹资活动产生的现金流量净额为-4,044.86 万元，其中筹资活动现金流入净额为 3,955.81 万元，主要为银行借款；筹资活动现金流出净额为 8,000.67 万元，主要包括偿还银行借款 2,000 万元、支付股利和借款利息 3,063.84 万元以及支付的借款保证金 2,936.84 万元。

四、资本性支出

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内公司发生的重大资本性支出主要是根据公司发展规划，用于扩大生产规模所需的固定资产及无形资产。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为 1,567.90 万元、5,542.69 万元、10,120.07 万元。

报告期内，公司资本性支出对公司销售规模增长、盈利能力增强产生了

积极影响。

（二）未来重大资本性支出计划及资金需求量

公司未来重大资本性支出主要为投资先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目。该项目为本次公开发行股票募集资金投资项目，具体情况详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。

五、重大或有事项和期后事项

详见本招股说明书“第十节 财务会计信息”之“十、财务报表附注中的或有事项、期后事项和其他重要事项”。

六、公司主要财务优势、财务困难以及盈利前景分析

（一）主要财务优势

1、公司资信良好，未发生过逾期偿还银行借款的情况，在银行拥有良好的信用记录；现金储备较高，偿债能力强。

2、公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的 99%以上；

3、公司资产质量优良，固定资产成新率高，生产设备技术先进，这为公司持续稳定发展提供了有力保证；

4、公司产品质量好、严格按照客户订单安排生产，长期的合作使公司与客户维持着稳定良好的关系，这有利于公司货款回笼、减少呆坏账损失；

5、公司具有较强的成本控制意识，一方面采取有效措施降低采购成本，另一方面严格控制生产成本费用，这为公司保持持续、稳定的盈利能力提供了保障。

（二）主要财务困难

随着半导体行业复苏，发行人 2010 年已经步入快速发展阶段，急需投入大量的资金用于固定资产投资建设，以调整产品结构和扩大生产规模。本公司除依靠自身经营积累的资金外，外部融资渠道单一，只能依靠银行借款，而晶圆级封装行业投资规模很大，依赖自身资本积累和银行借款无法早日实现产业升级和低成本扩张，资金瓶颈已经成为制约公司发展的一个主要因素。因此，公司拟通过本次公开发行股票向资本市场直接融资，以满足公司业务对于资金的需求。若本次发行成功，公司资金紧张的局面将得到根本改善，业务规模将继续扩大，

盈利能力将得到进一步提高。

（三）未来盈利前景分析

经过多年的发展，公司生产规模不断扩大，品牌知名度不断提高，新开发产品不断增多，为公司可持续发展奠定了基础。公司将充分利用现有的技术、研发、成本、质量、管理等方面的优势，针对 IC 封测行业出现的新的需求热点，通过加大研发投入、开发新产品等措施，培育公司新的利润增长点。

本公司未来将立足主业，充分利用国家鼓励发展集成电路的有关政策，抓住行业发展的机遇，不断进行技术改造，扩大生产规模，提高产品的技术含量和附加值，进一步增强公司的盈利能力。通过实施本次募集资金投资项目，公司的产品结构将更趋完善，生产技术水平 and 市场竞争能力将进一步得到提高。随着我国集成电路产业复苏，我国集成电路封装测试行业将面临难得的发展机遇。随着本次募集资金投资项目的实施，公司将紧跟集成电路封装测试行业的发展步伐，实现产品的升级换代，拓展盈利空间。

七、股东未来分红回报分析

（一）公司发行上市后三年（含发行当年）股东的回报规划

1、公司股东回报规划制定考虑因素

公司将着眼于长远和可行性发展，综合考虑企业实际情况，发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制定性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、公司股东回报规划制定原则

公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的 20%。若公司营收增长快速，并且董事会认可公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

3、股东回报规划制定周期

公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，并由公司董事会结合

具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当前资金需求，制定年底或中期分红方案。

4、发行上市后三年内（含发行当年），股东分红回报计划

发行上市后三年内（含发行当年），是公司谋求上市，实现跨越式发展目标的重要时期，公司该时期的发展与股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。

发行上市后三年内（含发行当年），公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

（二）股东回报规划的合理性分析

公司上市是实现跨越式发展目标的重要步骤，股东对公司的投入是出自对公司未来发展的信任。公司不但要用好股东投入的资金，更要对股东的投入和信任带来更好的汇报。因此，本公司在《分红回报规划》中，明确了发行上市后三年内（含发行当年）每年现金股利分配的比例不低于当年实现的可供分配利润的 20%。

该等安排符合公司的经营现状和发展规划：公司主营业务为提供晶圆级芯片尺寸封装测试服务，公司自设立以来，一直执行稳健的财务政策，公司流动比率和速动比率都较高，资产负债率较低，公司有较强的盈利能力，公司信用政策以月结 30 天为主，客户履约情况良好，公司的经营性现金流充裕，均高于同期净利润，通过日常积累、信贷支持以及本次募集资金可以获得足量发展资金。在可预见的将来，除募投项目外，公司不会出现其他重大性的资本支出，因此，能足额保证对股东的现金股利分配。

同时，本公司高管人员和核心骨干人员间接持有公司股份，股利分红是其工作和投资合理回报的重要部分，因此，为维持经营管理层和股东目标一致，公司在增强经营业绩的同时，严格执行公司股利分配政策。

本公司上市后，将通过募集资金进一步提升产能，增强研发能力，从而进一

步增强公司利润水平，为股东创造更多利益，与股东共享公司成长收益。

第十二节 业务发展目标

一、公司当前及未来两年目标发展计划

（一）公司经营理念与发展战略

公司经过五年多的发展，具备了“引进、消化、吸收、再创新”的核心竞争力，能及时地将实验室技术转化为量产技术，把量产技术应用到其他领域，具有快速响应市场的能力。

公司将坚持以做强和做大为根本出发点，立足于“晶圆级芯片尺寸封装技术是今后半导体封装技术的发展趋势之一”这一事实，坚持自主创新，通过机制优化、制度建设、环境创造，强化公司的创新和和谐氛围，不断激发员工的创造性和积极性，不断加强自身在封装领域的核心竞争力；同时坚持以市场为导向，开发多样化的晶圆级芯片尺寸封装技术，拓广其应用领域，使公司在技术创新、市场发展、内部管理等均衡发展。

公司在发展的同时，也注重自身的社会责任，以优异经营成果回报给顾客、员工、股东与社会，努力使公司成为国内外一流的半导体封装测试服务提供商。

（二）整体经营目标及主营业务目标

公司继续恪守“全员参与、精细管理、顾客满意、持续改进”的质量方针，以“执着、务实、创新、共赢”的理念，增加封装测试环节，为客户提供多样化的增值封装服务。

“十二五”期间，公司将继续保持快速发展。公司的封装技术将多样化和个性化（为客户量身定制），封装产品将进一步被拓展和细分，封装规模将进一步扩大，销售收入将大幅度增加。2011年，公司年封装产能达14万片（八英寸晶圆），年收入较2009年大幅度增加。公司将在现有产能的基础上进行技术改造和产能扩建，预计完成新厂投资后，公司年产能将达到48万片，达产后预计可实现8-9亿元人民币的年销售收入。

（三）具体业务计划

1、技术创新计划

公司将密切关注半导体封装技术的发展趋势，紧跟电子产品市场发展的潮流，及时了解客户的需求，制订技术创新计划。公司将加强与国内外院校的交流 and 联系，整合和优化内、外部资源，提升技术开发人员的水平，建立有效的技术创新体系，激励员工的创新意识。公司已经在美国设立了子公司，定位于研发和营销推广，培养并依赖敏锐的市场嗅觉，及时跟踪、引进、消化前沿技术，并进行再创新，真正做到为我所用。

公司以江苏省工程技术中心为平台，以先进的封装生产线为基础，利用公司五年多的封装量产经验，深化和细化 TSV 封装技术、MEMS 封装技术、LED 封装技术的研发，兼顾对 12 英寸晶圆的封装技术的研发。

2、市场开拓和开发计划

公司将不断巩固营销网络，加强与供应商的友好关系，建立新渠道，争取新客户，扩大老客户订单，扩大销售额，确保公司整体目标的实现。

巩固和开拓现有的市场。与现有客户建立密切的合作关系，快速响应客户的需求，对客户的封装要求能提供定制化服务，对客户不同产品可提供不同的封装解决方案，并设法增加更多的产业链环节，为客户提供个性化和更多的增值服务，帮助客户赢得更多的市场；

加强和深化与芯片设计服务商及晶圆制作厂的合作，在芯片设计与芯片制造开始即导入晶圆级封测的概念，为客户提供晶圆级封测技术的先期服务，串联并协助整合“设计-晶圆-封测-市场”的供应链，以期利用本公司晶圆级封测技术的广泛应用能力，进一步改革并开拓市场；

加强和深化对整个产业链的了解。了解芯片设计、芯片制造和应用端客户的想法或终端市场的需求，从封装的角度，提出合理性的建议或提供更为合适的封装解决方案，帮助客户一起成长和壮大；

由于公司的封装产品（影像传感芯片、MEMS、LED、light sensor、智能卡芯片）其市场情况不一样，需个性化地制订相应的市场开拓和发展计划；继续开拓公司现有封装产品（影像传感芯片、MEMS、LED、light sensor、智能卡芯片）在消费类电子产品的应用，加强在其他领域如物联网、电子标签（身份鉴别）、汽车电子、医疗电子领域的渗透。

利用在美建立的研发和营销平台，了解国外的市场，推介公司的技术，进一

步扩大公司在国外的知名度，扩大产品出口；利用公司在国际上现有的知名度，积极开拓国内市场，扩大公司的知名度；积极参加国际、国内的半导体封装相关的会议，加强公司在市场中的影响力；继续争取把公司产品列入国家重点新产品计划、国家火炬计划之重点新产品、中国半导体创新产品和技术奖，加强树立公司的品牌效应。

3、人力资源计划

为保证公司的发展后劲，公司一方面将稳定核心员工队伍，全方面地加强员工培训工作，不断提高公司现有员工的整体素质：通过给技术类员工提供海外技术培训的机会，不断提高其技术素养；通过给研发人员提供海外技术交流和参加国际性技术研讨会议，不断提高其研发的前瞻性和与国外技术研发主流的同步性；通过给中层管理人员提供企业管理技巧方面的培训，进一步提高公司的整体管理水平；同时，公司将通过完善薪酬福利及绩效考核体系，实施包括员工持股计划等激励措施，使公司的薪酬福利体系具有更强的激励性和吸引力。另一方面，公司将根据实际的需要从国内外吸纳优秀人才，特别是加大技术、管理和营销等方面的人才引进和培养力度，不断充实公司的人才梯队。

4、再融资计划

本公司将以股东利益最大化为原则，根据业务发展的需要不断优化公司的资本结构。在控制财务风险的前提下积极采取多种融资方式，适时选择包括银行融资、发行股票、引进战略投资者及公司的经营活动产生的净现金流来保证公司实施战略目标的资金需求。公司计划通过本次公开发行股票从资本市场融资投资于“先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目”，以把握市场机遇，实现公司的战略目标。

5、收购兼并计划

今后，本公司为谋求进一步发展，将根据需求情况围绕核心主业发展，积极寻找合作伙伴和投资项目，视竞争环境和市场变化，在充分考察论证的基础上，做出收购兼并及对外扩充安排。

二、本公司拟定上述计划所依据的假设条件

以下几点事项是上述发展计划制定及实施的前提条件：

- 1、本次股票公开发行能够顺利实施，募集资金能够如期到位；
- 2、国家对集成电路产业的扶持鼓励政策不会有重大变更，并被较好地执行；
- 3、未来集成电路市场处于近 3 年同等水平的发展状态，没有出现重大的市场突发事件；
- 4、公司能持续保持现有管理层、核心技术人员的稳定性和连续性；
- 5、国家宏观经济、政治、法律和社会环境无重大变化；
- 6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素对公司经营造成重大不利影响。

三、本公司实施上述计划将面临的主要困难

以下几点事项将有可能影响上述发展计划的制定及实施：

- 1、集成电路行业的发展和市场需求具有一定的周期性，如果行业周期与市场预期（或公司预期）有较大差距，则公司的生产经营将受到较大的影响。
- 2、随着芯片设计和制造工艺的提高，封装测试技术的发展也非常迅速。公司如不能开发出市场主流产品的技术，不能做到技术领先，将影响公司产品的销售收入和市场地位。
- 3、集成电路行业的资金投入较大，如果因宏观经济环境发生变化或其他原因，公司不能按计划筹措到所需资金，将影响公司的发展。

四、本公司制订业务目标与现有业务的关系

坚持主业发展是公司的战略方针，上述业务发展计划是在公司现有主营业务基础上，结合募集资金投资项目，按照公司的战略发展目标的要求制定的。通过实施上述技术创新、市场开拓和开发、人力资源等计划，公司的主业更加突出和稳固，公司将在产品结构、技术开发、营销网络建设等方面有实质的提高，公司现有业务的综合实力将再上一个新台阶，从而为公司参与更高层次的竞争提供了基础。

五、本次募集资金对实现上述业务目标的作用

本次募集资金的运用对于本公司实现上述业务目标具有关键作用。通过本次股票发行，公司不仅解决了快速发展过程中所面临的资金瓶颈问题，同时公司通过本次发行上市建立了直接融资渠道，改变单一依靠间接融资的局面，可以根据外界环境变化进行调整和选择最佳财务结构。

本次募集资金投资项目为先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目，该项目的顺利实施，将提升公司产品的技术含量，扩大公司的生产规模，增强业务利润增长能力，提高研发水平，增加市场份额，巩固公司核心竞争力，为实现公司的战略目标奠定良好基础。

第十三节 募集资金运用

一、募集资金运用项目情况

（一）预计募集资金总量及使用计划

经公司 2010 年年度股东大会审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于“先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目”：

项目名称	项目总投资额 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)	项目核准情况	环评情况
先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目	86,630.00	66,735.96	苏经信投资 【2011】10 号	苏环审【2010】 282 号

（二）募集资金余缺的处理方案

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，差额部分由公司自有资金、银行贷款等方式补足。若实际募集资金多于项目拟投入募集资金额，资金多余部分用于补充公司流动资金。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

（三）募集资金专户存储安排

本次募集资金用途及实施方案已经公司召开的董事会、股东大会审议通过。公司董事会已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，并将严格依照上海证券交易所关于募集资金管理的规定，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司上市后将在上海证券交易所规定时间内与保荐机构及募集资金存管银行签订《募集资金三方监管协议》。

（四）募集资金预计投入的时间进度

本次募集资金运用项目建设期为 2 年，所需资金将根据项目实施进度分期投入使用，具体投入的时间进度如下：

项目	第一年投资金额（万元）	第二年投资金额（万元）
先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目	36,036	50,594

注：第二年投资金额中包括铺底流动资金 4,400 万元。

二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系

（一）公司现有产能已无法满足日益增长的市场需求

公司系中国大陆首家、全球第二大能大规模提供影像传感器晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）量产服务的专业封测服务商。晶圆级芯片尺寸封装为近年来发展起来的新兴封装形式，其封装性能和成本优势具有显著的竞争优势，最近几年迅速发展。在 2008 年金融危机到来之前，晶圆级芯片尺寸封装行业一直处于供不应求的格局，2008 年、2009 年，晶圆级芯片尺寸封装行业由于受金融危机的影响，发展势头有所放缓，但随着金融危机影响的逐渐消退，下游电子消费行业回暖迹象明显，带动了半导体行业的迅速复苏。2010 年度公司承接的订单超过原生产设备的负荷，为顺利完成日益增加的订单任务，公司对制约产能的相关生产环节添置机器设备，同时改善和加强制程管理，不断提高生产效率和封装产能，以求有效地缓解产能不足的矛盾，2010 年度，公司产能一直处于满负荷状态。产能的瓶颈限制了公司承接更多的加工订单，目前状况下，公司为稳定现有客户的合作关系，尽量满足其日益增长的加工订单，已无产能承接新客户及潜在客户的订单，这制约了公司未来的发展空间。

虽然公司通过工艺改造等方式能相应提高产能，但该等产能扩充空间有限。目前公司产能扩张的瓶颈一方面体现在现有机器设备的产能极限，公司旧厂房的生产线经过逾五年的发展及设备扩充，已经达到了产能极限，无法再仅靠对制约产能的相关工艺环节添置生产设备来提升产能，在生产极限的情况下，各工艺环节任何一处的设备添加都要求其他环节也为之全面配套增加，无异于一条新的生产线的建设。另一方面，公司旧厂房的空间也达到了使用极限，无法容纳新设备和厂务设施的更新。而下游市场对 WLCSP 封装的需求日益增长，因此，急需购置新的设备、装修新厂房以扩大现有的封装产能。

（二）本次募集资金项目将有效增强公司竞争实力，进一步提升市场地位

为实现长期发展目标及未来可持续发展计划，发行人决定对现有业务进行技术改造，并实施扩大再生产，新增年可封装 36 万片晶圆的 WLCSP 封装产能，折合新增每月 3 万片晶圆的生产能力。因此，待募集资金实施完成，新厂投资建设完毕后，发行人年产能将达到 48 万片，达产后预计可实现 8-9 亿元人民币的年销售收入。

募集资金项目的实施,不仅可以扩充现有主营产品影像传感芯片的封装产能外,还将夺回由于目前产能紧张而失去的环境光传感芯片和医疗用电子芯片封装市场。本项目作为晶圆级封装的公共平台,扩产的晶圆级芯片尺寸封装还可以封装目前已小批量产的微机电系统(MEMS)和发光器件(LED)产品,进一步扩展公司 WLCSP 封装的领域。同时,项目中的部分设备可兼容 12 英寸,以封装作业未来主流的 12 英寸的晶圆。除此之外,应客户的要求,本项目将添加测试设备,配套相应的测试产能,给客户提供更多的增值服务。

在技术方面,本次募集资金项目除了应用目前的超薄晶圆级芯片尺寸封装(ThinPac)、光学型晶圆级芯片尺寸封装(ShellOP)、空腔型晶圆级芯片尺寸封装技术(ShellOC)外,还将导入硅通孔(TSV)技术、铜柱晶圆级芯片尺寸封装技术(Copper Pillar)、多层晶圆互联技术。通过实施本项目,也为公司日后进入扇出式晶圆级封装或嵌入式晶圆级封装(fan-out wafer level package、embedded wafer level package)、硅基板晶圆级封装(Si interposer wafer level package)、晶圆级照相(wafer level camera)、三维封装领域奠定了基础。

该项目建成后,可以满足我国电子整机生产小型化、轻量化的配套需求,进一步增强了公司的行业市场竞争力;同时也将提升我国半导体封装技术水平,帮助设计公司(由于得到强大的试验平台)提升设计水平,进一步整合优化下游模组企业的工艺标准,促进我国晶圆级芯片尺寸封装产业链的健康发展,提高我国电子产品的质量和技术水平,为我国电子行业的发展和进步做出一定的贡献。

三、募集资金投资项目的市场前景分析

(一) 募集资金投资项目产品的市场前景

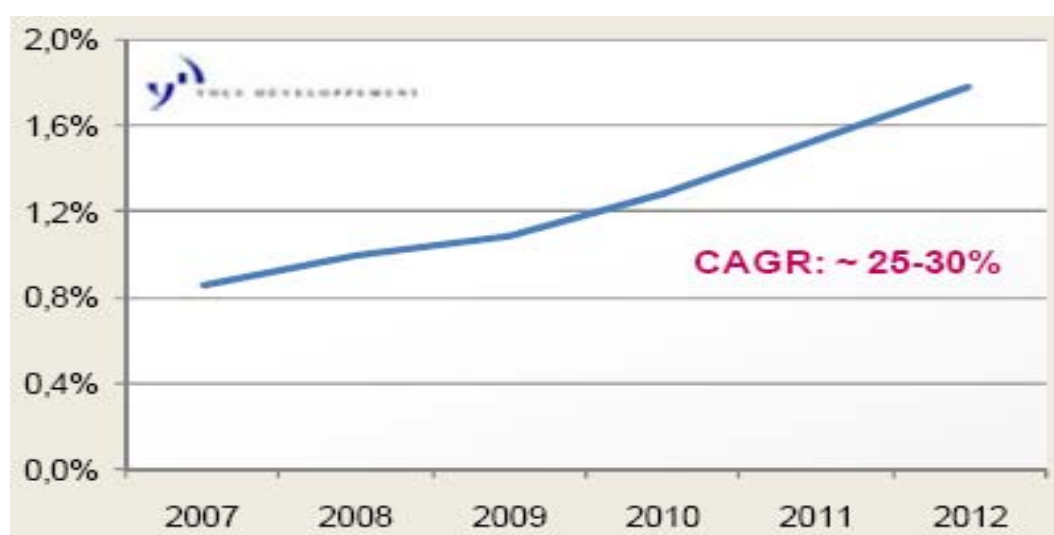
1、WLCSP 封装凭借优越的封装性能和成本优势逐步渗透主流半导体封装

晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)是近年来发展起来的新兴封装方式。与传统封装方式不同,晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)是先在整片晶圆上进行封装和测试之后,再切割成个别的芯片,无需经过打线和填胶程序,且封装后的芯片尺寸等同裸芯片原来的大小。因此,晶圆级芯片尺寸封装方式不仅明显缩小 IC 尺寸,符合移动电子产品对高密度体积空间的需求,也因芯片可以最短的电路路径,通过锡球直接与电路板连接,可大幅度提升信息传输速度,有效降低杂讯干扰几率。

除此之外，晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）也在下一代突破“摩尔定律”的三维封装技术中扮演了重要角色，是其量产化的一个必由之路。晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）在未来的相当一段时间将被半导体行业广泛采用，增长的空间和速度是其他封装技术所无法比拟的。

晶圆级芯片尺寸封装最初局限于少电极数的芯片，慢慢渗透至多电极数的芯片，据法国著名市场调研公司 Yole Développement 的分析，晶圆级芯片尺寸封装技术向主流半导体领域的渗透率将从 2009 年的 1% 增长至 2012 年的 2%。未来几年，晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）服务收入年均复合增长率将达到 25%-30%。

图：晶圆级芯片尺寸封装渗透至主流半导体的比例



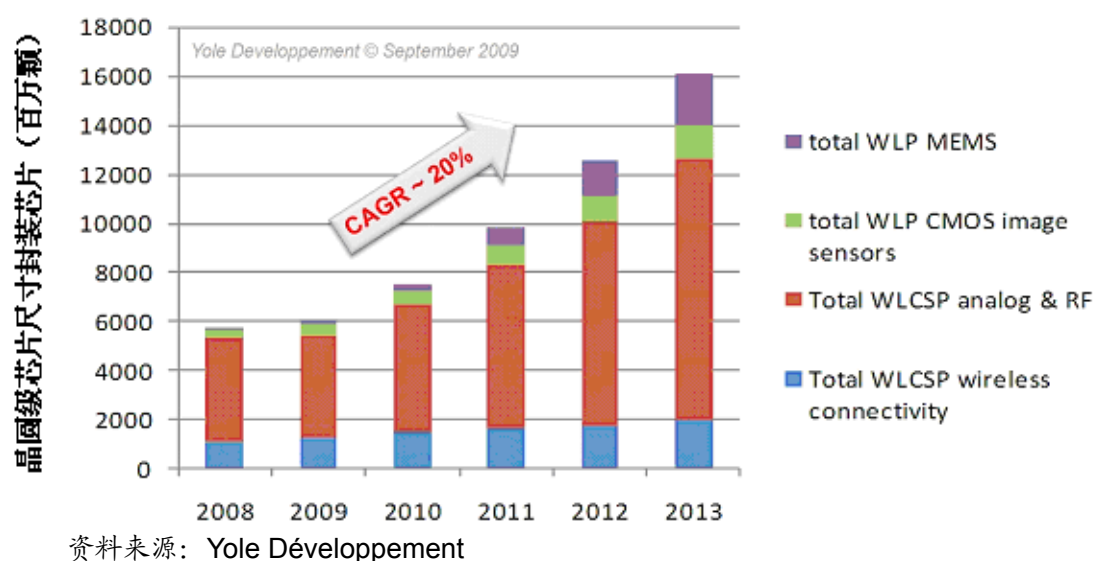
资料来源：《A Market & Technology Analysis of WLP Solution for ICs, CMOS Image Sensors & MEMS》，Yole Développement

2、未来几年 WLCSP 封装在主要应用领域的增长情况

未来几年，WLCSP 封装在影像传感芯片（CIS）、微机电系统（MEMS）和模拟和射频芯片（Analog&RF）等应用领域将继续保持高速的发展。

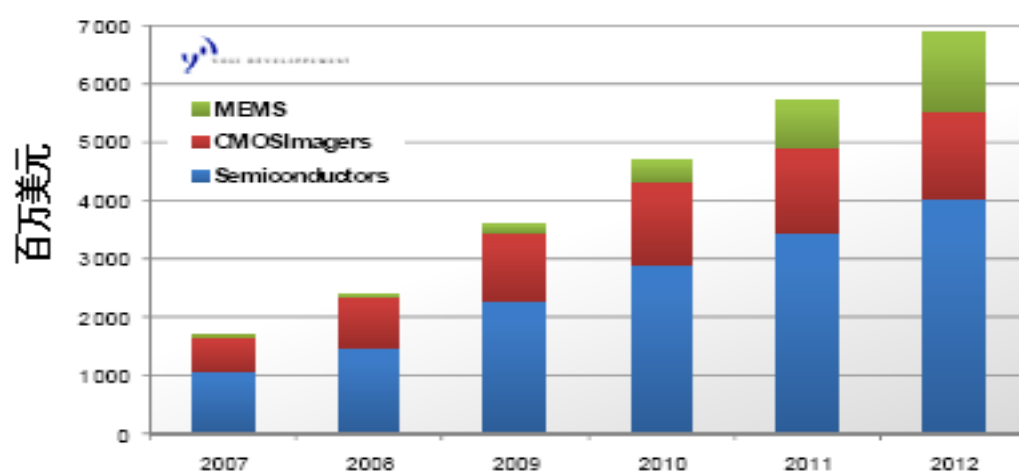
从用 WLCSP 技术封装的芯片数看，据 Yole Développement 预测，至 2013 年，影像传感芯片（CIS）、微机电系统（MEMS）和模拟和射频芯片（Analog&RF）等领域采用晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技术封装的芯片数，将以 20% 的年均复合增长率增长。

图：未来几年 WLCSP 在主要应用领域的增长情况



从 WLCSP 技术封装芯片对外出售实现的销售收入来看，据 Yole Développement 预测，该等收入将由 2009 年的 36 亿美元左右增长至 2012 年的 70 亿美元。

图：晶圆级芯片尺寸封装应用领域的市场产值预测



资料来源：《A Market & Technology Analysis of WLP Solution for ICs, CMOS Image Sensors & MEMS》，Yole Développement

（二）项目产品竞争对手分析

WLCSP 封装领域具有较高的技术壁垒，未来几年 WLCSP 封装领域新增供给能力有限，不会出现激烈竞争，其主要原因表现为两个方面：其一，WLCSP

封装技术属于目前新兴的封装技术，掌握该项技术的封测厂有限，目前全球能大规模向影像传感器（包括潜在的 MEMS、LED）领域提供 WLCSP 封装量产服务的专业封测服务商只有本公司和精材科技；其二，集成电路行业生产工艺复杂，精度要求高，制程水平至关重要，制程水平又取决于生产装备及工艺控制能力，其中工艺控制能力是企业在生产过程中经日积月累形成的，这为本行业设定较高的进入壁垒，预计未来 WLCSP 封装服务行业不会出现激烈的竞争。

（三）发行人为消化新增产能做出的后续安排

发行人将从产品市场推广和客户开发两方面着手对本次新产能做出后续安排。

1、产品市场推广

（1）巩固和扩大在影像传感芯片应用领域的市场份额

随着市场需求的发展，尤其是受消费类电子产品的推动，原使用传统封装技术的影像传感器厂商正逐步采用晶圆级芯片尺寸封装技术，以兼顾尺寸、性能、成本的要求。目前，影像传感器封装领域应用晶圆级芯片尺寸封装的比例较低，晶圆级封装技术在影像传感芯片应用领域对传统封装技术的渗透将带来巨大的市场容量，发行人将抓住市场机遇，进一步巩固和深化在影像传感芯片领域的领先优势，进一步扩大市场占有率。

（2）拓展除影像传感芯片外的新应用领域

发行人通过持续的技术创新，不仅研发了用于影像传感器应用领域的超薄晶圆级芯片尺寸封装技术（ThinPac）、硅通孔封装技术、晶圆级凸点封装技术（Wafer Bumping），还掌握了用于微机电系统（MEMS）、LED 等产品的晶圆级芯片尺寸封装技术。本次募投项目，公司将利用这些非影像传感器应用领域的封装技术以扩大 MEMS，LED，SIM 等产品的封装应用。目前，发行人已通过样品可行性设计和验证，在产能充足的情况下，发行人将开发新工艺的应用客户和应用领域。

2、客户开发策略

（1）进一步巩固和扩大现有客户群

公司为发挥规模生产的优势，集中力量服务于 Galaxycore、BYD、Hynix 三家主要客户。由于产能受限，发行人并未承接上述三家主要客户的全部订单。随着产能增加，发行人将进一步巩固和深化与 Galaxycore、BYD、Hynix 的战略合作关系，扩大对上述三家主要客户的销售量。

(2) 找回因产能不足而逐渐流失的客户，恢复和巩固业务合作关系

在产能充足的情况下，发行人除了巩固和扩大与主要客户的合作之外，还要找回以前年度由于产能限制而流失的客户，与其恢复和巩固业务合作关系，2011年，公司与 PIXELPLUS、SUPERPIX 等前客户重新取得合作，其中 PIXELPLUS 已成为公司目前第五大客户。对一些潜在的大客户（如东芝和 Aptina），发行人与其保持密切的关系，并已经开始着手产品设计，一旦产能大幅度提升，能立即与其达成合作意向。

综上所述，本次项目投资的实施是公司适应未来市场发展的需求，有利于公司增强市场竞争优势，有助于未来可持续发展。项目实施后所新增的产能在市场需求方面有充分的保障。

四、募集资金投资项目的相关情况

(一) 募集资金项目基本情况

本次募集资金投资项目的实施内容为新建年封装36万片晶圆的WLCSP封装平台。该项目的实施，一方面将有效缓解公司目前封装产能不足的局面；另一方面将公司的封装领域扩展到LED、MEMS等领域。

本项目总投资86,630.00万元，其中建设投资82,230.00万元，流动资金4,400.00万元，项目建设期24个月。

(二) 项目的工艺及技术来源情况

1、项目所需技术来源

本次募集资金项目所新建的封装平台，除了应用目前的超薄晶圆级芯片尺寸封装技术（ThinPac）、光学型晶圆级芯片尺寸封装技术（ShellOP）、空腔型晶圆级芯片尺寸封装技术（ShellOC）外，还导入硅通孔技术（TSV），将来还可根据此平台导入铜柱晶圆级芯片尺寸封装技术（Copper Pillar）、多层晶圆互联技术。

2、本项目的工艺流程

本项目拟主要使用的封装技术来源于公司现有的技术，产品封装的主要工艺流程与现有封装产品大致相同，具体的工艺流程过程详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人的主营业务”之“（二）封装技术及生产工艺流程”。

（三）项目实施安排

1、主要原材料、辅料的供应情况

项目实施后，不改变现有的生产经营模式。项目建设内容为产能的扩充，投产后不涉及新品种原辅料的增加。经过多年的合作，公司已与有关协作供应厂商建立了良好的供求关系，目前原材料供应渠道可以保证正常的生产需要。公司处长江中下游经济发达地区，物料流通渠道畅通，原辅材料均可得到正常供应。

2、项目人员编制

本项目新增人员约800人，其中一线操作工人500人，在线技术人员250人；此外，公司原已具备比较完善的管理技术和研发人员构架，所以部门主管人员、技术研发人员和公司高级管理人员增加50人。

3、项目选用设备的情况

本项目将新增压机、研磨机、蚀刻机、溅镀机、涂布机、曝光机、片式金属沉积机等生产设备，同时添置必要的晶圆级测试平台检测等设备仪器。本项目设备投资76,221.23万元，其中进口设备69,633.63万元，国产设备为6,587.60万元。主要进口设备如下：

序号	设备	数量	其中：12 英寸设备	金额（万美元）
1	压机	24	-	816.00
2	蚀刻机	7	1	1,700.00
3	研磨机	9	1	404.00
4	溅镀机	4	1	1,050.00
5	涂布机	18	1	285.00
6	曝光机	9	1	550.00
7	步进曝光机	1	-	300.00
8	片式金属沉积机	2	1	500.00
9	切割机	100	3	866.00

10	自动测试机	25	-	750.00
----	-------	----	---	--------

主要国产设备如下：

序号	设备	数量	其中：12 英寸设备	金额（万元人民币）
1	喷涂机	6	-	594.00
2	步进曝光机	1	-	820.00
3	激光打标机	6	1	495.00
4	半自动测试平台	15	-	495.00

（四）项目环保情况

1、环保措施

项目生产过程中，会产生少量的废水、废气和固定废弃物，公司已积极采取防治措施：

（1）废水处理

本项目废水由循环冷却水排污水、生产废水、生活污水三类组成。工艺装置循环冷却系统排污水，其污染物浓度较低，作为清洁下水可直接排入苏州工业园区雨水管网。生产废水经公司污水处理装置预处理，达到标准后，与生活污水一并纳入市政污水管道由水务公司集中处理。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂。

（2）废气处理

在生产过程中，会产生少量的有机废气和酸碱废气。有机废气经活性炭塔吸附后排放至室外，处理效率 90%左右，达标排放；酸碱废气经酸洗后，处理效率 85%左右，达标排放；洗涤废水由废水处理站收集处理后达标排放。

（3）固体废弃物的处理

生产固废包括包括一般工业固废和危险固废。一般固废主要为检测出的玻璃碎片、不合格产品、蒸镀废弃金属、废水处理站污泥，危险固废主要为浓酸、废光刻胶、废显影液、废异丙醇有机溶剂、有机废气处理产生的废活性炭。

生产中产生的不合格原料和产品、蒸镀废弃金属实行对外出售处理；废水物化处理污泥主要成分为氟化钙、无机硅，为一般工业固废，可作为制砖原料或填埋。危险固废委托有相应处理资质的单位安全处置。

2、环保评估意见

2010 年 12 月 8 日，公司取得江苏省环境保护厅关于本次募投项目环境影响的批复（苏环审【2010】282 号）。

（五）项目用地情况

本项目建设地位于苏州工业园区三区汀兰巷南，项目总用地面积 17,339 平方米。公司已取得相关土地和厂房权证，土地证号为苏工园国用(2010)第 00196 号，房产权证号为苏房权证园区字第 00350397 号。

在项目实施过程中，需对厂房进行净化装修改造，以形成良好的生产环境，满足封装精度的要求。厂房改造面积共 23,600 平方米，其中净化面积十级和百级为 1,592 平方米，高架地板千级为 2,408 平方米，普通千级为 4,000 平方米，十万级为 4,400 平方米。

（六）项目投资估算

本项目总投资 86,630.00 万元，其中建设投资 82,230.00 元，流动资产 4,400.00 万元，投资估算如下：

序号	项目名称	投资估算 投资金额（万元）	占总投资的 比例（%）
1	建筑工程费	4,280.00	4.94
2	设备购置费	76,221.23	87.98
3	设备安装费	699.63	0.81
4	其他工程和费用	710.57	0.82
5	预备费	318.57	0.37
6	小计	82,230.00	94.92
7	流动资金	4,400.00	5.08
合 计		86,630.00	100.00

（七）项目经济效益分析

本项目建设期为两年，达产期两年，第一年达产 60%，第二年达产 100%。项目达产后，预计年均新增营业收入 60,315.00 万元，年均新增净利润总额 18,237.00 万元。本项目的税后财务内部收益率为 26.90%，全部投资税后静态回收期为 4.79 年（包括两年建设期）。

五、募集资金运用对生产经营及财务状况的影响

本次发行募集资金投入使用后，对公司的生产经营和财务状况将产生一定影响。

（一）对生产经营的影响

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司的主营业务展开，并在原有应用领域基础上适当扩大新的应用领域，项目的建设符合公司的发展战略，项目的实施将有效缓解制约公司未来发展的产能瓶颈问题，提高公司的整体装备技术水平，进一步巩固公司在 WLCSP 封装领域的竞争优势和行业地位，全面提升公司的综合竞争实力，提高公司的盈利能力。

（二）对资产负债率及资本结构的影响

本次募集资金到位后，公司总资产将大幅度增加，短期内资产负债率将会有所下降。此外，公司偿债能力、持续经营能力将会得到进一步增强，进而降低公司的财务风险，提升信用和利用财务杠杆融资的空间，增强防范财务风险的能力。

（三）对净资产收益率的影响

本次发行募集资金到位后公司净资产将大幅提高，募集资金投资项目在短期内难以完全释放效益，公司存在发行当年净资产收益率大幅下降的风险。但是随着募集资金投资项目的展开，公司净资产收益率将逐步回复到合理的水平

第十四节 股利分配政策

一、发行前的股利分配政策

（一）成立股份公司前股利分配政策

根据晶方有限章程的规定，公司的任何税后利润（在扣除公司储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金以及依据董事会决定支付任何其他储备基金之后）均应根据各股东在注册资本中所占比例进行分配。若公司在上一年度发生任何亏损，公司本年度的利润应首先用于弥补亏损。在上一年或前几年亏损全部弥补前，不得分配利润或用其再投资。公司保留并从任何上年度结转的任何可分配利润可与本年度的可分配利润一起分配。

（二）股份公司的股利分配政策

1、股利分配的一般政策

按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》相关规定，公司制定了股利分配政策：本公司股票均为普通股，公司所有的股份实行同股同权，同股同利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、股利分配的顺序

根据相关法规和公司《章程》，公司缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：

- （1）弥补上一年度的亏损；
- （2）提取净利润的10%作为法定公积金；
- （3）经股东大会决议，提取任意公积金；
- （4）按照股东持有的股份比例支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%。

二、发行后的股利分配政策

本次发行上市后，在执行发行前连续、稳定的利润分配原则，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。2012年4月5日，公司2011年度股东大会会议审议通过了《公司修改上市后执行章程的议案》、《苏州晶方半导体科技股份有限公司股东未来分红回报规划》等2项议案，明确了上市后公司的利润分配政策。具体如下：

（一）公司实行连续、稳定的利润分配原则，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）公司利润分配政策为：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会根据实际盈利状况和公司发展需要，以经审计后净利润的一定比例向全体股东进行分配，在每次定期报告中对利润分配方案进行详细披露，经股东大会批准后实施。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会未作出现金分配预案的，应当于定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（三）发行上市后三年内（含发行当年），公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

（四）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

三、公司成立以来实际股利分配情况

公司成立于2005年6月10日，首个获利年度为2006年。

2009年11月10日，经公司董事会决议通过，分配现金股利2,000万元。鉴于

国际金融危机影响尚未结束，且公司正在建设新厂房，为防止出现资金周转困难，同意公司根据经营状况，在该决议后6个月内支付股利。

2010年3月24日，经公司董事会决议通过，分配现金股利2,000万元。

2011年2月25日，经公司2010年年度股东大会决议通过，分配现金股利3,000万元。

2012年4月5日，经公司2011年年度股东大会决议通过，分配现金股利3,000万元。

四、本次发行完成前未分配利润的分配政策

2012年4月5日，经公司2011年度股东大会决议通过，截至2011年12月31日的可供分配利润为13,130.26万元，分配现金股利3,000万元，本次股利分配完成后产生的可供分配利润将由本次发行上市后的新老股东共享。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露制度和投资者服务计划

为保护投资者的合法权利，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，公司制订了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》，并设立证券投资部作为公司信息披露和投资者关系的负责部门，该部门的负责人为公司董事会秘书段佳国先生。证券投资部对外咨询电话：0512-67730001。

二、报告期末正在履行的重要合同

截至本招股说明书签署日，公司及子公司已签署、正在履行的重大合同如下：

（一）借款合同

2011年10月25日，发行人与交通银行苏州分行签署了编号为3250502011MR00008200的《流动资金借款合同》，借款金额为1000万元人民币，到期日为2012年10月25日。

（二）销售合同

2011年11月9日，发行人与韩国Hynix Semiconductor Inc.签订了《2012年度晶圆级封装服务合作协议》，确认在2012年度将延续和保持关于晶圆级封装加工生产方面的技术和商务方面的长期合作伙伴关系。协议有效期为一年。

2011年11月15日，发行人与格科微电子（上海）有限公司签订了《2012年度量产合作协议》，确认在2012年度将延续和保持关于晶圆级封装加工生产方面的技术和商务方面的长期合作伙伴关系。协议有效期为一年。

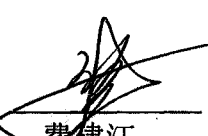
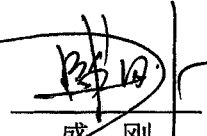
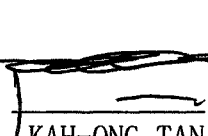
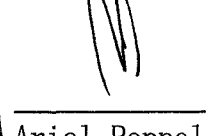
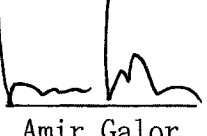
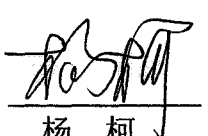
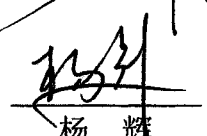
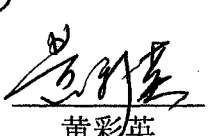
2011年11月21日，发行人与深圳比亚迪微电子有限公司签订了《2012年度量产合作协议》，确认在2012年度将延续和保持关于晶圆级封装加工生产方面的技术和商务方面的长期合作伙伴关系。协议有效期为一年。

第十六节 有关声明

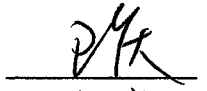
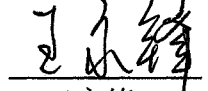
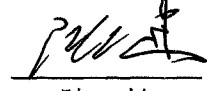
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

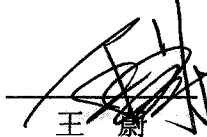
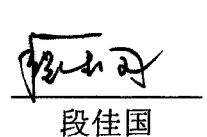
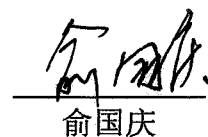
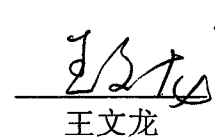
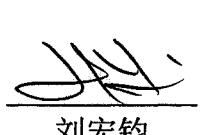
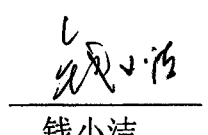
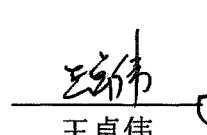
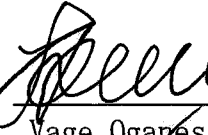
全体董事签名：

 王 蔚	 费建江	 盛 刚	 KAH-ONG TAN	 Ariel Poppel
 Amir Galor	 杨 柯	 杨 辉	 黄彩英	

全体监事签名：

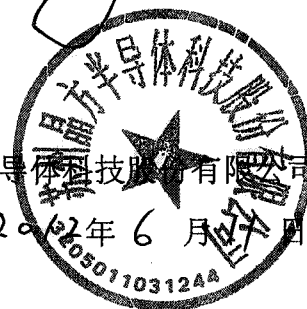
 王 庆	 王永锋	 陆 健
--	--	--

高级管理人员签名：

 王 蔚	 黄福龙	 段佳国	 俞国庆	 王文龙
 刘宏钧	 钱小洁	 王卓伟	 Vage Oganesian	

苏州晶方半导体科技股份有限公司

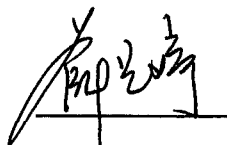
2022年6月24日



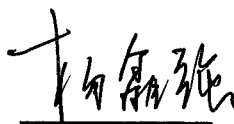
二、保荐人（主承销商）声明

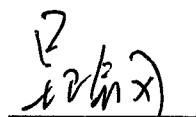
本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

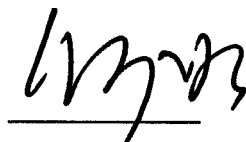

薛兰婷

保荐代表人：


杨鑫强


吴卫钢

法定代表人：


何 如



三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

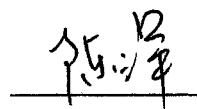


倪俊骥

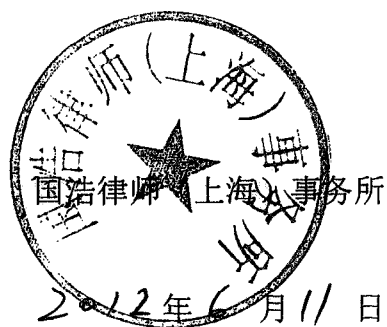
经办律师：



李辰



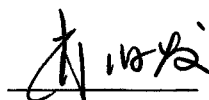
陈洋



四、会计师事务所声明

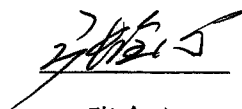
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人（签名）：

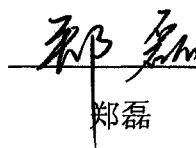


肖厚发

签字注册会计师（签名）：



张全心



郑磊

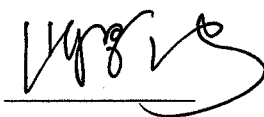
华普天健会计师事务所（北京）有限公司



五、资产评估机构声明

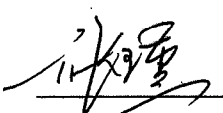
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人（签名）：

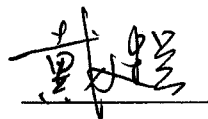


陈景庚

签字资产评估师（签名）：



张瑾



戴建芸


江苏华星会计师事务所有限公司
2012年6月11日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人（签名）：

张雨歌

签字资产评估师（签名）：

姚雪勇

周鸿君



说 明

江苏仁合资产评估有限公司就苏州晶方科技股份有限公司2010年4月增资、整体变更为股份有限公司及2010年5月增资事项，对截至2009年12月31日、2010年4月30日苏州晶方科技股份有限公司的股权价值进行了评估，于2010年4月7日、2010年5月19日、2010年5月25日分别出具苏仁评报字（2010）第57号《资产评估报告》、苏仁评报字（2010）第83号《资产评估报告》、苏仁评报字（2010）第149号《资产评估报告》。报告出具日时，江苏仁合资产评估有限公司具有从事证券期货相关业务的资格，法定代表人为张雨歌，签字注册资产评估师为姚雪勇、周鸿君。

由于目前姚雪勇、周鸿君二人已离职，故苏州晶方科技股份有限公司本次上市申请文件中，资产评估机构声明中未有签字注册资产评估师姚雪勇、周鸿君的签字。

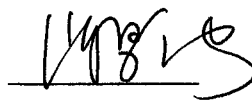
特此说明。



六、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人（签名）：

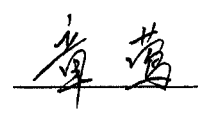


陈景庚

签字注册会计师（签名）：



陈鑫



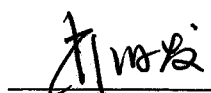
章莺



六、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人（签名）：

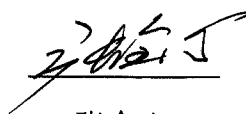


肖厚发

签字注册会计师（签名）：



方长顺



张全心

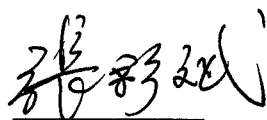
华普天健会计师事务所（北京）有限公司



六、验资机构声明

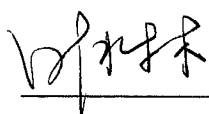
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人（签名）：

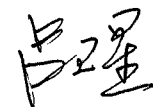


张彩斌

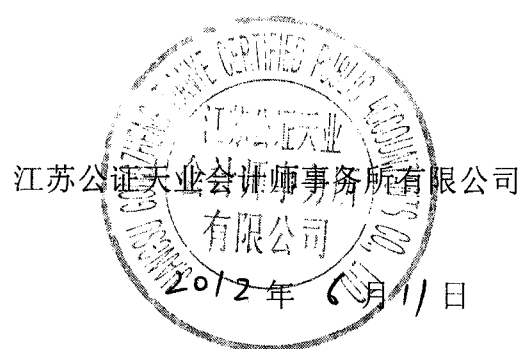
签字注册会计师（签名）：



叶水林



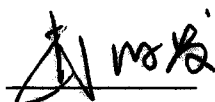
吕卫星



六、验资复核机构声明

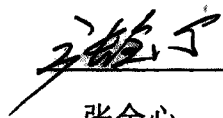
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人（签名）：



肖厚发

签字注册会计师（签名）：



张全心



郑磊

华普天健会计师事务所（北京）有限公司



第十七节 备查文件

一、备查文件内容

- 1、发行保荐书、保荐工作报告
- 2、审计报告及财务报告
- 3、内部控制鉴证报告
- 4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表
- 5、法律意见书及律师工作报告
- 6、公司章程（草案）
- 7、中国证监会核准本次发行的文件
- 8、其他与本次发行有关的重要文件

二、查阅地点和时间

- 1、公司证券部

地址：苏州工业园区汀兰巷 29 号

电话：0512-67730001

联系人：段佳国

查阅时间：星期一至星期五 上午 8:00—12:00 下午 2:00—6:00

- 2、国信证券股份有限公司

地址：上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层

电话：021-68864534

传真：021-68865179

联系人：徐伟、刘凌云、薛兰婷、葛体武、唐昕

查阅时间：星期一至星期五 上午 9:00—11:30 下午 1:00—5:00